木林森股份有限公司

（住所：中山市小榄镇木林森大道 1 号）

首次公开发行股票

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

中国平安
PING AN

平安证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼）

木林森股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型：	普通股（A 股）
每股面值：	1.00 元
发行股数：	4,385.25 万股，占发行后总股本的比例为 25.06%
发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期：	【　　】年【　】月【　】日
拟申请上市证券交易所：	深圳证券交易所
发行后总股本：	17,500 万股
保荐人（主承销商）：	平安证券有限责任公司
签署日期：	【　　】年【　】月【　】日

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、控股股东孙清焕承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

2、法人股东榄芯实业承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

3、其他法人股东小榄城建、深圳宝和林、深圳诠晶、天津安兴、平安财智承诺：自获得公司股份的工商变更登记手续完成之日（即 2010 年 9 月 26 日）

起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林文彩、郑明波、易亚男、李冠群、刘天明、赖爱梅、周立宏承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本次发行前公司总股本 13,114.75 万股，本次拟发行 4,385.25 万股流通股，发行后总股本为 17,500 万股，均为流通股。

二、发行前股东自愿锁定股份的承诺

1、控股股东孙清焕承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

2、法人股东榄芯实业承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

3、其他法人股东小榄城建、深圳宝和林、深圳诠晶、天津安兴、平安财智承诺：自获得公司股份的工商变更登记手续完成之日（即 2010 年 9 月 26 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林文彩、郑明波、易亚男、李冠群、刘天明、赖爱梅、周立宏承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

三、发行前公司滚存未分配利润的安排

根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议，本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：

1、行业竞争加剧的风险

受国家政策扶持的影响，整个 LED 行业呈现快速发展态势，吸引了社会大量资本，不断出现新的厂商加入该行业。另外，随着世界范围内 LED 封装及应用产业向以中国为主的亚洲地区转移，国际知名 LED 厂商纷纷在我国建立生产基地，可能导致产品价格的下降、提高市场份额的难度增大，因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产工艺水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

2、产能不足的风险

报告期内，公司主要产品 Lamp LED 的产能利用率分别达到 81%、95%和 93%，生产设备全年基本接近满负荷生产状态，尤其在每年的生产高峰期，尽管公司近年来也陆续采购了新的生产设备，但仍然面临产能瓶颈的束缚。随着市场需求进一步扩大，受产能不足的影响，公司可能将无法完全满足部分客户对产品交货期和采购量的要求，公司将不得不放弃该部分客户订单，从而影响公司的快速增长。因此，公司面临着产能不足的风险。

3、主要原材料芯片依赖进口及供应商相对集中的风险

本公司在主要原材料芯片的采购上，以进口台湾芯片为主。目前，公司与晶元光电、光磊科技建立了较为稳定的长期合作关系，主要系晶元光电、光磊科技等公司实力雄厚，技术领先，能按公司订单规格要求规模生产、及时交货，且芯片质量较高，保证了公司正常生产经营之需要。2008 年、2009 年及 2010 年，公司通过晶元光电、光磊科技采购的芯片总额 1,624.93 万元、4,666.65 万元和 12,800.79 万元，公司与晶元光电、光磊科技合作以来，关系稳固、相互依赖，为公司对芯片的需求提供了充足的货源保证。

近几年，随着国内芯片生产厂商逐步增加，产量也获得大幅度提升，公司也加大国产芯片的采购力度，减少对进口台湾芯片的依赖。目前，公司已与国内芯片厂商建立采购芯片合作关系。尽管如此，公司仍面临供应商原材料采购相对较集中的风险，若因国内外芯片市场发生不利变化，导致供应商生产经营发生重大不利变化，可能给公司正常生产及经营业绩带来不利影响。

4、存货较大及发生跌价损失的风险

公司存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。由于公司产品覆盖面广，目前的产品包括 Lamp LED、Display、SMD LED 及 LED 应用产品（包括显示屏、室内外照明灯及灯饰），不同产品的规格、型号也较多，多系列产品导致公司备货金额相对较高；同时，为了保证原材料的稳定供应，降低市场经营风险，公司也需储备原材料以备生产经营使用，因此，公司存货金额较高。报告期末，存货净额分别为 11,857.49 万元、12,495.62 万元和 15,257.95 万元，若原材料市场、产品销售市场发生异常变化，可能导致一定的跌价风险，将给公司经营业绩带来较大影响。

目　录

第一节　释义 11

第二节　概览 16

一、发行人概况 16
二、核心竞争优势 16
三、控股股东及实际控制人 18
四、主要财务数据 18
五、本次发行情况及发行前后的股本结构 20
六、募集资金的运用 21

第三节　本次发行概况 22

一、本次发行基本情况 22
二、本次发行的有关机构 23
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 24
四、发行日程安排 24

第四节　风险因素 25

一、行业竞争加剧的风险 25
二、产能不足的风险 25
三、主要原材料芯片依赖进口及供应商相对集中的风险 25
四、存货较大及发生跌价损失的风险 26
五、营业收入季节性波动的影响 26
六、公司快速发展导致的管理风险 27
七、募集资金投资项目市场拓展的风险 27
八、人才缺失的风险 28
九、实际控制人对公司控制的风险 28
十、新增固定资产折旧费、无形资产摊销费影响未来经营业绩的风险 28
十一、净资产收益率大幅下降的风险 29

第五节　发行人基本情况 30

一、公司基本情况 30
二、历史沿革及改制重组情况 30
三、发行人设立以来资产重组情况 33
四、发行人设立以来股本结构的形成及其变化情况 38
五、历次验资情况 47
六、发行人的股权结构图及组织机构图 47
七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 56
八、发行人股本情况 59
九、公司员工及社会保障情况 61
十、本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况 62

第六节　业务和技术 63

一、主营业务及主要产品.....63
二、行业监管、主要法律法规及政策.....66
三、发行人所处行业基本情况.....68
四、本公司所处行业地位及竞争情况.....78
五、本公司主要业务.....83
六、环境保护情况.....101
七、与公司业务相关的主要资产.....104
八、主要技术情况.....112
九、质量控制情况.....120
第七节　同业竞争和关联交易.....123
一、同业竞争.....123
二、关联方和关联关系.....123
三、经常性关联交易.....127
四、偶发性关联交易.....132
五、关联方往来款情况.....135
六、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响.....136
七、本公司采取的减少和规范关联交易的措施.....136
八、发行人关联交易决策程序.....137
九、报告期内关联交易执行情况及独立董事的意见.....139
第八节　董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....140
一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历.....140
二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股及对外投资情况.....143
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬及兼职情况.....144
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的关系.....145
五、董事、监事和高级管理人员的任职资格.....145
六、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及与发行人签订的协议及其履行情况.....145
七、董事、监事和高级管理人员最近三年变动情况.....145
第九节　公司治理结构.....147
一、公司法人制度建立健全情况.....147
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法运作情况.....147
三、本公司接受监管与检查的情况.....149
四、本公司主要股东占用公司资金及本公司对主要股东担保情况.....149
五、管理层对本公司内部控制的说明以及会计师对本公司内部控制的鉴证报告.....149
第十节　财务会计信息.....151
一、公司最近三年的财务报表.....151
二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化.....158
三、主要会计政策和会计估计.....159
四、发行人适用的税率.....174
五、经会计师核验的非经常性损益明细表.....175
六、最近一期末主要资产.....176
七、最近一期末主要债项.....177
八、所有者权益变动情况.....178

九、现金流量情况.....179
十、期后事项、或有事项及其他重要事项.....179
十一、主要财务指标.....179
十二、历次评估验资情况.....181
第十一节　管理层讨论与分析.....182
一、财务状况分析.....182
二、盈利能力分析.....198
三、现金流量分析.....224
四、资本性支出分析.....225
五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....226
第十二节　业务发展目标.....228
一、未来三年发展目标.....228
二、具体业务实施计划.....228
三、制定以上规划的依据.....230
四、实施上述计划所面临的困难及后续措施.....230
五、业务发展计划与现有业务的关系.....231
六、本次募集资金对公司业务发展目标的作用.....231
第十三节　募集资金运用.....232
一、本次发行募集资金运用计划.....232
二、募集资金投资项目与公司发展战略之间的关系.....232
三、募集资金投资项目市场前景及必要性分析.....234
四、募集资金投资项目新增产能适应了公司发展的需要.....242
五、募集资金投资项目固定资产投资变化对经营成果的影响.....244
六、募集资金投资项目简介.....246
七、募集资金运用对发行人未来财务状况及经营成果的影响.....263
第十四节　股利分配政策.....264
一、基本政策.....264
二、近三年股利分配情况.....264
三、本次发行完成前滚存利润的分配政策.....264
四、本次发行上市后的现金分红政策.....265
第十五节　其他重要事项.....266
一、信息披露制度与投资者服务.....266
二、重要合同.....266
三、对外担保情况.....272
四、诉讼及仲裁事项.....272
第十六节　董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....273
第十七节　备查文件.....280
一、本招股说明书的备查文件.....280
二、查阅地点.....280
三、查阅时间.....280
四、查阅网址.....280

第一节　释义

一般术语		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发起人	指	本公司设立时的发起人，即孙清焕、中山市榄芯实业投资有限公司、赖爱梅、易亚男、林文彩
发行人、本公司、公司、股份公司、木林森	指	木林森股份有限公司
中山木林森	指	中山市木林森电子有限公司，本公司前身
木林森有限	指	木林森电子有限公司，本公司前身
小榄城建	指	中山市小榄镇城建资产经营有限公司
天津安兴	指	天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）
平安财智	指	平安财智投资管理有限公司
深圳宝和林	指	深圳市宝和林光电股份有限公司
深圳诠晶	指	深圳诠晶光电有限公司
榄芯实业	指	中山市榄芯实业投资有限公司
吉安木林森	指	吉安市木林森电子科技有限公司
格林曼	指	中山市格林曼光电科技有限公司
迪博	指	中山市迪博照明有限公司
安格森	指	上海安格森光电科技有限公司
威莱森	指	中山市威莱森贸易有限公司
赛维视觉	指	（香港）木林森赛维视觉有限公司
台州元泽	指	台州市元泽电子科技有限公司
鄞州振杰	指	宁波市鄞州振杰电子科技有限公司
森安	指	中山市森安照明工程有限公司
昌浩	指	中山市昌浩电子有限公司
心一	指	中山市心一电子有限公司

中山宏森	指	中山市宏森光电有限公司
宁波木林森	指	宁波木林森电子科技有限公司
香港木林森	指	M.L.S.Electronics Co
润森	指	中山市润森电子有限公司
翔光	指	中山市翔光电子有限公司
林森	指	深圳市林森电子有限公司
汇森	指	东莞市汇森电子有限公司
安林	指	佛山市南海安林电子有限公司
倍森	指	中山市倍森电子科技有限公司
永林	指	东莞市永林电子有限公司
怡德精密	指	中山市怡德精密塑胶制品有限公司
吉源	指	中山市吉源电子有限公司
日月明	指	深圳市日月明光电科技有限公司
广州木林森	指	广州木林森光电有限公司
海盛	指	中山市海盛电子有限公司
光磊	指	中山市光磊科技电子有限公司
纬源	指	中山市纬源光电有限公司
森森	指	中山市森森电子有限公司
汇海	指	中山市汇海照明科技有限公司
森益隆	指	中山市森益隆电子有限公司
美明	指	中山市美明电子有限公司
厦门木林森	指	厦门木林森电子有限公司
源森	指	中山市源森电子有限公司
森隆	指	东莞市森隆电子有限公司
永光	指	东莞市永光电子有限公司
晶元光电	指	（台湾）晶元光电股份有限公司
晶元宝晨	指	晶元宝晨光电（深圳）有限公司
光磊科技	指	（台湾）光磊科技股份有限公司

南昌宏森	指	南昌宏森光电科技有限公司
亿光	指	（台湾）亿光电子工业股份有限公司
ASM Pacific Technolegy Ltd	指	ASM 太平洋科技有限公司，成立于 1975 年，是全球最大的半导体及发光二极管行业的集成和封装设备供应商
报告期	指	2008 年、2009 年、2010 年
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
华东地区	指	山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、上海
华南地区	指	广东、广西、海南
华中地区	指	湖北、湖南、河南
华北地区	指	北京、天津、河北、山西、内蒙古
西北地区	指	宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃
西南地区	指	四川、贵州、云南、重庆、西藏
东北地区	指	辽宁、吉林、黑龙江
保荐人、主承销商、平安证券	指	平安证券有限责任公司
利安达	指	利安达会计师事务所有限责任公司
中伦、发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
拓墣产业研究所	指	台湾民间的高科技产业研究企业，由一群资深产业研究人员及专业而年轻化的经营团队组成，提供深度且全方位的产业资讯
专业术语		
LED	指	LED 英文全称“Light Emitting Diode”，中文名为发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件
LED 封装	指	将 LED 发光管芯固定于 PCB 或支架完成电气连接，并采用环氧或硅胶包封固化过程，以保护管芯正常工作
Lamp LED	指	直插式发光二极管
SMD LED	指	表面贴装式发光二极管

Top View LED	指	顶部发光二极管
Display LED	指	数码发光二极管
Power LED	指	功率型发光二极管，指使用电流在 100mA 以上的 LED
lm/w	指	流明每瓦，发光效率单位，是衡量光源转换效率的一个指标
外延片	指	在一块加热至适当温度的衬底基片（主要有蓝宝石和 SiC，Si）上，将气态物质 In,Ga,Al,P 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜
背光源	指	背光源（BackLight）是位于液晶显示器（LCD）背后的一种光源，液晶显示器本身并不发光，它的发光效果将直接影响到液晶显示模块（LCM）视觉效果。它显示图形或字符是它对光线调制的结果
固晶	指	使用粘合剂把 LED 管芯固定在 PCB 或支架上的一个工序
焊线	指	即为芯片打线，是芯片生产工艺中一种打线的方式，一般用于封装前将芯片内部电路用金属线与封装管脚连接的一个工序
封胶	指	把已经完成焊线工艺的半成品用环氧树脂或硅胶将管芯和邦定线包裹的一个工序
环氧树脂	指	分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物
硅胶	指	硅胶（Silicon dioxide）别名：硅橡胶，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，固化后，其化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物

		理结构，决定了它具有许多其他同类材料难以取代的特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等
IQC	指	英文全称为“Incoming Quality Control”，意思为来料质量控制
RoHS 指令	指	英文全称为“The Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electnical and Electronic Equipment”，即在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令
高压 AC LED	指	在 50V 以上 380V 以下的交流电中能长时间正常工作的发光二极管
UL 认证	指	UL（Underwriter Laboratories Inc.，美国安全检测实验室公司）采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料，同时开展实情调研业务
CE 认证	指	欧盟成员国执行的一种产品安全认证标志，凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通
CCC 认证	指	英文全称 China Compulsory Certification，中国强制性产品认证制度。指为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度

注：本《招股说明书》除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节　概览

发行人声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。

所有投资均涉及风险，有关投资本公司本次发行股份的主要风险载于本招股说明书第四节“风险因素”部分，投资者作出投资决策前应仔细阅读该节。

一、发行人概况

公司名称：　木林森股份有限公司

法定代表人：　孙清焕

成立日期：　1997 年 3 月 3 日

注册资本：　13,114.75 万元

住　　所：　中山市小榄镇木林森大道 1 号

公司一直专注于 LED 封装及应用系列产品的研发、生产与销售业务，是国内 LED 封装及应用产品的主要供应商，产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。

公司为国家高新技术企业，先后获得“广东省制造业百强企业”、“ 中山市民营科技企业”、“ 中山市装备制造业重点企业”等称号，先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。公司产品被评为“广东省名牌产品”，木林森品牌被评为“最受欢迎品牌”。

二、核心竞争优势

本公司的竞争优势主要体现在规模化生产、丰富的产品系列、技术研发、制造工艺及稳定的客户资源等方面。

1、规模化生产优势

经过多年发展，截止 2010 年末，公司已拥有年产 96 亿只 Lamp LED 封装器件的生产能力，拥有 218 台全自动化固晶机、258 台全自动焊线机、261 台全自动分光机、80 台全自动荧光粉机等生产设备，公司在扩大 LED 封装系列产品市场份额同时，逐步向 LED 应用产业链延伸。首先，规模化生产带动公司对

芯片实行规模化采购，能够从供应商处获得较低的芯片价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片采购成本，公司与台湾的芯片厂商晶元光电及光磊科技保持了多年的良好合作关系；其次，公司生产设备目前均已大规模实现全自动化生产，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用，降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；再次，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场影响力，从而促进行业协调发展。

2、产品系列丰富，LED 下游应用市场广阔

公司一直专注于 LED 封装及应用产品的研发、设计及生产，是国内较早生产 LED 封装及应用产品的供应商。公司目前产品包括 Lamp LED、SMD LED 、Display 和 LED 应用产品（包括显示屏、室内外照明灯及灯饰），产品系列丰富、型号多样、种类齐全，能满足客户对产品标准化和个性化的不同需求。

LED 下游应用市场广阔，公司 LED 封装产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域，公司下游应用客户群遍布于不同 LED 应用子行业。

产品系列丰富有助于公司能满足不同层次客户对产品的需求，与客户达成合作，提高市场占有率，同时减少市场开拓的重复投入，促进营销资源的有效整合，实现产品市场的交叉拓展，提升公司的市场地位。

3、技术研发优势带动生产工艺的创新

公司自成立以来，一直重视产品研发和技术创新，在 LED 封装及应用领域已取得一系列技术成果，具备解决 LED 封装及应用产品一整套方案的能力。公司先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。

公司在技术研发优势方面还体现在生产工艺流程的创新，在传统 LED 封装工艺的基础上，公司对产品的机器设备、原材料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名 LED 封装设备供应商 ASM 定制全自动固晶机、焊线机及封胶机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了 LED 封装产品的阻燃性能与抗紫外线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国 UL 行业协会认证资

质的企业，提升了公司产品的国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度降低产品的成本。

公司已经建立了运作高效、工艺领先的全自动化生产线，有效提高了设备利用率，实现公司生产资源的有效整合和利用。

三、控股股东及实际控制人

孙清焕直接持有本公司 88.92%的股权，通过榄芯实业间接持有本公司0.51%的股权，合计持有 89.43%的股权，系本公司控股股东及实际控制人。

孙清焕，中国国籍，无境外居留权。1997 年筹建中山木林森，一直担任公司执行董事、总经理等职。2010 年 7 月起任本公司第一届董事会董事长、总经理。孙清焕还兼任中山市石岐商会第四届理事会副会长，中山市个体劳动者协会、中山市私营企业协会石岐分会第四届理事会副会长，中山市照明电器行业协会常务副会长，中山市半导体照明产业技术联盟第一届理事会常务副理事长，中山市半导体照明行业协会副会长等职。

四、主要财务数据

经利安达审计，本公司报告期合并财务报表主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

科目名称	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产	42,757.39	24,014.04	23,531.09
固定资产	43,522.05	13,669.46	13,066.84
无形资产	6,267.54	2,705.65	127.63
资产合计	95,019.98	42,391.08	37,079.48
流动负债	43,452.11	22,293.16	21,378.80
非流动负债	9,498.80	18.32	-
负债总计	52,950.91	22,311.48	21,378.80

少数股东权益	1,217.87	898.00	807.28
所有者权益	42,069.08	20,079.60	15,700.68

（二）合并利润表主要数据

单位：万元、元/股

科目名称	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	81,476.63	45,640.52	38,539.09
营业利润	13,107.69	4,440.86	1,479.73
利润总额	12,899.12	4,919.64	1,914.62
净利润	10,397.19	4,210.68	1,603.85
归属母公司股东的净利润	10,193.70	4,175.42	1,705.47
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	10,397.25	3,747.41	1,380.79

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

科目名称	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生现金流量净额	16,647.40	5,700.97	4,608.16
投资活动产生现金流量净额	-38,167.70	-7,317.67	-6,411.73
筹资活动产生现金流量净额	31,517.46	980.29	2,802.80
现金及现金等价物净增加额	9,984.63	-644.94	999.78

（四）主要财务指标

财务指标	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动比率	0.98	1.08	1.10
速动比率	0.63	0.52	0.55
资产负债率（母公司）	53.39%	47.62%	52.83%
每股净资产（元）	3.11	1.60	1.24
财务指标	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**

存货周转率（次）	4.06	2.80	2.77
应收账款周转率（次）	8.86	6.69	7.13
息税折旧摊销前利润（万元）	16,314.83	6,896.27	3,401.66
利息保障倍数（倍）	16.81	17.53	7.44
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润）	0.85	0.31	0.12
每股经营性现金流（元）	1.27	0.48	0.38
加权平均净资产收益率（归属于母公司普通股股东的净利润）	37.99%	24.59%	12.23%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润）	38.92%	22.38%	10.14%

五、本次发行情况及发行前后的股本结构

股票种类：　人民币普通股（A 股）；

股票面值：　人民币 1.00 元；

发行股数：　4,385.25 万股，占发行后总股本为 25.06%；

发行价格：　通过向询价对象询价确定；

发行方式：　网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合；

发行对象：　符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

公司本次拟发行人民币普通股 4,385.25 万股，发行前后股本结构如下：

项目	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
有限售条件股份	孙清焕	11,661.00	88.92%	11,661.00	66.63%
	小榄城建	491.80	3.75%	491.80	2.81%
	天津安兴	262.29	2.00%	262.29	1.50%
	榄芯实业	240.00	1.83%	240.00	1.37%

	平安财智	131.15	1.00%	131.15	0.75%
	深圳宝和林	120.22	0.92%	120.22	0.69%
	深圳诠晶	109.29	0.83%	109.29	0.62%
	赖爱梅	36.00	0.27%	36.00	0.21%
	易亚男	36.00	0.27%	36.00	0.21%
	林文彩	27.00	0.21%	27.00	0.15%
	合计	13,114.75	100%	13,114.75	74.94%
本次发行股份				4,385.25	25.06%
总计				17,500	100%

六、募集资金的运用

本次发行成功后，所募集资金将用于下列项目的投资建设：

单位：万元

序号	投资项目	总投资额	募集资金使用量	建设期	项目备案
1	Lamp LED产品技术改造项目	26,981.92	22,229.67	12 月	10200039711001865
2	SMD LED 产品技术改造项目	14,677.13	13,249.28	12 月	10200039711001867
3	LED 应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目	5,435.92	4,188.28	12 月	10200039721001866
4	LED 产品研发中心技术改造项目	3,144.79	2,964.59	12 月	10200039721001864
5	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-

各募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书第十三节“募集资金运用”部分。上述项目资金的使用，按照轻重缓急的顺序安排。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹方式解决。

第三节　本次发行概况

一、本次发行基本情况

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行股数：4,385.25 万股，占发行后总股本的 25.06%

4、每股发行价格：通过询价确定发行价格

5、发行后每股收益（按本公司 2010 年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）：【 】元

6、发行市盈率（按发行后每股收益计算）：【 】倍

7、本次发行前每股净资产：3.11 元（按 2010 年 12 月 31 日经审计财务数据）

8、本次发行后每股净资产（全面摊薄）：【 】元（扣除发行费用）

9、发行市净率（按发行后每股净资产计算）：【 】倍

10、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

11、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

12、承销方式：采用余额包销方式

13、本次发行预计募集资金总额为【 】万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额【 】万元。

14、发行费用概算：

项目	金额
保荐及承销费用	【 】万元
会计师费用	【 】万元
律师费用	【 】万元

15、申请上市证券交易所：深圳证券交易所

二、本次发行的有关机构

1、 发行人：　　木林森股份有限公司

住所：　　中山市小榄镇木林森大道 1 号

法定代表人：　　孙清焕

联系电话：　　0760-87803366

传真：　　0760-87803399

联系人：　　赖爱梅

2、 保荐人（主承销商）：　　平安证券有限责任公司

住所：　　深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

法定代表人：　　杨宇翔

联系电话：　　0755-82404851

传真：　　0755-82434614

保荐代表人：　　丰赋、陈华

项目协办人：　　彭欢

项目组成员：　　何书茂、赵桂荣、张小艳、蔡强

3、 发行人律师：　　北京市中伦律师事务所

负责人：　　张学兵

住所：　　中国北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

电话：　　010-59572288

传真：　　010-59571022

经办律师：　　赖继红、邹晓冬

4、 申报会计师：　　利安达会计师事务所有限责任公司

法定代表人：　　姜波

业务负责人：　　杨敢林

住所：　　北京朝阳区八里庄西里 100 号一号楼东区 20 层 2008 室

电话：　　010-85866870

传真：　　010-85866877

经办注册会计师：　　潘新华、杨敢林

5、 资产评估机构： 广东中广信资产评估有限公司

负责人： 汤锦东

住所： 广州市越秀区东风中路 300 号之一金安商务大厦 17 楼 L、K 位

电话： 020-83637940

传真： 020-83637840

注册资产评估师： 周丽、梁学熙

6、 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所

住所： 深圳市深南东路 5045 号

联系电话： 0755-82083333

传真： 0755-82083164

7、 收款银行：

户名：

账号：

三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况

保荐人的子公司平安财智持有发行人 131.15 万股，占发行前总股本的 1.00%。除此之外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、发行日程安排

询价推介时间： 【】年【】月【】日－【】月【】日

定价公告刊登时间： 【】年【】月【】日

申购和缴款时间： 【】年【】月【】日

预计股票上市日期： 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

第四节　风险因素

投资者在评价发行人此次公开发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、行业竞争加剧的风险

受国家政策扶持的影响，整个 LED 行业呈现快速发展的态势，吸引了社会大量资本，不断出现新的厂商加入该行业。另外，随着世界范围内 LED 封装及应用产业向以中国为主的亚洲地区转移，国际知名 LED 厂商纷纷在我国建立生产基地，可能导致产品价格的下降、提高市场份额的难度增大，因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产工艺水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。

二、产能不足的风险

报告期内，公司主要产品 Lamp LED 的产能利用率分别达到 81%、95%和 93%，生产设备全年基本接近满负荷生产状态，尤其在每年的生产高峰期，尽管公司近年来也陆续采购了新的生产设备，但仍然面临产能瓶颈的束缚。随着市场需求进一步扩大，受产能不足的影响，公司可能将无法完全满足部分客户对产品交货期和采购量的要求，公司将不得不放弃该部分客户订单，从而影响公司的快速增长。因此，公司面临着产能不足的风险。

三、主要原材料芯片依赖进口及供应商相对集中的风险

本公司在主要原材料芯片的采购上，以进口台湾芯片为主。目前，公司与晶元光电、光磊科技建立了较为稳定的长期合作关系，主要系晶元光电、光磊科技等公司实力雄厚，技术领先，能按公司订单规格要求规模生产、及时交货，且芯片质量较高，保证了公司正常生产经营之需要。2008 年、2009 年及 2010 年，公司通过晶元光电、光磊科技采购的芯片总额 1,624.93 万元、4,666.65 万元和

12,800.79 万元，公司与晶元光电、光磊科技合作以来，关系稳固、相互依赖，为公司对芯片的需求提供了充足的货源保证。

近几年，随着国内芯片生产厂商逐步增加，产量也获得大幅度提升，公司也加大国产芯片的采购力度，减少对进口台湾芯片的依赖。目前，公司已与国内芯片厂商建立采购芯片合作关系。尽管如此，公司仍面临供应商原材料采购相对较集中的风险，若因国内外芯片市场发生不利变化，导致供应商生产经营发生重大不利变化，可能给公司正常生产及经营业绩带来不利影响。

四、存货较大及发生跌价损失的风险

公司存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。由于公司产品覆盖面广，目前的产品包括 Lamp LED、Display、SMD LED 及 LED 应用产品（包括显示屏、室内外照明灯及灯饰），不同产品的规格、型号也较多，多系列产品导致公司备货金额相对较高；同时，为了保证原材料的稳定供应，降低市场经营风险，公司也需储备原材料以备生产经营使用，因此，公司存货金额较高。报告期末，存货净额分别为 11,857.49 万元、12,495.62 万元和 15,257.95 万元，若原材料市场、产品销售市场发生异常变化，可能导致一定的跌价风险，将给公司经营业绩带来较大影响。

五、主要原材料芯片价格波动的风险

本公司生产所需主要原材料为芯片，公司通过向芯片供应商实施规模化采购、提高芯片利用率、拓宽芯片采购渠道等方式降低芯片采购成本，避免芯片采购价格波动对公司生产经营造成不利影响。随着全球芯片生产技术的不断成熟、市场供应量增加，公司芯片平均采购单价也呈逐年下降的态势。但是，由于近年来国内 LED 封装厂商不断增加，市场对芯片的需求量逐渐增大，若未来芯片市场供应不足，芯片的采购价格可能会因市场供求关系影响而出现较大波动，从而对公司经营业绩造成不利影响。

六、营业收入季节性波动的影响

LED 应用产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明及平板显示等领域，国外普及率相对较高。而 LED 应用产品销售旺季一般在国外法定节假日期

间，如圣诞节、元旦节等。受此影响，下游 LED 应用制造商（如圣诞节日灯饰等）会在每年的 2 季度及 3 季度提前向 LED 封装器件供应商下发较多订单，近三年公司第 3 季度收入为全年最高，占全年销售收入的比重一般在 30%-40%之间。每年 12 月到次年 1、2 月，公司逐步进入生产经营的淡季，在每年 1 季度销售收入相对较低，2 季度则逐步回升。收入季节性波动的特征会对公司财务状况的持续稳定产生一定不利影响。

七、下游产品价格较高，存在一定的市场推广难度风险

LED 光源相对于传统光源具有无可比拟的优越性（节能、环保、使用寿命长、色泽丰富等），近年来在国家政策的大力扶持下获得较快发展，生产技术亦不断成熟。从 LED 整个产业链来看，国内芯片产能不断提高，市场供应充足，价格逐年下降，使得 LED 下游封装及应用产品成本也呈下降的态势，LED 应用产品普及率逐步提高，应用领域日益广泛。但是，相对于传统照明产品，下游 LED 应用产品市场售价仍较昂贵，这可能导致下游 LED 应用行业尤其是 LED 照明领域的市场开发具有一定难度。虽然公司产品 Lamp LED（主要用于灯饰）具有较大成本优势，若下游应用产品整体市场开发迟缓，公司生产经营将受到不利影响。

八、公司快速发展导致的管理风险

2008年、2009年及2010年，公司营业收入为38,539.09万元、45,640.52万元和81,476.63万元，报告期内经营业绩整体呈快速增长态势。随着募集资金到位、投资项目的陆续开展，现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能无法适应公司的快速发展。虽然本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并在过去管理经验积累的基础上，制订了一系列的规章制度，在实际执行中运作良好。但公司仍将面临一定的管理风险。

九、募集资金投资项目市场拓展的风险

公司本次募集资金使用将导致产品产能增加幅度较大。其中，Lamp LED 技术改造项目将新增产能 623,000.00 万只/年，SMD LED 技术改造项目将新增产能 238,000.00 万只/年，LED 应用技术改造项目中的显示屏、室内外照明灯及灯饰

新增产能分别为 8,500.00 平方米/年、269,000 盏/年和 4,000,000 米/年。募集资金投资项目能有效缓解公司产能瓶颈，进一步提升公司盈利水平，但同时也对公司的市场拓展提出了较高要求。

尽管本公司已对募集资金拟投资项目市场前景进行了充分的调研和论证，并在生产、销售以及产品品质保障等方面制定了完善可行的实施计划，能在较大程度上保证产品的市场销售，但如果未来市场竞争环境发生重大变化，可能导致募集资金拟投资项目投产后产能无法消化而达不到预期效益的风险。

十、人才缺失的风险

本公司在长期的业务发展中培养并造就了一批高素质的技术及管理人员，然而国内 LED 行业由于发展较晚，高素质专业技术及管理人才相对较缺乏，特别是在市场竞争加剧的情况下，技术和管理人才的竞争也日趋激烈。虽然公司在稳定发展的过程中，已建立了规范的人力资源管理体系以留住及吸引 LED 行业优秀的技术及管理人才，但随着生产经营规模的进一步扩张，公司对人才的需求也将大幅增长，公司将面临人才缺失的风险。

十一、实际控制人对公司控制的风险

本次发行前，实际控制人孙清焕持有公司 88.92%的股份。若本次发行 4,385.25 万股，孙清焕持股比例下降为 66.63%，仍处于绝对控股地位。实际控制人可能通过其对公司的绝对控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配政策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司重大决策事项。若公司内部控制制度不健全、法人治理结构不够完善、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

十二、新增固定资产折旧费、无形资产摊销费影响未来经营业绩的风险

本次募集资金拟投资的项目建成达产后，本公司新增固定资产 35,937.67 万元和无形资产 1,402.67 万元，新增加年折旧摊销费约 3,476.15 万元。以公司 2010 年的营业收入 81,476.63 万元和 30.86%的毛利率计算，只要公司营业收入增长超过 13.83%，即可确保公司营业利润不会因此而下降，而目前公司营业收入保持

着良好的增长态势，2008 年至 2010 年公司营业收入年复合增长率达到 45.40%，未来增长超过 13.83%具有可行性。

若公司成功发行股票并上市，将进一步提高公司经营管理水平和市场竞争能力，提升公司的品牌形象，有助于公司继续保持较高的增长速度。因此，本次募集资金投资项目建成后，公司仍会保持较佳的盈利水平，使公司利润不因固定资产折旧的增加而下降。但是，如果市场经营环境发生重大变化，募集资金投资项目预期收益不能实现，则公司存在因为固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。

十三、净资产收益率大幅下降的风险

2010 年，本公司实现净利润 10,397.19 万元，加权平均净资产收益率为 37.99%。本次发行成功后，公司净资产将大幅增加，而公司发行当年实现的净利润难以保持同比例增长，因此，公司净资产收益率将大幅下降。同时，募集资金投资项目可能因市场经营环境发生重大变化或因行业竞争加剧以及公司市场开拓不足等因素导致难以实现预期收益，因此，在募集资金投资项目建成后一段期间内，公司净资产收益率可能难以达到较高水平。

第五节　发行人基本情况

一、公司基本情况

1、公司名称：　　木林森股份有限公司

英文名称：　　MLS CO.,LTD.

2、法定代表人：　　孙清焕

3、成立日期：　　1997年3月3日

4、变更设立日期：　　2010年8月6日

5、注册资本：　　13,114.75万元

6、注册地址：　　中山市小榄镇木林森大道1号

7、邮政编码：　　528400

8、联系电话：　　0760-87803366

9、传真：　　0760-87803399

10、互联网网址：　　www.zsmls.com

11、电子信箱：　　ir@zsmls.com

二、历史沿革及改制重组情况

（一）公司设立情况

本公司是由木林森有限整体变更设立的股份有限公司。

2010 年 8 月 6 日，本公司在中山市工商行政管理局办理工商变更登记手续，并领取了注册号为 442000000024530 的《企业法人营业执照》，注册资本、实收资本均为 12,000 万元。公司的经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工。

（二）发起人及主要发起人

本公司的发起人为孙清焕、林文彩、易亚男、赖爱梅及榄芯实业，其中孙清焕为主要发起人。

（三）发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司的主要发起人为孙清焕。在本公司整体变更设立前，孙清焕除拥有本公司股权外，还拥有相关关联公司股权，该等关联公司陆续进入注销程序，详见本节“七、（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业”。

本公司整体变更设立后，孙清焕主要持有本公司股权。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司变更设立时，承继了木林森有限的全部资产和业务，拥有的主要资产是从事 LED 封装及应用系列产品的研发、设计、生产与销售的经营性资产，实际从事的主要业务是 LED 封装及应用系列产品的研发、设计、生产与销售。本公司变更设立前后主营业务及经营模式未发生变化。

（五）改制前后发行人的业务流程及与原企业业务流程间的联系

由于本公司是整体变更设立的股份公司，因此本公司整体上承继了原企业的业务，改制前后本公司的业务流程没有变化。详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、（二）主要产品工艺流程”。

（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人关联关系及演变情况

发行人整体变更设立以来，在生产经营方面与主要发起人不存在关联关系。

（七）发起人出资资产变更手续的办理情况

本公司系经有限公司整体变更设立的股份公司，木林森有限的全部资产、负债和权益由本公司承继，《土地使用权证》、《房屋所有权证》、《专利权证》、《机动车登记证书》等权属证书均已变更到本公司名下。木林森有限持有的注册商标及商标申请权均已向国家商标局提交商标注册人名称变更为本公司的申请。

（八）发行人独立经营情况

本公司拥有独立的产、供、销体系，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东相互独立和分开。

1、业务独立完整

本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

目前本公司从事 LED 封装及应用系列产品的研发、设计、生产与销售，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或者间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

2、资产完整

本公司拥有独立于发起人股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。本公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

本公司设有人力资源部，公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司股东单位兼任除董事、监事以外的任何职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立

本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务分开

本公司设有独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。本公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。本公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。本公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

截止本招股说明书签署日，本公司股东及其他关联方未以任何形式占用本公司的货币资金或其他资产；本公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；本公司独立对外签订各项合同。

三、发行人设立以来资产重组情况

为消除同业竞争和减少关联交易，公司收购了吉安木林森、格林曼、迪博、威莱森、安格森、赛维视觉等公司的股权，使其成为公司控股子公司。

（一）关联公司设立的背景

公司成立早期，由于LED产业发展缓慢，并且公司资金实力较弱、经营规模较小，为大力推动LED封装及应用领域的市场拓展，最大限度的吸引和激励优秀人才加入LED产业，共同推动产业发展，同时保证本公司专注于LED封装产品的研发、设计、生产及销售，公司实际控制人孙清焕通过与其他自然人共同投资设立公司的方式拓展LED业务。通过该种模式，吸引并培养了大批优秀的LED行业人才，也推动了LED产业发展，同时公司亦获得良好的外部产业环境，实现持续、快速、稳定发展。

（二）收购程序及定价

1、收购吉安木林森 55%股权

吉安木林森主要从事 LED 封装产品生产及作为本公司部分产品的委托生产加工基地。具体情况详见本节“六、（四）控股子公司基本情况”。

吉安木林森成立于2003年5月15日，注册资本为1,080万元，其中孙清焕出资712.80万元，出资比例为66%，张建军出资367.20万元，出资比例为34%。

2004年7月7日，吉安木林森股东会通过决议，同意张建军将其持有吉安木林森2%的股权转让给孙清焕，股权转让后，孙清焕出资比例为68%，张建军出资比例为32%。

2008年1月，吉安木林森股东会通过决议，同意孙清焕按照原始出资为作价依据分别将其持有吉安木林森55%的股权按594万元价格转让给中山木林森、13%的股权按140.40万元价格转让给张建军。中山木林森股东会同意按原始出资额594万元收购吉安木林森55%股权。中山木林森与孙清焕签署了《股权转让协议》。

2008年3月24日，吉安木林森完成了有关本次股权转让的工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。

2、收购格林曼 60%股权

格林曼主要从事LED下游应用产品灯饰的生产及销售。具体情况详见本节“六、（四）控股子公司基本情况”。

格林曼成立于2003年12月11日，注册资本为100万元，其中孙清焕出资80万元，出资比例为80%，孔令华出资20万元，出资比例为20%。

2007年11月19日，格林曼股东会通过决议，同意格林曼注册资本增加420万元，其中孙清焕增资232万元，孔令华增资188万元，增资完成后，孙清焕出资312万元，出资比例为60%，孔令华出资208万元，出资比例为40%。

2010年5月，木林森有限股东会通过决议，同意公司收购孙清焕持有格林曼60%股权，收购价格以经利安达审计的格林曼2009年末净资产661.64万元为依据。格林曼股东会通过决议，同意由木林森有限收购孙清焕持有格林曼60%的股权，并增加注册资本480万元，其中木林森有限增资288万元，孔令华增资192万元，增资完成后，木林森有限出资600万元，持股比例为60%，孔令华出资400万元，持股比例为40%。

木林森有限与格林曼的股东孙清焕签订《股权转让协议》，孙清焕将其所持有格林曼60%的股权作价396万元转让给本公司。

2010 年 6 月 1 日，格林曼完成了有关本次股权转让、增资的工商变更登记

手续。本次收购完成后，格林曼成为公司的控股子公司。

3、收购迪博 80%股权

迪博主要从事LED下游应用产品节能灯的生产及销售。具体情况详见本节“六、（四）控股子公司基本情况”。

迪博成立于2009年11月29日，注册资本为100万元，其中孙清焕出资80万元，出资比例为80%，朱三龙出资20万元，出资比例为20%。

2010年5月，迪博股东会和木林森有限股东会分别通过决议，同意由木林森有限收购孙清焕持有迪博80%的股权，收购价格以经利安达审计的迪博2009年末净资产79.05万元为依据。木林森有限与孙清焕签订《股权转让协议书》，孙清焕将其所持有迪博80%的股权作价63万元转让给本公司。

2010 年 5 月 27 日，迪博完成了有关本次股权转让的工商变更登记手续。本次收购完成后，迪博成为公司的控股子公司。

4、收购威莱森 70%股权

威莱森主要从事LED封装产品出口贸易。具体情况详见本节“六、（四）控股子公司基本情况”。

威莱森成立于2007年11月29日，注册资本为100万元，其中孙清焕出资70万元，持股比例为70%，娄平出资30万元，持股比例为30%。

2010年5月，木林森有限股东会和威莱森股东会分别通过决议，同意公司收购孙清焕持有威莱森70%股权，收购价格以经利安达审计的威莱森2009年末净资产67.49万元为依据。木林森有限与孙清焕签订《股权转让协议书》，孙清焕将其所持有的威莱森70%股权作价47万元转让给本公司。

2010 年 5 月 27 日，威莱森完成了有关本次股权转让的工商变更登记手续。本次收购完成后，威莱森成为公司的控股子公司。

5、收购安格森 100%股权

安格森主要从事LED封装产品国内贸易。具体情况详见本节“六、（四）控股子公司基本情况”。

安格森成立于2005年3月8日，注册资本为100万元，其中孙宪军出资51万元，持股比例为51%，石菊芳出资49万元，持股比例为49%。

2006年3月30日，安格森股东会通过决议，同意孙宪军将其持有安格森2%股权转让给孙清焕的配偶罗萍，石菊芳将其持有安格森49%的股权转让给罗萍。

2010 年 4 月，经木林森有限股东会和安格森股东会审议，同意木林森有限收购股东罗萍持有 51%的股权；公司与罗萍签订《股权转让协议书》。本次收购价格以经利安达审计的 2009 年末净资产为依据确定为 36 万元。

2010 年 5 月 10 日，安格森完成了有关本次股权转让的工商变更登记手续。本次收购完成后，安格森成为公司的控股子公司。

2010 年 10 月，公司与安格森另一股东孙宪军签订《股权转让协议书》，孙宪军将其所持有 49%股权作价 34 万元转让给本公司。

2010 年 11 月 24 日，安格森完成了有关本次股权转让的工商变更登记手续。至此，安格森转变为本公司的全资子公司。

6、收购赛维视觉 48%股权

赛维视觉成立于 2008 年 12 月 18 日，注册地为香港，该公司股本为 10 万美元，其中孙清焕出资 4 万美元，持股比例为 40%，GOTTFRIED ANDRZEJ 出资 2 万美元，持股比例为 20%， KASPEROWICZ JACEK MAREK 出资 1.6 万美元，持股比例为 16%，RUSINOWSKI TOMASZ 出资 1.6 万美元，持股比例为 16%，魏玉红出资 0.8 万美元，持股比例为 8%；2009 年 3 月 19 日，GOTTFRIED ANDRZEJ 分别将其持有的赛维视觉 6%股权转让给 KASPEROWICZ JACEK MAREK、6%股权转让给 RUSINOWSKI TOMASZ。2009 年 7 月 8 日，GOTTFRIED ANDRZEJ 将其持有的赛维视觉 8%股权转让给孙清焕。转让完成后，孙清焕持有赛维视觉 48%的股权。

2010 年 5 月 5 日，木林森有限与孙清焕签订《股权转让协议书》，孙清焕将其所持有赛维视觉 48%的股权作价 4.8 万美元转让给本公司，2010 年 5 月 26 日，公司取得投资赛维视觉的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 4400201000131 号）。本次收购完成后，赛维视觉成为公司的控股子公司。

（三）收购关联公司股权对公司的影响

吉安木林森、格林曼、迪博、安格森、威莱森及赛维视觉被收购前均系发行人实际控制人孙清焕控股的公司，且自报告期期初即与发行人受同一实际控制人控制。同时，该等公司主要业务为从事 LED 封装产品生产、销售或者下游 LED 应用产品的拓展。因此，本次资产重组为同一控制下的资产重组。

1、收购关联方规模较小，对公司影响较小

收购前一年度吉安木林森、格林曼、迪博、安格森及威莱森的主要财务数据（未扣除关联交易）及其占发行人相应科目的比例情况如下：

金额单位：万元

项目	2007年12月31日资产总额	2007年营业收入	2007年利润总额
吉安木林森	4,825.55	3,712.83	10.14
占发行人比例	24.19%	17.98%	0.59%
项目	**2009年12月31日资产总额**	**2009年营业收入**	**2009年利润总额**
格林曼	1,740.73	4,482.88	66.09
迪博	116.83	0	-27.93
安格森	747.41	946.67	0
威莱森	1,983.31	9,469.70	38.24
赛维视觉	115.13	0	0
合计	4,703.41	14,899.25	76.40
合计占发行人比例	11.10%	32.64%	1.55%

从上表可知，以上关联公司的资产及利润总额占公司相关科目的比例都较小，由于威莱森主要从事 LED 产品出口贸易，扣除从公司采购产品关联交易外，占公司营业收入比重也较低，对公司影响较小。

2、公司产业链进一步完善、业务规模不断扩大

通过对关联公司格林曼（主营 LED 灯饰）、迪博（主营 LED 节能灯）进行收购，公司逐步向 LED 下游应用行业拓展，产业链得到进一步完善，发挥产业协同效应；对关联公司安格森、威莱森及赛维视觉进行收购，以上公司主要从事 LED 产品国内外贸易，则有利于扩大公司销售体系及业务规模，增强公司盈利

能力，提升公司的市场竞争力。

3、有利于公司规范运作

本次收购前，公司部分产品的对外出口通过威莱森境外销售，同时公司为格林曼及迪博生产下游应用产品提供原材料，吉安木林森为公司部分产品的委托加工基地，因此本公司与上述关联公司之间存在着较多关联交易。本次收购完成后，彻底解决了发行人与上述关联公司的同业竞争及关联交易问题，有利于发挥业务协同优势，有利于发行人股权架构的清晰，便于管理及规范运作，保护全体股东的利益。

本次收购未导致公司主营业务、董事、高级管理人员和实际控制人发生变更，未构成对公司经营模式与持续经营能力的重大改变。

四、发行人设立以来股本结构的形成及其变化情况

（一）1997年3月，公司前身设立

木林森有限前身为中山市木林森电子有限公司，系由孙清焕、中山市华北机电阀门有限公司于 1997 年 3 月共同出资设立，法定代表人为孙清焕，设立时注册资本为 50 万元，其中孙清焕现金出资 35 万元，占股权比例为 70%；中山市华北机电阀门有限公司现金出资 15 万元，占股权比例为 30%。本次出资经中山会计师事务所出具的“中会所验字（1997）085 号”《中山会计师事务所企业法人验资证明书》审核验证。1997 年 3 月 3 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商注册登记手续，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	35.00	70.00%
中山市华北机电阀门有限公司	15.00	30.00%
合计	50.00	100.00%

（二）2000年4月，第一次股权转让

2000 年 1 月 1 日，经中山木林森全体股东一致同意，中山市华北机电阀门有限公司将所持中山木林森 20%的股权以原始出资作价 10 万元转让给孙清焕，将所持中山木林森 10%的股权以原始出资作价 5 万元转让给岑妙芳。2000 年 4

月 4 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	45.00	90.00%
岑妙芳	5.00	10.00%
合计	50.00	100.00%

本次股权转让原因系中山市华北机电阀门有限公司因急需资金周转而同意将持有的 30%股权分别转让给孙清焕、岑妙芳。

（三）2001年9月，第二次股权转让

2001 年 8 月 10 日，经中山木林森全体股东一致同意，孙清焕将所持中山木林森 40%的股权以原始出资作价 20 万元转让给郭心元；岑妙芳将所持中山木林森 10%的股权以原始出资作价 5 万元转让给郭心元。2001 年 9 月 3 日，该公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	25.00	50.00%
郭心元	25.00	50.00%
合计	50.00	100.00%

本次股权转让原因系中山木林森设立初期，急需引进人才加快发展步伐，因郭心元具备较为丰富的生产制造企业管理经验，公司引进其为股东合作经营。

（四）2002年10月，第三次股权转让

2002 年 9 月 15 日，经中山木林森全体股东一致同意，郭心元将所持中山木林森 5%的股权以原始出资作价 2.5 万元转让给孙清焕，将所持中山木林森 45%的股权以原始出资作价 22.5 万元转让给林文彩。2002 年 10 月 10 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例

孙清焕	27.50	55.00%
林文彩	22.50	45.00%
合计	50.00	100.00%

（五）2004年6月，第一次增资

2003 年 12 月 10 日，经中山木林森全体股东一致同意，注册资本由 50 万元增加至 1,200 万元，其中孙清焕以实物认缴新增注册资本 1,052.50 万元，岑妙芳以实物认缴新增注册资本 97.50 万元。2004 年 4 月 20 日，中山香山会计师事务所有限公司出具了“（2004）香山评字 9900008 号”《关于孙清焕先生资产评估报告书》，对孙清焕的实物出资进行了评估，其中孙清焕出资的固定资产评估值为 900.22 万元；2004 年 5 月 26 日，中山香山会计师事务所有限公司出具了“（2004）香山评字 9900009 号”《关于孙清焕、岑妙芳资产评估报告书》，对孙清焕和岑妙芳的实物出资进行了评估，其中孙清焕出资的固定资产评估值为 156 万元，岑妙芳女士出资的固定资产评估值为 100 万元。上述孙清焕投入固定资产价值 1,056.22 万元中的 1,052.50 万元转为注册资本，超出部分 3.72 万元转为其他应付款；上述岑妙芳投入固定资产价值 100 万元中的 97.50 万元转为注册资本，超出部分 2.50 万元转为其他应付款。2004 年 6 月 16 日，本次增资经中山香山会计师事务所有限公司出具的“（2004）香山内验字第 7360101 号”《验资报告》审核验证。

2004 年 6 月 29 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，本次增资完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	1,080.00	90.000%
林文彩	22.50	1.875%
岑妙芳	97.50	8.125%
合计	1,200.00	100.000%

（六）2006年4月，第二次增资

2006 年 3 月 22 日，经中山木林森全体股东一致同意，注册资本由 1,200 万

元增加至 1,210 万元，由孙清焕以现金认缴新增注册资本 10 万元。本次增资经中山正泰会计师事务所出具“正泰验字【2006】03040007 号”《验资报告》审核验证。2006 年 4 月 24 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	1.090.00	90.082%
林文彩	22.50	1.860%
岑妙芳	97.50	8.058%
合计	1,210.00	100.000%

（七）2006年12月，第三次增资、第四次股权转让

根据中山同力会计师事务所有限公司出具的同力报字[2006]283 号《审计报告》，截止 2006 年 11 月 15 日，公司“其他应付款”科目中孙清焕债权余额 6,129.15 万元，为货币资金投入。

2006 年 11 月 20 日，经中山木林森全体股东一致同意，注册资本由 1,210 万元增加至 7,000 万元，由股东孙清焕以因业务发展需要形成对本公司的货币债权投入 5,790 万元，岑妙芳将所持中山木林森 8.058%的股权以原始出资作价 97.50 万元转让给孙清焕。本次增资经中山同力会计师事务所出具“同力验字（2006）164 号”《验资报告》审核验证。2006 年 12 月 20 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，本次增资及股权转让完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	6,977.50	99.68%
林文彩	22.50	0.32%
合计	7,000.00	100.00%

第三、四次股权转让原因系 2002 年至 2006 年，国内 LED 封装市场较低迷，LED 厂商大部分为半自动半手工化甚至是纯手工化生产程度，产品品质较低、质量不稳定、不良品率较高、销售毛利率相对较低，导致国内 LED 封装厂商利润水平较低，盈利前景不明朗。在对 LED 封装行业及公司发展前景缺乏信心时，

股东郭心元、岑妙芳相继退出公司，收回对公司的原始出资，用于改善自身的生活及发展事业。

（八）2007年8月，第四次增资

2007 年 8 月 16 日，经中山木林森全体股东一致同意，注册资本由 7,000 万元增加至 8,000 万元。由孙清焕以现金认缴新增注册资本 1,000 万元。本次增资经中山同力会计师事务所有限公司出具“同力验字【2007】120 号”《验资报告》审核验证。2007 年 8 月 22 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	7,977.50	99.72%
林文彩	22.50	0.28%
合计	8,000.00	100.00%

（九）2007年11月，第五次增资

2007 年 11 月 16 日，经中山木林森全体股东一致同意，注册资本由 8,000 万元增加至 9,000 万元，由孙清焕以现金认缴新增注册资本 1,000 万元。本次增资经中山同力会计师事务所有限公司出具“同力验字【2007】137 号”《验资报告》审核验证。2007 年 11 月 26 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	8,977.50	99.75%
林文彩	22.50	0.25%
合计	9,000.00	100.00%

（十）2008年1月，第六次增资

2008 年 1 月 8 日，经中山木林森全体股东一致同意，注册资本由 9,000 万元增加至 10,000 万元，由孙清焕以现金认缴新增注册资本 1,000 万元。本次增资经中山同力会计师事务所有限公司出具“同力验字【2008】005 号”《验资报告》审核验证。2008 年 1 月 21 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登

记手续。本次增资完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	9,977.50	99.775%
林文彩	22.50	0.225%
合计	10,000.00	100.000%

（十一）2008年6月，公司名称变更

2008 年 6 月 9 日，经中山木林森全体股东一致同意，公司名称由“中山市木林森电子有限公司”变更为“木林森电子有限公司”。2008 年 6 月 12 日，木林森有限在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

（十二）2010年6月，第五次股权转让

2010 年 6 月 8 日，经木林森全体股东一致同意，孙清焕将所持木林森有限 0.30%的股权作价 63.30 万元转让给赖爱梅，将所持木林森有限 0.30%的股权作价 63.30 万元转让给易亚男，将所持木林森有限 2%的股权作价 422 万元转让给榄芯实业。以上股权转让作价以公司 2010 年 5 月末每股账面净资产（未经审计）为依据。

2010 年 6 月 23 日，该公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，中山木林森股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例
孙清焕	9,717.50	97.175%
榄芯实业	200.00	2.000%
赖爱梅	30.00	0.300%
易亚男	30.00	0.300%
林文彩	22.50	0.225%
合计	10,000.00	100.000%

本次股权转让原因系木林森有限对管理层和骨干员工进行股权激励，孙清焕将持有的部分股权转让给易亚男、赖爱梅和骨干员工持股的榄芯实业。

（十三）2010年8月，整体变更为股份公司

2010 年 7 月 25 日，经木林森有限临时股东会决议，木林森有限整体变更为股份有限公司。根据利安达审字【2010】第 1303 号审计报告，木林森有限以其 2010 年 6 月 30 日经审计的账面净资产 236,109,294.32 元，按 1:0.5082 的比例折为 12,000 万股，原木林森有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。利安达出具利安达验字[2010]第 1052 号《验资报告》对本次整体变更的净资产折股进行验证。

2010 年 8 月 6 日，公司在中山市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 442000000024530 的企业法人营业执照，注册资本为 12,000 万元，公司名称变更为木林森股份有限公司。

整体变更为股份公司时，本公司的股权结构及股东持股情况如下表：

股　东	持股数（万股）	持股比例
孙清焕	11,661.00	97.175%
榄芯实业	240.00	2.000%
赖爱梅	36.00	0.300%
易亚男	36.00	0.300%
林文彩	27.00	0.225%
合计	12,000.00	100.000%

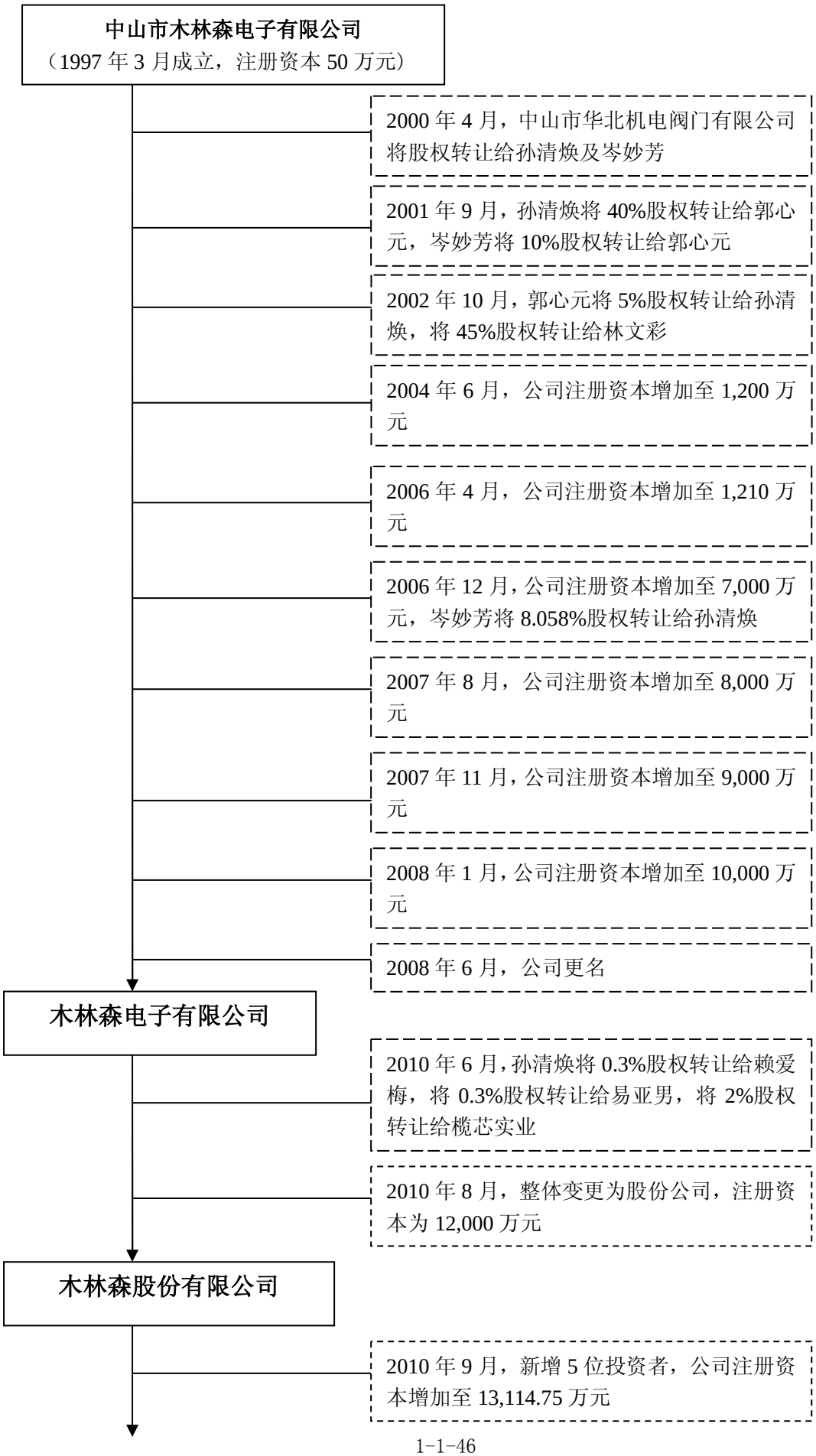
（十四）2010年9月，第七次增资

2010 年 9 月 9 日，经本公司全体股东一致同意，注册资本由 12,000 万元增加至 13,114.75 万元。其中，小榄城建以现金认缴新增注册资本 491.80 万元、天津安兴以现金认缴新增注册资本 262.29 万元、平安财智以现金认缴新增注册资本 131.15 万元、深圳宝和林以现金认缴新增注册资本 120.22 万元、深圳诠晶以现金认缴新增注册资本 109.29 万元。本次新增股东增资作价均为每股 9.15 元，利安达出具利安达验字[2010]第 1064 号《验资报告》对本次增资进行验证。2010 年 9 月 26 日，公司在中山市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，本公司股权结构如下：

股　东	持股数（万股）	持股比例

孙清焕	11,661.00	88.92%
小榄城建	491.80	3.75%
天津安兴	262.29	2.00%
榄芯实业	240.00	1.83%
平安财智	131.15	1.00%
深圳宝和林	120.22	0.92%
深圳诠晶	109.29	0.83%
赖爱梅	36.00	0.27%
易亚男	36.00	0.27%
林文彩	27.00	0.21%
合计	13,114.75	100.00%

本公司股权历次变动情况如下图所示：

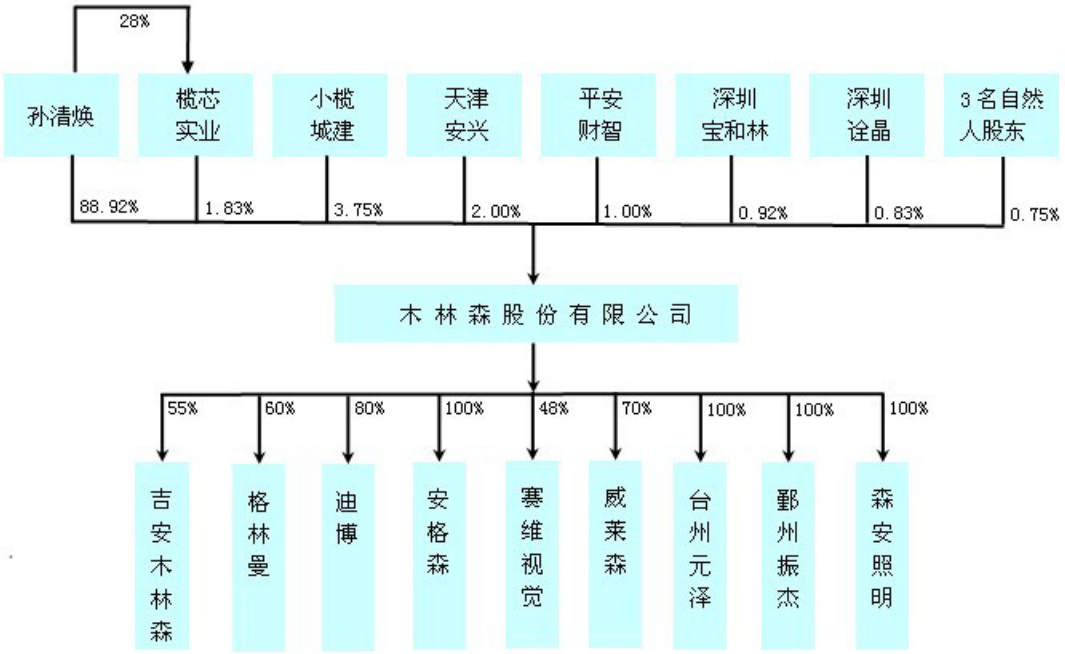

中山市木林森电子有限公司
（1997 年 3 月成立，注册资本 50 万元）
2000 年 4 月，中山市华北机电阀门有限公司将股权转让给孙清焕及岑妙芳
2001 年 9 月，孙清焕将 40%股权转让给郭心元，岑妙芳将 10%股权转让给郭心元
2002 年 10 月，郭心元将 5%股权转让给孙清焕，将 45%股权转让给林文彩
2004 年 6 月，公司注册资本增加至 1,200 万元
2006 年 4 月，公司注册资本增加至 1,210 万元
2006 年 12 月，公司注册资本增加至 7,000 万元，岑妙芳将 8.058%股权转让给孙清焕
2007 年 8 月，公司注册资本增加至 8,000 万元
2007 年 11 月，公司注册资本增加至 9,000 万元
2008 年 1 月，公司注册资本增加至 10,000 万元
2008 年 6 月，公司更名
木林森电子有限公司
2010 年 6 月，孙清焕将 0.3%股权转让给赖爱梅，将 0.3%股权转让给易亚男，将 2%股权转让给榄芯实业
2010 年 8 月，整体变更为股份公司，注册资本为 12,000 万元
木林森股份有限公司
2010 年 9 月，新增 5 位投资者，公司注册资本增加至 13,114.75 万元

五、历次验资情况

序号	事项	注册（实收）资本	出资方式	出资情况	验资报告
1	设立出资	50 万元	现金	已缴足	中山会计师事务所出具的“中会所验字（1997）085 号”《法人验资证明书》
2	增资	1,200 万元	实物资产	已缴足	中山香山会计师事务所有限公司出具的“（2004）香山内验字第 7360101 号”《验资报告》
3	增资	1,210 万元	现金	已缴足	中山正泰会计师事务所出具的“正泰验字【2006】03040007 号”《验资报告》
4	增资	7,000 万元	债权出资	已缴足	中山同力会计师事务所出具的“同力验字（2006）164 号”《验资报告》
5	增资	8,000 万元	现金	已缴足	中山同力会计师事务所有限公司出具的“同力验字【2007】120 号”《验资报告》
6	增资	9,000 万元	现金	已缴足	中山同力会计师事务所有限公司出具的“同力验字【2007】137 号”《验资报告》
7	增资	10,000 万元	现金	已缴足	中山同力会计师事务所有限公司出具的“同力验字【2008】005 号”《验资报告》
8	整体变更	12,000 万元	净资产折股	已缴足	利安达出具的“利安达验字[2010]第 1052 号”《验资报告》
9	增资	13,114.75	现金	已缴足	利安达出具的“利安达验字[2010]第 1064 号”《验资报告》

六、发行人的股权结构图及组织机构图

（一）发行人的股权结构图



1、榄芯实业

榄芯实业的具体情况请见本节“七、（一）发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人”。

2、小榄城建

小榄城建成立于1999年3月29日，现持有中山市工商行政管理局核发的4420001009162号《企业法人营业执照》，住所为中山市小榄镇升平中路10号15楼，法定代表人为唐燕梅，注册资本为2,000万元，公司类型为有限责任公司，主要从事投资、企业管理咨询业务，其股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例
1	中山市小榄镇城镇建设发展总公司	1,800.00	90.00%
2	中山市雄业贸易公司	200.00	10.00%
合计		2,000.00	100.00%

中山市雄业贸易公司为中山市小榄镇城镇建设发展总公司下属的集体企业，中山市小榄镇城镇建设发展总公司为中山市小榄镇资产经营公司下属的集体企业，中山市小榄镇资产经营公司为中山市小榄镇下属的集体企业。

截至2010年12月31日，小榄城建总资产为14,881.72万元，净资产为5,061.45万元，2010年度净利润为109.11万元。（上述数据未经审计）

3、天津安兴

天津安兴成立于 2010 年 7 月 30 日，现持有天津市工商行政管理局天津港保税区分局核发的注册号为 120192000066608 的《合伙企业营业执照》，主要经营场所为天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202－B029，执行事务合伙人为上海金韩投资管理有限公司（委派代表：刘建光），企业类型为有限合伙企业，主要从事对未上市企业的投资业务。天津安兴共有 27 名合伙人，其中普通合伙人即执行事务合伙人为上海金韩投资管理有限公司（委派代表：刘建光），其余为有限合伙人，各合伙人认缴出资的情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海金韩投资管理有限公司	500.00	3.27%
2	周新元	500.00	3.27%
3	曾顺自	500.00	3.27%
4	谢伟	500.00	3.27%
5	刘克勤	500.00	3.27%
6	李苗颜	500.00	3.27%
7	何泽坚	500.00	3.27%
8	李启信	500.00	3.27%
9	海景投资集团有限公司	500.00	3.27%
10	广州市宏源实业有限公司	500.00	3.27%
11	李月萍	900.00	5.88%
12	王丁	500.00	3.27%
13	肖雨星	500.00	3.27%
14	赵国有	500.00	3.27%
15	闵颉	600.00	3.92%
16	郑志群	1000.00	6.54%
17	侯志新	1000.00	6.54%
18	周建清	500.00	3.27%
19	林淑英	500.00	3.27%
20	周幼英	600.00	3.92%
21	林晖	500.00	3.27%
22	柏杨	500.00	3.27%
23	尚予心	500.00	3.27%

24	王健光	900.00	5.88%
25	蒋海平	500.00	3.27%
26	姚央毛	200.00	1.31%
27	傅榕	600.00	3.92%
合计		15,300.00	100.00%

上海金韩投资管理有限公司的股东为刘建光、王健光，持股比例分别为 95%、5%。

截至 2010 年 12 月 31 日，天津安兴总资产为 15,071.57 万元，净资产为 15,063.92 万元，2010 年度净利润为-236.08 万元。（上述数据未经审计）

4、平安财智

平安财智成立于 2008 年 9 月 26 日，现持有深圳市工商行政管理局核发的 440301103642591 号《企业法人营业执照》，住所为深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层 F 区，法定代表人为薛荣年，注册资本为 60,000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），主要从事股权投资业务，该公司由平安证券全额出资设立。

截至 2010 年 12 月 31 日，平安财智总资产为 62,050.79 万元，净资产为 61,777.84 万元，2010 年度净利润为 711.91 万元。（上述数据未经审计）

5、深圳宝和林

深圳宝和林成立于 1999 年 9 月 13 日，现持有深圳市工商行政管理局核发的 440301102779412 号《企业法人营业执照》，住所为深圳市福田区深南大道阳光高尔夫大厦 24 楼 2412、2413、2415 房，法定代表人为常宝，注册资本为 2,000 万元，公司类型为股份有限公司，主要从事电子元器件、光电器件及其生产设备和原材料的购销业务，其股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	常宝	1,840.00	92.00%
2	常伟明	100.00	5.00%
3	李军	60.00	3.00%
合计		2,000.00	100.00%

截至 2010 年 12 月 31 日，深圳宝和林总资产为 4,829.72 万元，净资产为

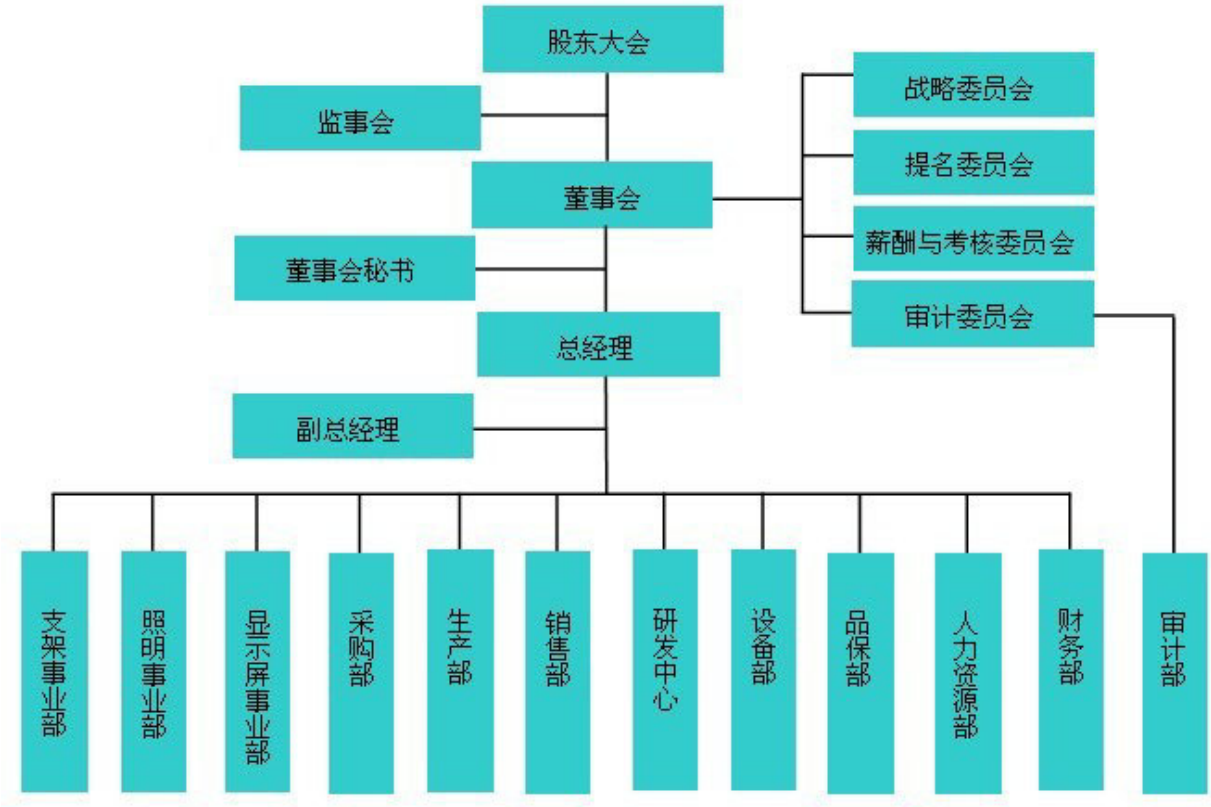
4,253.65 万元，2010 年度净利润为 264.92 万元。（上述数据未经审计）

6、深圳诠晶

深圳诠晶成立于 2007 年 8 月 10 日，现持有深圳市工商行政管理局核发的 440301503230205 号《企业法人营业执照》，住所为深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦 1006，法定代表人为陈仲铭，注册资本为 7 万美元，公司类型为有限责任公司（台港澳自然人独资），主要从事太阳能电池、电子产品、光电子元器件的批发、进出口及其配套业务，该公司由陈仲铭全额出资设立。

截至 2010 年 12 月 31 日，深圳诠晶总资产为 6,853.69 万元，净资产为 141.95 万元，2010 年度净利润为 72.34 万元。（上述数据未经审计）

（二）发行人的组织机构图



（三）发行人内部主要职能部门情况

公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各职能部门的主要职能是：

支架事业部：主要负责制定公司 LED 封装产品支架的生产计划并付诸实施，对各种生产信息进行收集、整理、分析与反馈，并配合研发中心完成相关研发工

作。

照明事业部：主要负责制定公司 LED 照明应用产品的生产计划并付诸实施，对各种生产信息进行收集、整理、分析与反馈，并配合研发中心完成相关研发工作。

显示屏事业部：主要负责制定公司 LED 显示屏的生产计划并付诸实施，对各种生产信息进行收集、整理、分析与反馈，配合研发中心完成相关研发工作。

生产部：主要负责制定公司各类 LED 封装产品的生产计划并付诸实施，对各种生产信息进行收集、整理、分析与反馈，配合研发中心完成相关研发工作。

采购部：根据公司的整体发展策略及各产品事业部的具体采购需求，确定货源寻找条件，寻找合适供应商，负责制订采购计划，并定期组织对供应商进行评审；根据公司的生产销售能力确定库存周转目标，杜绝浪费；准时为生产部门提供物料。

销售部：主要负责制定公司各类产品的销售政策、产品发展策略、销售策略制定等工作，并负责实施；不断拓展公司业务的销售渠道，挖掘客户需求，开发客户资源，建立完善的客户关系体系，完成全年销售任务；及时准确地向相关部门提供有效的客户信息、产品需求和市场信息；客户关系的维护和客户投诉的处理。

研发中心：组织实施新技术及新产品的具体研发工作；对新产品进行验证测试，进行跟踪、及时改进；组织制定新产品的技术规范及产品工艺方案；负责产品及技术的知识产权管理；负责公司产品技术认证、生产测试规范等制定和管理工作；负责公司产品的注册及维护，产品计量等涉及产品市场化的规范工作；负责对外技术交流及公司科技项目的政府申报工作。

设备部：根据设备使用情况制定维修及换季保养计划，保障生产设备的正常运作；负责维修成本控制，积极开展技术革新和技术改造；负责生产所需的气、水、电和办公所需的水电供应保障、维修维护工作。

品保部：负责制订出厂产品、工序产品、原辅材料、设备、器具企业标准（技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存）及工艺操作规程、作业指导书等技术、文件并监督执行；建立、运行、维护、改善质量管理体系；制订生产

消耗、质量奖罚标准，并按月统计报财务执行；及时处理生产中出现的质量、工艺技术问题和不断改进工艺、提升质量；把关检验成品、原辅材料，监督抽查工序产品、设备、器具。

人力资源部：根据公司战略发展方针，进行人力资源规划、开发、储备和管理；负责人员的招聘、入职、升迁、调动、离职、考勤、奖惩、档案管理等各项常规人事管理工作；建设企业文化，营造和谐的组织气氛，形成具有本公司特色的核心价值观；进行人力资源任职体系建设，提高员工职业化水平；统筹各项后勤管理事务。

财务部：严格执行财务管理制度，加强财务监督。负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理确保资产的安全性与收益性；建立和完善会计核算体系，为公司的经营管理提供准确的决策建议；合理筹措、调配资金确保公司资金正常运转；计划、核算和控制成本，促进公司的成本控制目标的达成及利润的最大化；编制公司的年度、月度预算，定期对执行情况进行检查分析；负责配合会计师事务所及有关中介机构对公司的财务管理体系实施审计。

审计部：主要负责公司内审工作计划的制定和实施。

（四）控股子公司基本情况

1、吉安木林森

吉安木林森成立于 2003 年 5 月 15 日，法定代表人为张建军，注册地址为国家井冈山经济技术开发区（江西吉安），注册资本及实收资本均为 1,080 万元，本公司出资比例为 55%，张建军出资比例为 45%，经营范围为开发、生产、销售光电器件、组件及其它电子产品。该公司主要从事 LED 封装产品生产及本公司部分产品委托生产加工基地。

经利安达审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,688.76 万元，净资产为 1,172.28 万元，2009 年净利润为 31.36 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,156.67 万元，净资产为 1,290.62 万元，2010 年净利润为 118.34 万元。

2、格林曼

格林曼成立于 2003 年 12 月 11 日，法定代表人为孔令华，注册地址为中山

市西区沙朗名流路，注册资本及实收资本均为 1,000 万元，本公司出资比例为 60%，孔令华出资比例为 40%，经营范围为生产、加工、销售：光电器件、灯饰产品、照明产品、发光二极管产品、电子产品、电子元器件、灯串；照明工程设计与安装；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。该公司主要作为本公司 LED 下游应用行业灯饰产品的研发及生产平台。

经利安达审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,740.73 万元，净资产为 661.64 万元，2009 年净利润为 43.32 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,138.35 万元，净资产为 1,377.68 万元，2010 年净利润为 236.04 万元。

3、迪博

迪博成立于 2009 年 10 月 19 日，法定代表人为朱三龙，注册地址为中山市石岐区海景路 15 号三层，注册资本及实收资本均为 100 万元，本公司出资比例为 80%，朱三龙出资比例为 20%，经营范围为货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；设计、生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰；承接：城市及道路照明工程，铝合金、不锈钢安装工程，室内外装饰工程，园林绿化工程。该公司主要作为本公司 LED 下游应用行业节能灯产品的研发及生产平台。

经利安达审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 116.83 万元，净资产为 79.05 万元，2009 年净利润为-20.95 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,089.94 万元，净资产为 299.29 万元，2010 年净利润为 220.24 万元。

4、安格森

安格森成立于 2005 年 3 月 8 日，为本公司全资子公司，法定代表人为孙宪军，注册地址为上海市金山区石化地区松南支路 48 号-569 座，注册资本及实收资本均为 100 万元，经营范围为从事光电领域内技术服务，景观工程，电子产品及元器件，灯具，照明设备，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），工艺礼品销售（企业经营涉及行政许可的，凭

许可证件经营）。该公司主要从事 LED 封装产品贸易，作为本公司在华东地区的销售业务拓展载体。

经利安达审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 747.41 万元，净资产为 69.99 万元，2009 年净利润为-0.01 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,015.08 万元，净资产为 140.39 万元，2010 年净利润为 70.40 万元。

5、威莱森

威莱森成立于 2007 年 11 月 29 日，法定代表人为娄平，注册地址为中山市火炬开发区濠头村峰景花园第 42 卡 B，注册资本及实收资本均为 100 万元，本公司出资比例为 70%，娄平出资比例为 30%，经营范围为货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：电子产品及配件、灯饰、卫浴产品、家用电器、鞋类。该公司主要从事 LED 封装产品出口贸易，拓展本公司海外销售渠道。

经利安达审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,983.31 万元，净资产为 67.49 万元，2009 年净利润为 26.73 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 911.48 万元，净资产为 54.03 万元，2010 年净利润为-13.45 万元。

6、赛维视觉

赛维视觉成立于 2008 年 12 月 18 日，注册资本为 10 万美元，注册地址为 FLAT/RM 1704, HANG LUNG CENTRE, PARERSON STREET, CAUSEWAY BAY, HK，该公司主要从事代理贸易本公司 LED 封装产品，获得其他外资股东海外客户资源，扩大公司在海外市场中品牌知名度。

该公司股权结构如下：

股东名称	出资额（美元）	出资比例
木林森	48,000	48.00%
KASPEROWICZ JACEK MAREK	22,000	22.00%
RUSINOWSKI TOMASZ	22,000	22.00%
魏玉红	8,000	8.00%
合计	100,000	100.00%

经利安达审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 115.13 万元，净资产为 68.25 万元，2009 年净利润为 0 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 104.03 万元，净资产为 19.19 万元，2010 年净利润为-49.07 万元。

7、台州元泽

台州元泽成立于 2011 年 2 月 21 日，为本公司全资子公司，法定代表人为孙宪军，注册地址为台州市东海大道 88 号 1 幢，注册资本和实收资本为 50 万元，经营范围为电子产品、发光二极管及灯饰、液晶显示屏研发、制造、销售，园林绿化工程，货物和技术的进出口（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。该公司主要从事 LED 封装产品贸易，拓展本公司在浙江地区销售渠道。

8、鄞州振杰

鄞州振杰成立于 2011 年 3 月 23 日，为本公司全资子公司，法定代表人为张国启，注册地址为宁波市鄞州区集士港镇丰成村，注册资本和实收资本为 50 万元，经营范围为电子产品、发光二极管及灯饰、液晶显示屏的研发、制造、销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；园林绿化工程的设计和施工（上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。该公司主要从事 LED 封装产品贸易，拓展本公司在宁波地区销售渠道。

9、森安

森安成立于 2011 年 5 月 17 日，为本公司全资子公司，法定代表人为申雨晨，注册地址为中山市小榄镇木林森大道 1 号办公楼二层 201 室，注册资本和实收资本为 500 万元，经营范围为技术及货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；研发、设计、销售液晶显示器、显示屏、电子产品、LED 发光系列产品、灯饰、照明产品；销售五金材料，承接铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工城市及道路照明工程、城市绿化工程。该公司主要作为本公司 LED 下游应用行业亮化工程的销售平台。

七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人

情况

（一）发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人

发起人	孙清焕、榄芯实业、易亚男、赖爱梅及林文彩
持有公司 5%以上股份的主要股东	孙清焕
控股股东	孙清焕
实际控制人	孙清焕

孙清焕

孙清焕，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 36222219730508****，住所为广东省中山市石岐区上海城****，现任发行人董事长、总经理。

榄芯实业

榄芯实业成立于 2010 年 6 月 18 日，法定代表人为孙清焕，注册地为中山市小榄镇升平中路 10 号 8 楼 811 室，注册资本及实收资本均为 500 万元，经营范围为投资兴办实业、投资管理咨询。

该公司股权结构如下：

股　东	出资额（万元）	出资比例	在本公司任职
孙清焕	140.00	28.00%	董事长、总经理
周立宏	75.00	15.00%	副总经理、支架事业部总经理
郑明波	75.00	15.00%	副总经理
陈玉梅	75.00	15.00%	销售部副经理
刘天明	45.00	9.00%	监事、研发中心经理
李冠群	45.00	9.00%	监事会主席、人力资源部经理
罗燕	45.00	9.00%	华东区业务总监
合计	500.00	100.00%	

截至 2010 年 12 月 31 日该公司总资产为 498.96 万元、净资产为 498.96 万元，2010 年净利润为-1.04 万元。（上述数据未经审计）

易亚男

易亚男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 36243019680617****，

住所为广东省中山市港口镇丽江花园****，现任发行人董事、副总经理、财务总监。

赖爱梅

赖爱梅，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 36242819690710****，住所为广东省中山市西区翠景花园****，现任发行人副总经理、董事会秘书。

林文彩

林文彩，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号 35052519700314****，住所为广东省中山市石岐区第一城****，现任发行人董事。

（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业

除本公司外，本公司控股股东、实际控制人孙清焕控制的其他企业情况如下：

1、昌浩

中山市昌浩电子有限公司成立于 2006 年 4 月 24 日，法定代表人为何清，注册地址为中山市石岐区海景路 11 号二层之一，注册资本为 50 万元，孙清焕出资比例为 70%，何清出资比例为 30%，主要从事 LED 封装及应用产品的生产与销售。

该公司已于 2011 年 1 月完成工商注销。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 895.10 万元，净资产为 131.56 万元，2009 年净利润为 2.17 万元。（上述数据未经审计）

2、森森

中山市森森电子科技有限公司成立于 2009 年 10 月 21 日，法定代表人为宁超华，注册地址为中山市石岐区海景路 11 号四层之一，注册资本为 500 万元，孙清焕出资比例为 60%，宁超华出资比例为 40%，主要从事 LED 应用产品的开发、生产及销售。

该公司已于 2011 年 3 月完成工商注销。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 532.38 万元，净资产为 500 万元，2009 年净利润为 0 万元。（上述数据未经审计）

3、森益隆

中山市森益隆电子科技有限公司成立于 2009 年 10 月 19 日，法定代表人为袁宏，注册地址为中山市石岐区海景路 11 号三层之一，注册资本为 100 万元，孙清焕出资比例为 80%，袁宏出资比例为 20%，主要从事 LED 应用产品的开发、生产及销售。

该公司已于 2011 年 3 月完成工商注销。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 278.96 万元，净资产为 100 万元，2009 年净利润为 0 万元。（上述数据未经审计）

4、中山宏森

中山市宏森光电有限公司成立于 2007 年 9 月 18 日，法定代表人为周立宏，注册地址为中山市石岐区海景路 11 号底层 B 座，注册资本为 500 万元，孙清焕出资比例为 51%，周立宏出资比例为 49%，主要从事电子元件的生产与销售。

该公司已于 2011 年 1 月完成工商注销。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 707.51 万元，净资产为 496.76 万元，2009 年净利润为 3.21 万元。（上述数据未经审计）

5、汇海

中山市汇海照明科技有限公司成立于 2009 年 5 月 8 日，法定代表人为李小忠，注册地址为中山市古镇曹三创业园华泰东路北 1 号二层，注册资本为 50 万元，孙清焕出资比例为 51%，李小忠出资比例为 49%，主要从事 LED 应用产品的研发、生产及销售。

该公司已于 2011 年 5 月完成工商注销。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 54.38 万元，净资产为 50.81 万元，2009 年净利润为 0.81 万元。（上述数据未经审计）

（三）控股股东和实际控制人持有的发行人股份被质押或者其他争议情况

本公司控股股东、实际控制人孙清焕直接持有本公司股份 11,661.00 万股，占公司总股本的 88.92%，该部分股份不存在质押或者其他有争议的情况。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本公司本次发行前总股本 13,114.75 万股，本次发行 4,385.25 万股，发行后总股本为 17,500 万股，本次发行的股份占发行后总股本的 25.06%。

项目	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
有限售条件股份	孙清焕	11,661.00	88.92%	11,661.00	66.63%
	小榄城建	491.80	3.75%	491.80	2.81%
	天津安兴	262.29	2.00%	262.29	1.50%
	榄芯实业	240.00	1.83%	240.00	1.37%
	平安财智	131.15	1.00%	131.15	0.75%
	深圳宝和林	120.22	0.92%	120.22	0.69%
	深圳诠晶	109.29	0.83%	109.29	0.62%
	易亚男	36.00	0.27%	36.00	0.21%
	赖爱梅	36.00	0.27%	36.00	0.21%
	林文彩	27.00	0.21%	27.00	0.15%
本次发行股份		-	-	4,385.25	25.06%
总计		13,114.75	100.00%	17,500.00	100.00%

（二）股东、自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东	直接持股数（万股）	直接持股比例	在公司的任职
1	孙清焕	11,661.00	88.92%	董事长、总经理
2	易亚男	36.00	0.27%	董事、副总经理、财务总监
3	赖爱梅	36.00	0.27%	副总经理、董事会秘书

（三）外资股份

本公司股东中不存在外资股东。

（四）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

股东林文彩直接持有公司 0.21%股份，为本公司实际控制人孙清焕之兄；罗燕通过榄芯实业间接持有公司 0.16%股份，为本公司控股股东、实际控制人孙清焕配偶之妹。

（五）本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、控股股东孙清焕承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

2、法人股东榄芯实业承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

3、其他法人股东小榄城建、深圳宝和林、深圳诠晶、天津安兴、平安财智承诺：自获得公司股份的工商变更登记手续完成之日（即 2010 年 9 月 26 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林文彩、郑明波、易亚男、李冠群、刘天明、赖爱梅、周立宏承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。

九、公司员工及社会保障情况

（一）员工人数情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司的在职职工为 2,969 人，构成情况如下：

专业构成	人数	占比	学历构成	人数	占比	年龄构成	人数	占比
销售人员	133	4.48%	本科及以上	89	3.00%	45 岁以上	15	0.51%
研发人员	469	15.80%	大专	941	31.69%	35-45 岁	229	7.71%

财务人员	32	1.08%	中专	1,157	38.97%	25-35 岁	1,051	35.40%
采购人员	16	0.54%	中专以下	782	26.34%	25 岁以下	1,674	56.38%
管理人员	322	10.85%	-			-		
生产人员	1,973	66.45%	-			-		
后勤人员	24	0.80%	-			-		
合计	2,969	100%	合计	2,969	100%	合计	2,969	100%

（二）社会福利和保险情况

本公司按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规、政策及规定要求，统一向所在地劳动和社会保障部门缴纳养老、医疗、失业、工伤等保险费用。

中山市人力资源和社会保障局对公司在社保和劳动法规方面的执行情况出具证明，自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间，没有发现发行人存在违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情况。

十、本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况

（一）避免同业竞争的承诺

请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、（二）本公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。

（二）流通限制和锁定股份的承诺

请参见本节“八、（五）本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

（三）补缴住房公积金的承诺

实际控制人孙清焕承诺：若公司被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此而遭受任何损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下及时、全额承担公司由此遭受的一切损失。

第六节　业务和技术

一、主营业务及主要产品

（一）主营业务及其变化情况

公司一直专注于 LED 封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，是国内 LED 封装及应用产品的主要供应商，产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。

本公司自设立以来，主营业务未发生变更。

（二）主要产品

目前，本公司产品主要有四大类，具体情况如下图所示：

产品种类	小类	外观特性	应用领域
Lamp LED	-	1、体积小，直径 2-12mm； 2、直插环氧封装； 3、防水、防震性较好； 4、外型可变异性较大，分为圆型、方型、三角型。	指示灯、小家电、交通灯、室内照明、LED 显示屏
Display LED（数码管及点阵）	-	1、平面型环氧封装； 2、防水、防震性能较好； 3、外型可变异性较大，可分为方形、圆形等； 4、按性能分为数码管、平面管、点阵、异形特殊管等， 5、按发光亮度可分为普亮、高亮、超高亮等。	数码显示、点阵显示屏，特殊信息显示
LED 应用	显示屏	—	户内外看板、特殊信息显示屏、广告牌
	室内外照明灯	—	日光灯、Par 灯、筒灯、路灯
	灯饰	—	圣诞灯、轮廓灯、护栏管、广告牌
SMD LED	Top LED	1、体积小、耐高温； 2、一般采用硅树脂进行封装； 3、主要用于照明及背光。	柔性灯带、室内照明、电视背光

（三）公司产品最终用途

报告期内，公司产品最终用途如下表所示：

产品种类	产品最终用途		2010 年	2009 年	2008 年
			占比	占比	占比
Lamp LED	灯饰	欧美节日装饰灯	29.29%	29.02%	38.02%
		家居装饰灯	4.63%	3.60%	3.06%
	家电产品指示灯		3.52%	3.89%	0.51%
	户内外显示屏		13.33%	14.09%	8.14%
	室内外照明灯具		4.99%	2.77%	3.33%
	便携式照明		8.01%	11.27%	14.41%
Display LED（数码管及点阵）	家用电器生产	冰箱数码显示	0.01%	0.04%	0.04%
		微波炉数码显示	2.92%	3.24%	2.22%
		电磁炉、电饭煲、抽油烟机数码显示	0.21%	0.13%	0.12%
		电子称数码显示	0.08%	0.13%	0.04%
		卫星接收器（机顶盒）数码显示	0.36%	0.01%	0.01%
	户内显示屏生产		8.68%	5.91%	2.69%
	时钟显示		2.52%	2.47%	3.69%
LED 应用	显示屏	单色	0.62%	2.54%	3.55%
		双色	1.65%	2.49%	3.33%
		全彩	3.96%	3.89%	4.46%

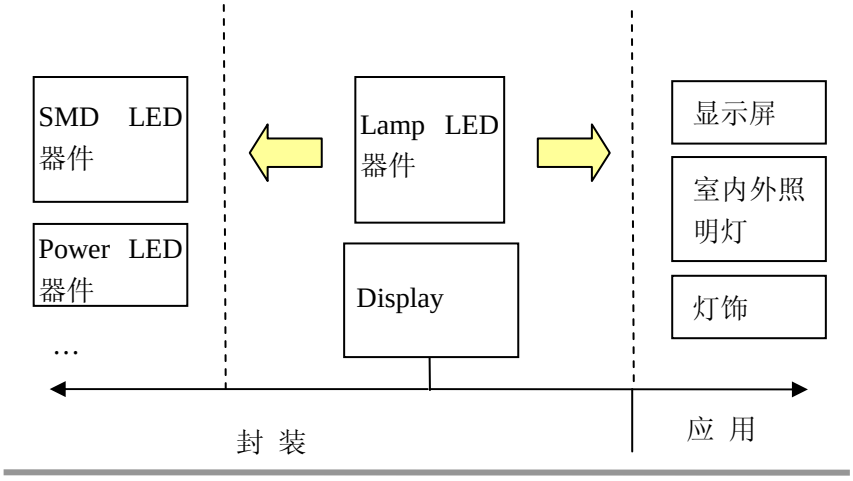
	室内外照明灯	球泡、日光灯、Par灯、筒灯、路灯、射灯等	5.44%	3.12%	-
	灯饰	圣诞灯、轮廓灯、护栏管、彩虹管、广告牌等	6.42%	9.63%	9.64%
SMD LED	显示屏生产	全彩	0.80%	-	-
	室内外照明灯具生产	球泡、日光灯、Par灯、筒灯、路灯、射灯等	0.90%	0.08%	0.01%
	室内外装饰灯生产	柜台照明、吊顶装饰灯等	0.20%	-	-
其他	发射管、光敏管等		1.46%	1.68%	2.73%

（四）公司产品线分布

为适应业务发展的需要，增强公司综合竞争实力，公司依托技术研发实力，在稳固 Lamp LED 市场地位的同时，加大了 SMD LED 的研发投入，并适度向 LED 应用产业链延伸。

公司于 2010 年开始对 SMD LED 器件进行规模化生产，SMD LED 器件产品也将是公司未来利润增长点之一，另外功率型 LED 器件也在小批量试产中。随着公司产品线的不断完善及产业链的适度延伸，公司的核心竞争力将不断强化。

公司产品线分布如下图所示：



二、行业监管、主要法律法规及政策

（一）行业管理体制

公司所处行业为半导体光电器件制造业。目前，半导体光电器件制造业主要由政府部门进行宏观管理，由中国光学光电子行业协会下属光电器件分会进行行业自律管理。

国家工业和信息化部是本行业的主管部门，负责制定指导性产业政策、起草相关法律法规草案，制定规章等，调控行业的发展。

中国光学光电子行业协会光电器件分会主要从事产业研讨及学术交流等工作及自律管理。

政府部门和行业协会对本行业的管理及自律仅限于行业宏观方面，各企业具体业务管理和产品生产经营则完全基于市场化的方式进行。

（二）产业政策及发展规划

公司所属 LED 行业是国家重点扶持的朝阳行业。为支持 LED 产业健康快速发展，以适应经济发展方式转变的需要，近年来国家陆续制定了许多相关产业政策及战略规划。在国家产业政策扶持及企业自身技术不断创新等因素推动下，半导体光电器件制造业正进入快速发展时期。

相关产业政策及发展规划情况如下表所示：

时间	产业政策及发展规划	涉及主要内容
2003 年 6 月	启动半导体照明工程并成立	——中远期培育新兴的大功率白光通用

	国家半导体照明工程协调领导小组	照明产业为目标，从形成一个完整产业链的角度出发，体现政府引导、企业主体、市场化运作的原则，以应用促发展，解决产业化的关键技术和原创性核心技术，形成一批专利、培育一批企业、建设一批基地，形成有自主知识产权的标准体系，最终发展成为具有国际竞争力的中国半导体照明新兴产业
2005 年 12 月	《产业结构调整指导目录（2005 年本）》	——新型电子元器件（片式元器件、光电子元器件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、新型机电元件等）生产被列为鼓励类产业
2006 年 2 月	《国家中长期科学和技术发展规划纲要》	——高效节能、长寿命的半导体照明产品被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能）
2006 年 3 月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》	——把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会
2006 年 7 月	《十一五城市绿色照明工程规划纲要》	——实现单位国内生产总值能源消耗降低 20%的目标，强调要落实节约资源和保护环境的要求，建设低投入、高产出、低能耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会 ——把“绿色照明——在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节能照明系统等”列为十大节能重点工程之一
2007 年 1 月	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》	——半导体照明器件：高亮度外延片、蓝宝石衬底片制造及发光新技术，芯片及半导体发光二极管（LED）检测新技术，大功率LED封装及散热新技术，高效节能、长寿命的半导体照明材料与产品及其制备技术与设备，LED照明标准被列为当前优先发展的高技术产业化重点领域
2008 年 1 月	《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》	——对高效照明中的普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品，半导体(LED)照明产品，以及必要的配套镇流器等产品实行财政补贴
2009 年初	“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案	——在天津、石家庄、上海、深圳、武汉、重庆、西安等 21 个城市开展半导体照明应用工程
2009 年 4 月	《电子信息产业调整和振兴	——围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集

	规划》	成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系 ——实现集成电路、新型显示器件、软件等核心产业关键技术的突破
2009 年 10 月	《半导体照明节能产业发展意见》	——积极推进半导体照明节能产业健康有序发展；继续通过国家973计划、863计划、高技术产业化示范工程等渠道，加大对半导体照明领域的科学研究和技术应用的支持力度；积极实施促进半导体照明节能产业发展的鼓励政策；积极推动半导体照明标准制定、产品检测和节能认证工作 ——到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右，产品市场占有率逐年提高

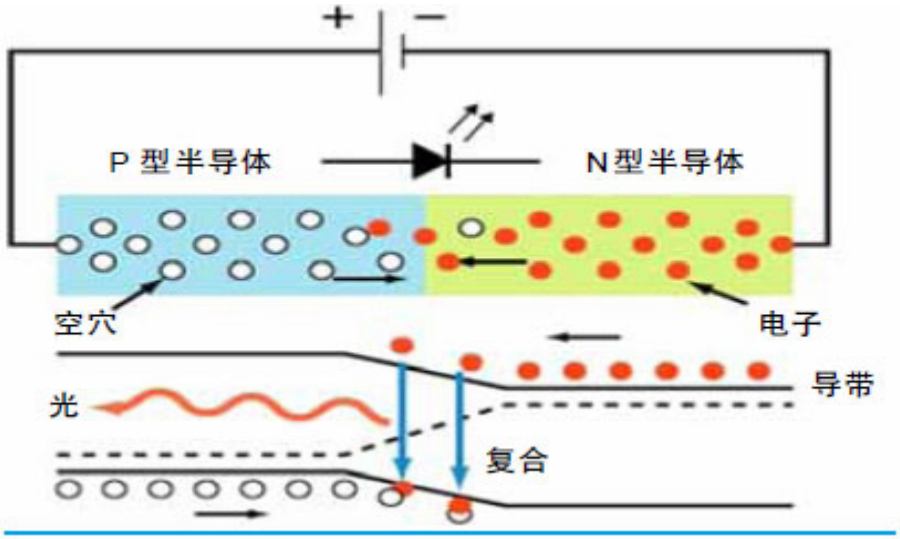
三、发行人所处行业基本情况

（一）LED产业概述

1、LED 发光原理

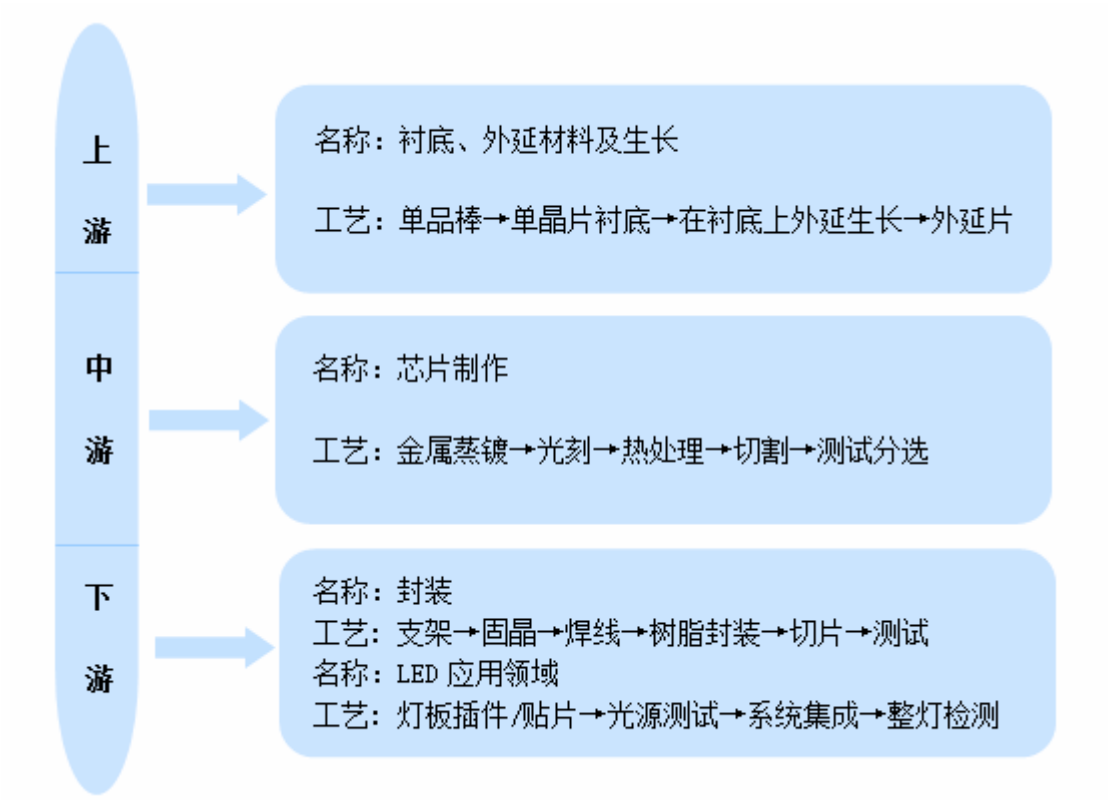
LED 半导体晶片由两部分组成：P 型半导体和 N 型半导体，二者相连接处形成一个“P-N 结”。当电流通过导线作用于晶片时，N 型半导体区域的电子会被推向 P 型半导体区域，与 P 型半导体区域的空穴复合后将电能转化为光能而发光。

LED 发光原理如下图所示：



2、LED 产业链

根据生产流程，将 LED 产业链分为上游外延片生长、中游芯片制造、下游芯片封装及应用。LED 产业链如下图所示：



3、LED 光源将成为未来电光源的主要发展方向

与传统光源相比，LED 光源具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势，成为人类照明史上的一次飞跃，被公认为 21 世纪最具发展前景的电光源。凭借在节能降耗等诸多方面的优异性能，LED 近年来在全球获得迅速发展。

我国在 LED 产业政策上相继启动绿色照明、半导体照明工程，在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863 计划新材料领域中先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目，具备了较好的产业基础，初步形成了完善的产业链。

2009 年 10 月，国家发展和改革委员会、科技部等六部门联合发布《半导体照明节能产业发展意见》，指出：“到 2015 年半导体节能照明产业产值年均增长率在 30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到 20%左右，液晶背光源达到 50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到 70%以上”。

可以预见，LED 光源是未来电光源的主要发展方向。

LED 光源与传统光源相比其优势如下图所示：

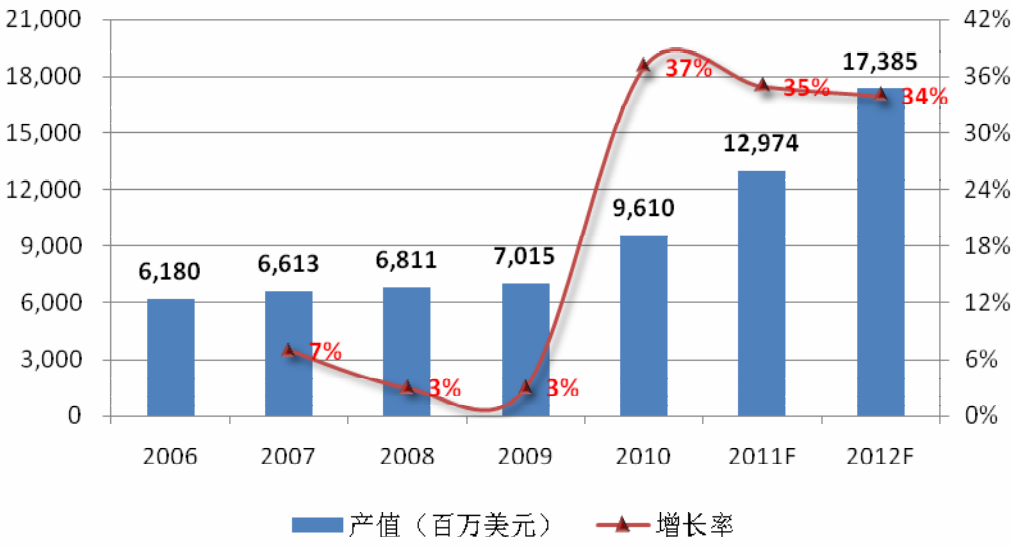
品名	寿命（H）	光效（lm/w）	启动特性	频闪	电磁干扰	环保	抗震性	易损性
白炽灯	1,000	15	快	严重	无	-	差	玻璃材质易损坏
荧光灯	6,000	80	慢	轻	大	汞污染	差	玻璃材质易损坏
LED	100,000	150	极快	无	小	绿色	好	全固体不易损坏

（二）LED产业发展概况

1、全球 LED 产业快速发展

随着 LED 技术不断进步以及下游应用领域逐渐扩大，特别是 LED 照明市场的快速发展，整个 LED 行业出现加速增长势头。据拓墣产业研究所数据，2010 年全球 LED 产值可达到 96.1 亿美元，增长率达到 37%。

2006-2012 年全球 LED 产值增长



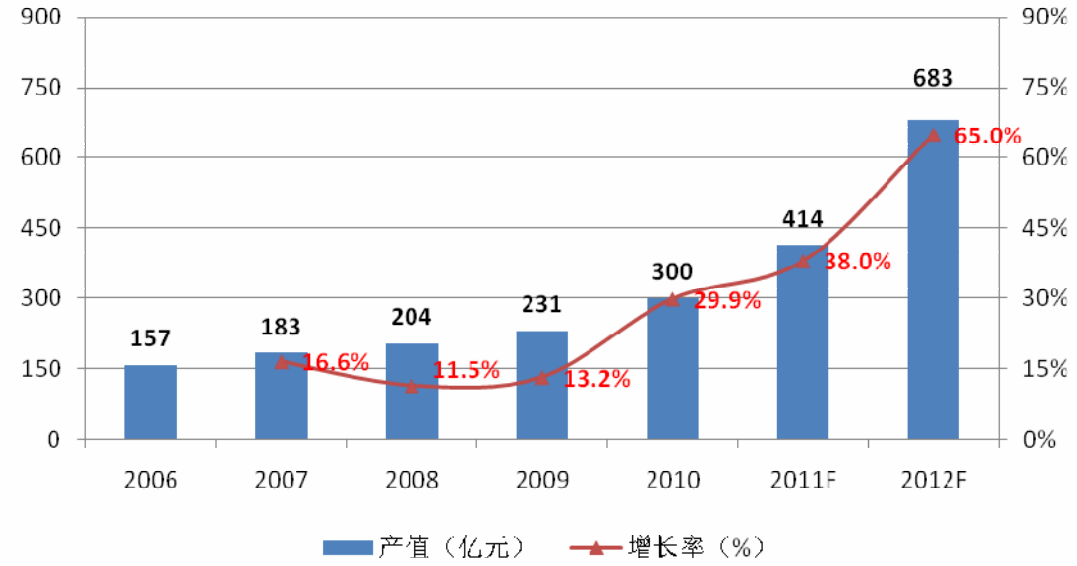
数据来源：拓墣产业研究所

2、我国 LED 产业迅速发展

LED 在中国兴起较晚，但发展迅速。目前国内 LED 已在显示屏、景观装饰、交通信号、街道照明、车用照明、家用电子消费及背光源领域获得了全面应用和

推广。从产值来看，即使在 2009 年因金融危机致使全球 LED 产业增速放缓的情况下，中国 LED 产业仍保持了快速增长的势头。2010 年国内 LED 产业实现产值 300 亿元，增幅为 29.9%，预计 2011 年国内 LED 产值超过 400 亿元。

2006-2012 年中国 LED 产值增长



数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，拓墣产业研究所

随着 LED 产业工艺技术的不断提高，使得下游应用领域逐步延伸，产品应用范围越来越广，市场需求随之扩大。未来国内 LED 产业发展空间广阔。

3、国内 LED 封装行业概况

国内 LED 封装产业在下游广阔的应用市场等因素带动下规模不断扩大，同时，近年来国际 LED 企业逐步向中国转移。内资封装企业在与各类外资封装企业竞争过程中技术不断成熟。目前国内企业主要集中在中低端封装领域，部分成熟企业在高端领域封装技术也有了较大突破。

随着工艺技术的不断完善和积累，国内 LED 封装企业在高端封装领域的市场份额逐步提高，竞争实力不断增强。

在良好的产业政策引导下，以及持续的技术创新，LED 封装行业伴随 LED 产业快速增长。据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，2010 年，国内 LED 封装产值达到 250 亿元，较 2009 年的 204 亿元增长 23%。

4、LED封装产业发展趋势

大功率化

在大尺寸面板背光及室内照明等新应用领域逐渐扩展的带动下，高亮度 LED 处于高速增长阶段，比重逐渐加大，未来 LED 封装产品将由小功率向大功率方向发展。

模块化

通过多个 LED 模块的相互连接可实现良好的流明输出叠加，满足高亮度照明的要求。通过模块化封装，可以将多个点光源或 LED 模块按照随意形状进行组合，满足不同领域的照明要求。

低功耗化

LED 产品以节能环保著称，随着应用产品的不断普及，为达到节能环保要求，减少应用产品的功耗等目的，器件的封装也会朝此方向发展。

（三）行业竞争格局

全球 LED 市场以亚洲、美国、欧洲三大区域为主导，主要厂商有日本的日亚化学（Nichia）和丰田合成（Toyoda Gosei）、美国的 Cree 以及欧洲的 Philips Lumileds 和欧司朗（Osram）。以上五大厂商产业链比较完善，在产业链上游拥有强大的技术实力，垄断着高端产品市场。

我国 LED 起步较晚，大多厂商从下游封装起步，逐步进入上游外延片生产。目前国内 LED 上中游企业较少，使得外延片和芯片行业产业集中度较高；而涉足下游封装及应用领域的企业较多，但形成规模效应的企业较少，产业集中度较低，竞争相对比较激烈；由于国内人力成本相对发达国家较为低廉，且政府出台较多 LED 产业优惠政策，近年来国外大型 LED 厂商纷纷来中国投资设厂，国际封装产业逐渐向国内转移。

目前，国内 LED 产业群主要集中在长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区，其中珠三角地区是中国 LED 封装企业最集中、封装产业规模最大的地区，企业数量约占全国一半左右，该地区聚集众多封装物料和封装设备的生产厂商与代理商，配套最为完善。

国内 LED 各产业链环节代表企业如下：

产业链环节	国内代表企业

上游（衬底、外延片）	企业较少且都未形成规模
中游（芯片制造）	三安光电、乾照光电
下游（封装及应用）	国星光电、木林森、鸿利光电、雷曼光电

由于上游衬底、外延材料及中游芯片制备具有资本、技术密集的特点，进入门槛较高，而下游 LED 封装和应用领域对资本、技术要求相对不高，进入门槛较相对较低，导致国内 LED 上中游企业较少，特别是 LED 上游企业。

（四）进入LED封装行业主要障碍

1、专业技术人才较少

国内 LED 发展较晚，本土技术研发人员较少，国内技术研发多集中在大学和科研院所。目前国内成熟 LED 企业在技术研发方面多采用自主研发的同时联合国内高校及科研院所产、学、研相结合的形式，使得科研成果能迅速产业化；另外，随着 LED 行业不断发展，各企业必须通过技术研发带动产品不断创新，以保持自身竞争优势。因此，专业技术人才缺失对新进入者构成障碍。

2、下游客户基于产品品质、性能方面对成熟供应商形成依赖

下游大型 LED 应用生产商在原材料采购上对 LED 封装器件产品品质稳定性要求较高、需求量较大，出于对上游封装企业能够持续稳定地提供一致性能的封装产品考虑，下游 LED 应用生产商一般会选择技术实力雄厚、产品品质有保证的 LED 封装厂商作为其原材料采购的对象，而一旦确定上游 LED 封装企业为其原材料供应商后，一般不会轻易改变与以上企业已经建立起来的战略合作关系，从而形成对现有供应商的依赖。

成熟的 LED 封装企业由于其行业进入时间较长且技术实力比较雄厚，一般都拥有一批稳固的战略合作客户从而构成行业进入障碍。

3、较大的生产规模可有效降低成本

下游 LED 应用厂商一般要求供应商具有大规模的供应能力，以保证产品品质的一致性，规模较小的封装企业无法满足其要求。同时，规模较大的封装企业原材料采购规模较大，与上游原材料供应商合作关系密切，可获得稳定的原材料供应，并通过大宗采购有效降低成本。

另外，由于先进设备固定投资较大，较大的生产规模可充分利用先进的生产设备，提高先进设备的使用效率，降低单位固定成本。

4、出口产品需要通过国外严格认证

我国半导体照明产业行业标准已开始逐步完善。近年来，国际上许多国家越来越重视产品品质及安全的认证工作，目前国内出口至国外的 LED 产品需要通过进口国本国权威认证机构认证通过后才能于当地市场流通。国内较多 LED 企业因规模小、技术方面优势不明显以致产品品质及安全性能等方面无法达到国外认证标准而不能出口。

（五）行业利润水平

产业链环节	国内代表企业	毛利率	净利率
上游（衬底、外延片）	-	-	-
中游（芯片制造）	三安光电	47.38%	48.60%
	乾照光电	61.24%	46.14%
	平均	54.31%	47.37%
下游（封装及应用）	国星光电	30.72%	16.80%
	鸿利光电	35.61%	14.46%
	雷曼光电	36.56%	18.91%
	平均	34.30%	16.72%
	本公司	30.86%	12.76%

注：以上数据来源于各公司 2010 年报，三安光电净利率高于毛利率主要系当期获得财政补贴计入营业外收入较大。

从国内 LED 产业链看，上中游外延片、芯片生产厂商较少，由于 LED 上中游行业技术含量相对较高，导致其毛利率及净利率水平偏高，而 LED 封装及应用受上游原材料芯片供应的影响，使得毛利率及净利率相对低于上中游厂商。

近年来，随着全球芯片生产技术的不断成熟、以及芯片的国产化率不断提高影响，市场供应量也逐步增加，封装行业利润水平有所提高并将逐步稳定。

LED 封装企业利润水平取决于行业发展水平、企业研发实力、产品性能及品牌知名度、上游原材料价格变动以及企业自身运营水平等诸多因素。因此，技术研发及产品创新能力较强、封装工艺水平领先、规模化效应显著、成本控制能力突出、产品品质稳定及行业知名度高的封装企业，将拥有较高的利润水平。

（六）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产品应用领域广泛，市场空间广阔

LED 光源相对于传统光源具有无可比拟的优越性（使用寿命长、能耗低、色泽丰富、耐振动、环保等），已逐渐在显示屏、景观装饰、交通信号灯、街道照明、车用照明、手机键盘及背光源等领域获得全面应用和推广，拥有巨大的市场空间。近年来，LED 技术不断进步，产品发光效率不断提高，大尺寸 LED 显示屏价格逐步下降，同时液晶电视以及大尺寸 LED 背光等应用领域迅速普及并得到广泛应用，因此 LED 应用市场需求也将出现较大幅度增长。

巨大的 LED 应用市场为上中游外延片、芯片生产及下游封装器件生产环节提供了广阔的发展空间。

（2）全球 LED 上游产业逐渐向我国转移

随着 LED 产业的不断发展，LED 企业数量也呈快速增加的态势。处于产业链高端的日本、美国、欧洲和产业链中下游的中国台湾、韩国正逐步向制造成本较低的新兴市场转移。

由于国内巨大的市场发展空间以及国家优惠政策的吸引，国际上较多大型 LED 企业陆续在国内投资建厂，一方面引进了先进的研发生产技术和管理模式，提高了国内 LED 产业的国际竞争力；另一方面大量增加了上游原材料的供应，促进了封装及应用领域的快速发展。

（3）产业集群效应逐步显现

从国内 LED 产业的发展来看，地域上出现以长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区为主的四大产业聚集区域。四大产业区域涵盖了整个 LED 产业链，每一区域定位于不同的产业链，在技术研发、人才及产品市场定位等方面各具特色，逐步显现出区域集群化效应。

国内 LED 产业区域化特点如下表所示：

区域	主要特点
上海、江苏、浙江（长三角）	芯片生产及封装生产企业集中，高端应用突出，人才、资金比较集中
深圳、佛山、广州（珠三角）	封装和应用产业国内规模最大，产业配套能力最强，离市场最近，投资活跃，承接海外 LED 企业转移较多
北京、大连、天津、河北（环渤海）	研发力量最强，研发机构最集中，封装、应用发展速度较快
厦门、南昌（闽赣地区）	产业链较完整，从事外延片及芯片生产的企业规模较大，承接台湾 LED 企业转移较多

（4）半导体照明产业标准将逐步完善，行业竞争秩序将逐步规范有序

随着半导体照明产业的快速发展，国家相关部门越来越重视行业标准的规范工作，通过对行业标准的逐步规范，以促使 LED 产业健康有序发展。2010 年 1 月 24 日，由中国电子技术标准化研究所、工业和信息化部半导体照明技术标准工作组联合发布《半导体光电子器件功率发光二极管空白详细规范》、《半导体发光二极管测试方法》等 9 项半导体照明行业标准。行业标准的逐步完善，将规范半导体照明行业市场、完善现行制度、鼓励先进企业跨地区自由竞争及推动技术创新等，有利于推动我国半导体照明产业健康良性发展。

2、不利因素

（1）产业链需进一步完善

从国内 LED 企业在产业链分布来看，封装行业厂商较多，吸收了大量资金，发展迅速；而外延片、芯片环节涉足企业较少，导致芯片产量不足，难以满足下游封装企业生产所需，部分芯片特别是高端芯片需要进口。国内 LED 产业链特别是中、上游的芯片、外延片生产环节有待进一步完善。

（2）技术水平有待进一步提高

由于我国 LED 技术起步较晚，缺少本土专业化研发人才，技术研发实力有待进一步提高，缺少核心高端专利，核心技术相对还较薄弱，技术水平特别是中上游芯片和外延片制备技术与国外相比还有进一步提升的空间。

（3）下游 LED 应用产品价格昂贵，抑制了产品应用的普及率

LED 应用产品生产所需原材料来源于上游 LED 封装厂商，虽然近年来随着整个 LED 产业技术水平的不断提升，LED 应用产品成本有所降低，产品价格呈

下降趋势，但 LED 应用产品在市场流通环节其价格还是比较昂贵，价格因素抑制了 LED 应用的普及率。

（七）行业技术水平及技术特点

近年来国内 LED 企业在与外资、合资厂商的市场竞争过程中，工艺技术不断创新，技术水平不断提升，国内 LED 封装企业在全球的知名度逐步提高。

LED 封装行业涉及的主要技术包括封装设计技术、封装工艺控制技术、封装辅助材料技术等。

封装设计技术

从 LED 封装形式来看，主要有 Lamp LED、SMD LED 及功率型 LED 三大类。LED 的封装设计包括外形结构设计、散热设计、光学设计、材料匹配设计、参数设计等。总体来看，国内 LED 封装技术水平与国外大型厂商相比还有一定差距，但在某些具体设计细节方面取得了一定突破。

SMD LED 封装技术尤其是 Top 型 SMD 封装技术处在不断发展之中，国内企业在对 Top 型 SMD 封装支架尺寸、封装结构设计、材料选择、光学设计及散热设计等技术方面有不断创新，积累了较强的技术实力。

从功率型 LED 封装技术来看，随着功率型大尺寸芯片制造技术的不断提升，功率型 LED 封装在结构、光学、材料及参数设计等技术方面也在不断进步。

封装工艺控制技术

封装工艺技术在 LED 封装生产中至关重要。例如固晶机的胶量控制、焊线机的焊线温度和压力控制、烤箱的温度及时间控制、封胶机的气泡和卡位管控等，均是封装工艺重点环节。即使芯片质量好、辅材匹配好、设计优异、设备精度高，若工艺不正确或管控不严，最终也会影响封装产品的可靠性、衰减及光学特性等。

近年来随着封装技术的快速发展，国内 LED 封装工艺已经上升到较高的水平，甚至在一些高端需求领域，封装工艺水平已接近国外水平。

封装辅助材料技术

封装辅助材料包括支架、金线、环氧树脂、硅胶、模条等。辅助材料质量的优劣决定了 LED 封装产品品质的高低，包括封装产品的失效率、衰减率、光学性能及能耗等。目前国内封装辅助材料供应链已比较完善，大部分辅助材料已能

实现国内供应，但高性能的环氧树脂和硅胶以进口居多。

（八）行业周期性、区域性及季节性

LED 产品广泛应用于显示屏、景观装饰、交通信号灯、街道照明、车用照明、家电电子产品、手机键盘及背光源等领域，而拥有巨大应用空间的普通室内照明领域覆盖率还相当低，发展空间广阔，因此 LED 封装行业不存在周期性。

LED 行业区域性比较明显。全球主要以亚洲、美国及欧洲三大区域为主导；国内呈现以长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区为主的四大产业聚集区域，四大区域在 LED 产业发展定位上各具特色。

节假日因素对 LED 应用产品市场具有直接影响。由于国庆节、圣诞节、元旦以及春节等节假日相对集中，四季度和一季度成为 LED 应用产品（如景观灯饰等）销售旺季。一般来说，下游 LED 应用制造商需提前 2 个月备货，因此二、三、四季度是 LED 封装行业生产旺季，而一季度则处于生产淡季。

（九）LED封装行业与上下游产业的关联性

LED 封装生产主要原材料为芯片、支架等，因此封装企业上游为芯片、支架制造商。由于芯片在 LED 封装产品成本中占比最高，因此封装企业上游主要为芯片供应商，芯片的供应情况对封装行业具有一定影响。随着国内芯片企业的逐渐增加及生产技术的提升，芯片产量将逐渐扩大，供应趋于充足。

LED 封装行业下游为 LED 应用产品，应用产品领域广泛，生产厂家众多。LED 应用市场的快速发展同时促进了 LED 封装行业的发展。

四、本公司所处行业地位及竞争情况

（一）行业地位

公司一直专注于 LED 封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，是国内 LED 封装及应用产品的主要供应商。

本公司 2010 年实现营业收入为 8.15 亿元，其中 LED 封装及应用产品实现销售收入 7.82 亿元，销售收入占国内市场份额的 2.61%

2010 年	本公司	市场总规模	本公司占市场总规模比重
LED 封装及应用产品产值	7.82 亿元	300 亿元	2.61%

注：市场总规模数据来自国家半导体照明工程研发及产业联盟

（二）同行业主要企业

1、佛山市国星光电股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司于 1976 年开始涉足 LED 领域，2010 年 7 月在深圳证券交易所上市（002449.SZ），股本 2.15 亿元，其产品以 SMD LED 为主，产品应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程等领域。该公司 2010 年实现营业收入 8.77 亿元。

2、广州市鸿利光电股份有限公司

广州市鸿利光电股份有限公司成立于 2002 年，2011 年 5 月在深圳证券交易所上市（300219.SZ），股本 1.23 亿元，主要产品包括 Power LED、SMD LED、Lamp LED 等，产品应用于背光、汽车、照明等领域。该公司 2010 年实现营业收入 4.38 亿元。

3、深圳雷曼光电科技股份有限公司

深圳雷曼光电科技股份有限公司成立于 2004 年，2011 年 1 月在深圳证券交易所上市（300162.SZ），股本 0.67 亿元，主要产品包括 Lamp LED、SMD LED、Power LED 等，产品应用于照明、显示屏等领域。该公司 2010 年实现营业收入 2.06 亿元。

4、亿光电子工业股份有限公司

亿光电子工业股份有限公司成立于 1983 年，为台湾 LED 封装龙头企业。亿光拥有全系列的产品线，包括 High Power LEDs、Lamp LED、SMD LED 及 Display 等，产品主要应用于家电、汽车、仪器仪表、计算机、通讯、交通信号灯及广告屏等领域。

上述资料均来源于各企业上市招股说明书、年报或相关网站等公开信息。

（三）上下游企业相互渗透情况

从 LED 发展来看，国外大厂主要集中于产业链上中游，但为进一步延伸产业链，形成协同效应，近年来国外较多 LED 大厂商纷纷来国内投资设立封装厂。国内 LED 企业在与各类外资企业竞争过程中技术不断成熟，部分成熟企业在高端芯片及封装领域技术也有了较大突破。国内 LED 企业在做大做强原有产业链

产品的同时，也逐步向上游或下游产业链延伸，以进一步增强各自竞争实力。代表企业有三安光电及国星光电。

1、三安光电

三安光电为国内较早从事 LED 外延片、芯片生产制造的企业之一，该公司主要从事全色系超高亮度 LED 外延片及芯片、化合物太阳能电池、PIN 光电探测器芯片等的研发、生产与销售。该公司在确立以 LED 外延片、芯片生产制造为主的同时，逐步向 LED 下游产业链延伸。2010 年，该公司 LED 封装及应用产品营业收入为 2.23 亿元，占收入比重为 25.84%，毛利率为 40.28%。

2、国星光电

国星光电一直以 LED 封装器件为主，随着该公司顺利上市，整体实力大幅提升，该公司于 2010 年 12 月投资 4 亿元设立控股子公司国星半导体技术有限公司，从事 LED 芯片制造，逐步向 LED 中游芯片延伸。

随着 LED 产业的快速发展，LED 芯片制造技术和封装应用技术已日趋成熟，实力较强的 LED 厂商逐步向上下游拓展，实现垂直整合。LED 芯片生产商比如三安光电向下游封装应用拓展，LED 封装厂商比如国星光电则向上游芯片制造领域拓展，业务环节相互渗透。

本公司从事 LED 封装行业多年，经过近几年的发展，已形成一整套适合自身发展的生产工艺流程体系及广泛的客户群体。公司依托较强的技术研发实力、先进工艺流程及广泛的客户群体，在稳固 Lamp LED 市场地位的同时，逐步发展 SMD LED 产品，并进一步向 LED 下游应用行业拓展，产业链的延伸使得公司成本优势更加突显，综合竞争实力增强。

（四）竞争优势

本公司的竞争优势主要体现在规模化生产、丰富的产品系列、技术研发、制造工艺及稳定的客户资源等方面。

1、规模化生产优势

经过多年发展，截止 2010 年末，公司已拥有年产 96 亿只 Lamp LED 封装器件的生产能力，拥有 218 台全自动化固晶机、258 台全自动焊线机、261 台全自动分光机、80 台全自动荧光粉机等生产设备，公司在扩大 LED 封装系列产品市

场份额同时，逐步向 LED 应用产业链延伸。首先，规模化生产带动公司对芯片实行规模化采购，能够从供应商处获得较低的芯片价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片采购成本，公司与台湾的芯片厂商晶元光电及光磊科技保持了多年的良好合作关系；其次，公司生产设备目前均已大规模实现全自动化生产，规模化生产能有效减少产品分摊的单位人工成本及制造费用，降低了公司产品的生产成本，提升了产品的市场竞争力；再次，大规模的生产能力有助于公司拥有较高的市场影响力，从而促进行业协调发展。

2、产品系列丰富，LED 下游应用市场广阔

公司一直专注于 LED 封装及应用产品的研发、设计及生产，是国内较早生产 LED 封装及应用产品的供应商。公司目前产品包括 Lamp LED、SMD LED 、Display 和 LED 应用产品（包括显示屏、室内外照明灯及灯饰），产品系列丰富、型号多样、种类齐全，能满足客户对产品标准化和个性化的不同需求。

LED 下游应用市场广阔，公司 LED 封装产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域，公司下游应用客户群遍布于不同 LED 应用子行业。

产品系列丰富有助于公司能满足不同层次客户对产品的需求，与客户达成合作，提高市场占有率，同时减少市场开拓的重复投入，促进营销资源的有效整合，实现产品市场的交叉拓展，提高公司的市场竞争力。

3、技术研发优势带动生产工艺的创新

公司自成立以来，一直重视产品研发和技术创新，在 LED 封装及应用领域已取得一系列技术成果，具备解决 LED 封装及应用产品一整套方案的能力。公司先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。

公司在技术研发优势方面还体现在生产工艺流程的创新，在传统 LED 封装工艺的基础上，公司对产品的机器设备、原材料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名 LED 封装设备供应商 ASM 定制全自动固晶机、焊线机及封胶机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了 LED 封装产品的阻燃性能与抗紫外线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国 UL 行业协会认证资质的企

业，提升了公司产品的国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度降低产品的成本。

公司已经建立了运作高效、工艺领先的全自动化生产线，有效提高了设备利用率，实现公司生产资源的有效整合和利用。

4、销售渠道及客户优势

公司一直注重营销渠道的建设，坚持走多元化道路。首先是强化全国各地办事处的辐射力度，目前公司在全国省市主要大中城市建立了销售办事处；其次是强化经销商的作用，发挥经销商在面对终端市场的客户资源优势；第三是发挥电子商务平台在拓展销售渠道的作用。公司目前是国内 LED 封装及应用行业中营销服务网络较为发达和完善的企业，销售网络基本覆盖全国。

公司不断强化“服务型营销”理念，对重要客户派遣驻厂人员，积极为客户提供各种技术、信息服务，从而使公司积累了大批优质、长期合作客户，如长期合作伙伴东裕电器、协顺电器、苏扬灯饰及格兰仕等；公司目前客户资源稳固并呈逐年增加之势，与客户合作关系良好。伴随客户资源的稳定增长，公司各产品销售额呈现快速增长的良好势头。

5、优异的产品品质

公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台，实行标准化规模生产，导入单位竞争体系，进行系统目标考核，执行有效的奖惩制度。

公司非常注重产品品质的保障及不断提升工作，建立了全套的质量保证体系，从原材料供应商的选择、原材料检验、员工上岗前培训、标准化生产、产成品检测、客户对产品信息反馈及公司对产品品质统计分析等方面严控产品质量。公司实行全程质量控制，从原材料进货检验、生产过程操作监控、产品过程质量检测到成品入库检测均设有严格的质量标准和操作规范，公司内部设有品保部，专职负责各业务流程质量保障工作。

公司还引进全新自动化实验检测设备，从芯片采购、生产过程及产品入库、出库均需通过检测设备的检测测试。

公司于 2004 年成功通过了 ISO9001:2000 质量保证体系认证；公司根据产品用途、销售区域的要求，分别申请并通过了 UL、CE、CCC 等多项认证，公司产品分别获得“广东省名牌产品”、“最受欢迎品牌”等荣誉称号。

（五）竞争劣势

1、业务规模迅速扩张面临资金压力

公司自成立以来在完善的销售服务体系、优秀的技术研发、创新的产品工艺等多重因素的推动下，不断发展壮大。虽然公司现有规模优势明显，但仍不能满足旺盛的市场需求，公司还需进一步投入资金、扩大产能。而公司尽管经过近几年的发展，已具备了一定的规模和实力，但仍然面临着资金紧张压力，从而制约了公司规模快速扩张。

2、人力资源建设亟需进一步加强

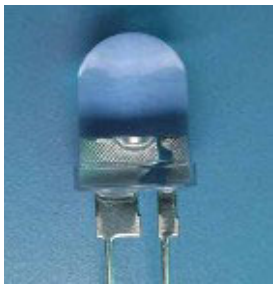
随着公司生产规模的不断扩大，对公司的生产管理、营销、物流和信息等系统化的组织和管理等方面提出了更高的要求，公司目前的人力资源现状还不能完全满足这个方面的需要。

五、本公司主要业务

（一）主要产品

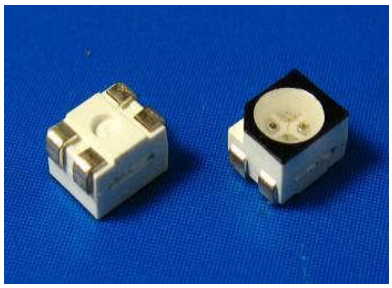
1、Lamp LED 产品

应用于指示灯、小家电、交通灯、室内照明、LED 显示屏等产品生产的原材料。



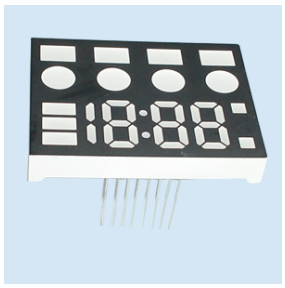
2、SMD LED 产品

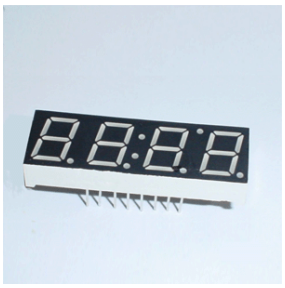
应用于灯饰、室内照明、特殊照明、LED 显示屏、指示灯、手机背光、手机键盘灯、电视背光等产品生产的原材料。



3、Display

用于家电电子产品数码显示、点阵显示屏，特殊信息显示等产品生产的原材料。





4、LED 应用产品

公司主要应用产品包括灯饰、室内外照明灯及显示屏等。

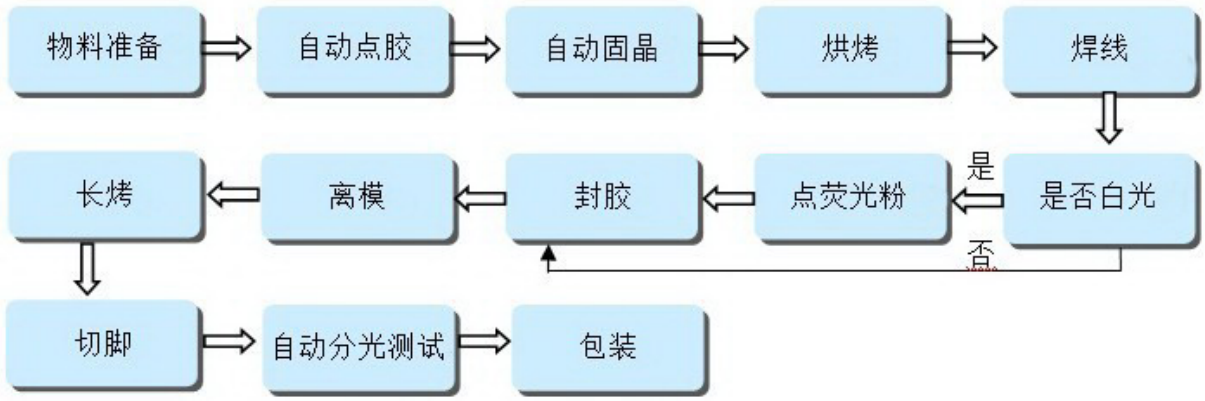
灯饰

室内外照明灯

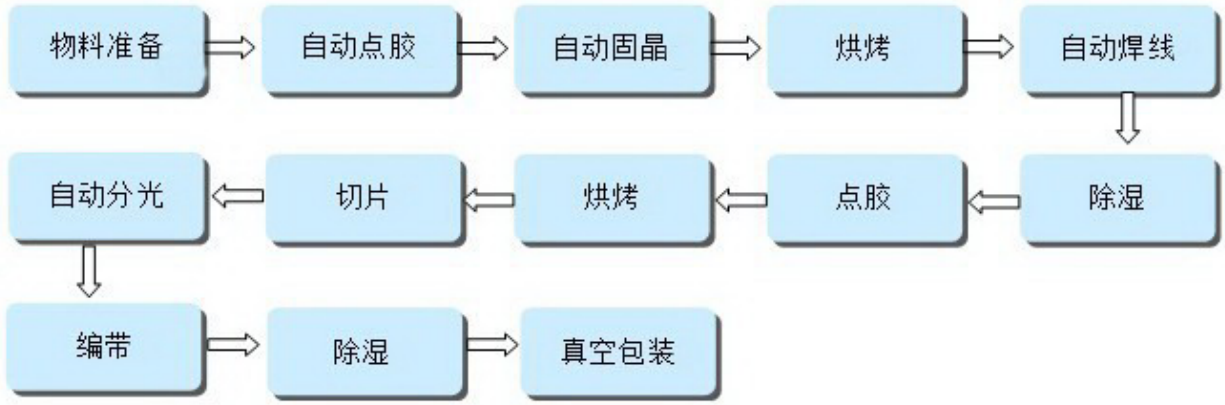
显示屏

（二）主要产品工艺流程

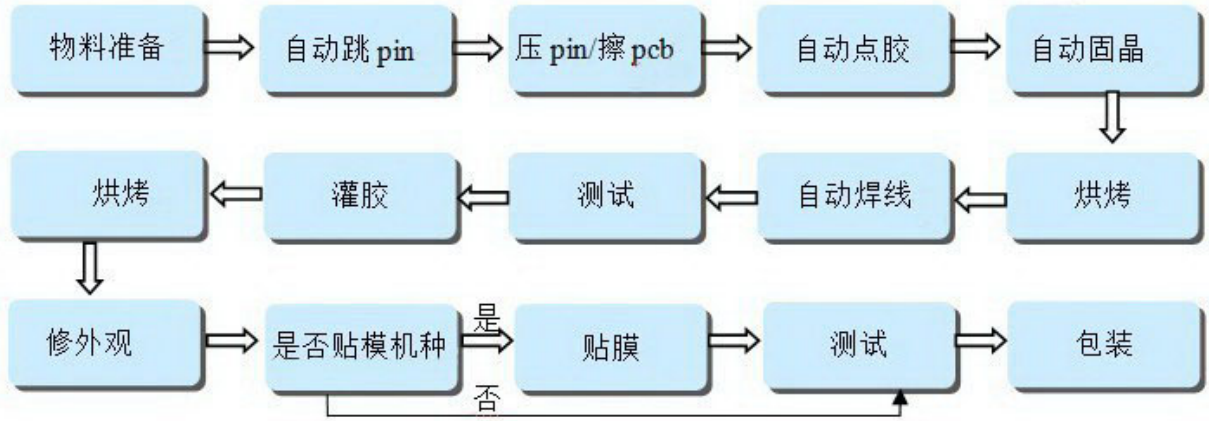
1、Lamp LED 产品工艺流程



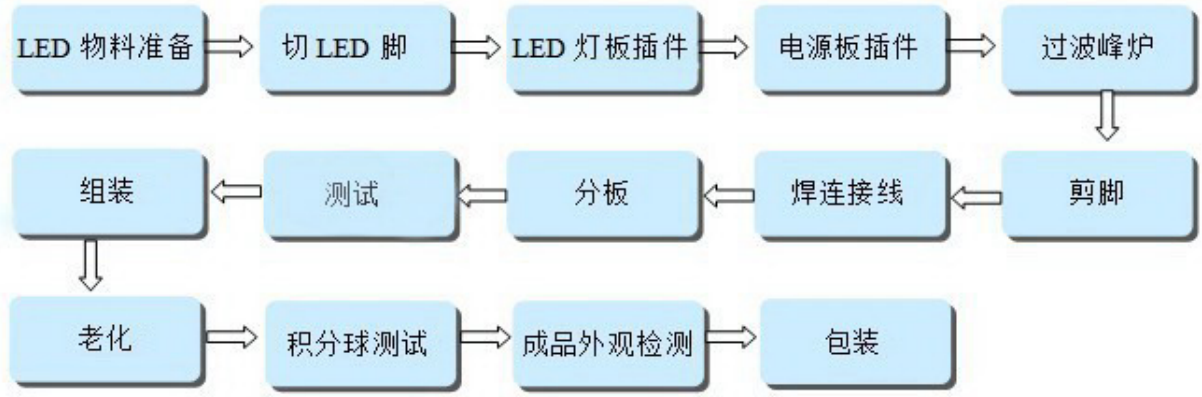
2、SMD LED 产品工艺流程



3、Display 产品工艺流程



4、LED 应用产品生产工艺流程



（三）公司业务模式

1、采购模式

公司一般在年初对原材料制定采购计划再根据实际订单及库存情况不断作出调整。公司的原材料采购包括对芯片、支架及支架生产所用原料、焊线材料、PCB、环氧树脂及其他辅料的采购等。根据原材料对生产的重要程度及供需情况，

公司的采购分为战略采购和常规采购。

（1）战略采购

随着公司业务规模的不断扩张，对芯片特别是部分高端芯片需求量日益增大，公司与台湾大型芯片厂商如晶元光电、光磊科技等建立了稳固的战略合作关系，实行战略采购，具体如下：

- 晶元光电、光磊科技基本情况

晶元光电为台湾上市公司，成立于 1996 年，总部位于台湾新竹科学工业园区，为全球最大的超高亮度芯片制造商之一。晶元光电目前已于国内厦门及常州投资建设芯片生产基地；并于深圳设有子公司晶元宝晨光电（深圳）有限公司，负责中国大陆 LED 芯片销售业务。

光磊科技为台湾上市公司，成立于 1983 年，总部位于台湾新竹科学工业园区，芯片生产为其核心业务，其芯片制造技术先进，品种系列丰富。光磊科技目前在国内苏州设有生产基地及服务总部。

- 公司与晶元光电、光磊科技的合作方式

公司的原材料芯片采购以进口台湾芯片为主。主要系晶元光电、光磊科技等公司实力雄厚，技术领先，能按公司采购订单中的规格要求规模生产、及时交货，且芯片质量较高，保证了公司正常生产经营之所需。目前，公司与晶元光电、光磊科技建立了较为稳定的长期战略合作关系。具体合作方式如下：

每个会计年度初，公司根据前一年度芯片采购情况及本年度订单、生产计划，对未来芯片的整体价格趋势及供需情况作出初步判断后，决定本年度芯片的采购量及采购周期。同时，公司与晶元宝晨、光磊科技签订未来一年芯片供货框架协议，通过框架协议拟定未来一年芯片的总供货量，有助于台湾芯片供应商安排生产，且约定芯片供货价格须优惠于同期芯片市场价格。

在前述框架协议下，公司通过分次发送订单的方式向晶元宝晨、光磊科技采购芯片并结算相应款项。在此种采购模式下，公司既保证原材料芯片充足的供应，又有效避免了芯片价格波动给公司生产经营造成不利影响，增强了公司的市场竞争力。

- 公司向晶元宝晨、光磊科技采购芯片情况

1）芯片采购框架协议内容

本公司芯片采购框架协议主要条款如下：

需方为稳定且满足【】年度生产之需要，经与供方友好协商，现签订【】年度产品采购框架协议如下：

1、需方预估【】年度向供方采购的芯片总量约为【】万只，供方可满足需方上述需求；

2、需方所定购的芯片规格型号、质量要求以需方具体下单时为准；

3、需方在下单前应与供方充分协商，给予供方合理的供货期；

4、供方承诺，需方定购产品的单价应优惠于实际交货时该产品的市场价；

5、产品交货地点：中国广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号；

6、货款结算方式：月结对账后【】天内付清全款；

7、本协议其他未尽事宜，以实际订单为准。

8、本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。

2）芯片采购订单内容

本公司芯片采购订单主要条款如下：

1、订单编号：【】订货日期：【】币别：【】

2、物料名称：【】规格型号：【】采购数量：【】单价：【】总价：【】要求交货期：【】

3、交货地点：中国广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号

4、付款方式：月结【】天

5、备注：

供应商获得订单信息后盖章回传，以确认订单信息；

供应商交货品质规格必须与本公司订单信息相符，且必须符合 ROHS 要求，否则本公司拒绝接受，由此造成的一切损失由供应商负责；

检验后如发现有不良产品，供应商接获通知后三日内应将退货取回并尽快补发，若供应商不能按上述要求执行，给公司造成损失的，由供应商负责赔偿损失；

采购时相关检验费用由供应商负责。

3）采购芯片定价依据

公司与晶元光电、光磊科技采购芯片价格以市场价格走势为定价依据，同时参考以下因素：

A、芯片的采购量，芯片采购数量多则采购单价更优惠；

B、客户接受芯片规格范围情况，因芯片规格型号较多，若客户采购时接受的芯片规格型号较广，则供应商会给予优惠于同期市场的价格，与此同时，如果客户采购的芯片规格型号单一，则芯片的售价较高；

C、客户在 LED 行业中的综合影响力，对于规模优势明显、产能产量较大、工艺技术实力雄厚及信誉良好的客户，供应商则给予优惠于同期芯片市场的平均价格。

由于公司封装产品涉足 LED 下游应用领域较广，产品规格、型号也较多，能消化不同波长、亮度等规格芯片，公司对芯片实施以整张为单位进行规模化采购，无需芯片供应商对芯片规格进行筛检，每年芯片采购量较大，使得公司与晶元光电、光磊科技等供应商建立长期稳固的合作关系。

近几年，随着国内芯片生产厂商逐步增加及芯片工艺技术水平的不断提升，国产芯片产量也逐步增加，市场供应相对充足，芯片采购价格也呈逐年下降的态势。报告期内，公司芯片的平均采购价格随市场价格变化也呈逐年下降的态势。

- 公司在芯片成本控制及应对价格波动风险方面的具体措施

为有效控制芯片成本，防止芯片价格波动给公司经营造成不利影响，公司采取的具体措施如下：

1）规模化采购

截止 2010 年末，公司 Lamp LED 产品年产能达到 96 亿只，规模优势突出，与生产规模相对应，公司对原材料芯片实行规模化采购，与晶元宝晨和光磊科技等芯片供应商签订采购框架协议，规模化采购提高了公司芯片采购的议价能力，使芯片采购成本降低；另一方面，规模化的芯片采购能快速补充库存，一旦发现芯片供应趋紧，价格上升，公司能提前备货及锁定价格，以最大限度保证芯片价格的稳定，减少芯片价格波动对公司生产经营造成不利影响。

2）提高芯片的利用率

由于本公司 LED 封装产品系列丰富，产品覆盖面较广，生产中可接受的芯

片规格范围需求较广，符合供应商的供货要求；另外，公司技术工艺不断成熟，对不同规格型号及性能的芯片能得到合理利用，对芯片的利用率较高，减少了芯片的浪费，使芯片成本得到有效控制。

3）拓宽芯片采购渠道

公司目前与台湾芯片供应商晶元光电、光磊科技建立起长期稳固的合作关系，直接向该二家厂商采购芯片；同时，为进一步拓宽芯片采购渠道，公司逐步与国内部分芯片供应商建立合作关系。随着国内芯片生产厂商不断增加及芯片工艺技术水平的提升，国产芯片供应量逐步增加，价格呈下降态势。因此，公司芯片供应以进口台湾为主的同时也逐步加大对国产芯片的采购力度。目前，公司已与深圳市奥伦德光电有限公司、山东浪潮华光光电子有限公司、南昌欣磊光电科技有限公司等国内芯片厂商建立采购合作关系。

4）根据芯片市场价格走势，主动与供应商协商调整芯片采购价格

在芯片市场价格走势相对平稳时，公司以芯片采购框架协议为基础，与供应商协商确定以优惠于芯片市场价格作为公司芯片采购定价依据；若芯片市场售价持续走低，为了避免原材料芯片价格下降对公司经营业绩造成的不利影响，公司则主动与供应商协商降低芯片采购价格，使公司芯片采购价格与市场波动保持一致。

（2）常规采购

公司生产所需其他原材料，因国内市场供应充足，所以由采购部根据生产需求在国内市场直接采购。

（3）采购货款结算方式

根据公司与主要供应商的协议及公司与主要供应商长久合作所形成的商业惯例，公司采购货款一般在货到后的 60-90 日内以现金或承兑汇票方式支付。

2、生产模式

本公司按照“订单生产”为主、“补充货源生产”为辅相结合的模式组织生产。“补充货源生产”是指在满足客户订单生产外为补充一定库存、应对市场需求而组织的生产活动。

“订单生产”避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性，以销定产，

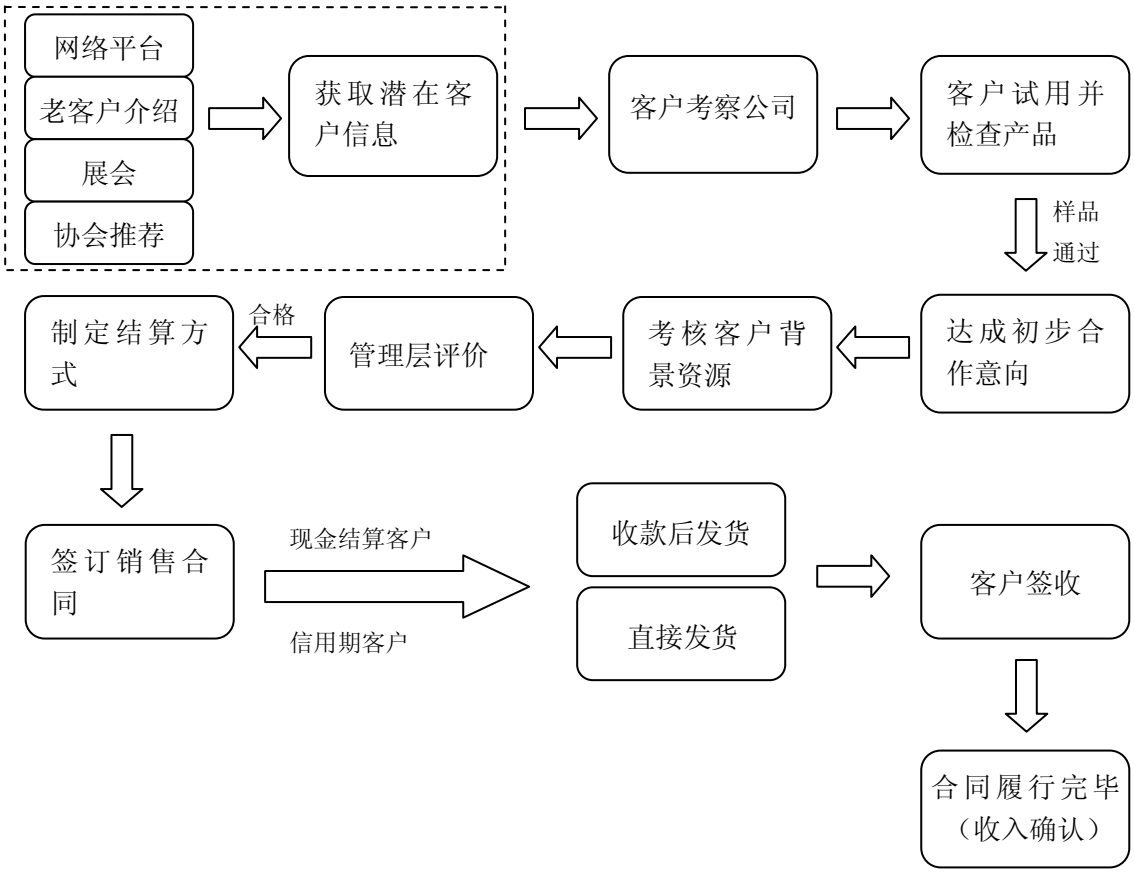
原材料采购和生产更有计划性，可以降低存货跌价风险，还可以最大限度控制原材料库存，提高资源利用效率。在订单生产之外进行补充货源生产，最大限度的提高了生产设备的使用效率。

3、销售模式

公司产品采取直接销售为主、经销商分销为辅的销售模式。

（1）直销模式

公司的 LED 封装产品以直销为主，在直销方面坚持以开发高端大型客户为主，直销模式拉近了与下游客户的距离，能及时、准确的把握市场的动态、客户需求，也有利于更好的服务客户。公司销售流程如下图所示：



公司国内销售主要营销方式包括：

①参加有广泛影响力的行业展会，如中国国际 LED 半导体及太阳能展（深圳）、中国国际光电博览会（深圳）、深圳光电显示周、广州国际 LED 展览会、广州国际照明展览会、上海国际广告技术设备展览会等，向下游客户集中展示公司主流产品和新产品，提高公司知名度；

②积极参与并赞助行业协会相关的技术研讨会、信息交流会；

③通过公司网站、行业主流网络媒体进行宣传和推广。

公司在国外市场通过展会、电子商务平台、原有客户推荐、网络、杂志、国外直接拜访客户及邀请国外客户来访等多种方式进行产品推广。

（2）经销商模式

- 具体业务流程及销售确认时点

公司的客户群结构中除直接面对 LED 下游大型应用厂商，还包括全国各地的经销商，公司通过利用经销商在面对终端市场的客户资源优势同时，提升了公司产品在行业中的知名度，并把大部分精力集中在大型长期合作客户上，而对于部分中小型、零星 LED 下游生产厂商客户，由于公司 LED 封装产品质量好、性能稳定，具有较大市场竞争力，该零星客户对 LED 通用封装产品需求较大，公司一般通过经销商给予销售，有助于公司减少对该等客户群信用评判、货款回收，避免坏账的发生。

公司对经销商销售收入的具体确认方法：根据经销商的发货申请及销售订单，组织发货，经销商收到货物后进行验收并向发行人签署验收回执单时，产品的主要风险和报酬也已转移，本公司确认营业收入并结转成本。

- 通过经销商销售明细

报告期内，公司通过经销商销售情况如下：

经销商	主要内容	金额（万元）	占比
2008 年度			
永林	Lamp LED	1,435.59	3.88%
广东济胜科技贸易有限公司	LED 灯饰	346.96	0.94%
源森	Lamp LED	308.28	0.83%
林森	Lamp LED 及 Display	291.48	0.79%
美明	Lamp LED 及 Display	265.91	0.72%
上海文佳光电科技有限公司	Lamp LED	180.25	0.49%
纬源	Lamp LED	152.51	0.41%

润森	Lamp LED 及 Display	147.80	0.40%
安林	Display	114.40	0.31%
其他经销商	Lamp LED	278.02	0.75%
合计		3,521.20	9.52%
2009 年度			
润森	Lamp LED 及 Display	363.37	0.82%
永林	Lamp LED	342.64	0.77%
源森	Lamp LED	292.36	0.66%
广东济胜科技贸易有限公司	LED 灯饰	274.40	0.62%
上海文佳光电科技有限公司	Lamp LED	206.07	0.46%
美明	Lamp LED 及 Display	174.52	0.39%
佛山市夏越电子有限公司	Lamp LED	70.00	0.16%
林森	Lamp LED 及 Display	69.12	0.16%
北京恒电电源设备有限公司	Display	18.31	0.04%
其他经销商	Lamp LED	76.14	0.17%
合计		1,886.93	4.24%
2010 年			
美明	Lamp LED	525.34	0.67%
深圳市群宇科技有限公司	Lamp LED	318.72	0.41%
北京恒电电源设备有限公司	LED 显示屏	299.15	0.38%
永林	Lamp LED	282.29	0.36%
吉源	Display	232.80	0.30%
宁波市鄞州旭晟电子有限公司	Lamp LED	193.44	0.25%
北京百世中恒光电有限公司	Display	186.52	0.24%
上海文佳光电科技有限公司	Lamp LED	175.15	0.22%

润森	Lamp LED	148.97	0.19%
其他经销商	Lamp LED	701.34	0.90%
合计		3,063.72	3.92%

注：“占比”指占主营业务收入的比重

以上经销商中，永林、源森、林森、美明、纬源、润森、安林、吉源曾是公司关联方。

报告期内，公司对非关联方经销商销售分别为 707.59 万元、618.21 万元、1,720.17 万元，占收入比重分别为为 1.91%、1.38%、2.20%，占比较小，该部分经销商主要销往国内小型、零散的 LED 应用生产厂商，用于 LED 圣诞灯饰产品生产等。未来公司将加大经销商的拓展力度，带动公司营业收入快速增长。

（3）货款结算方式

对于国内直销客户，公司根据客户资信情况一般给予 60-90 日信用期；对于经销商，公司一般给予 30-60 日信用期；对于新开发、规模较小的客户则采取先收款后发货的结算方式。对于国外客户，公司一般采取信用证方式结算。

（三）主要产品的生产和销售情况

1、主要产品的产能、产量及产销率

报告期，公司各产品的产能、产量、产能利用率及产销率情况如下：

年度	项目	Lamp LED（万只）	Display（万只）	SMD LED（万只）	LED 应用产品		
					显示屏（平方米）	室内外照明灯（盏）	灯饰（米）
2010 年度	产能	960,000	6,600	21,900	8,112	276,000	4,668,000
	产量	894,233	6,412	21,701	6,941	258,598	4,725,102
	产能利用率	93%	97%	99%	86%	94%	101%
	销量	815,061	6,348	17,983	6,272	237,120	4,675,835
	产销率	91%	99%	83%	90%	92%	99%
2009 年度	产能	444,000	3,000		5,880	109,920	4,440,000
	产量	421,192	2,775		5,314	105,612	4,080,000

	产能利用率	95%	93%		90%	96%	92%
	销量	339,080	2,972		4,995	88,889	3,914,023
	产销率	81%	107%		94%	84%	96%
2008 年度	产能	444,000	1,360		5,160		4,320,000
	产量	359,393	1,355		4,985		3,789,043
	产能利用率	81%	99%		97%		88%
	销量	280,747	1,138		4,786		3,220,686
	产销率	78%	84%		96%		85%

2、主要产品的销售收入

单位：万元

产品种类	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Lamp LED	49,843.49	63.77%	28,758.86	64.64%	24,947.26	67.47%
LED 应用	14,135.70	18.09%	9,639.67	21.67%	7,758.39	20.98%
Display	11,548.14	14.78%	5,309.51	11.93%	3,258.28	8.81%
SMD LED	1,488.68	1.90%	37.71	0.08%	5.17	0.01%
其他	1,139.48	1.46%	745.81	1.68%	1,008.21	2.73%
合计	78,155.49	100%	44,491.56	100%	36,977.31	100%

3、主要产品销售区域分布

报告期内，公司主要产品销售市场的分布情况如下：

地区	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	**67,149.03**	**85.92%**	**26,573.55**	**59.73%**	**27,553.24**	**74.51%**
其中：华南地区	45,179.34	57.81%	21,238.15	47.74%	22,472.57	60.77%
其中：出口代理商	3,115.05	3.99%	8,520.79	19.15%	14,275.60	38.61%

华东地区	12,498.98	15.99%	3,739.26	8.40%	4,757.71	12.87%
华中地区	6,249.19	8.00%	30.01	0.07%	20.76	0.06%
华北地区	1,361.41	1.74%	1,277.82	2.87%	11.90	0.03%
东北地区	1,093.82	1.40%	54.61	0.12%	233.41	0.63%
西南地区	482.69	0.62%	143.74	0.32%	18.15	0.05%
西北地区	283.60	0.36%	89.96	0.20%	38.75	0.10%
国外	**11,006.45**	**14.08%**	**17,918.02**	**40.27%**	**9,424.07**	**25.49%**
其中：香港木林森	-	-	11,699.30	26.30%	7,664.43	20.73%
合计	**78,155.49**	**100%**	**44,491.56**	**100%**	**36,977.31**	**100%**

4、向前五名主要客户销售情况

年度	客户名称	金额	占主营业务收入比重
2010 年度	中裕电器（深圳）有限公司	5,211.25	6.67%
	协顺电器（赣州）有限公司	3,322.38	4.25%
	中山格兰仕工贸有限公司	3,191.89	4.08%
	固邦(东莞)电器有限公司	2,502.06	3.20%
	东莞苏扬灯饰有限公司	2,501.23	3.20%
	合 计	**16,728.81**	**21.40%**
2009 年度	香港木林森	11,699.30	26.30%
	中山市天博商贸有限公司	5,704.02	12.82%
	广东省中山水产进出口有限公司	2,816.78	6.33%
	佛山市顺德格兰仕工贸有限公司	1,335.88	3.00%
	中山格兰仕工贸有限公司	574.69	1.29%
	合计	**22,130.67**	**49.74%**
2008 年度	中山市天博商贸有限公司	11,006.30	29.77%
	香港木林森	7,664.43	20.73%

	广东省中山水产进出口有限公司	2,605.15	7.05%
	永林	1,435.59	3.88%
	广德利德照明有限公司	1,097.12	2.97%
	合计	**23,808.59**	**64.39%**

上述客户中，永林、香港木林森曾为本公司关联方。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东不存在于上述客户中占有权益的情形。

上述客户中，中山市天博商贸有限公司、广东省中山水产进出口有限公司为本公司的出口商，主要系公司前期外贸人员较少，为简化程序，由专业的出口商办理出口报关业务。

随着出口业务增长，公司聘请了外贸人员，通过香港木林森办理出口业务。香港木林森是公司在 2008-2009 年部分出口业务的窗口，主要是充分利用香港商业发达的贸易环境，便于集中境外客户资源、货款催收等。2010 年以来，由公司直接与最终客户办理出口业务，不再通过香港木林森办理出口业务。

报告期内，前五名最终客户销售情况如下：

单位：万元

年度	客户名称	金额	占主营业务收入比重
2010 年度	中裕电器（深圳）有限公司	5,211.25	6.67%
	协顺电器（赣州）有限公司	3,322.38	4.25%
	中山格兰仕工贸有限公司	3,191.89	4.08%
	固邦(东莞)电器有限公司	2,502.06	3.20%
	东莞苏扬灯饰有限公司	2,501.23	3.20%
	合 计	**16,728.81**	**21.40%**
2009 年度	协顺工艺股份有限公司	3,877.80	8.72%
	东裕电器股份有限公司	3,874.59	8.71%
	苏扬企业（香港）有限公司	2,905.70	6.53%
	佛山市顺德格兰仕工贸有限公司	1,335.88	3.00%
	MK Illumination Handels GmbH	1,117.96	2.51%

	合计	**13,111.93**	**29.47%**
2008 年度	东裕电器股份有限公司	2,199.37	5.95%
	苏扬企业（香港）有限公司	2,177.98	5.89%
	协顺工艺股份有限公司	2,153.65	5.82%
	元美（香港）装饰灯涂装公司	1,613.06	4.36%
	永林	1,435.59	3.88%
	合计	**9,579.65**	**25.90%**

注：东莞苏扬灯饰有限公司、苏扬企业（香港）有限公司为苏扬企业有限公司（台湾）的控股子公司；协顺电器（赣州）有限公司为协顺工艺股份有限公司的控股子公司。

5、产品销售毛利率变化趋势

随着研发技术、生产工艺水平的不断提高，以及 LED 产业市场规模急剧扩大，LED 行业生产成本下降明显，公司毛利率在报告期内呈逐年上升态势。

随着 LED 产业的技术不断成熟，并且国内产业链日益完善，未来毛利率水平呈上升并保持稳定趋势。

（四）主要原材料及能源供应

1、主要产品的原材料

本公司营业成本中，原材料所占比重较高，报告期内原材料占营业成本比重分别为 82.50%、80.24%和 79.35%。公司主要原材料为芯片、支架、焊线材料、胶水及其他辅料等。2009 年开始，公司生产所需原材料支架实现以自产为主，支架的主要原材料为钢带和铜带。

公司主要原材料占营业成本的比重如下表所示：

单位：万元

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	44,699.29	79.35%	27,381.44	80.24%	25,989.88	82.50%
其中：芯片成本	14,291.89	25.37%	9,081.45	26.61%	8,873.78	28.17%
支架	9,868.91	17.52%	6,589.44	19.31%	5,402.64	17.15%

焊线材料	1,757.48	3.12%	1,409.35	4.13%	2,194.33	6.97%
胶水	1,445.98	2.57%	810.09	2.37%	790.71	2.51%
PCB	1,803.94	3.20%	993.02	2.91%	771.81	2.45%
其他	15,531.10	27.57%	8,498.09	24.90%	7,956.61	25.26%

占比=项目/营业成本

公司所使用芯片的主要规格、用途情况如下表：

芯片主要规格	主要用途
红、黄、橙色 7 mil *7 mil	圣诞灯串、指示灯及数码显示 LED
蓝、绿色 7.5 mil *7.5 mil	圣诞灯串、便携式照明（手电筒等）LED
蓝、绿色 7 mil *9mil	圣诞灯串、便携式照明（手电筒等）LED
红色 8 mil *8mil	圣诞灯串、装饰灯 LED
蓝、绿色 8 mil *10mil	户内显示屏 LED
蓝色 8 mil *15mil	便携式照明、广告装饰 LED
红、黄色 9 mil *9mil	户内外显示屏 LED
红、黄色 10 mil *10mil	户外广告装饰灯 LED
蓝色 10 mil *18mil	室内外照明（灯管、球泡等）LED
蓝色 10 mil *23mil	室内外照明（灯管、球泡等）LED

2、主要能源耗用

公司主要耗用能源为电力，随着生产规模的扩大，耗用电力逐年增加，电力价格近几年保持稳定。报告期内，具体耗用电力情况及电力价格如下表：

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额（万元）	单价（元）	金额（万元）	单价（元）	金额（万元）	单价（元）

电力	1,890.04	0.85	1,046.35	0.85	870.35	0.81

3、向前五名供应商采购情况

报告期内，本公司对前 5 名供应商的采购情况如下表所示：

年度	供应商名称	金额	采购内容	占采购总额比例
2010 年度	晶元宝晨光电(深圳)有限公司	9,990.67	芯片	15.61%
	先域微电子技术服务（上海）有限公司	5,937.52	固晶机、焊线机等设备	9.28%
	光磊科技股份有限公司	2,810.12	芯片	4.39%
	贵研铂业股份有限公司	2,152.75	金线	3.36%
	先进自动器材有限公司（香港）	1,524.18	固晶机、焊线机等设备	2.38%
	合计	**22,415.24**		**35.02%**
2009 年度	光磊科技股份有限公司	2,475.83	芯片	7.75%
	晶元宝晨光电（深圳）有限公司	2,190.82	芯片	6.86%
	贵研铂业股份有限公司	1,707.54	金线	5.35%
	心一	1,439.07	Display	4.50%
	深圳宝和林	1,313.46	芯片	4.11%
	合计	**9,126.72**		**28.57%**
2008 年度	先进自动器材有限公司（香港）	3,877.87	固晶机、焊线机等设备	11.85%
	中山宏森	3,212.91	支架	9.82%
	上海蓝宝光电材料有限公司	2,664.22	芯片	8.14%
	贵研铂业股份有限公司	2,106.05	金线	6.44%
	光磊科技股份有限公司	1,624.93	芯片	4.97%
	合计	**13,485.98**		**41.21%**

注：晶元宝晨光电(深圳)有限公司为晶元光电股份有限公司的子公司，先域微电子技术服务（上海）有限公司、先进自动器材有限公司（香港）为 ASM Assembly Automation Limited 的子公司

上述供应商中山宏森和心一曾为本公司关联方。深圳宝和林自 2010 年 9 月

26 日起持有本公司 0.92%股权，深圳宝和林控股股东常宝担任供应商晶元光电子公司晶元宝晨光电（深圳）有限公司的董事长。

除上述情况外，本公司不存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、主要关联方、持有本公司 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情形。

六、环境保护情况

（一）公司的生产经营符合环保标准

LED 产业为国家鼓励的绿色环保产业，公司一直将绿色环保作为战略发展方向，不仅在开发新产品时注重使用环保材料，研究环保工艺，而且在生产经营过程中一直高度重视环境保护工作，采取一系列措施将环保责任落实到个人。公司最近三年根据生产工艺的需要，不断加大环保的投入力度，在各生产基地根据环保要求分别配置了环保处理设施，并已通过环保部门的环保监测，指标达到环保要求。

公司于 2005 年通过了 ISO14001：2004 环境管理体系认证。自 2005 年开始，公司全面执行欧盟 RoHS 指令，已建立 RoHS 保障体系，在物料选择、供应商管理、来料、储存、生产等各个运行环节均按照该体系进行控制，RoHS 保障体系运行有效。2008 年，公司通过欧盟 RoHS 认证，确保了整个生产过程符合环保要求。

公司现有的主要生产基地位于中山市小榄镇木林森大道，项目新建时取得了中山市环境保护局签发的《环境影响报告表的批复》，项目建设完毕后顺利通过了环保验收，取得了中山市环境保护局签发的《关于木林森股份有限公司厂房建设项目一、二、三期竣工环境保护验收意见的函》（中环验表[2010]000639 号）。

中山市环境保护局于 2011 年 1 月 6 日出具证明，确认公司及其控股子公司格林曼、迪博自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间，遵守国家有关环境保护的法律、法规，没有发生环境污染事故和环境违法行为，不存在被环境保护主管部门处罚的情形。吉安市环境保护局于 2011 年 1 月 6 日出具证明，确认子公司吉安木林森近三年来能够依照国家有关环境保护方面的法律、法规的规定进行生产经营，不存在因违反有关环境保护方面的法律、法规受到行政处罚且情节严重的情形。

（二）公司生产过程产生的污染物、污染量及采取的环保措施

从 LED 产业整体来看，由于 LED 封装产品属于节能环保产品，其生产过程不存在高污染的情况，公司产生的主要污染物为废水、固体废弃物和噪音。为有效治理污染，公司制定了多项环保措施治理：

1、废水

公司产生的废水主要为生产废水、生活废水和废有机溶剂。公司每天排放的生产废水、生活废水共计 150 吨左右。生产废水经公司由专用管道排至有资质的污水处理厂进行再次处理后排放；公司排放的生活废水不含任何可能对环境造成重大影响的有毒有害物质，通过公司在厂区修建的化粪池排入市政管网，由有资质的污水处理厂进行处理，不会对环境造成任何不良影响。废有机溶剂系公司于生产过程中清洗生产设备所产生，每年约 10 吨，公司在生产车间中设置专门的存放室存放，并配备专人管理，每季度转移给公司聘请的深圳市东江环保股份有限公司进行回收处理。

2、固体废弃物

公司生产过程中所产生的固体废弃物为产品生产中产生的边角料。公司每年因生产而产生边角料约 60 吨，由公司在生产车间中设置专门的存放室存放，并配备专人管理，每周变卖给专业的废品回收公司进行回收处理。

3、噪音

公司生产过程中产生的噪音主要来自于生产设备，因此，公司在所有生产设备底部都放置附震垫，减小设备产生的震动噪音；并将噪音较大的冲压设备安装在专门的隔音室中独立工作，降低噪音对环境的影响。此外，公司设有专门的监测部门每年对生产过程产生的噪音进行监测，出具噪音检测报告并存档，确保噪音符合国家现行的 GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》的要求。

（三）公司聘请专业环保公司进行污染物处理

公司生产经营产生的废弃物经过妥善处理，不会对环境产生不良影响。公司已与深圳市东江环保股份有限公司（下称“东江环保”）签订合作协议，向东江环保支付相关费用，在获得广东省中山市环境保护局批准之后，将生产经营过程中产生废有机溶剂定期交由东江环保处理。

东江环保是一家专业从事废物管理和环境服务的企业，拥有危险废物经营许可证，并通过了 GB/T19001-2000 ═ ISO9001：2000 质量管理体系认证、ISO14001 认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证。

（四）吉安木林森的环保情况

本公司控股子公司吉安木林森主要生产 Lamp LED 产品，生产期间主要产生噪声、废水和固体废弃物，没有废气污染。2008 年 3 月 20 日，江西省环保监察局进行环保核查时发现，吉安木林森在向江西省环境保护厅报送的环境影响评价文件尚未获得批准的情况下于 2008 年 3 月 15 日将相关生产项目投入试生产且相关环保设备未同时投入试生产。因前述在环境影响评价文件尚未获批情况下进行试生产，吉安木林森于 2008 年被江西省环境保护厅处以罚款 5 万元；并因相关环保设备未同时投入试生产而产生外排废水中污染物超标问题，吉安木林森于 2009 年被吉安市环境保护局处以罚款 5 万元。

在受到环境保护主管部门的行政处罚后，吉安木林森及发行人管理层高度重视，组建了以吉安木林森总经理为首的“环保治理领导小组”领导吉安木林森的环境治理工作，并由主管环保的副总经理全程负责相关整改工程，现已累计投入用于环保的资金共计 179.96 万元。此后，吉安木林森向江西省环境保护厅重新报送了环境影响评价文件。目前，相关的环境影响评价手续已经办理完毕，环保设施也全部投入运行并通过了验收，并且，在吉安市环境保护厅此后对吉安木林森进行的多次环境监测中，吉安木林森均不存在排放超标的情况。

根据吉安市环境保护局出具的证明文件，吉安木林森上述行为未对环境造成严重污染和损害，上述行为不属于重大违法行为。根据江西省环境保护厅出具的证明，吉安木林森在受到处罚后重新报送了环境影响评价文件，相关的环境影响评价手续已经办理完毕，环保设施也全部投入运行并通过了验收。江西省环境保护厅认为吉安木林森上述行为未造成污染后果。

保荐人认为，吉安木林森的环保违法行为不构成重大违法行为，不会对本次发行上市构成实质障碍。

发行人律师认为，上述两宗行政处罚事项涉及的金额较小，且未造成严重的后果，因此不属于情节严重的违法行为，不会对本次发行构成实质性的法律障碍。

（五）募投项目所采取的环保措施

募投项目系对公司 Lamp LED 产品、SMD LED 产品、LED 应用产品以及研发中心的技术改造，中山市环境保护局已对募投项目出具了审查批复意见，同意公司实施募投项目。各募投项目均不排放生产废水、危险废物；各募投项目产生的固体废弃物、噪音等污染物仍将采用公司生产经营中现已实施的环保措施处理。

七、与公司业务相关的主要资产

（一）主要固定资产

1、主要固定资产情况

公司的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。截至2010年12月31日，公司主要固定资产账面原值为49,156.50万元，累计折旧5,634.45万元，固定资产净值43,522.05万元，具体情况如下：

单位：万元

类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋建筑物	17,168.17	144.49	17,023.68
机器设备	30,609.34	4,920.06	25,689.27
运输工具	626.51	217.00	409.51
办公设备及其他	752.49	352.90	399.59
合计	49,156.50	5,634.45	43,522.05

2、房产及土地

（1）发行人拥有的土地使用权

发行人拥有的土地使用权如下：

序号	证号	位置	面积（M^2）	终止日期
1	中府国用（2010）第 051709 号	中山市小榄镇木林森大道 1 号	70,696.60	2059-06-20
2	中府国用（2010）第 290177 号	中山市五桂山龙石村	36,895.70	2056-06-20
3	中府国用（2010）第 290178 号	中山市五桂山龙石村	3,104.30	2056-06-20

4	中府国用（2010）第 290179 号	中山市五桂山龙石村	1,449.80	2056-06-20
5	中府国用（2010）第 290180 号	中山市五桂山龙石村	23,440.00	2056-06-20
6	中府国用（2011）第 0501166 号	中山市小榄镇联丰村	44,048.30	2061-04-22

发行人中府国用（2010）第051709号国有土地使用权已办理抵押登记，为发行人拟从平安银行股份有限公司中山分行获得综合授信额度40,000万元的债权提供担保。

发行人中府国用（2010）第 290177 号、第 290178 号、第 290179 号、第 290180 号国有土地使用权已办理抵押登记，为发行人拟从兴业银行股份有限公司中山分行取得的贷款提供担保。

发行人拥有的房屋所有权如下：

证号	位置	建筑面积（M^2）
粤房地权证中府字第 0110013957 号	中山市小榄镇木林森大道 1 号	10,335.97
粤房地权证中府字第 011001454 号	中山市小榄镇木林森大道 1 号	57,366.47
粤房地权证中府字第 011001455 号	中山市小榄镇木林森大道 1 号	94,462.48

2011年3月18日，发行人与平安银行股份有限公司中山分行签订《最高额抵押合同》，发行人将其所拥有的粤房地权证中府字第0110013957号房产、粤房地权证中府字第011001454号房产、粤房地权证中府字第011001455号房产作为抵押，为其与该行签订的《综合授信额度合同》项下综合授信额度40,000万元的债权提供担保。

（2）发行人控股子公司拥有的土地使用权及房屋所有权

吉安木林森拥有的土地使用权如下：

序号	证号	位置	面积（M^2）	终止日期
1	吉高新国用（2006）第 I-015A 号	君山大道以南	1,838.00	2053 年 5 月
2	吉高新国用（2003）第 I-015 号	君山大道南侧	11,142.40	2053 年 5 月
3	吉高新国用（2003）第 I-016-A 号	京九大道北侧	17,920.68	2053 年 5 月
4	吉高新国用（2003）第 I-016-B 号	京九大道北侧	29,311.20	2053 年 5 月

5	吉高新国用（2006）第 I-076 号	君山大道南侧、建设大道北侧	22,464.20	2053 年 3 月

吉安木林森拥有的房屋所有权如下：

序号	证号	位置	建筑面积（M^2）
1	房权证吉市高第 A0078 号	吉安市高新区君山大道南侧	4,275.00
2	房权证吉市高第 A00107 号	吉安市高新区君山大道南侧	1,320.00
3	房权证吉市高第 A00092 号	吉安市高新区君山大道南侧	5,685.60
4	房权证吉市高第 A00147 号	吉安市高新区君山大道南侧	1,320.00
5	房权证吉市高第 A00099 号	吉安市高新区君山大道南侧	4,201.20
6	房权证吉市高第 A00108 号	吉安市高新区君山大道南侧	6,912.00

2011年3月16日，吉安木林森与中国建设银行股份有限公司吉安支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：XC建赣庐高抵2011－009）。根据该合同，吉安木林森将上述5项国有土地使用权、6项房屋所有权及部分机器设备作为抵押，为吉安木林森在2011年3月16日至2012年3月16日期间从中国建设银行股份有限公司吉安支行取得的2500万元贷款及承兑汇票贴现提供担保。

3、房屋、土地使用权的租赁情况

承租方	出租方	房屋坐落	出租面积（M^2）	年租金（元）	租赁期限
迪博	苏永盛、余玉辉	中山市石岐区海景路 15 号三楼	1,102.32	114,336.00	2009-11-01 至 2011-10-30
威莱森	黄少颜	中山市火炬区歧濠路 108 号 42 卡	56.17	6,000.00	2010-12-01 至 2013-12-01
格林曼	叶桂芳	中山市西区沙朗名流路	9,230.83	924,000.00	2006-01-01 至 2011-12-31
安格森	上海石化地区粮油食品综合	上海市金山区石化地区松南支路	24.00	12,000.00	2005-02-24 至 2015-02-23

	经营贸易部	48 号-569 座			
台州元泽	台州市风泰工贸有限公司	台州经济开发区东海大道 88 号	786.00	145,908.00	2011-01-16 至 2014-01-15
鄞州振杰	宁波市鄞州百川电器厂	宁波市鄞州区集士港镇丰城村	1,200.00	132,920.00	2011-03-01 至 2013-02-28

（二）主要无形资产

1、专利和非专利技术

（1）发行人拥有的专利

本公司已获得授权专利20项，其中实用新型专利16项，外观设计专利4项。

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请时间
1	一种LED两件套全彩点阵模组	ZL200920157645.0	实用新型	2009-5-27
2	一种LED照明电路	ZL200720054739.6	实用新型	2007-7-27
3	一种由LED灯组成的灯泡	ZL200720056132.1	实用新型	2007-8-20
4	LED灯泡	ZL200720056133.6	实用新型	2007-8-20
5	一种光电元件	ZL200720059783.6	实用新型	2007-11-15
6	一种LED灯串控制器	ZL200820178607.9	实用新型	2008-11-4
7	一种光电元件	ZL200820178608.3	实用新型	2008-11-4
8	整流发光二极管装置	ZL200820180490.8	实用新型	2008-12-3
9	一种三合一全彩食人鱼LED灯	ZL200920237325.6	实用新型	2009-10-11
10	一种螺旋式高亮LED灯	ZL201020159123.7	实用新型	2010-4-8
11	由LED灯组成的灯泡	ZL200720056134.0	实用新型	2007-8-20
12	LED发光二极管	ZL200930088901.0	外观设计	2009-9-10
13	LED灯(MLS-Daylight M901)	ZL200730059809.2	外观设计	2007-7-10
14	LED灯(MLS-Starlight G301)	ZL200730059808.8	外观设计	2007-7-10
15	LED灯(C301)	ZL200730059811.X	外观设计	2007-7-10

16	一种敞开式吊装箱体	ZL200920261058.6	实用新型	2009-12-7
17	LED电子显示屏模组结构	ZL 200920261059.0	实用新型	2009-12-7
18	一种可发光的LED灯串控制器	ZL 201020204045.8	实用新型	2010-5-26
19	一种内嵌芯片式电阻发光二极管	ZL 201020292621.9	实用新型	2010-8-12
20	支架（通用型3528-12）	ZL 201030543470.5	实用新型	2010-9-30

上述第 16、17 项专利系由发行人及其子公司赛维视觉共同所有。

（2）发行人控股子公司拥有的专利

发行人控股子公司格林曼已获得授权专利 18 项，其中实用新型专利 13 项，外观设计专利 5 项。

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请时间
1	一种太阳能灯	ZL200820205748.5	实用新型	2008-12-18
2	一种灯带	ZL200920056806.7	实用新型	2009-5-14
3	全结构防水的LED轮廓灯	ZL200920056306.3	实用新型	2009-5-6
4	一种灯串	ZL200420095960.2	实用新型	2004-12-3
5	一种LED灯带	ZL200520062161.X	实用新型	2005-7-27
6	一种LED灯管的密封堵头	ZL200720049006.3	实用新型	2007-2-26
7	一种带图案的装饰灯	ZL200720048092.6	实用新型	2007-1-27
8	一种灯带	ZL200720050760.9	实用新型	2007-4-20
9	一种彩色LED灯带	ZL200720061848.0	实用新型	2007-12-26
10	一种高防水性的轮廓灯	ZL200820043454.7	实用新型	2008-1-24
11	自闪式灯串或灯带	ZL200720058137.8	实用新型	2007-10-12
12	一种具有旁路保护的灯串	ZL200320119056.6	实用新型	2003-12-8
13	一种LED灯串的灯体组件	ZL200620059602.5	实用新型	2006-5-24
14	节日灯(金童)	ZL200830222950.4	外观设计	2008-12-18
15	节日灯(玉女)	ZL200830222952.3	外观设计	2008-12-18

16	节日灯(中国结)	ZL200830222949.1	外观设计	2008-12-18
17	节日灯(双鱼)	ZL200830222954.2	外观设计	2008-12-18
18	节日灯(蝴蝶)	ZL200830222953.8	外观设计	2008-12-18

（3）非专利技术

本公司非专利技术情况详见本节“主要技术情况”部分。

3、商标

（1）发行人拥有的商标

发行人目前拥有以下 11 项商标：

序号	商标名称	商标注册证编号	注册有效期限	注册类别
1		第 3798287 号	2016-11-27	第 11 类
2		第 6821565 号	2020-10-20	第 11 类
3		第 6821566 号	2020-7-6	第 11 类
4	森霸	第 6821715 号	2020-9-27	第 11 类
5	森泰	第 6821716 号	2020-9-27	第 11 类
6	SML	第 6821717 号	2020-9-27	第 11 类
7	MLS	第 6821718 号	2020-7-6	第 11 类
8	SML	第 6821568 号	2020-7-6	第 9 类
9	森泰	第 6821569 号	2020-11-6	第 9 类

10	森霸	第 6821570 号	2020-11-6	第 9 类
11	MLS	第 7145579 号	2020-9-20	第 37 类

发行人的控股股东、实际控制人孙清焕目前拥有以下 5 项商标：

序号	商标名称	商标注册证编号	注册有效期限	注册类别
1	MLS	第 3695098 号	2015-7-6	第 9 类
2	MLS	第 3201884 号	2014-2-20	第 9 类
3	MLS 木林森	第 3798306 号	2015-10-20	第 9 类
4	木林森	第 3201887 号	2014-2-20	第 9 类
5	MLS	第 3798288 号	2015-10-20	第 9 类

截至本招股说明书签署日，发行人与孙清焕已就上述 5 项商标与孙清焕签订《商标使用许可合同》，约定在该等商标的有效期内，孙清焕授权发行人无偿使用该等商标。孙清焕与发行人已就其无偿向发行人转让上述 5 项商标签署转让协议，且相关申请文件已经提交国家工商行政管理总局商标局。

经查询国家工商行政管理总局商标局主办的中国商标网信息，截至本招股说明书签署日，以上 5 项商标已转让至本公司前身木林森电子有限公司，变更至本公司的转让手续仍在办理过程中。

（2）发行人拥有的境外商标

发行人拥有以下 2 项香港注册商标：

序号	商标名称	当地注册号	类别	权利期限

1		301229184	第 11 类	2008/10/29-2018/10/28
2	MLS	301229175	第 11 类	2008/10/29-2018/10/28

发行人的控股股东、实际控制人孙清焕拥有以下 2 项马德里注册商标：

序号	商标名称	马德里商标国际注册号	已发出保护通知的缔约国	类别	权利期限
1		968662	澳大利亚、英国、日本、新加坡	第 11 类	2008/06/24-2018/06/24
2	MLS	969039	澳大利亚、英国、新加坡	第 9 类	2008/07/01-2018/07/01

截至本招股说明书签署日，发行人与孙清焕已就上述 2 项商标与孙清焕签订《商标使用许可合同》，约定在该等商标的有效期内，孙清焕授权发行人无偿使用该等商标。孙清焕与发行人已就其无偿向发行人转让上述 2 项商标签署转让协议，且相关申请文件已经提交商标管理部门。

根据国家工商行政管理总局商标局签发的《商标国际注册收费通知单》及相关缴付办理费用的财务凭证，上述 2 项商标的转让申请已由国家工商行政管理总局商标局受理，公司已缴纳上述 2 项商标的转让费用。按照相关程序，该等转让费用在国家工商行政管理总局商标局收到后将由其转交国际局。截至本招股说明书签署日，上述 2 项商标的转让手续仍在办理过程中。

（3）发行人控股子公司拥有的商标

发行人控股子公司格林曼目前拥有以下 1 项商标：

序号	商标名称	商标注册证编号	注册有效期限	注册类别
1	格林曼	第 4986524 号	2019-2-20	第 11 类

4、公司所获主要荣誉

序号	资质	授予单位	授予时间
1	文明单位	中共中山市委、中山市人民政府	2005-12-1
2	中山市劳动保障守法诚信 A 级企业	中山市劳动和社会保障局	2006-5-1
3	市级企业技术中心	中山市人民政府	2006-12-1

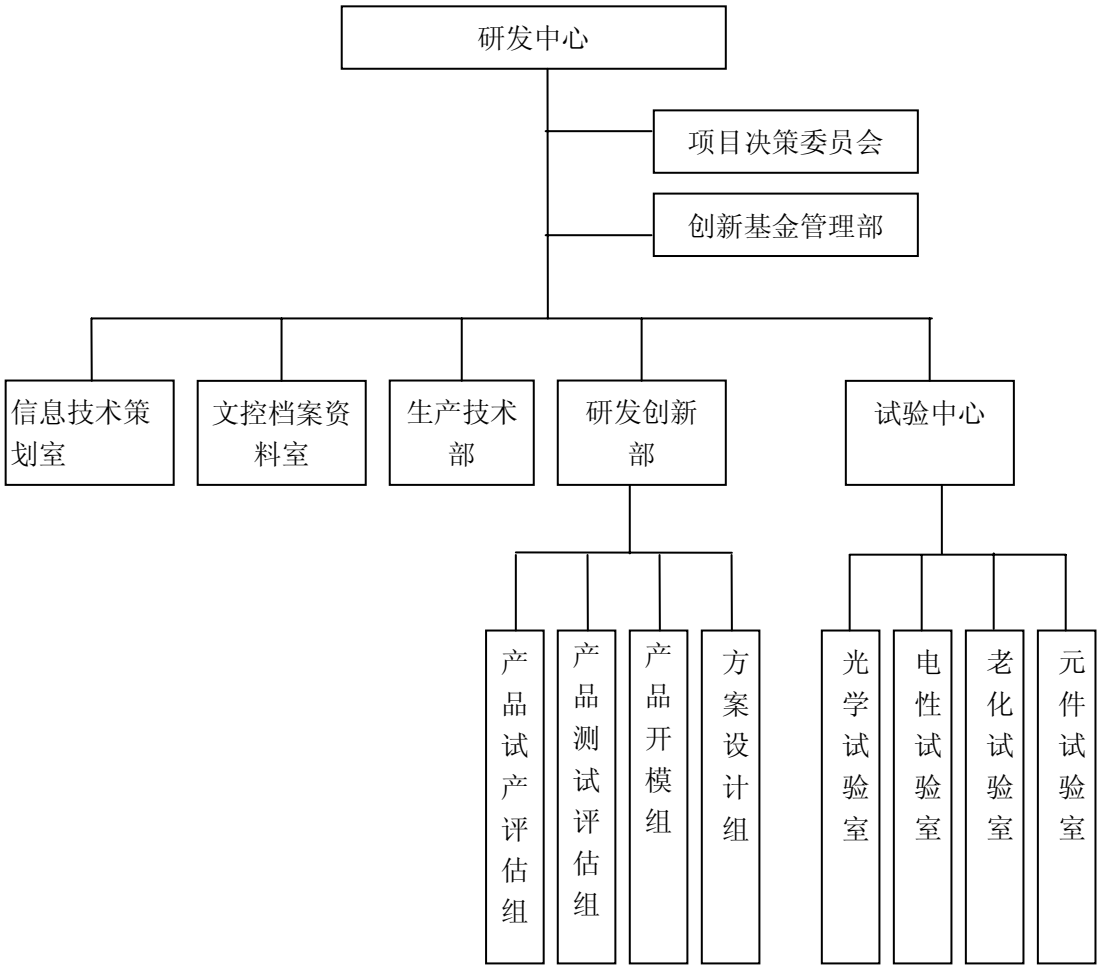
4	中山市装备制造业重点企业	中山市人民政府	2006-12-1
5	广东省名牌产品	广东省质量技术监督局	2007-9-1
6	最受欢迎品牌	广东省照明电器协会	2007-12-1
7	诚信公约会员单位	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2008-4-12
8	广东省著名商标	广东省工商行政管理局	2008-12-1
9	高新技术企业	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2008-12-16
10	广东省重大科技专项实施单位	广东省科学技术厅	2009 年
11	优秀企业	中山市照明电器行业协会	2009-12-1
12	2010 年度格兰仕集团核心供应商	广东省格兰仕集团有限公司	2010-2-1
13	先进单位	中山市安全生产监督管理局	2010-3-1
14	广东省诚信示范企业	广东省企业协会、广东省企业家协会	2010-4-20
15	广东省制造业百强企业	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2010-7-1
16	广东省企业 500 强	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2010-7-1
17	中山市“十大创新企业”	中山市科学技术局、中共中山市委宣传部	2010-7-1
18	广东省守合同重信用企业	中山市工商行政管理局	2010-7-20
19	中山市民营科技企业	中山市科学技术局	-
20	广东省 LED 产业联盟会员单位	广东平板显示产业促进会	-

八、主要技术情况

（一）研发机构设置

公司拥有独立的研发机构，建立了完善的研发体系。公司设生产技术副总经理 1 名，主管公司科技项目设计和开发、技术改造等工作；并设立项目决策委员会和创新基金管理部，分别负责对公司产品技术创新、研发方向等提出决策意见和研发费用的预算、运作及研发人员的考评等。公司具体研发工作由研发中心完成，研发中心下设试验中心、研发创新部、生产技术部、文控档案资料室及信息技术策划室等。

公司研发机构设置情况如下图所示：



研发中心及下属部门职责如下：

（1）研发中心：组织实施新技术及新产品的具体研发工作；对新产品进行验证测试，进行跟踪、及时改进；组织制定新产品的技术规范及产品工艺方案；负责产品及技术的知识产权管理；负责公司产品技术认证、生产测试规范等制定

和管理工作；负责公司产品的注册及维护，产品计量等涉及产品市场化的规范工作；负责对外技术交流及公司科技项目的政府申报工作。

（2）试验中心：主要有光学试验室、电性试验室、老化试验室、元件试验室。

（3）研发创新部：负责研发新产品新技术以及各项工程设计，具体负责普通发光二极管研发、白光发光二极管研发、大功率发光二极管研发、灯饰产品 LED 研发、芯片材料切割技术研发，并相应成立了研发小组。

（4）文控档案资料室：主要负责工程研发技术资料和档案管理。

（5）生产技术部：负责设计开发后，向批量生产转化时做需要的生产技术准备工作，并准备产品的售后服务工作。

（6）信息技术策划室：主要负责研发信息的收集、整理、提供有效的开发信息以及前期的技术筹划和开发计划。

报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生重大变动。

（二）研发流程

1、需求规划

信息技术策划室收集需求信息（包括产品功能要求、外观及使用条件等），进行需求分析，将需求信息整理并会同创新基金管理部对研发项目经费进行预估，形成《项目研发可行性报告》后文档提交项目决策委员会申请立项。

2、立项

项目决策委员会审核《项目研发可行性报告》，批准立项后，信息技术策划室输出《立项项目研发指令》，经研发中心经理及负责技术研发的副总经理审批后分发研发创新部实施项目研发工作。

3、研发方案设计

研发创新部收到立项通过信息后向下属机构方案设计组下达研发指令，方案设计组根据研发指令对研发所需原材料、设备进行预估并出具《研发方案设计书》，将设计好的研发方案交产品开模组。

4、样品开发制作

产品开模组根据设计方案对原材料、设备进行采购并反馈至试验中心品管部元件试验室，经试验测试原材料合格后，反馈回产品开模组。产品开模组进行产品的初步开发，并掌握开发进度，确定开发样品的各外形尺寸、性能后提交生产技术部进行样品制作。

5、新开发样品检测及中试

生产技术部在进行样品制作的同时产品测试评估组对开发生产过程按照相关规定进行严格管控，并将样品送至试验中心进行光学、电性、老化试验，试验中心将试验结果信息汇总后反馈至产品开模组及生产技术部。产品开模组及生产技术部沟通之后对样品性能样式进一步优化后进行中试。

6、新产品试产

中试合格后，产品试产评估组负责召开试产会议并会同产品测试评估组及生产技术部检讨样品开发过程中的问题，试产评估组对研发过程提出改善意见。产品试产评估组对改善后的样品检测无误后交生产技术部进行小批量试产。

7、验收

小批量试产后，经产品试产评估组检测合格，研发创新部向项目决策委员会递交《研发项目验收申请》，并提供样品，对反馈意见及问题进行总结处理。项目决策委员会对项目进行审核，查看产品的具体参数及生产工艺，审批是否达到验收要求。

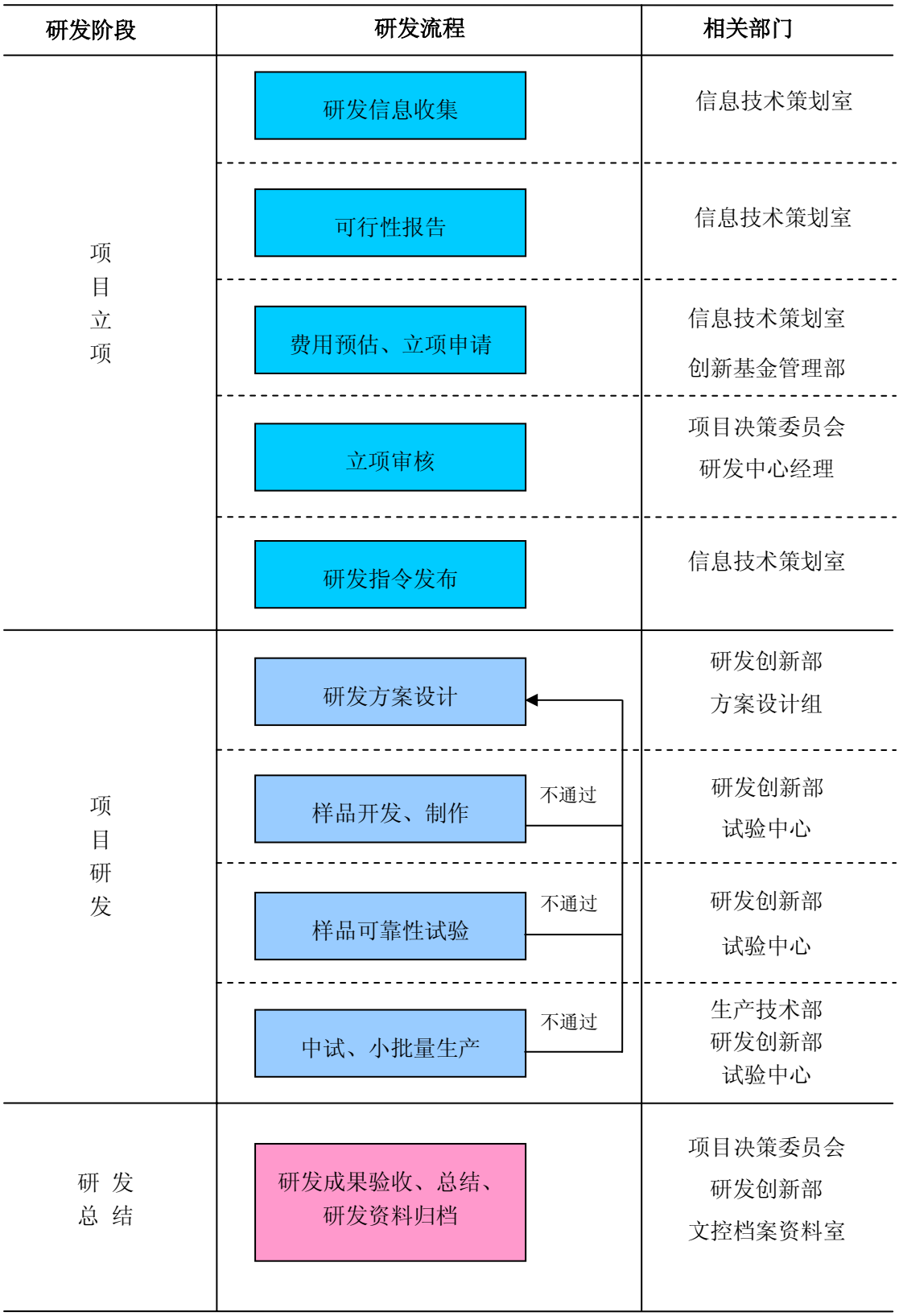
8、研发资料管控

文控档案资料室对研发生产全过程中的重要数据进行跟踪收集并加以整理归档。

9、项目总结

研发创新部在项目试产通过后，拟定《××产品制程管控》，经项目决策委员会审核后报送研发中心经理审批；总结项目进度、质量、成本及经验数据，文控档案资料室与研发创新部联合出具《研发项目总结报告》归档留底。

本公司研发流程图如下所示：



（三）主要技术研发成果

在 LED 封装及应用领域中，发行人通过自主研发取得了一系列技术成果，在行业内树立了良好的品牌形象，影响力较强。经过多年的技术和产品创新，发

行人及其子公司拥有已获授权的专利共计 38 项。公司 LED 封装产品在技术上处于国内领先水平，并拥有相应的自主知识产权。

（四）研发方向与正在进行的研发工作

目前公司正处于研发阶段或已研发完成但尚未转换为产品大批量生产的技术主要包括：

名称	项目简介	拟达到目标	所处阶段
高性能光学硅胶	采用新型的技术、原材料国产化研发高性能光学硅胶，使封装产品整体成本下降。	研制光学级别硅橡胶，用于大功率 LED 或其他低光衰 LED 灌封；提高透光率，特别是自带粘性硅胶的透光率。	研发阶段
大功率 LED 硅胶液态模顶技术	作业中除上下料工序外，其他工序全程自动化作业，人工干预少，产品产量高、品质好。	大功率 LED 封装流程自动化作业。	研发阶段
SMD 用高 Tg 点胶水	SMD 用高 Tg 点胶水研发，采用新技术、原材料实现国产化，以降低产品成本。	耐高温黄变、胶水和支架的结合性要好。	研发阶段
IRM 环氧树脂液态模顶技术	可采用价格较低的环氧树脂代替胶饼封装，使产品成本有效降低。	眼珠型 IRM 自动化生产线导入。	研发阶段
SMT 白光数码管导入生产	白光数码管基本是封装荧光粉和表贴 SMD 再封装，通过采用表贴 SMD 封装工艺生产。	自动化表贴 SMD 生产线导入。 掌握回流焊变温曲线。	完成研发，样品小批量生产中

红外光电耦合器产品开发	市售产品基本是胶饼模顶封装，成本较高，通过采用环氧树脂封胶，能降低产品成本，便于推广。	自动化红外光电耦合器产品生产线导入。封装工艺流程自动化。	支架图纸设计中
高密度大功率支架开发	市面用 1W 大功率支架间距大，颗粒少，通过设计高密度新型支架，间距小，效率高。	成功设计高密度大功率支架，使其单位成本最低。	完成研发，样品小批量生产中
高密度 45 连体 LED 支架开发	市面用 LED 直插支架间距大，颗粒少，通过设计高密度新型支架，间距小，效率高。	成功设计高密度大功率支架，使其单位成本最低。	完成研发，样品小批量生产中
高密度 SMD 支架开发	市面用 SMD 支架间距大较大，颗粒较少，我司设计高密度新型支架，间距小，效率高。	使支架间距合理最小化，提升支架生产率，减小封装上下料时间；	完成研发，样品小批量生产中
高压 AC LED 开发	传统 LED 的使用电压较低，接上市电使用一般需要加上降压、限流等电子元件后方能正常使用，而开发的此款 LED 是不用任何外接电子元件，接上市电即可使用。	邦定的稳定性、不良品返修的速度	完成论证，样品制作中
功率型集成式路灯模组自动化生产线	人工插件效率低容易出错，通过使用自动化作业流水线，全程自动化，人工干预少，效率高。	功率型集成式路灯模组自动化生产线的导入。	编写《可行性报告》中

多晶集成式大功率自动化生产线	集成化产品要求较高，人手无法生产，需导入自动化生产。	芯片距离的一致性；邦定质量的控制。	编写《可行性报告》中
高效率 LED 荧光粉	市售荧光粉辉度一般 120-150%，开发 200%以上辉度的荧光粉，提升 LED 的亮度。	荧光粉晶体排列结构对亮度的影响。	编写《可行性报告》中
连体食人鱼支架开发	市面用食人鱼支架间距大，颗粒少，设计高密度新型支架，间距小，效率高。	支架间距合理化。	完成研发，小批量生产中
照明用低光衰 SMD 自动化生产线	SMD 照明市场巨大，单靠手工操作无法满足需求，通过导入自动化生产线以提高产能。	照明用低光衰 SMD 自动化生产线的导入。	编写《可行性报告》中

（五）报告期内研发投入情况

为保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和技术的领先水平，公司每年投入大量资金用于研究开发。公司的研发费用主要包括：研发中心人员工资、研发设备仪器折旧费、研发耗材、新产品试制费等支出，其占母公司营业收入比例如下表：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发费用（万元）	2,064.46	1,214.09	1,298.18
母公司营业收入（万元）	64,094.09	39,947.40	32,147.28
占营业收入比例	3.22%	3.04%	4.04%

（六）保持持续研发能力的主要举措

1、完善用人机制

公司根据自身业务和技术发展的需要，不断采取有效措施，与高校合作培养人才和吸引社会优秀人才，强化科研队伍的人才工程建设。在人事管理上，研发

人才作为公司重要人力资源，享受在评选晋升、利益分配、教育培训、福利保障等各方面的优惠。公司注重对员工的培训和再教育，并创造和提供条件，组织管理人才、技术骨干与同行交流和考察，提高员工的业务素质。近年来公司建立了各项规范的管理制度，努力营造一个支持创新、激励创新、保护创新的良好氛围和环境，最大限度地调动技术创新积极性，促使企业技术创新资源得以发挥最大效应。

2、提供资金保障

为确保公司的创新能力和技术优势，公司将逐年增加研发投入，以满足公司在技术创新及研发项目上的需要。

3、实行激励政策

根据公司规定，凡在产品创新及工艺流程创新上有独到之处并能取得一定经济效益的皆属创新成果，成果经评估后可获得公司奖励，按效益大小给予不同奖金额度。公司制定并实施了对研发成果完成人员做出突出贡献的人员给予重奖的各类措施，提高了研发人员技术创新的积极性。

4、加强外部合作

公司始终注重技术研发交流与对外合作，与中山大学、中国科学院半导体研发中心等全国著名高等院校、研究机构建立了良好的合作机制，在人才培养、技术攻关、科技成果转化，产业化实施等领域形成了深入的合作。

（七）关键技术的保密情况

公司全体涉密研发人员均签署了保密协议，员工对工作中所获知的公司机密，承担保密责任。

项目研发过程中，研发人员组成的项目小组对研发项目技术资料的保密负责，研发人员不得将阶段性研发成果的书面版或电子版本文件携带出研发实验室，研发的阶段性成果严禁对外公布。

公司支持研发人员与国际国内专业研究机构、技术专家学习、沟通、交流，并鼓励研发人员在专业期刊上发表技术论文，但所有的技术论文均需对关键技术点进行屏蔽，并需经过领导团队审查方可发表。

九、质量控制情况

（一）质量控制标准

本公司于 2004 年成功通过了 ISO9001:2000 质量保证体系认证；公司根据产品用途、销售区域的要求，分别通过了 UL、CE、CCC 等多项认证。

公司严格执行国家质量法律法规《中华人民共和国产品质量法》，并在公司内部制定了一系列相关标准以保证产品质量。

公司内部产品标准有：

标准编号	标准适用范围
Q/MULS 01—2010	规定了片式白光发光二极管(LED)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存
Q/MULS 02—2010	规定了半导体功率型发光二极管(LED)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存
Q/MULS 03—2010	规定了半导体蓝色发光二极管(LED)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存
Q/MULS 04—2010	规定了半导体红色发光二极管(LED)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存
Q/MULS 05—2010	规定了半导体绿色发光二极管(LED)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存
Q/MULS 06—2010	规定了全彩点阵系列数码显示模组的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存

通过建立完善产品质量体系和标准，确保公司在产品质量方面始终保持良好的控制水平。鉴于优秀的产品质量，近年来公司与格兰仕、美的、创维、TCL 等家电企业建立了较好的合作关系，并且被格兰仕确定为 2010 年核心供应商。

（二）质量控制的措施

公司推行全面、全员、全过程的质量管理，建立了覆盖供应商管理、原材料检验、生产过程控制、成品出厂把关检验及售后服务全过程系统化质量管理体系。

1、供应商管理

公司对原材料的采购质量严格把关，对供应商严格考核，符合公司要求则具备供货资格。公司品保部对采购的原材料进行严格抽检，不符合要求的原材料一

律通知相关部门退回供应商。

2、实施标准化上岗制度

公司对每个岗位的生产员工，从来料检验的品质人员，到生产过程的作业人员，都制定了相关的岗位职责及标准，新员工必须进过一个月的培训，取得上岗证之后方可正式上岗。正式上岗后，生产部技术人员不定期给作业员进行技能培训，以巩固和加深其操作技能和专业知识。

3、制程管控

公司在每个生产环节都设立了质控点，在生产过程中，实行作业员自检、PQC抽检、主管巡检的制度，对于生产前的机台状况、生产出的不良品都进行的严格监控，本单位的产品合格之后方可进入下一道工序，以确保产品的可靠性。

4、产品出厂检验

公司有专门的设备对产成品进行分类处理，对于同一种类不同规格的产品进行分类标识，区分摆放。产品入库之前都必须进过包装检验和入库检验两级检验单位抽检，确保无不良品入库。

5、配备先进的检测设备

公司在生产线和质量管理部门都配备了先进的检测设备，如管芯推力计、金线拉力计、金球推力计、环氧树脂 Tg 点测试仪、LED 光电参数测试仪、LED 芯片测试仪等。

6、建立品保试验室

公司建立了品保试验室，配备了高低温存贮、冷热冲击和寿命点亮器等设备，按照相关的企业标准要求定期对产品进行相关可靠性试验。同时，根据客户要求研发的新型产品都需经过实验室检验合格之后，才销往客户，确保出厂产品满足客户的要求。

（三）质量控制结果与产品质量纠纷

公司严格执行国家有关质量、计量法律法规，产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求，质量稳定可靠，报告期内不存在因产品质量而引起的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

第七节　同业竞争和关联交易

一、同业竞争

（一）本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

孙清焕持有本公司 11,661 万股股份，占本公司发行前总股本的 88.92%，系本公司控股股东和实际控制人。

根据本招股说明书“第五节 发行人基本情况”的“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”中的“（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业”的相关内容，公司控股股东和实际控制人控制的昌浩、森森、森益隆、中山宏森、汇海均已停止经营并完成工商注销，不存在与本公司同业竞争的情况。

因此，公司控股股东和实际控制人控制的其他企业均不存在与本公司进行同业竞争的情况。

（二）本公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为保障本公司及本公司其他股东的合法权益，本公司控股股东、实际控制人孙清焕向本公司出具避免同业竞争的承诺函，承诺如下：

本人及本人控制的企业不会直接或间接从事与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何活动。

对于本人及本人控制的企业将来因收购、兼并或其它方式增加的与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，股份公司有优先购买该等资产、业务的权利。

本人及本人控制的企业拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，股份公司有优先购买该等资产、业务的权利。

二、关联方和关联关系

（一）存在控制关系的关联方

名称	与本公司关系
孙清焕	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
吉安木林森、格林曼、迪博、威莱森、赛维视觉	本公司控股子公司
安格森、台州元泽、鄞州振杰、森安	本公司全资子公司
广州木林森	曾是本公司控股子公司，已于 2008 年 12 月注销

广州木林森主要从事 LED 封装及应用产品的生产及销售，已于 2008 年 12 月 31 日经广州市工商行政管理局番禺分局核准注销登记。广州木林森注销前的注册资本为 200 万元，木林森有限、孙清焕及王子能分别持有其 70%、15%及 15%的股权。

（二）不存在控制关系的关联方

关联方	与本公司之关联关系
林文彩	董事
郑明波	董事、副总经理
易亚男	董事、副总经理、财务总监
李冠群、刘天明、林玉陕	监事
赖爱梅	副总经理、董事会秘书
周立宏	副总经理
罗萍	实际控制人孙清焕之配偶
王招娣	董事林文彩之配偶
榄芯实业	实际控制人孙清焕担任执行董事
昌浩、森森、森益隆、中山宏森、汇海	实际控制人孙清焕控制的其他企业，已注销
倍森、汇森、林森、安林、厦门木林森、永光、永林、怡德精密	曾经由实际控制人孙清焕控股或参股，已转让予无关联第三方
宁波木林森、香港木林森、南昌宏森、翔光、润森	曾经受实际控制人孙清焕控制，已注销
美明	曾经由董事林文彩控股，已转让予无关联第三方
日月明	由监事李冠群控股，已注销
纬源	由监事林玉陕参股，已注销

森隆	曾经由赖爱梅参股，已注销
源森	曾经由罗萍控股，已转让予无关联第三方
海盛、光磊	由罗萍控股，已注销
吉源	曾经由王招娣控股，已注销
心一	曾经由王招娣参股，已注销

1、已注销的企业

单位：万元

序号	名称	成立日期	注册资本	主要业务	关联关系	完成注销时间
1	中山宏森	2007-9-18	500	电子元件的生产与销售	孙清焕持有51%股权	2011-01-26
2	宁波木林森	2006-7-6	150	LED 封装及应用产品的生产、销售	孙清焕曾持有 51%股权	2010-11-30
3	南昌宏森	2004-3-22	240	五金交电、金属材料批发、零售	孙清焕曾持有 41.67%股权	2010-12-01
4	昌浩	2006-4-24	50	LED 封装及应用产品的生产与销售	孙清焕持有70%股权	2011-01-24
5	心一	2006-10-12	100	LED 应用产品的生产销售	王招娣曾持有 39%股权	2011-02-18
6	森森	2009-10-21	500	LED 应用产品的开发、生产及销售	孙清焕持有 60%股权	2011-03-15
7	森益隆	2009-10-19	100	LED 应用产品的开发、生产及销售	孙清焕持有80%股权	2011-03-16
8	海盛	2000-9-22	52	光电产品、电子元器件的销售	罗萍持有50%股权	2011-03-21
9	纬源	2005-12-8	50	电子五金及塑料制品的销售	林玉陕持有49%股权	2011-03-21
10	光磊	2005-6-13	50	电子元器件的销售	罗萍持有60%股权	2011-03-21
11	日月明	2006-8-22	100	LED 器件的生产销售	李冠群持有60%股权	2011-03-21
12	翔光	2006-4-26	50	LED 发光系列产品的销售	孙清焕曾持有 51%股权	2011-03-30
13	香港木林森	2005-5-31	-	电子零件贸易	孙清焕个人开办	2010-11-17

14	汇海	2009-5-8	50	LED 应用产品的研发、生产及销售	孙清焕持有51%股权	2011-05-23
15	吉源	2006-10-12	50	LED 应用产品销售	王招娣曾持有 85%股权	2011-05-18
16	润森	2005-10-12	50	电子元器件、电子产品的销售	孙清焕曾持有 51%股权	2011-05-16
17	森隆	2005-8-2	50	发光系列产品及其他电子产品的生产销售	赖爱梅曾持有 42.5%股权	2011-04-18

2、已转让股权的企业

序号	名称	成立日期	注册资本	主要业务	原股权结构	转让日期	转让后股权结构	新增股东情况
1	倍森	2010-1-8	600	LED 应用产品的开发、设计、生产与销售	孙清焕：55% 晏冠林：45%	2010-4-23	刘志兰：49% 晏冠林：51%	刘志兰系晏冠林配偶
2	汇森	2005-10-11	50	电子产品的销售	孙清焕：51% 孙建芬：49%	2010-3-12	梁建昌：51% 孙建芬：49%	梁建昌系孙建芬配偶
3	林森	2005-6-1	50	发光二极管、液晶显示及电子产品、灯饰的销售	孙清焕：40% 林立强：18% 林立勇：42%	2010-4-21	林立强：18% 林立勇：82%	林立勇系林立强兄弟
4	厦门木林森	2004-5-28	50	从事 LED 产品的开发、研制、生产与销售	孙清焕：70% 王凡：30%	2010-6-18	王苗：70% 王凡：30%	王苗系王凡侄子
5	永光	2006-1-8	50	从事电子产品、灯饰产品的销售	孙清焕：51% 张治永：49%	2010-11-3	邓群华：51% 张治永：49%	邓群华系张治永配偶
6	永林	2005-3-23	50	LED 应用产品的生产与销售	孙清焕：50% 林启程：50%	2009-9-20	林春英：50% 林启程：50%	林春英系林启程配偶
7	美明	2003-10-28	50	电子元器件、五金配件的销售	林文彩：51% 景斌：49%	2010-3-16	秦纬钰：51% 景斌：49%	秦纬钰系景斌配偶
8	源森	2005-6-30	50	电子元器件、电子产品的销售	罗萍：51% 胡美华：49%	2010-3-30	劳凡权：51% 胡美华：49%	劳凡权系胡美华配偶
9	怡德精密	2007-4-30	50	塑料制品、电子产品、灯饰制品、生产与销售	孙清焕：50% 郭心元：50%	2009-12-11	郭心元：100%	-

10	安林	2005-2-3	100	从事 LED 产品贸易	孙清焕：51% 熊增光：39% 唐元杰：10%	2010-6-18	熊增光：90% 唐元杰：10%	-

上述股权转让均按照原始出资额作为定价依据。

三、经常性关联交易

（一）经常性关联交易情况

1、报告期内的关联销售

单位：万元

关联方名称	主要销售内容	2010 年度	2009 年度	2008 年度
昌浩	LED 芯片	14.93	60.88	4.92
心一	LED 芯片	236.85	353.99	239.90
厦门木林森	LED 芯片	-	7.26	131.61
森隆	LED 芯片	23.04	540.73	305.42
源森	Lamp LED	9.58	292.36	308.28
美明	Lamp LED	525.34	174.52	265.91
润森	Lamp LED	148.97	363.37	147.80
倍森	Lamp LED	153.11	-	-
汇森	Lamp LED	0.11	8.81	10.34
永光	Lamp LED	-	-	6.39
翔光	Lamp LED	139.65	-	-
宁波木林森	Lamp LED	-	37.00	141.60
日月明	Lamp LED	-	-	337.21
纬源	Lamp LED	-	-	152.51
光磊科技	Lamp LED	-	-	80.91
永林	Lamp LED	282.29	342.64	1,435.59
林森	Lamp LED 及 Display	4.81	69.12	291.48
安林	Display	-	17.90	114.40
吉源	Display	232.80	-	-

怡德精密	零星材料	-	-	0.04
香港木林森	LED 等系列产品	-	11,699.29	7,664.43
合计		1,771.48	13,967.87	11,638.74
占比		2.27%	31.39%	31.48%

注：占比指与该关联方发生的销售收入占当期公司主营业务收入的比例

（1）香港木林森的基本情况

香港木林森成立于 2005 年 5 月 31 日，投资人为孙清焕，曾持有香港税务局商业登记署颁发的编号为 35689198-000-05-08-A 的《商业登记证》，注册地址为九龙官塘开源道 55 号开联工业中心 A 座 605 室，业务性质为电子零件贸易。2010 年 11 月 17 日，香港木林森注销完毕并取得了香港税务局商业登记署出具的注销证明文件。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,071.57 万元，净资产为-11.65 万元，2009 年净利润为-5.98 万元。

（2）香港木林森成立的背景

由于公司部分客户为境外下游 LED 应用厂商，为了方便出口及结汇，实际控制人孙清焕在香港设立了香港木林森，公司通过其进行转口贸易。香港木林森在公司的出口销售业务中实际上仅承担货款回收、国际结算的作用，并不具有实际销售功能。

（3）公司向香港木林森销售的基本流程

报告期内，由于公司生产经营规模持续扩大且相当部分 LED 封装产品用于出口，为方便公司的出口业务及结汇管理，充分利用香港发达的商业贸易环境、集中境外客户资源和外资银行资源、办理银行结算、客户货款催收等手续，公司通过关联方香港木林森向最终客户销售产品，其基本业务流程如下：

公司直接与境外客户洽谈，约定销售产品的品种、规格型号、数量、价格、交货期、售后服务等，并约定由香港木林森代为收取货款，公司将货物发送至香港木林森并办理相关出口报关手续。月末，与境外客户对账，境外客户将到期货款向香港木林森在境外银行账户支付，同时，香港木林森将收到的境外客户货款全额转付给公司，由公司办理结汇事宜，香港木林森未向公司收取费用。

（4）公司通过香港木林森实现销售的情况

公司于 2008 年、2009 年通过关联方香港木林森向最终客户销售了部分 LED 产品，具体情况如下：

年度	最终销售客户	内容	金额（万元）
2008 年	苏扬企业（香港）有限公司	Lamp LED	2,064.01
	元美（香港）装饰灯涂装公司	Lamp LED	979.86
	东裕电器股份有限公司	Lamp LED	853.97
	骏弘实业有限公司	Lamp LED	620.84
	伟易达通讯设备有限公司	Display	400.58
	其他客户	LED 产品	2,745.19
	合计		7,664.45
2009 年	协顺工艺股份有限公司	Lamp LED	3,201.41
	东裕电器股份有限公司	Lamp LED	3,000.39
	苏扬企业（香港）有限公司	Lamp LED	2,611.88
	元美（香港）装饰灯涂装公司	Lamp LED	792.23
	Sellsys Vision St.Zo.o	LED 显示屏	563.27
	其他客户	LED 产品	1530.12
	合计		11,699.30

注：2008 年度按照 1 美元兑换 7.01 元人民币计算，2009 年度按照 1 美元兑换 6.83 元人民币计算。

2、报告期内的关联采购

报告期内，公司与关联公司的关联采购如下：

单位：万元

关联方名称	采购内容	2010 年度	2009 年度	2008 年度
南昌宏森	采购 LED 支架	-	-	-
中山宏森	采购 LED 支架	-	-	3,212.91
心一	委托加工 Display	145.58	1,439.07	744.76
吉源	委托加工 Display	-	-	248.51

昌浩	委托加工 Lamp LED	82.09	102.91	99.54
森隆	委托加工 Lamp LED	38.88	40.98	40.28
宁波木林森	委托加工 Lamp LED	-	-	7.54
润森	采购 SMD LED	-	2.22	-
永光	采购 SMD LED	-	0.12	0.42
厦门木林森	采购 Display	3.51	-	18.90
日月明	采购 LED 应用产品	-	-	16.42
光磊	采购 LED 芯片	-	-	52.31
怡德精密	采购原材料模条	242.81	359.54	202.80
汇海	零星材料	-	0.10	-
纬源	零星材料	-	-	-
林森	零星材料	-	0.48	-
倍森	零星材料	1.07	-	-
合计		513.94	1,945.42	4,644.39
占比		1.10%	6.56%	17.58%

注：占比指与该关联方发生的采购占当期采购总额的比例

2008 年之前，公司向关联方南昌宏森采购 LED 支架，随后实际控制人孙清焕成立中山宏森，将南昌宏森业务转移至中山宏森，该二家公司主要为本公司提供 LED 支架业务，导致公司 2008 年采购 LED 支架金额较大。随着业务规模逐步扩大及公司内部架构调整，公司于 2008 年底成立了支架事业部，并引进国际先进的全自动化支架生产线，同时中山宏森管理及业务团队全部转移至本公司支架事业部，自 2009 年开始，公司支架业务由外购转变为自产。

心一主要从事 Display 产品的生产，借助公司在业内较高的品牌知名度，公司向其委托加工该产品并销售给国内消费电器供应商，主要客户为格兰仕。由于心一规模较小，且为了承接格兰仕更多的采购订单及其他消费电器供应商（如美的、格力等）的订单，公司于 2010 年引进生产 Display 产品全自动化生产线，由委托加工转变为自产，导致 2010 年委托心一加工 Display 产品业务较少。

其他关联方采购主要系公司业务处于销售旺季时，委托关联方加工部分 Lamp LED、Display 产品及采购零星材料等。

（二）关联交易定价依据及其公允性

公司向关联方销售 LED 芯片及封装产品均按照市场价格为准，与销售给非关联方价格类似；公司向关联方采购 LED 支架，根据产品的型号、规格，以行业内平均毛利率水平，按产品生产成本加成为定价标准，对于委外加工封装产品支付加工费，定价则参照当地市场委托加工一般价格确定。

公司通过香港木林森出口产品的定价以公司与境外客户之间的订单价格为准，香港木林森未向本公司收取其他费用。

保荐人通过同一产品与境外客户、报关出口至香港木林森、境内客户价格进行抽样对比的方法，对出口至香港木林森价格公允性进行审查，所抽取的样本显示公司对香港木林森的销售价格公允。具体如下：

产品种类	产品代码	单位名称	单价（元）	单据编号	日期	售价差异（元）
LED 封装产品	M-3ZC2SC40-14S-M	境外客户：苏扬（香港）企业有限公司	0.14	订单：20080705001	2008-7-26	0
		香港木林森	0.14	报关单：218667893	2008-8-12	
		国内：山东霓虹王电子有限公司	0.14	出库单：313090	2008-7-25	
LED 封装产品	M-8MCISC00-4	境外客户：元美（香港）装饰灯涂装公司	1.03	订单：080809-003	2008-11-29	0
		香港木林森	1.03	报关单：218768105	2008-12-15	
		国内客户：广州市松乐电子科技有限公司	1.03	出库单：328037	2008-12-11	
LED 封装产品	M-5ZB2ST13-15	境外客户：协顺工艺股份有限公司	0.07	订单：980610001	2009-6-10	0
		香港木林森	0.07	报关单：219614809	2009-6-27	
		国内客户：江门市蓬江区广达电器有限公司	0.07	出库单：HX20090623-40	2009-6-23	

LED封装产品	M-5AW3C03	境外客户：东裕电器股份有限公司	0.12	订单：I01-028-059	2009-6-20	0
		香港木林森	0.12	报关单：219615036	2009-7-10	
		国内客户：佛山中元创新实业有限公司	0.12	出库单：XOUT-01.007896	2009-7-15	
LED封装产品	M-3CC2SC40	境外客户：YUCENT GROUP LIMITED	0.09	订单：7100085802	2009-8-25	0
		香港木林森	0.09	报关单：219686760	2009-9-10	
		国内客户：泰兴玩具（深圳）有限公司	0.09	出库单：XOUT-01.009383	2009-8-8	

保荐人和申报会计师对于关联交易价格公允性进行了核查，认为报告期内发生关联交易定价公允，不存在损害公司利益或向公司输送利润情形。

四、偶发性关联交易

（一）关联方为本公司借款提供担保

报告期内，关联方为本公司借款提供担保情况如下：

担保方	债权人	最高被担保金额（万元）	担保期间	担保方式
孙清焕、罗萍、林文彩	广东发展银行股份有限公司中山分行	900	2007年2月5日至2008年2月4日	连带责任保证
孙清焕、罗萍	广东发展银行股份有限公司中山分行	900	2007年2月5日至2008年2月4日	抵押担保
孙清焕、罗萍	中国农业银行股份有限公司中山分行	3,000	2006年5月1日至2009年12月30日	连带责任保证
孙清焕、罗萍	兴业银行股份有限公司中山支行	1,000	2008年1月23日至2009年1月23日	连带责任保证
格林曼	广东发展银行股份有限公司中山分行	1,050	2008年5月19日至2011年5月18日	连带责任保证
孙清焕、罗萍、林文彩	广东发展银行股份有限公司中山分行	1,050	2008年5月19日至2011年5月18日	连带责任保证
孙清焕、罗萍	兴业银行股份有限公司中山支行	1,500	2009年1月13日至2010年1月13日	连带责任保证

孙清焕、罗萍	交通银行股份有限公司中山分行	1,100	2009 年 12 月 11 日至 2011 年 12 月 11 日	存单质押担保
孙清焕、罗萍	兴业银行股份有限公司中山支行	5,000	2010 年 1 月 12 日至 2011 年 1 月 12 日	连带责任保证
孙清焕、罗萍	广东发展银行股份有限公司中山分行	4,500	2010 年 3 月 29 日至 2011 年 3 月 28 日	连带责任保证
林文彩	广东发展银行股份有限公司中山分行	4,500	2010 年 3 月 29 日至 2011 年 3 月 28 日	连带责任保证
孙清焕、罗萍	兴业银行股份有限公司中山分行	20,000	2010 年 11 月 19 日至 2015 年 11 月 19 日	连带责任保证
孙清焕	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	5,000	2010 年 11 月 1 日至 2011 年 11 月 1 日	连带责任保证
孙清焕	中国工商银行股份有限公司中山孙文支行	10,000	2011 年 1 月 4 日至 2016 年 1 月 3 日	连带责任保证
孙清焕、罗萍	平安银行股份有限公司中山分行	40,000	2011 年 3 月 18 日至 2016 年 3 月 17 日	连带责任保证
孙清焕、罗萍	中国民生银行股份有限公司中山分行	12,000	2011 年 4 月 13 日至 2012 年 4 月 12 日	连带责任保证
孙清焕	交通银行股份有限公司中山分行	34,000	2011 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日	连带责任保证

（二）收购关联方为控股子公司

收购关联方为控股子公司的详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人设立以来资产重组情况”。

（三）资产转让与购置

报告期内，公司向关联方转让部分过时、自动化程度不高的机器设备，具体如下：

单位：万元

关联方名称	2010 年度	2009 年度	2008 年度
倍森	128.40	-	-
合计	128.40	-	-

报告期内，由于关联方宁波木林森、吉源停止生产经营，公司向其采购部分机器设备，具体如下：

单位：万元

关联方名称	2010 年度	2009 年度	2008 年度

宁波木林森	-	-	393.61
吉源	-	-	13.87
合计	-	-	407.48

2008 年 7 月，孙清焕与公司签订《注册商标转让协议》，将其持有的注册号为 3798287 号的注册商标无偿转让给公司（该注册商标现已变更至本公司名下）；2010 年 6 月，孙清焕与公司签订《注册商标转让协议》，将其持有的 5 项境内注册商标（注册号分别为 3695098、3798288、3798306、3201884、3201887）及 4 项境外注册商标（其中注册号为 301229184、301229175 的香港注册商标现已变更至本公司名下）无偿转让给公司。

2010 年 6 月，孙清焕与公司签订《专利权转让合同》，将其持有的专利号为 ZL200720059783.6 的专利“一种光电元件”无偿转让给公司。

2010 年 6 月，孙清焕与格林曼签订《专利权转让协议》，将其持有的专利号为 ZL200320119056.6 的专利“一种具有旁路保护的灯串”无偿转让给格林曼。

2010 年 8 月，孙清焕与公司签订《专利权转让合同》，将其持有的专利号为 ZL200920237325.6 的专利“一种三合一全彩食人鱼 LED 灯”、专利号为 ZL200930088901.0 的专利“LED 发光二极管”无偿转让给公司。

（四）商标授权许可

因公司生产经营需要，孙清焕与公司于 2005 年 7 月签订《商标使用许可合同》，约定在其持有的注册号为 3695098 号的境内注册商标有效期内，孙清焕授权公司无偿使用该等商标。

2006 年 11 月，孙清焕与公司签订《商标使用许可合同》，约定在其持有的注册号为 3798287 号的境内注册商标有效期内，孙清焕授权公司无偿使用该注册商标（该注册商标现已变更至本公司名下）。

2010 年 6 月，孙清焕与公司签订《商标使用许可合同》，约定在其持有的其他 4 项境内注册商标（注册号分别为 3798288、3798306、3201884、3201887）及 4 项境外注册商标（其中注册号为 301229184、301229175 的香港注册商标的转让手续已办理完毕）的有效期内，孙清焕授权公司无偿使用该等商标。

五、关联方往来款情况

报告期内，本公司与关联方之间往来款余额情况如下：

单位：万元

往来科目	关联方名称	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
应收票据	昌浩	-	25.73	-
	永林	-	-	168.67
应收账款	昌浩	-	8.54	1.45
	心一	-	76.45	36.52
	源森	-	140.31	40.17
	美明	-	3.13	25.38
	润森	-	191.04	74.64
	森隆	-	73.00	69.42
	永光	-	2.53	5.53
	厦门木林森	-	10.86	51.64
	林森	-	31.59	72.53
	宁波木林森	-	0.00	25.45
	香港木林森	-	659.79	-
	安林	-	-	18.62
	日月明	-	-	183.31
	纬源	-	-	0.87
	永林	-	323.90	408.72
预付款项	昌浩	-	4.55	12.47
	心一	-	-	0.36
	润森	-	-	0.75
其他应收款	孙清焕	-	-	30.00
应付票据	吉源	-	-	82.59
应付账款	昌浩	-	91.38	0.25
	南昌宏森	-	51.98	181.98
	心一	-	869.32	303.59
	中山宏森	-	511.66	1,134.68
	厦门木林森	-	-	20.14

	森隆	-	58.47	81.22
	永光	-	0.14	-
	润森	-	1.84	-
	汇海	-	0.23	-
	日月明	-	0.66	0.66
	吉源	-	24.07	113.01
	怡德精密	-	90.57	18.98
预收款项	美明	-	-	28.84
	源森	-	-	87.92
	厦门木林森	-	-	2.73
	森隆	-	-	27.82
	汇森	-	-	9.79
	安林	-	-	2.76
其他应付款	孙清焕	-	905.42	2,622.63

六、报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司拥有独立的采购、销售体系，关联销售和采购为正常经营所需要。报告期内，关联销售占主营业务收入的比例分别为 31.48%、31.39%和 2.27%，报告期关联采购占同类采购金额的比例分别为 17.58%、6.56%和 1.10%。关联交易均有可执行的定价依据，定价公允。公司与关联方之间除处于正常付款期的往来款项外，关联方未占用公司资金。因此，报告期内的关联交易未对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

七、本公司采取的减少和规范关联交易的措施

为减少和规范关联交易，确保公司在存在重大关联交易的情况下独立运作，本公司实施了一系列有针对性的措施。

（一）规范关联方关系

详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人设立以来资产重组情况”、“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况”和本节“二、关联方和关联关系”。

（二）制定减少和规范关联交易的制度

为避免和消除可能出现的公司控股股东及实际控制人利用其地位从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益，公司引入 3 名独立董事，建立了独立董事制度。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》，对公司的关联方、关联交易、关联交易的回避制度、关联交易决策权限和表决程序等内容进行了规定。

八、发行人关联交易决策程序

（一）《公司章程》对规范关联交易的安排

1、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程特别规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

2、公司与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12 个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）在 1000 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易事项应由股东大会审议。

3、公司与其关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12 个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）中与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以上、与关联自然人达成的关联交易总额在 30 万元以上，需经董事会审议。

4、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（二）《关联交易决策制度》对规范关联交易的安排

《关联交易决策制度》的主要内容如下：

1、公司董事会就关联交易表决时，与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权。

未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。

2、在董事回避表决的情况下，有关董事会会议形成决议须经公司全体董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

3、公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

4、公司与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12 个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）中与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以上、与关联自然人达成的关联交易总额在 30 万元以上的交易，需经董事会审议。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

5、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

除上述条款之外，《关联交易决策制度》还对关联交易、关联法人、关联自然人的概念、关联交易范围、关联交易的审议及实施权限、关联交易的审议程序、

关联人的回避表决及其他相关事项作出明确具体的规定。

九、报告期内关联交易执行情况及独立董事的意见

公司独立董事对报告期内的关联交易进行了审查，并发表了独立意见。公司独立董事认为：报告期内的关联交易已依据交易发生时的有关法律、法规及当时《公司章程》和相关制度的规定，履行了必要的合同审批程序，关联交易价格合理，未损害本公司及本公司其他股东的利益。

第八节　董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历

（一）董事

截止本招股说明书签署日，本公司共有董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满可连选连任。本届董事会至 2013 年 7 月 28 日任期届满。

孙清焕　先生，董事长，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1997年创建中山木林森，一直担任公司执行董事、总经理等职。2010年7月起任本公司第一届董事会董事长、总经理。孙清焕还兼任中山市石岐商会第四届理事会副会长，中山市个体劳动者协会、中山市私营企业协会石岐分会第四届理事会副会长，中山市照明电器行业协会常务副会长，中山市半导体照明产业技术联盟第一届理事会常务副理事长，中山市半导体照明行业协会副会长等职。

林文彩　先生，董事，中国国籍，无境外居留权，1970年生，高中学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，2010年7月起任本公司第一届董事会董事。

郑明波　先生，董事，中国国籍，无境外居留权，1982年生，大专学历。曾任职于建伦电器工业（中山）有限公司，2003年8月加入中山木林森，历任公司人力资源部经理、品保部经理、生产经理、副总经理等职；2010年7月起任本公司第一届董事会董事、副总经理。

易亚男　女士，董事，中国国籍，无境外居留权，1968年生，大专学历。曾任职于香港美地集团有限公司，2004年11月加入中山木林森，任职财务部；2010年7月起任本公司第一届董事会董事、副总经理兼财务总监。

王钢　先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1968年生，教授、博士生导师。曾任职于日本富士通量子器件公司，现任中山大学（理科）学术委员会委员、中山大学佛山研究院院长、中山大学半导体照明系统研究中心主任、光电材料与技术国家重点实验室主任助理、广东高校宽禁带半导体材料与器件工程技术研究中心主任、科技部“863”重大项目“半导体照明工程”总体专家组成员、

广东半导体照明工程省部产学研创新联盟理事长、广东省材料学会理事、《半导体学报》理事会理事；2010年7月起任本公司第一届董事会独立董事。

罗元清　先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，研究生学历，律师。具有多年的证券法律从业经历，曾任职于香港贵联集团、深圳天利地产集团等，现任北京市中银律师事务所合伙人；2010 年 7 月起任本公司第一届董事会独立董事。

鄢国祥　先生，独立董事，中国国籍，无境外居留权，1966年生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。具有多年的审计及资产评估从业经历，曾任职于天健会计师事务所有限公司等，现任章源钨业股份有限公司总会计师兼财务部经理；2010年7月起任本公司第一届董事会独立董事。

（二）监事

截至本招股说明书签署日，本公司共有 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期 3 年，任期届满可连选连任。本届监事会至 2013 年 7 月 28 日任期届满。

李冠群　先生，监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大专学历。曾任职于中山市怡华集团，2000年加入中山木林森，先后担任公司会计、财务部部长、执行董事助理等职，现任人力资源部经理；2010年7月起任本公司第一届监事会主席。

刘天明　先生，监事，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，大专学历。曾任职于东莞翔鹤电子厂，2001 年加入中山木林森，先后担任公司技术员、部长等职，现任研发中心经理；2010 年 7 月起任本公司第一届监事会监事。刘天明先生从事 LED 行业多年，一直致力于 LED 封装技术的研发，主导研发大功率 LED 硅胶液态模顶等技术；曾参与国家 863 计划、2009 年广东省重大科技专项、广东省教育部产学研等多个重大科技项目。

林玉陕　先生，职工监事，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007 年加入中山木林森，担任公司销售部长职务；2010 年 7 月起任本公司第一届监事会监事。

（三）高级管理人员及核心技术人员

截至本招股说明书签署日，本公司的高级管理人员及核心技术人员基本情况如下：

郑明波、易亚男的简历详见本节“一、（一）董事”部分。

赖爱梅　女士，副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1969年生，大专学历。曾任职于中山市朗玛光电器材有限公司，1999年加入中山木林森，先后担任公司财务部部长、财务经理、执行董事助理；现任公司副总经理兼董事会秘书。

周立宏　先生，副总经理，核心技术人员，中国国籍，无境外居留权，1971年生，中专学历。曾任职于江西分宜电机厂、江西南方电子有限公司；2007 年 6 月加入中山木林森，任支架事业部总经理，目前任公司副总经理兼支架事业部总经理。周立宏先生在 LED 支架及模条的研发设计上具有较高造诣，曾成功开发出直插式高密度 LED 支架和高密度模条等。

刘天明　先生，核心技术人员，简历详见本节“一、（二）监事”部分。

杨润　先生，核心技术人员，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大专学历。2004年2月加入中山木林森，现从事数码显示屏系统及媒体评估方法的研究和开发。杨先生在LED显示屏、计算机图形学方面有较高的造诣，对国内外数码显示屏行业的发展状况有较深入的了解。

（四）公司董事、监事的提名及选聘情况

1、公司董事的提名及选聘情况

2010年7月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举孙清焕、林文彩、郑明波、易亚男、王钢、罗元清、鄢国祥为本公司董事，其中王钢、罗元清、鄢国祥为公司独立董事。其中孙清焕、林文彩、易亚男、王钢、罗元清、鄢国祥由发起人孙清焕提名，郑明波由发起人榄芯实业提名。

2、公司监事的提名及选聘情况

2010年7月26日，经职工代表大会选举产生林玉陕为公司职工代表监事；2010年7月29日，经公司创立大会审议通过，选举李冠群、刘天明为公司监事。李冠群、刘天明由发起人孙清焕提名。

二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股及对外投资情况

（一）直接持有公司股份情况

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有本公司股份具体情况如下：

姓名	持股数（万股）	持股比例
孙清焕	11,661.00	88.92%
赖爱梅	36.00	0.27%
易亚男	36.00	0.27%
林文彩	27.00	0.21%

（二）间接持有公司股份情况

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属通过榄芯实业间接持有本公司股份具体情况如下：

姓名	在间接持股主体所占股权比例	间接拥有本公司权益比例
孙清焕	28%	0.51%
周立宏	15%	0.27%
郑明波	15%	0.27%
李冠群	9%	0.16%
刘天明	9%	0.16%
罗燕	9%	0.16%

（三）上述人员对外投资情况

姓名	持有股权的公司	投资额（万元）	股权比例
孙清焕	榄芯实业	140	28%
	昌浩	35	70%
	森森	300	60%
	森益隆	80	80%
	中山宏森	255	51%

	汇海	25.50	51%
周立宏	榄芯实业	75	15%
	中山宏森	245	49%
郑明波	榄芯实业	75	15%
李冠群	榄芯实业	45	9%
	日月明	60	60%
刘天明	榄芯实业	45	9%
林玉陕	纬源	24.50	49%

注：昌浩、森森、森益隆、中山宏森、汇海、日月明、纬源已完成工商注销

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬及兼职情况

（一）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司领取收入情况

上述人员2010年度薪酬情况见下表：

姓名	年薪（万元）	领薪单位	姓名	年薪（万元）	领薪单位
孙清焕	58.00	本公司	周立宏	42.00	本公司
林文彩	-	本公司	李冠群	21.60	本公司
郑明波	42.00	本公司	刘天明	18.00	本公司
易亚男	21.60	本公司	林玉陕	18.00	本公司
赖爱梅	21.60	本公司	杨润	7.20	本公司

董事林文彩未在公司领薪。

（二）独立董事津贴

公司每年向独立董事支付津贴6万元（含税）。

（三）董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与核心技术人员对外兼职情况

姓名	兼职单位	担任职位	兼职单位与发行人关系
孙清焕	格林曼	执行董事	控股子公司
	迪博	执行董事	控股子公司

	威莱森	执行董事	控股子公司
	赛维视觉	董事	控股子公司
	榄芯实业	执行董事	法人股东
周立宏	榄芯实业	监事	法人股东

四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的关系

孙清焕与林文彩为兄弟关系。除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

五、董事、监事和高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及相关规范性文件规定的任职资格。

六、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及与发行人签订的协议及其履行情况

（一）重要承诺

详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况”。

（二）与公司签订的协议和合同

1、本公司内部董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均在本公司任职，并与本公司签署了《劳动合同》，就劳动期限、劳动报酬及保险福利、劳动纪律、劳动合同的变更及解除、违约责任、劳动争议处理等内容进行了约定。

2、本公司与内部董事、监事和高级管理人员均签署了《保密协议》，就保守公司商业秘密及竞业限制等内容进行了约定。

截至本招股说明书签署日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。

七、董事、监事和高级管理人员最近三年变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

2007 年初以来，公司设执行董事一名，由孙清焕担任。

2010 年 6 月 8 日，木林森有限召开股东会，设立董事会，董事会成员为孙清焕、林文彩、郑明波、易亚男，其中孙清焕为董事长。

2010 年 7 月 29 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举孙清焕、林文彩、郑明波、易亚男、王钢、罗元清、鄢国祥为公司董事，其中王钢、罗元清、鄢国祥为独立董事。2010 年 7 月 29 日，发行人第一届董事会第一次会议选举孙清焕为董事长。

本公司董事的上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和公司章程的规定，对本公司的持续经营未造成影响。股份公司成立后，公司董事会成员稳定，未发生变动。

（二）监事变动情况

2007 年初以来，公司设监事一名，由林文彩担任。

2010 年 6 月 8 日，木林森有限召开股东会，设立监事会，监事会成员为李冠群、刘天明、林玉陕，其中林玉陕为职工代表监事。

2010 年 7 月 29 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举李冠群、刘天明为股东代表监事，与职工代表监事林玉陕组成发行人第一届监事会。2010 年 7 月 29 日，发行人第一届监事会第一次会议选举李冠群为监事会主席。

本公司监事的上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和本公司章程的规定。

（三）高级管理人员变动情况

2007 年初以来，孙清焕任总经理，郑明波任副总经理，易亚男任财务负责人。

2010 年 7 月 29 日，发行人第一届董事会第一次会议聘请孙清焕任总经理，郑明波、易亚男、赖爱梅、周立宏任副总经理，易亚男兼任财务总监，赖爱梅兼任董事会秘书。

本公司高级管理人员的上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和本公司章程的规定。报告期内，公司高级管理人员稳定。

第九节　公司治理结构

一、公司法人制度建立健全情况

本公司成立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立健全。公司已建立了比较科学和规范的法人治理结构，并能依法运作，依法履行各自的权利和义务，未出现任何违法违规现象。

2010年7月29日，本公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举产生了公司第一届董事会、监事会成员，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策管理制度》、《独立董事工作细则》、《投资决策管理办法》；2010年7月29日，本公司分别召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，并聘任了总经理、董事会秘书，根据总经理提名，聘任了副总经理和财务总监等高级管理人员；同时审议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计管理制度》等法人治理制度文件，并在实际经营中严格遵照执行。第一届监事会第一次会议选举产生了公司监事会主席。

二、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法运作情况

（一）股东大会、董事会、监事会

股东大会是本公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。

本公司董事会是股东大会的执行机构，负责制定财务预算和决算方案；确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；组织有关专家、专业人士对公司重大投资项目进行评审，并报股东大会批准。

监事会是本公司内部的专职监督机构，对股东大会负责。

本公司自设立以来，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中的有关规定。

（二）独立董事

公司建立的独立董事制度，对进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作发挥了积极作用。

公司全体股东和董事会认为，独立董事对公司重大事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用，独立董事所具备的丰富的专业知识和勤勉尽责的职业道德在董事会制定公司发展战略、发展计划和经营决策，以及确定募集资金投资项目等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性。

随着公司法人治理结构的不断完善和优化，尤其是股票发行以后，独立董事将能更好地发挥作用，本公司也将尽力为其发挥作用提供良好的机制环境和工作条件。

（三）董事会秘书

公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权，对提升公司治理和促进公司运作规范有着重要作用。公司已设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

（四）专门委员会

1、审计委员会

审计委员会由鄢国祥、罗元清、易亚男三名董事组成，其中独立董事鄢国祥为会计专业人士并担任主任委员。审计委员会履行法律法规和公司章程赋予的职权，包括审阅年报报告和中期财务报告，审议外聘会计师的聘任及协调相关工作；为董事会提供公司内部控制体系的运作的咨询和建议；研究公司运作、境内外法规、监管规则和有关政策对公司财务报告可能产生的影响。

2、提名委员会

提名委员会由王钢、鄢国祥、孙清焕三位董事组成，其中独立董事王钢担任主任委员。提名委员会的主要职责为：根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议；研究董事与高级管理人员选择标准和程序并提出建议；搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；董事会换届时提出下一届董事会候选人的建议；董事会授权的

其他事项。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由罗元清、王钢、孙清焕三位董事组成，其中独立董事罗元清担任主任委员。薪酬与考核委员会的主要职责为：制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；制订和审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案；董事会授权的其他事项。

4、战略委员会

战略委员会由孙清焕、易亚男、郑明波三位董事组成，其中董事孙清焕担任主任委员。战略委员会的主要职责为：负责对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事项。

三、本公司接受监管与检查的情况

公司自成立至今，已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等法人治理结构，公司及董事、监事、高级管理人员均遵守国家法律法规和公司章程的规定开展经营活动。

四、本公司主要股东占用公司资金及本公司对主要股东担保情况

截至本招股说明书签署日，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情况，或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、管理层对本公司内部控制的说明以及会计师对本公司内部控制的鉴证报告

（一）本公司管理层对内部控制制度的自我评价

公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为，公司现有的内部控制已经覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营中可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的不断发展，业务职能的调整、

外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制的完善和改进还需要进一步改进和完善。

（二）注册会计师对本公司内部控制制度的评价

本次发行审计机构利安达会计师事务所有限责任公司就公司内部控制制度出具了利安达专字[2011]第 1062 号《内部控制鉴证报告》，总体评价如下：“木林森董事会按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”

第十节　财务会计信息

利安达审计了公司 2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度、2009 年度、2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注，利安达对上述报表出具了利安达审字【2011】第 1333 号标准无保留意见审计报告。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表或据其计算而得。

一、公司最近三年的财务报表

（一）资产负债表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：			
货币资金	145,084,817.03	25,895,296.83	35,759,275.53
交易性金融资产	-	19,000.00	-
应收票据	3,209,024.00	1,124,480.40	1,686,740.00
应收账款	107,758,959.01	66,125,818.92	62,064,070.52
预付款项	9,742,870.04	9,034,935.58	6,299,040.10
其他应收款	9,198,803.98	10,754,461.96	10,926,935.48
存货	152,579,451.58	124,956,232.97	118,574,877.93
其他流动资产	-	2,230,133.02	-
流动资产合计	**427,573,925.64**	**240,140,359.68**	**235,310,939.56**
固定资产	435,220,453.21	136,694,551.00	130,668,386.62
在建工程	23,316745.90	18,560,602.62	1,998,479.77
无形资产	62,675,396.86	27,056,451.98	1,276,291.67
递延所得税资产	1,413,327.09	1,458,851.61	1,540,683.14
非流动资产合计	**522,625,923.06**	**183,770,457.21**	**135,483,841.20**

资产总计	**950,199,848.7**	**423,910,816.89**	**370,794,780.76**
流动负债：			
短期借款	166,840,000.00	53,280,000.00	41,850,000.00
应付票据	61,302,463.12	43,135,023.43	46,349,982.31
应付账款	143,772,591.35	91,142,719.69	83,649,233.61
预收款项	4,142,315.23	2,538,727.70	5,039,109.92
应付职工薪酬	10,718,764.48	6,986,106.00	5,008,506.00
应交税费	7,163,825.24	12,029,904.59	4,024,016.76
应付利息	439,829.63	68,742.65	150,176.55
其他应付款	4,441,277.17	13,750,367.77	27,716,974.51
一年内到期的非流动负债	35,700,000.00	-	-
流动负债合计	**434,521,066.22**	**222,931,591.83**	**213,787,999.66**
长期借款	94,300,000.00	-	-
递延所得税负债	187,989.63	183,174.36	-
其他非流动负债	500,000.00	-	-
非流动负债合计	**94,987,989.63**	**183,174.36**	-
负债合计	**529,509,055.85**	**223,114,766.19**	**213,787,999.66**
股东权益：			
股本	131,147,500.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	208,141,705.68	14,266,068.97	13,164,218.08
盈余公积	6,760,695.59	7,906,873.69	4,141,056.27
未分配利润	62,462,164.18	69,643,077.23	31,628,753.97
归属于母公司股东权益合计	408,512,065.45	191,816,019.89	148,934,028.32
少数股东权益	12,178,727.40	8,980,030.81	8,072,752.78
股东权益合计	**420,690,792.85**	**200,796,050.70**	**157,006,781.10**
负债和股东权益总计	**950,199,848,70**	**423,910,816.89**	**370,794,780.76**

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：			
货币资金	130,458,859.71	10,434,898.57	18,817,790.75
应收票据	3,209,024.00	1,024,480.40	1,686,740.00

应收账款	94,226,768.57	64,263,596.77	63,060,948.14
预付款项	8,404,012.25	7,036,823.90	2,787,843.06
其他应收款	9,234,821.63	4,815,034.12	2,303,626.50
存货	123,156,591.46	97,972,049.35	103,303,065.87
其他流动资产	-	2,230,133.02	-
流动资产合计	**368,690,077.62**	**187,777,016.13**	**191,960,014.32**
非流动资产：			
长期股权投资	15,103,859.81	6,732,651.24	6,732,651.24
固定资产	398,421,695.00	116,908,548.09	113,550,496.13
在建工程	22,838,150.62	16,777,673.56	1,998,479.77
无形资产	61,465,876.87	25,808,276.31	-
递延所得税资产	788,184,88	806,260.80	470,376.07
非流动资产合计	**498,617,767.18**	**167,033,410.00**	**122,752,003.21**
资产总计	**867,307,844.80**	**354,810,426.13**	**314,712,017.53**
流动负债：			
短期借款	145,000,000.00	35,250,000.00	25,250,000.00
应付票据	47,109,115.44	26,061,023.43	39,465,982.31
应付账款	123,653,675.94	81,062,970.81	70,051,216.89
预收款项	2,685,362.32	1,734,830.81	2,292,311.36
应付职工薪酬	7,611,971.00	5,675,391.00	3,599,030.00
应交税费	3,374,366.85	10,424,664.70	1,990,460.14
应付利息	425,777.78	-	-
其他应付款	3,237,441.48	8,761,160.41	23,620,904.94
一年内到期的非流动负债	35,700,000.00	-	-
流动负债合计	**368,797,710.81**	**168,970,041.16**	**166,269,905.64**
长期借款	94,300,000.00	-	-
负债合计	**463,097,710.81**	**168,970,041.16**	**166,269,905.64**
股东权益：			
股本	131,147,500.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	206,961,794.32	8,351,100.47	8,351,100.47
盈余公积	6,651,939.80	7,798,117.90	4,058,290.59
未分配利润	59,448,899.87	69,691,166.60	36,032,720.83
股东权益合计	**404,210,133.99**	**185,840,384.97**	**148,442,111.89**

负债和股东权益总计	**867,307,844.80**	**354,810,426.13**	**314,712,017.53**

（二）利润表

1、合并利润表

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	**814,766,254.12**	**456,405,216.05**	**385,390,886.89**
减：营业成本	563,294,108.02	341,245,323.03	315,022,958.01
营业税金及附加	4,045,955.75	1,693,046.51	1,334,564.42
销售费用	19,063,123.97	14,252,063.78	9,054,404.63
管理费用	**81,540,786.60**	51,177,474.54	41,073,125.64
财务费用	8,239,890.5	3,299,967.81	2,788,009.18
资产减值损失	7,621,100.45	355,095.51	1,320,508.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,577.92	4,577.92	-
投资收益（损失以“-”号填列）	120,194.66	21,818.25	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**131,076,905.57**	**44,408,641.04**	**14,797,316.66**
加：营业外收入	4,313,938.58	5,154,838.69	6,105,883.61
减：营业外支出	6,399,646.78	367,032.40	1,756,975.42
其中：非流动资产处置损失	5,928,271.60	257,786.04	368,238.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**128,991,197.37**	**49,196,447.33**	**19,146,224.85**
减：所得税费用	25,019,331.22	7,089,686.73	3,107,704.32
五、净利润	**103,971,866.15**	**42,106,760.60**	**16,038,520.53**
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-828,947.61	490,830.20	-870,379.94
归属于母公司所有者的净利润	101,937,018.13	41,754,150.57	17,054,651.29
少数股东损益	2,034,848.02	352,610.03	-1,016,130.76

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.83	0.35	0.14
（二）稀释每股收益	0.83	0.35	0.14
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	**103,971,866.15**	**42,106,760.60**	**16,038,520.53**
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,937,018.13	41,754,150.57	17,054,651.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,034,848.02	352,610.03	-1,016,130.76

2、母公司利润表

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	**640,940,912.24**	**399,473,981.50**	**321,472,830.71**
减：营业成本	420,641,355.93	303,169,533.46	261,050,272.42
营业税金及附加	3,135,098.13	1,313,939.78	947,289.90
销售费用	13,216,072.69	10,887,851.70	6,050,736.51
管理费用	66,713,895.63	42,400,851.08	31,719,972.38
财务费用	6,719,117.86	1,468,191.24	1,415,585.37
资产减值损失	7,905,794.64	239,231.58	1,293,613.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-1,450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**122,609,577.36**	**39,994,382.66**	**17,545,360.81**
加：营业外收入	3,497,906.37	4,961,128.14	5,884,011.83
减：营业外支出	4,917,611.23	1,568,243.61	1,447,664.45
其中：非流动资产处置损失	4,514,242.33	1,531,569.10	-
三、利润总额（亏损总	**121,189,872.50**	**43,387,267.19**	**21,981,708.19**

额以“-”号填列）			
减：所得税费用	22,314,208.05	5,988,994.11	3,172,835.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**98,875,664.45**	**37,398,273.08**	**18,808,872.23**
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	**98,875,664.45**	**37,398,273.08**	**18,808,872.23**

（三）现金流量表

1、合并现金流量表

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	835,486,563.57	478,422,351.88	381,020,105.69
收到的税费返还	11,200,298.85	11,643,589.91	6,596,241.10
收到其他与经营活动有关的现金	17,611,708.18	16,495,929.54	19,306,618.16
经营活动现金流入小计	**864,298,570.60**	**506,561,871.33**	**406,922,964.95**
购买商品、接受劳务支付的现金	494,717,957.11	321,246,566.91	253,436,079.55
支付给职工以及为职工支付的现金	99,862,632.93	72,237,065.48	58,093,500.22
支付的各项税费	62,057,998.03	19,916,077.40	17,085,260.89
支付其他与经营活动有关的现金	41,185,990.29	36,152,455.99	32,226,490.13
经营活动现金流出小计	**697,824,578.36**	**449,552,165.78**	**360,841,330.79**
经营活动产生的现金流量净额	**166,473,992.24**	**57,009,705.55**	**46,081,634.16**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	305,550.86	117,867.92	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,496,044.61	58,500.00	112,000.00
投资活动现金流入小计	**11,801,595.47**	**176,367.92**	**112,000.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,267,733.35	73,242,566.56	60,229,309.70
投资支付的现金	525,356.20	110,471.75	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,627,840.00	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	4,057,650.00	-	-
投资活动现金流出小计	**393,478,579.55**	**73,353,038.31**	**64,229,309.70**
投资活动产生的现金流量净额	**-381,676,984.08**	**-73,176,670.39**	**-64,117,309.70**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	103,920,000.00	1,682,273.32	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,920,000.00	554,669.00	-
取得借款收到的现金	307,800,000.00	62,840,000.00	52,350,000.00
筹资活动现金流入小计	**411,720,000.00**	**64,522,273.32**	**62,350,000.00**
偿还债务支付的现金	64,240,000.00	51,410,000.00	31,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,242,484.29	3,057,270.90	2,821,966.08
支付其他与筹资活动有关的现金	23,062,947.74	252,080.97	-
筹资活动现金流出小计	**96,545,432.03**	**54,719,351.87**	**34,321,966.08**
筹资活动产生的现金流量净额	**315,174,567.97**	**9,802,921.45**	**28,028,033.92**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-125,324.93**	**-85,340.03**	**5,405.16**
五、现金及现金等价物净增加额	**99,846,251.20**	**-6,449,383.42**	**9,997,763.54**
加：期初现金及现金等价物余额	13,985,767.72	20,435,151.14	10,437,387.60
六、期末现金及现金等价物余额	**113,832,018.92**	**13,985,767.72**	**20,435,151.14**

2、母公司现金流量表

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	656,065,863.21	410,780,517.38	326,705,104.27
收到的税费返还	2,910,846.25	317,901.94	202,000.14
收到其他与经营活动有关的现金	9,930,489.20	13,557,716.90	7,487,226.64
经营活动现金流入小计	**668,907,198.66**	**424,656,136.22**	**334,394,331.05**
购买商品、接受劳务支付的现金	363,338,511.89	275,477,302.71	219,229,231.26
支付给职工以及为职工支付的现金	73,081,839.72	55,503,773.90	40,378,845.54
支付的各项税费	51,554,024.10	14,625,818.92	12,606,478.36
支付其他与经营活动有关的现金	30,799,731.79	17,113,506.99	25,245,985.24
经营活动现金流出小计	**518,774,107.50**	**362,720,402.52**	**297,460,540.40**

经营活动产生的现金流量净额	**150,133,091.16**	**61,935,733.70**	**36,933,790.65**
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,206,840.61	58,500.00	-
投资活动现金流入小计	2,206,840.61	58,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,952,688.25	70,783,391.40	58,631,687.39
投资支付的现金	340,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,627,840.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,057,650.00	-	-
投资活动现金流出小计	**364,978,178.25**	**70,783,391.40**	**58,631,687.39**
投资活动产生的现金流量净额	**-362,771,337.64**	**-70,724,891.40**	**-58,631,687.39**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	102,000,000.00	-	10,000,000.00
取得借款收到的现金	285,000,000.00	35,250,000.00	35,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计	387,000,000.00	35,250,000.00	45,750,000.00
偿还债务支付的现金	45,250,000.00	25,250,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,077,240.83	1,435,809.35	1,863,041.25
支付其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	**75,827,240.83**	**26,685,809.35**	**21,363,041.25**
筹资活动产生的现金流量净额	**311,172,759.17**	**8,564,190.65**	**24,386,958.75**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-81,672.43**	**-40,329.86**	**2,240.33**
五、现金及现金等价物净增加额	**98,452,840.26**	**-265,296.91**	**2,691,302.34**
加：期初现金及现金等价物余额	5,448,369.45	5,713,666.36	3,022,364.02
六、期末现金及现金等价物余额	**103,901,209.71**	**5,448,369.45**	**5,713,666.36**

二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化

（一）财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准

则——基本准则》和其他各项会计准则的规定（以下简称“新会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制 2008 年度、2009 年度和 2010 年度财务报表。

（二）财务报表合并范围及变化情况

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

三、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于

形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（3）终止确认部分的账面价值；

（4）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（三）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司于资产负债表日，将单项应收款余额占该类应收款项总余额 10%（含 10%）以上或单项应收款项期末余额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

本公司将账龄超过 3 年且不属于单项金额重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行组合分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）本公司根据款项性质采用账龄组合分析对应收款项计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例
一年以内(含一年)	5%

一至二年(含二年)	20%
二至三年(含三年)	50%
三年以上	100%

（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（5）对合并报表范围内各公司之间的应收款项单独进行减值测试，如果单项测试发生减值，按实际减值金额确认减值损失，计提坏账准备，如果单项测试未发生减值的，则不计提坏账准备。

（四）存货

1、存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等大类。

2、取得和发出存货的计价方法

原材料、低值易耗品和包装物的购入和发出采用计划成本计价，每月结转相应的材料成本差异；存货发出采用加权平均法核算。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以存货的公允价值为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

（1）存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

（五）长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

1、初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为

取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价

值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b.涉及合营企业基本经营活动

的决策需要各合营方一致同意。c.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c.与被投资单位之间发生重要交易。d.向被投资单位派出管理人员。e.向被投资单位提供关键技术资料。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（六）固定资产及折旧

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2、各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20 年	1.00-5.00	4.75-4.95
机器设备	5-10 年	1.00-5.00	9.50-19.80
运输设备	4-5 年	1.00-5.00	19.00 -24.75
办公设备及其他	3-5 年	1.00-5.00	19.00-33.00

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定

租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（七）在建工程

1、在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（八）无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

2、无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（1）对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3、寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

a.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

c.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开

发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（九）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

（十）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

1、递延所得税资产的确认依据

（1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金

额。

四、发行人适用的税率

（一）本公司适用的主要税种及税率如下：

税　　种	计税依据	税率%
增值税	产品、原材料销售收入	注 1
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7
教育费附加	应缴纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	注 2

注 1：国内销售收入增值税率为 17%，出口销售收入免征增值税。

注2：公司被认定为高新技术企业，根据企业所得税法规的规定，适用15%的企业所得税税率。

（二）主要子公司税率

1、吉安木林森

税　　种	计税依据	税率（%）
增值税	产品、原材料销售收入	17
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5
教育费附加	应缴纳流转税额	注 3
企业所得税	应纳税所得额	25

注 3：2008 年度、2009 年度、2010 年 1-8 月份教育费附加税率为 3%，2010 年 9-12 月份教育费附加税率为 5%。

2、格林曼

税　　种	计税依据	税率（%）
增值税	产品、原材料销售收入	17
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7
教育费附加	应缴纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25

3、威莱森

税　　种	计税依据	税率（%）
增值税	产品、原材料销售收入	注 4
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7

教育费附加	应缴纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25

注 4：国内销售收入增值税率为 17%，出口销售收入免征增值税。

4、安格森

税　　种	计税依据	税率（%）
增值税	产品、原材料销售收入	17
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7
教育费附加	应缴纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	注 5

注 5： 2008 年度、2009 年度被认定为小型微利企业适用所得税税率 20%，2010 年度所得税税率为 25%。

5、迪博

税　　种	计税依据	税率（%）
增值税	产品、原材料销售收入	17
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7
教育费附加	应缴纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25

五、经会计师核验的非经常性损益明细表

单位：元

非经常性损益项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	-5,758,445.43	-222,578.04	-297,080.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,120,975.00	5,041,600.86	5,924,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-

委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,340,051.80	551,024.73	-965,023.52
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,616.74	26,396.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,762.23	-31,216.53	-1,278,511.64
其他符合非经营性损益定义的损益项目	-	-	-
小 计	**-3,310,143.26**	**5,365,227.19**	**3,383,884.67**
减：所得税影响额	-721,782.11	864,457.38	403,598.58
少数股东权益影响额（税后）	-552,867.92	220,678.06	-266,436.03
合 计	**-2,035,493.22**	**4,280,091.75**	**3,246,722.12**

六、最近一期末主要资产

（一）固定资产

公司最近一期末固定资产账面净值为 43,522.05 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	17,168.17	144.49	17,023.68
机器设备	30,609.34	4,920.06	25,689.27
运输设备	626.51	217.00	409.51
办公设备及其他	752.49	352.90	399.59
合计	49,156.50	5,634.45	43,522.05

（二）在建工程

公司最近一期末在建工程账面价值为 2,331.67 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	1,997.12	-	1,997.12
小榄厂房建设	287.15	-	287.15
厂房及其附属工程	47.40	-	47.40
合　计	2,331.67	-	2,331.67

（三）无形资产

公司最近一期末无形资产账面价值为 6,267.54 万元，具体情况如下：

单位：万元

无形资产	摊销年限	取得方式	原始金额	累计摊销	期末摊余价值
土地使用权	43-50 年	自购	6,381.72	135.57	6,246.15
商标、专利注册费	10 年	自购	20.92	2.54	18.38
软件	10 年	自购	3.04	0.03	3.01
合计			6,405.68	138.14	6,267.54

七、最近一期末主要债项

（一）应付账款

截至 2010 年 12 月 31 日，应付账款余额为 14,377.26 万元，无欠持本公司

5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

（二）银行借款

截至 2010 年 12 月 31 日，短期借款余额为 16,684.00 万元，具体如下：

单位：万元

类别	2010-12-31
质押借款	4,684.00
抵押借款	7,000.00
保证借款	5,000.00
合　　计	16,684.00

（三）应付职工薪酬

截至 2010 年 12 月 31 日，应付职工薪酬余额为 1,071.88 万元，具体如下：

单位：万元

项目	2010-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	1,071.88
职工福利费	-
社会保险费	-
住房公积金	-
合计	1,071.88

八、所有者权益变动情况

单位：万元

项目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
股本	13,114.75	10,000.00	10,000.00
资本公积	20,814.17	1,426.61	1,316.42
盈余公积	676.07	790.69	414.11
未分配利润	6,246.22	6,964.31	3,162.88
归属于母公司股东权益	40,851.21	19,181.60	14,893.40
少数股东权益	1,217.87	898.00	807.28
股东权益合计	42,069.08	20,079.61	15,700.68

九、现金流量情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	16,647.40	5,700.97	4,608.16
投资活动产生的现金流量净额	-38,167.70	-7,317.67	-6,411.73
筹资活动产生的现金流量净额	31,517.46	980.29	2,802.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.53	-8.53	0.54
现金及现金等价物净增加额	9,984.63	-644.94	999.78

十、期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项

（二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十一、主要财务指标

（一）主要财务指标

财务指标	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动比率	0.98	1.08	1.10
速动比率	0.63	0.52	0.55
资产负债率（母公司）	53.39%	47.62%	52.83%
每股净资产（元）	3.11	1.60	1.24
财务指标	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
存货周转率（次）	4.06	2.80	2.77
应收账款周转率（次）	8.86	6.69	7.13
息税折旧摊销前利润（万元）	16,314.83	6,896.27	3,401.66

利息保障倍数（倍）	16.81	17.53	7.44
每股经营性现金流（元）	1.27	0.48	0.38

主要财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债`

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%（以母公司数据为基础）

归属于发行人股东每股净资产=归属于发行人股东期末净资产/期末股本总额（为提供各年可比较的财务信息， 2008 年及 2009 年每股指标按公司股本 12,000 万股算）

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销

利息保障倍数＝（合并利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额（为提供各年可比较的财务信息，2008 年及 2009 年每股指标按公司股本 12,000 万股计算）

（二）净资产收益率及每股收益

1、净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率		
	2010 年度	**2009 年度**	**2008 年度**
归属于公司普通股股东的净利润	37.99%	24.59%	12.23%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.92%	22.38%	10.14%

（2）每股收益

项目	基本每股收益			稀释每股收益		
	2010 年度	**2009 年度**	**2008 年度**	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**

归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.35	0.14	0.83	0.35	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.31	0.12	0.85	0.31	0.12

注：以上列示相关指标的计算公式参见《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010 年修订）。

十二、历次评估验资情况

公司整体变更为股份公司时，根据《公司法》和工商行政管理部门的要求，公司委托广东中广信资产评估有限公司对木林森有限进行了整体资产评估，评估基准日为 2010 年 6 月 30 日，经评估的净资产为 25,870.60 万元，增值率为 9.57%。该报告仅作为报送工商登记材料使用，公司未根据该评估报告调整财务报表。

第十一节　管理层讨论与分析

本公司提请投资者注意，以下讨论分析应结合本公司经审计的财务报表及报表附注和本招股说明书揭示的其他财务信息一并阅读。非经特别说明，以下数据均为经审计的财务报表口径，货币计量单位为人民币万元。

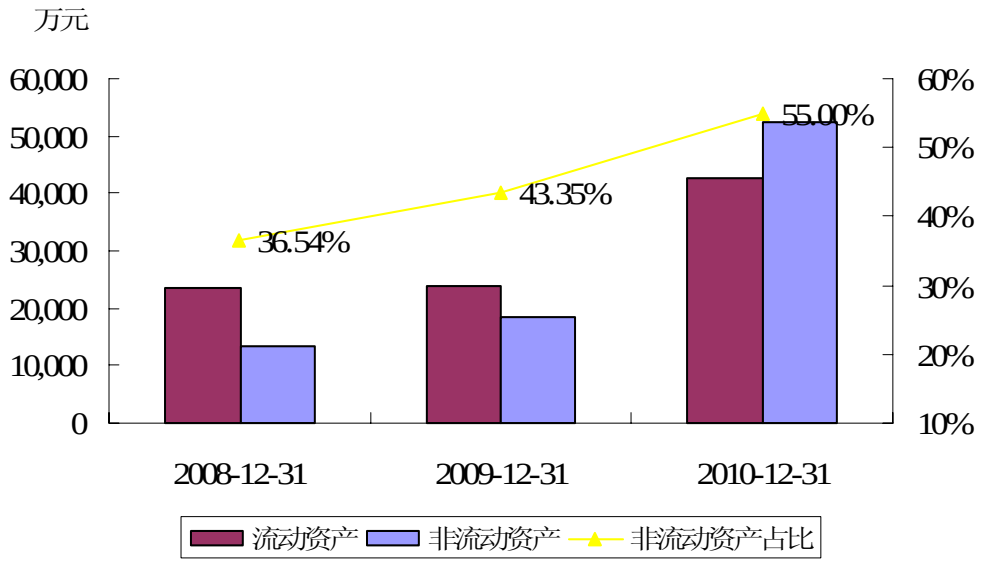
一、财务状况分析

（一）资产状况分析

1、资产结构及变化趋势

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	42,757.39	45.00%	24,014.04	56.65%	23,531.09	63.46%
固定资产	43,522.05	45.59%	13,669.46	32.25%	13,066.84	35.24%
在建工程	2,331.67	2.45%	1,856.06	4.38%	199.85	0.54%
无形资产	6,267.54	6.60%	2,705.65	6.38%	127.63	0.34%
递延所得税资产	141.33	0.15%	145.89	0.34%	154.07	0.42%
非流动资产合计	52,262.59	55.00%	18,377.05	43.35%	13,548.38	36.54%
资产总计	95,019.98	100%	42,391.08	100%	37,079.48	100%

报告期内，公司资产总规模呈快速增长态势，从 2008 年末的 37,079.48 万元增长到 2010 年末的 95,019.98 万元。公司资产总额的增长主要源于近几年公司在 LED 封装行业中取得了较高的声誉，获得销售订单增多，带动公司营业收入快速增长。与此相适应，公司新增了大量的机器设备，购置了土地使用权，新建生产基地及办公场所、并加大了原材料的采购力度，以上因素导致应收账款、存货和固定资产、无形资产的期末余额也相应增长，从而带动资产总额快速增长。公司的资产结构变化趋势如下图：



报告期内，公司非流动资产占总资产比重从 2008 年末的 36.54%上升至 2010 年末的 55.00%，非流动资产占比偏高及呈上升态势。主要原因为：第一、随着 LED 封装生产技术的不断革新，用于 LED 封装的机器设备目前已大规模实现全自动化，替代原先半自动化半人工的格局。本公司近几年加大了先进自动化机器设备的采购力度，而自动化机器设备的价值相对较昂贵，导致公司非流动资产中的固定资产占比较高；第二、由于公司早期资金有限，母公司生产经营及办公场所均通过租赁方式取得，公司分别在中山市五桂山龙石村及中山市小榄镇购得工业用地，该土地使用权于 2009 年末、2010 年上半年转入无形资产，并在中山市小榄镇工业区新建生产基地及办公场所，因此导致非流动资产中的固定资产及无形资产大幅增加。

随着本次发行募集资金投资项目的实施，公司的房屋建筑物及设备类固定资产将会有所增加，届时固定资产在总资产中的比例将有所上升。

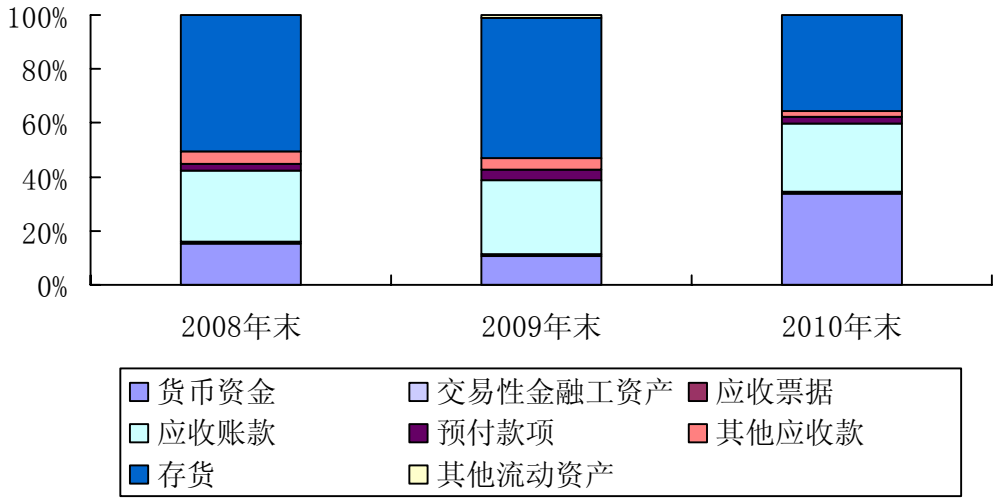
2、流动资产构成分析

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	14,508.48	33.93%	2,589.53	10.78%	3,575.93	15.20%
交易性金融资产	-	-	1.90	0.01%	-	-
应收票据	320.90	0.75%	112.45	0.47%	168.67	0.72%
应收账款	10,775.90	25.20%	6,612.58	27.54%	6,206.41	26.38%

预付款项	974.29	2.28%	903.49	3.76%	629.90	2.68%
其他应收款	919.88	2.15%	1,075.45	4.48%	1,092.69	4.64%
存货	15,257.95	35.68%	12,495.62	52.03%	11,857.49	50.38%
其他流动资产	-	-	223.01	0.93%		
流动资产合计	42,757.39	100%	24,014.04	100%	23,531.09	100%

报告期内，公司流动资产随营业收入的增长呈上升态势，从 2008 年末的 23,531.09 万元增长到 2010 年末的 42,757.39 万元。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货组成， 2008 年末、2009 年末和 2010 年末三项资产合计占流动资产的比重分别为 91.96%、90.35%和 94.82%。

本公司流动资产构成呈现以下特点：应收账款相对金额大、账龄短。公司的客户都为国内外知名企业，其信誉良好，回款有保证，发生坏账的风险小；销售订单规模扩大导致公司存货余额较大。流动资产的结构变化趋势如下图：



各类资产的具体变化情况分析如下：

（1）货币资金

报告期内，货币资金期末余额分别为 3,575.93 万元、2,589.53 万元和 14,508.48 万元，货币资金在流动资产中所占的比重分别为 15.20%、10.78%和 33.93%。报告期内，货币资金期末余额总体保持逐步增加态势，主要原因为公司生产经营规模的进一步扩大，对货币资金的需求相应增加，同时销售收入增加及回款力度的加大也导致货币资金期末余额增加。

2010 年末，公司货币资金为 14,508.48 万元，较上年末增加 11,918.95 万元，主要系公司于 2010 年新增银行借款 24,356 万元及 2010 年 9 月 21 日引进新的投资者增资 10,200.00 万元，除满足公司投资活动用于购置机器设备及扩建生产基地所需外有所结余所致。该部分资金将主要用于公司在小榄镇工业区生产基地及办公场所的建设。

报告期内，其他货币资金余额分别为 1,532.41 万元、1,190.95 万元和 416.25 万元，其他货币资金主要系公司开具银行承兑票据保证金。

（2）交易性金融资产

2009 年末交易性金融资产余额为 1.90 万元，主要系随着 2009 年国内证券市场转暖，为提高货币资金的利用效率，子公司威莱森使用闲置流动资金用于短期投资，主要方式为在一级市场中申购新股。为保障资金运营的安全性，公司改制前将证券市场的短期投资全部收回，并注销其证券账户，且在股份公司设立后严格按照《公司章程》等相关管理制度进行对外投资决策。

（3）应收票据

报告期内，应收票据期末余额分别为 168.67 万元、112.45 万元和 320.90 万元。随着公司销售规模的扩大，获取的销售订单增多，部分客户采取银行汇票与公司结算。目前采取票据结算的客户主要为美的、创维、力升等公司，由于应收票据信用较高及能按期收回货款，防止拖欠，且在急需资金时，还可以向银行申请贴现，有效扩大了公司资金流动性。

（4）应收账款

报告期内，公司应收账款账龄如下：

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	11,307.09	99.58%	6,818.37	96.97%	6,197.91	93.60%
一至二年	42.06	0.37%	159.75	2.27%	379.85	5.74%
二至三年	1.01	0.01%	14.67	0.21%	29.03	0.44%
三年以上	4.68	0.04%	38.31	0.54%	14.94	0.23%
合计	11,354.84	100%	7,031.09	100%	6,621.73	100%

报告期内，公司应收账款余额较大，截至 2010 年末，账龄在一年内的应收

账款为 99.58%，发生坏账的可能性较小。

- 应收账款较大原因分析

报告期内，公司应收账款净额为 6,206.41 万元、6,612.58 万元和 10,775.90 万元，与营业收入增长相配比，公司应收账款净额也呈增加态势。公司应收账款总额较大，主要原因为：根据行业惯例，LED 封装产品供应商通常会给予下游 LED 应用厂商 60 天至 90 天的信用期，下游客户多为国内从事家用电器、灯饰照明等行业中较知名企业，由于其信誉良好，还款有保证，公司为了扩大市场及加强长期客户战略合作关系，通常会给予一定的信用期；而对于经销商，公司一般会给予30天至60天的信用期，经销商销售渠道有效减少了占用公司流动资金；对于新开发、规模较小的客户则采取先收款后发货的销售方式。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司前五大应收账款余额情况如下：

客户	金额
中山格兰仕工贸有限公司	1,715.51
ROUNDTRIPPING LTD,	1,302.07
YUCENT GROUP LIMITED	1,118.38
深圳市富士新华电子科技有限公司	468.36
山东霓虹王电子有限公司	448.31
合计	5,052.63
占应收账款余额比重	44.50%

- 坏账计提比例

公司客户多为一些信誉良好、长期合作的客户，客户具有较高的资信水平和偿债能力，公司应收账款回收有保证，发生坏账的可能性较小。公司根据谨慎性原则，每年仍然以稳健的比例计提坏账准备。公司对坏账准备的计提比例如下：

账龄	计提比例
一年以内（含一年）	5%
一年至二年（含二年）	20%
二年至三年（含三年）	50%
三年以上	100%

报告期内，公司每年对应收账款计提的坏账准备余额平均比重为 6.27%、

5.95%和 5.07%，应收账款坏账计提充分。

- 应收账款变动分析

报告期内，公司应收账款余额呈上升的态势，其中 2009 年末较上年末增加 409.36 万元，2010 年末较上年末增加 4,323.75 万元，主要原因为近年来随着公司业务规模的不断扩大，营业收入增长迅速，客户数量及销售额大幅增加所致。

- 与同行业上市公司的比较

目前国内上市公司中与本公司业务类型相似的可比公司为国星光电、雷曼光电，应收账款周转率对比情况如下表所示：

名称	2010 年度	2009 年度	2008 年度
国星光电	6.25	4.85	5.64
鸿利光电	5.82	4.48	7.87
雷曼光电	7.84	6.81	9.04
平均	6.64	5.38	7.52
本公司	8.86	6.69	7.13

报告期内，本公司应收账款周转率分别为 7.13、6.69 和 8.86，高于同行业平均水平，表明公司应收账款管理较好，收款较及时。

- 应收账款管理

公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、谨慎选择销售客户，严格使用应收账款的信用条款，包括信用评估与管理、赊销审批与执行，将货款回收情况作为业务部门业绩考核的重要依据；第二、通过建立客户动态管理制度，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取措施，加大应收账款的回收力度。第三、依据谨慎性原则，公司于 2010 年主要核销了应收喜斯达电器(惠州）有限公司货款 27.83 万元、中山市西格玛科技照明有限公司货款 11.72 万元及深圳市雅佳誉电子有限公司货款 12.50 万元，主要原因为以上公司财务状况严重恶化导致无法收回该款项。近三年，应收账款周转率分别为 7.13、6.69 和 8.86，呈上涨态势，表明公司应收账款管理较好。随着公司市场竞争力的不断增强，公司将继续严格应收账款管理，防范风险。

公司管理层认为：

报告期内，公司对应收账款的管理保持连续性和一致性，应收账款政策维持稳定，没有拖欠货款的情况发生。公司制订的信用政策及应收账款管理措施符合公司的实际情况及内部控制要求，近年来货款回笼良好，公司坏账准备计提足额、合理，不存在因应收账款数量过大而影响公司持续经营能力的情形。

（5）预付款项

报告期内，公司预付款项余额分别为 629.90 万元、903.49 万元和 974.29 万元，占流动资产比重分别为 2.68%、3.76%和 2.28%。预付款项主要内容为预付机器设备采购款。近几年，公司持续扩大 LED 封装产品的产能，增加采购机器设备，而大部分设备供应商需预付部分设备款。

（6）其他应收款

报告期内，公司其他应收款净值分别为 1,092.69 万元、1,075.45 万元和 919.88 万元，其他应收款内容主要为公司应收出口退税款及租赁厂房、办公场所、员工宿舍的押金。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司前五大其他应收款余额情况如下：

单位：元

客户	金额	性质
应收出口退税	4,633,183.74	出口退税款
海关进口保证金	1,387,832.57	海关进口保证金
广东美的制冷设备有限公司	500,000.00	投标保证金
中山市石岐物业管理公司	292,588.00	厂房租赁押金
中国石油化工股份有限公司广东中山石油分公司	235,195.27	押金
合计	7,048,799.58	
占其他应收款余额比重	72.74%	

（7）存货

报告期内，公司存货明细情况如下表所示：

种类	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

原材料	4,875.31	31.95%	2,920.24	23.37%	1,987.66	16.76%
库存商品	8,658.19	56.74%	8,491.94	67.96%	8,524.48	71.89%
在产品	1,664.82	10.91%	1,068.95	8.55%	1,294.84	10.92%
低值物耗品	59.63	0.39%	14.49	0.12%	50.51	0.43%
合计	15,257.95	100%	12,495.62	100%	11,857.49	100%

- 存货余额较大且呈逐年增加态势的原因

截至 2010 年末，公司存货余额为 15,257.95 万元，占流动资产比重为 35.68%。报告期内，公司存货余额较大且呈逐年增加的态势，主要是由于：

第一，随着生产销售规模的扩大，公司存货呈现自然增长。公司营业收入 2009 年较 2008 年增加 7,101.43 万元，增长幅度为 18.43%，2010 年较 2009 年增加 35,836.10 万元，增长幅度为 78.52%，。由于营业收入的快速增长，公司生产所需较多的存货以支撑业务规模的扩大，存货保持与营业收入同步增长。

第二，公司为一家从事 LED 封装器件及下游 LED 应用产品研发及生产的高新技术企业，行业产业链较长，公司目前的产品包括 Lamp LED、LED 应用（包括显示屏、室内外照明灯及灯饰）、Display 和 SMD LED，不同产品的规格、型号也较多，多系列产品导致公司备货金额相对较高。另外，为了降低外购原材料成本，公司 LED 封装器件生产所需原材料支架、胶水均通过自制完成，生产环节覆盖面较广也使公司存货金额相对较高。

第三、出于对 LED 应用产品稳定性考虑，客户对于封装产品的规格、型号、颜色区域等要求较统一，而由于 LED 封装设备的特殊性，生产的最终封装产品存在差异，公司依靠规模化优势，在满足不同客户的需求同时，也增加了公司存货储备，使得公司产品在 LED 封装市场上具有较大的竞争优势，

第四，由于芯片为 LED 封装产品最具核心的原材料，市场需求量和价格波动较大，为保证原材料的稳定供应，降低市场经营风险，公司需要储备原材料以备生产经营使用。目前，公司已与台湾芯片供应商晶元光电和光磊科技形成了长期的战略合作关系，且采购周期相对较长，公司采取了提前式采购订单计划，从台湾采购芯片需要 50 天左右，导致芯片采购库存量较大；另一方面，其他主要原材料胶水、金线、铜带受国际原油、黄金、铜价格波动影响较大，公司需储备较多该种原材料以抵抗价格上涨带来不利影响。

- 公司库存商品占存货比重较高的原因分析

报告期末，公司库存商品余额分别为 8,524.48 万元、8,491.94 万元和 8,658.19 万元，占存货比重分别为 71.89%、67.96%和 56.74%，库存商品占比较高，主要系公司产品型号规格较多，体积小、数量大，客户的销售订单相对较大，为了快速响应市场及满足客户需求，公司需备存较多的库存商品；同时，公司业务特征季节性波动较明显，一般 2、3、4 季度为行业旺季，为了平滑季度性波动对公司生产经营影响，公司也需备存部分通用标准产品用于旺季销售。

另外，公司与国内大型家用电器生产商建立了长期合作关系，受客户的采购模式决定（主要系格兰仕、美的等），公司每月频繁出货，货物到达客户处后，经过客户检验合格验收入库，公司一般于下月初定期进行对账，核对本月发出产品数量、单价、金额、产品品种等，经双方确认无误后确认营业收入并结转库存商品，导致库存商品中的发出商品较大。报告期末，发出商品期末余额分别为 1,403.10 万元、1,549.67 万元、2,273.13 万元，占存货比重分别为 11.83%、12.40%、14.90%，也导致公司库存商品占比较高。

与同行业企业库存商品占存货比重对比情况如下：

费用种类	2010 年末		2009 年末		2008 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国星光电	16,576.21	68.99%	7,102.32	61.64%	8,012.60	69.92%
鸿利光电	3,023.54	40.89%	1,710.27	43.21%	1,427.07	43.85%
雷曼光电	3,886.62	66.58%	1,435.15	64.13%	1,016.39	65.61%
本公司	8,658.19	56.74%	8,491.94	67.96%	8,524.48	71.89%

注：“占比”指占存货的比重

从上表可看出，同行业中库存商品占存货比重较高为行业普遍特点。2008 年末、2009 年末，公司库存商品占存货比重偏高于同行业水平，2010 年末则高于鸿利光电，低于国星光电及雷曼光电，主要系公司于 2010 年加大库存商品管理力度，且取得良好效果，导致库存商品占存货比重下降。

- 存货跌价准备的计提

公司对于存货原材料确认是否具有使用价值（如原材料是否过期、毁损），对于不具备使用价值的原材料计提全额跌价准备；对于库存商品及低值物耗品检查是否受产品升级淘汰、库存账龄长等情况而计提跌价准备。根据谨慎性原则，公司于 2010 年针对库存商品计提了 567.60 万元的存货跌价准备，并在 2010 年末转销处理了该批存货。

公司管理层认为，报告期内公司存货质量较好，存货金额、增长速度处于行业合理水平，符合行业及公司的运营特征。存货的正常增长成为公司销售增长的有效保障。在未来一段时期内，公司将进一步规范存货管理，合理安排采购、生产及备货，在确保公司正常生产经营前提下，减少存货占用流动资金的比重。

- 与同行业上市公司的比较

目前国内上市公司中与本公司业务类型相似的可比公司国星光电、鸿利光电、雷曼光电，其存货周转率对比情况如下表所示：

存货周转率	2010 年度	2009 年度	2008 年度
国星光电	3.44	3.66	3.21
鸿利光电	4.96	4.73	7.21
雷曼光电	3.24	3.26	3.41
本公司	4.06	2.80	2.77

2008、2009 年的存货周转率分别为 2.77、2.80，偏低于行业平均水平，主要系由于公司 LED 封装器件生产所需的原材料支架、胶水大部分通过自产获取，而国星光电、鸿利光电、雷曼光电则通过外购完成，公司生产环节覆盖面较全导致存货余额偏高。

2010 年，公司存货周转率为 4.06，与同行业水平相当，主要系公司于 2010 年加大存货管理力度，并取得良好效果；同时，随着产能、产量提升，公司能快速满足客户的订单需求，存货备货量也相应较少，也导致 2010 年存货周转率有所上升。

3、非流动资产分析

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	43,522.05	83.28%	13,669.46	74.38%	13,066.84	96.45%
在建工程	2,331.67	4.46%	1,856.06	10.10%	199.85	1.48%
无形资产	6,267.54	11.99%	2,705.65	14.72%	127.63	0.94%
递延所得税资产	141.33	0.27%	145.89	0.79%	154.07	1.14%
非流动资产合计	52,262.59	100%	18,377.05	100%	13,548.38	100%

（1）固定资产

报告期内，公司固定资产余额变动情况如下：

种类	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋建筑物	17,023.68	39.12%	676.89	4.95%	716.34	5.48%
机器设备	25,689.27	59.03%	12,392.73	90.66%	11,730.39	89.77%
办公设备及其他	409.51	0.94%	352.64	2.58%	330.7	2.53%
运输设备	399.59	0.92%	247.19	1.81%	289.41	2.21%
合计	43,522.05	100%	13,669.46	100%	13,066.84	100%

公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、办公设备及运输设备，使用状况良好。截至 2010 年 12 月 31 日，公司固定资产余额为 43,522.05 万元，占总资产的比重为 45.80%，其中房屋建筑物占固定资产余额的 39.12%、机器设备占固定资产余额的 59.03%、办公设备及其他占固定资产余额的 0.94%、运输设备占固定资产余额的 0.92%。公司近几年处于快速成长阶段，随着公司业务规模扩大，为了扩大产能，公司不断引进先进的机器设备，因此报告期内固定资产余额有所增加。

未来几年，通过募集资金投资项目及其他可能的自有资金投资项目的建设，公司将投资购置相当数量的机器设备和办公设备等固定资产，届时固定资产总额将有较大规模的增长，其占总资产的比重将有所上升。

（2）无形资产

2010 年末，公司无形资产明细情况如下：

无形资产	摊销年限	原始金额	累计摊销	期末摊余价值
土地使用权	43-50 年	6,381.72	135.57	6,246.15
商标、专利注册费	10 年	20.92	2.54	18.37
软件	10 年	3.04	0.03	3.01
合计		6,405.68	138.14	6,267.54

报告期内，无形资产期末余额分别为 127.63 万元、2,705.65 万元和 6,267.54 万元，无形资产主要构成为土地使用权和商标、专利注册费。公司于 2009 年 12 月、2010 年 4 月分别在中山市五桂山龙石村及中山市小榄镇购得工业用地导致 2009 年末、2010 年末无形资产大幅增加。

（二）资产减值准备提取情况

项目	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
坏账准备：	628.15	533.18	497.97
其中：应收账款	578.95	418.51	415.32
其他应收款	49.20	114.67	82.65
存货跌价准备	-	-	-
合计	628.15	533.18	497.97

公司已根据企业会计准则及公司的具体情况对应收账款、其他应收款提取了坏账准备。报告期末账龄在一年以内的应收账款为 99.58%，发生坏账的风险较小，故坏账准备提取金额相对较小；公司对存货中库存商品于 2010 年计提了 567.60 万元的存货跌价准备，主要系由于受产品升级影响，对库龄较长、毁损的库存商品进行了清理，全额计提了存货跌价准备，并于 2010 年末转销处理该存货。

公司固定资产、在建工程等其他资产未发生需提取减值准备的情形，故未计提资产减值准备。

公司管理层认为，公司根据实际情况制定了稳健的资产减值准备计提政策，

主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在因资产减值准备计提不足而影响公司持续经营能力的情形。

（三）负债结构及主要项目分析

1、负债构成分析

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	43,452.11	82.06%	22,293.16	99.92%	21,378.80	100.00%
长期借款	9,430.00	17.81%	-	-	-	-
递延所得税负债	18.80	0.04%	18.32	0.08%	-	
其他非流动负债	50.00	0.09%	-		-	
负债合计	52,950.91	100%	22,311.48	100%	21,378.80	100%

报告期内，与公司资产总额增长趋势一致，负债总额也呈增长态势，从 2008 年末的 21,378.80 万元增至 2010 年末的 52,950.91 万元。公司负债大部分为流动负债。2010 年末的其他非流动负债主要系子公司吉安木林森收到下拨科技专项经费 50 万元，确认递延收益所致。

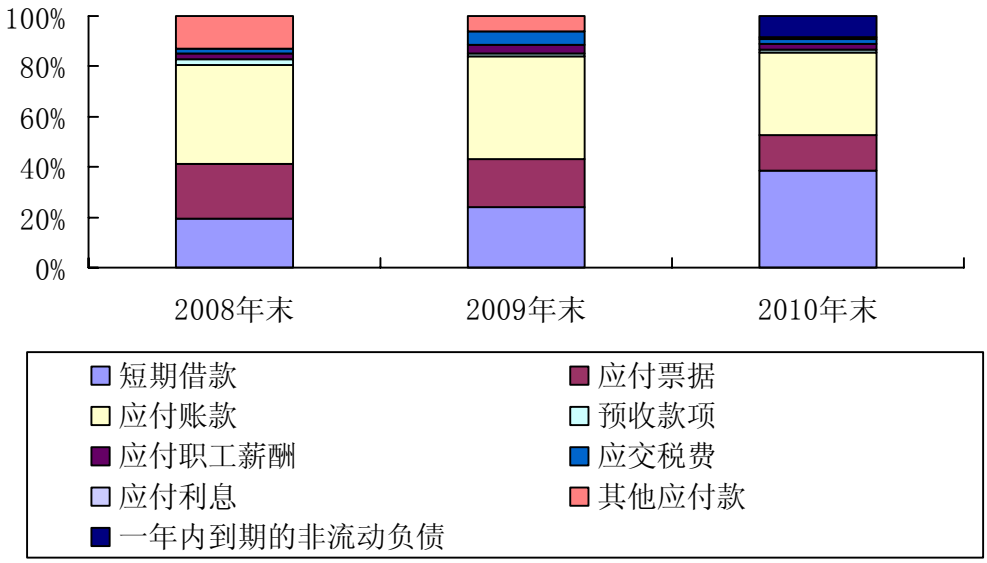
2、流动负债构成分析

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	16,684.00	38.40%	5,328.00	23.90%	4,185.00	19.58%
应付票据	6,130.25	14.11%	4,313.50	19.35%	4,635.00	21.68%
应付账款	14,377.26	33.09%	9,114.27	40.88%	8,364.92	39.13%
预收款项	414.23	0.95%	253.87	1.14%	503.91	2.36%
应付职工薪酬	1,071.88	2.47%	698.61	3.13%	500.85	2.34%
应交税费	716.38	1.65%	1,202.99	5.40%	402.4	1.88%
应付利息	43.98	0.10%	6.87	0.03%	15.02	0.07%
其他应付款	444.13	1.02%	1,375.04	6.17%	2,771.70	12.96%
一年内到期的非流动负债	3,570.00	8.22%	-	-	-	-

流动负债合计	43,452.11	100%	22,293.16	100%	21,378.80	100%

报告期末，与流动资产相匹配，公司流动负债也呈增长态势，从 2008 年末的 21,378.80 万元增长到 2010 年末的 43,452.11 万元。公司流动负债主要由短期借款、应付票据和应付账款组成，2008 年末、2009 年末、2010 年末三项负债合计占流动负债的比重分别为 80.39%、84.13%和 85.59%。

本公司流动负债构成呈现以下特点：与公司流动资产中存货高配比，公司的应付账款较大；融资渠道多样化，增加短期借款，满足公司营运资金需求。流动负债的结构变化趋势如下图：



（1）短期借款

报告期末，公司短期借款余额分别为 4,185.00 万元、5,328.00 万元和 16,684.00 万元，主要系随着公司业务规模的扩大，获得的销售订单增多，公司需耗用更多的营运资金来满足生产经营的需求，同时，报告期内公司主要融资渠道为银行借款。2010 年末短期借款较上年末增加 11,356.00 万元，主要系公司为了扩大产品产能，增加向银行借款用于满足购买固定资产及相应配套的流动资金需求。

（2）应付票据

报告期内，应付票据期末余额分别为 4,635.00 万元、4,313.50 万元和 6,130.25 万元，占流动负债的比重分别为 21.68%、19.35%和 14.11%，应付票据主要为向供应商开具的银行承兑汇票及商业汇票。具体明细如下：

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	1,107.50	18.07%	2,205.73	51.14%	1,264.11	27.27%
商业承兑汇票	5,022.75	81.93%	2,107.77	48.86%	3,370.89	72.73%
合计	6,130.25	100%	4,313.50	100%	4,635.00	100%

目前，公司主要向芯片供应商晶元宝晨采取商业汇票方式进行货款结算，主要系公司与晶元光电已有多年合作，公司付款能力得到对方的高度认可。通过应付票据与原材料供应商进行结算，有效的扩大了公司融资渠道，减少财务费用支出。

（3）应付账款

报告期内，公司应付账款账龄分析如下：

项目	2010-12-31		2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	14,276.83	99.30%	8,656.91	94.98%	7,829.96	93.60%
一至二年	100.43	0.70%	457.36	5.02%	534.96	6.40%
二至三年	-	-	-	-	-	-
三年以上	-	-	-	-	-	-
合计	14,377.26	100%	9,114.27	100%	8,364.92	100%

报告期内，公司应付账款余额分别为8,364.92万元、9,114.27万元和14,377.26万元，与公司存货增长趋势相配比，公司应付账款也呈增加的态势，应付账款主要为公司正常生产经营过程中应付材料采购款。报告期内，公司应付账款大部分都在一年以内，表明公司能及时偿还供应商货款，不存在拖欠供应商采购原材料款情况发生。

（4）其他应付款

报告期内，公司其他应付款期末余额分别为2,771.70万元、1,375.04万元和444.13万元。2008末和2009年末，其他应付款期末余额主要为欠付实际控制人孙清焕暂借款。近几年，受公司业务规模迅速扩大影响，公司通过向孙清焕暂借款方式解决业务发展带来部分资金需求。2010 年上半年，公司偿还了该借款，导致2010年末其他应付款较上年末减少930.91万元。

（四）偿债能力分析

报告期内，公司的主要财务指标如下表所示：

财务指标	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动比率	0.98	1.08	1.10
速动比率	0.63	0.52	0.55
资产负债率(母公司)	53.39%	47.62%	52.83%
财务指标	**2010 年度**	**2009 年度**	**2008 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	16,314.83	6,896.27	3,401.66
利息保障倍数	16.81	17.53	7.44

报告期内，公司流动比率和速动比率与公司业务发展模式相适应。其中流动比率、速动比率相对较低，主要系受公司机器设备自动化程度不断提高及增加购买土地使用权，导致目前资产结构中非流动资产比重较大，而流动资产占比呈下降态势，同时公司主要融资渠道短期银行借款余额呈增加态势，也是流动比率、速动比率较低的另外一个因素。

报告期内，公司资产负债率分别 52.83%、47.62%和 53.39%，保持在 50%左右，表明公司随着业务发展并持续盈利，自有资本逐步增强，在控制风险的基础上合理利用财务杠杆，适应了公司业务规模的快速增长，公司资产负债管理能力较强。随着募集资金投资项目的实施，公司资产负债率将进一步下降，资本结构将进一步优化，抗风险能力逐步增强。

报告期内公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均较高，表明公司盈利能力和长期偿债能力较强。此外，公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的需特别披露的或有负债，亦不存在表外融资的情况。

上述情况表明，公司负债水平合理，资产流动性较高，银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。

（五）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下表所示：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度

应收账款周转率	8.86	6.69	7.13
应收账款周转天数	41	54	50
存货周转率	4.06	2.8	2.77
存货周转天数	89	128	130
总资产周转率	1.19	1.15	1.21

报告期内，公司应收账款周转率为 7.13、6.69 和 8.86，应收账款周转较快，主要系公司与主要客户合作关系稳固，客户付款及时，同时公司加强应收账款管理，取得良好效果。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.77、2.80 和 4.06，存货周转相对较慢，主要系由于行业经营特点影响，公司存货数量较大，2010 年存货周转率较快，主要系公司于 2010 年加强存货管理力度，并获得良好效果，存货占流动资金比重有所下降所致。

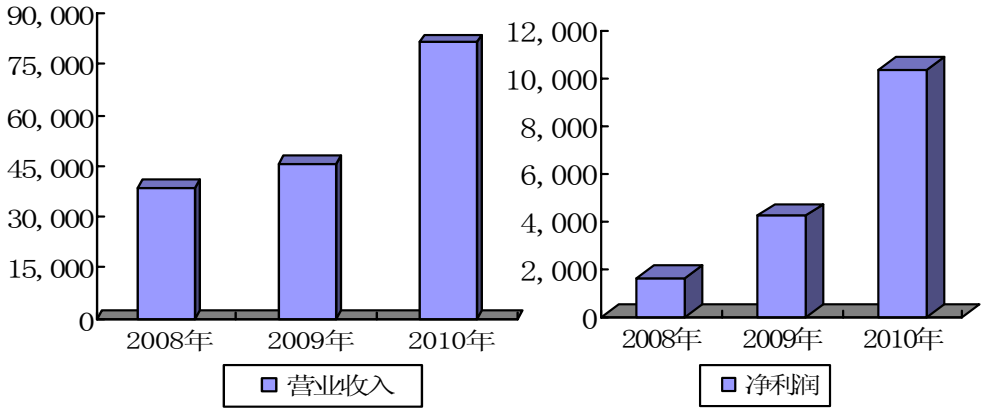
经过多年的发展，公司已建立适应自身生产经营特点和市场状况的生产、物流、销售和财务管理模式，并得到有效执行，公司具有良好的资产周转能力，资产管理效率较高。

二、盈利能力分析

（一）经营业绩情况总体分析

报告期公司经营成果如下表：

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	81,476.63	78.52%	45,640.52	18.43%	38,539.09
净利润	10,397.19	146.92%	4,210.68	162.54%	1,603.85



报告期内公司经营业绩增长迅速，营业收入 2009 年较上年增长 18.43%，2010 年较上年增长 78.52%；净利润 2009 年较上年增长 162.54%，2010 年较上年增长 146.92%。

（二）营业收入构成及变化趋势分析

1、营业收入变化趋势及原因分析

报告期内公司营业收入绝大部分来源于主营业务 LED 封装器件及下游应用产品的销售，其他业务收入（主要为销售原材料等收入）所占比重极小。具体收入结构如下表所示：

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
LED 封装器件及应用产品	78,155.49	95.92%	44,491.56	97.48%	36,977.31	95.95%
其他业务收入	3,321.13	4.08%	1,148.96	2.52%	1,561.77	4.05%
营业收入	81,476.63	100%	45,640.52	100%	38,539.09	100%

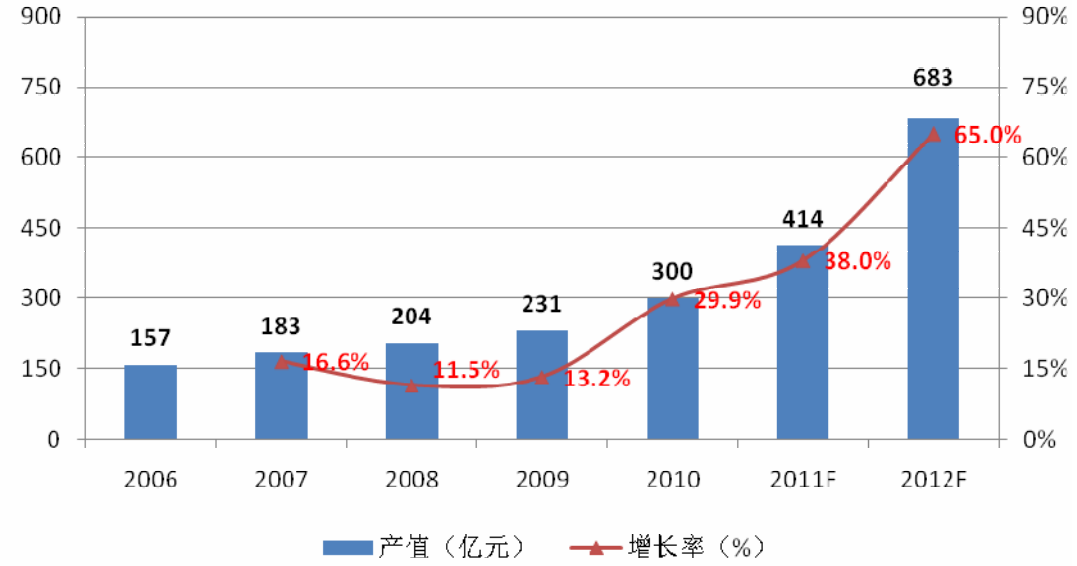
报告期内，公司作为国内 LED 封装器件及下游应用产品的主要供应商，营业收入迅速增长的主要原因包括以下几个方面：

（1）市场需求不断增加是公司收入增长的外在基础，导致公司各产品销量增加

LED 光电行业是一个新兴的朝阳产业，具有节能、环保的特点，尤其是 2009 年 12 月在哥本哈根召开全球气候会议倡导的低碳经济，获得全球各国在 LED 照明领域的大力支持，市场需求量呈不断上升的态势。近年来，随着国内 LED 产

品的推广应用，特别是 LED 背光电视、节日灯和照明领域等的广泛应用，促使了国内 LED 行业的快速发展。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟及拓墣产业研究所的统计，2010 年国内 LED 产业实现产值 300 亿元，增幅为 29.9%，预计 2011 年国内 LED 产值超过 400 亿元。

2006-2012 年中国 LED 产值增长



数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，拓墣产业研究所

（2）公司建立和健全国内较齐全的LED封装系列产品，并逐步延伸LED下游应用产品，提高公司市场占有率

报告期内，公司不断建立和健全国内较齐全的 LED 封装及应用系列产品，抓住行业发展契机，顺应国家产业政策，不断扩大公司在 LED 下游封装及应用行业中的影响力。目前，公司产品涵盖 Lamp LED、LED 应用（包括显示屏、室内外照明灯和灯饰）、Display、SMD LED 四大系列产品，能满足不同客户对各系列产品的颜色、形状、尺寸等个性化需求。

近年来，国内 LED 产业逐步朝着下游应用行业发展，特别是科技部启动的“十城万盏”半导体照明应用工程以来，带动国内 LED 下游应用产业进入了快速发展阶段。公司在发展封装系列产品的同时，逐步延伸 LED 的下游应用产品，顺应国家政策，做大做强公司的各系列产品线，不断提高公司的市场占有率。

（3）凭借着领先的封装技术及产品高质量优势，公司在行业中的品牌知名度不断得到提升，获得长期合作客户的订单不断增加

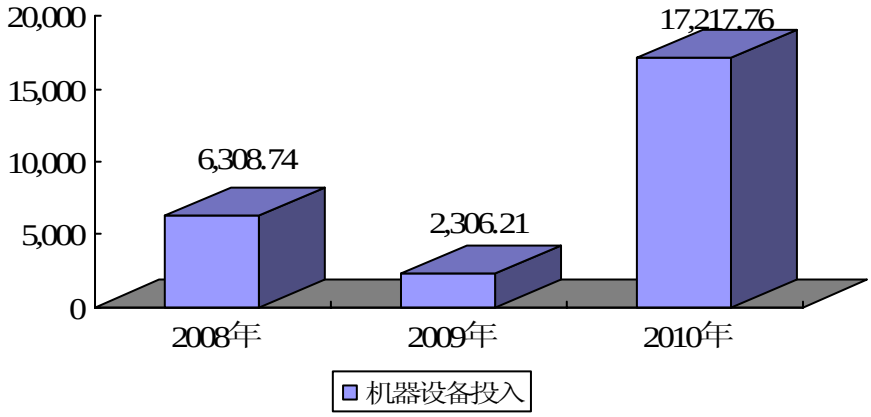
2006 年 4 月，公司与中山大学联合成立了“中山大学木林森光电技术研究中心暨半导体照明联合实验室”，专门用于从事具有自主知识产权的 LED 材料、芯片、封装及应用技术的研究；公司着重于产学研合作，并成立了技术研发部与实验小组，聘请了境外高科技研发人员与国内技术精英组成项目研发专案小组；高科技的精英人才结合公司科研技术的创新机制，公平合理的评价办法与经费使用，及激发工作热情的奖励措施，使得公司的研发技术水平一直处于同行业领先水平。

另外，公司一直致力于产品质量监控与保障，不断建立健全公司的质量管理体系，2004 年公司成功通过了 ISO9001：2000 质量管理体系认证；2005 年，公司成功导入 ROHS 欧盟环保指令标准，并通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证；2007 年，公司通过美国 UL 产品安全认证并于 2008 年通过美国 UL ROHS 认证，确保了整个生产过程符合环保要求。公司内部通过制定一系列的产品相关标准，保证公司产品在生产各个环节的质量，力保公司的产品质量一直保持在行业的领先水平。近几年，公司在行业中的品牌知名度不断得到提升，获得客户销售订单也呈增加的态势。

（4）公司加大了国际先进、全自动化制造设备投入力度，扩大了公司产品的产能及规模化、标准化生产带动的较低产品成本，使公司LED封装产品市场竞争力不断加强

公司不断加大国际先进、全自动化机器设备的投入力度。目前，公司从全球最大的 LED 生产设备供应商 ASM 引进先进的全自动固晶机、焊线机等制造设备，大幅度提高了公司产品的产能。与传统的手工 LED 封装企业面临着技术水平低、封装设备落后、产业规模小、生产效率低且产品品质不稳定等诸多问题，公司引进国际先进的全自动化生产设备，从根本上解决了以上问题，且有利于吸收国外的先进工艺生产技术，为公司营业收入的增长奠定了坚实基础。

报告期内公司机器设备投入情况如下图：



2010 年 5 月，公司参与“标准化良好行为企业”的申报。标准是技术创新和创新成果推广应用的有效途径，公司通过制定一系列的标准，从生产到管理，从技术到品质，以标准化的战略形成标准化的生产模式，优化公司的产品结构并节约资源。

公司产能的扩大、规模化以及标准化的生产条件，使得公司 LED 封装产品具有较强的市场竞争力。

（5）公司2010年营业收入大幅增长原因分析

2010 年，公司营业收入较 2009 年增加 35,836.11 万元，增长幅度为 78.52%。受益于 LED 封装及应用市场需求增多，及公司在行业中的市场知名度扩大，与公司长期合作客户对 LED 封装及应用产品需求也呈增加的态势，长期合作客户带动公司营业收入增加 27,883.08 万元，占当年营业收入增加额的 77.81%。凭借着在行业内良好的口碑，公司于 2010 年加大市场营销力度，获得部分新增 LED 下游客户，其中营业收入超过 200 万元的新增客户为 9 家，新增客户带动公司营业收入增加 7,953.03 万元，占当年营业收入增加额的 22.19%。公司 2010 年营业收入较上年大幅增加的原因如下：

- 长期稳定并持续扩大的核心客户群是公司业绩持续增长的基础

公司不断强化“服务型营销”理念，对重要客户派遣驻厂人员，积极为客户提供各种技术、信息服务，从而使公司积累了大批优质、长期合作客户，而一旦客户选择了本公司作为 LED 封装产品供应商，出于稳定下游产品质量及成本因素考虑，一般不轻易更换原材料供应商，且本公司作为国内 LED 封装产品的领先供应商，规模化优势明显，能大规模提供 LED 封装产品，保证下游 LED 应用

客户的旺季需求。由于下游 LED 应用行业景气度较高，公司核心客户均对 LED 封装产品需求有所增加。2010 年，长期合作客户带动公司营业收入增长如下：

单位：万元

长期合作客户	2010 年		2009 年
	金额	增长额	金额
协顺电器	4,352.19	474.39	3,877.80
东裕电器	6,513.32	2,638.73	3,874.59
格兰仕	3,191.89	1,281.32	1,910.57
固邦电器	3,620.44	2,926.79	693.65
力昇国际	1,005.26	198.56	806.7
美的	753.74	421.52	332.22
其他客户	54,086.75	19,941.76	34,144.99
合计	73,523.59	27,883.07	45,640.52

注：协顺电器包含协顺工艺股份有限公司、协顺电器（赣州）有限公司、协顺灯饰（惠州）有限公司；东裕电器包含东裕电器股份有限公司、中裕电器（深圳）有限公司、ROUNDTRIPPING LTD,；格兰仕包含中山格兰仕工贸有限公司、佛山市顺德格兰仕工贸有限公司、佛山市顺德区格兰仕电子元件有限公司；固邦电器包含固邦（东莞）电器有限公司、YUCENT GROUP LIMITED；力昇国际包含力昇国际有限公司、力升树灯（河源）有限公司；美的包含佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司、广东美的制冷设备有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司。

公司始终将有效维护既有客户作为公司持续快速发展的基础，建立了客户维护工作组，实行统一的客户管理及售后服务，对客户的要求及时响应、处理，努力提高客户的满意度，并通过不断调整营销策略，为既有客户提供主动式的贴身服务，以建立和维持良好的客户关系。核心客户群的不断扩大，有力地保证了公司业务的不断扩张。

- 同行业公司 2010 年营业收入增长具有普遍性

报告期内，公司与同行业国星光电、鸿利光电、雷曼光电营业收入增长对比如下：

单位：万元

项目	国星光电	鸿利光电	雷曼光电	本公司
2009 年				
营业收入	62,791.09	25,659.15	10,164.17	45,640.52
增长额	6,118.70	2,442.51	2,599.51	7,101.43
增长率	10.80%	10.52%	34.36%	18.43%
2010 年				
营业收入	87,746.55	43,750.63	20,610.26	81,476.63
增长额	24,955.46	18,091.48	10,446.09	35,836.11
增长率	39.74%	70.51%	102.77%	78.52%

近三年，由于国家对 LED 行业大力支持，带动 LED 封装及应用产品需求增多，同行业国星光电、鸿利光电及雷曼光电营业收入均呈增长态势，特别是 2010 年。其中，2010 年，国星光电营业收入较上年增加 24,955.46 万元，增长率为 39.74%，鸿利光电营业收入较上年增加 18,091.48 万元，增长率为 70.51%，雷曼光电营业收入较上年增加 10,446.09 万元，增长率为 102.77%，本公司营业收入较上年增加 35,836.11 万元，增长率为 78.52%。与同行业相比，公司 2010 年营业收入增加额较大，主要系公司于 2009 年下半年提前向国际 LED 生产设备供应商 ASM 定制封装设备，导致 2010 年各种产品线的产能均获得增加，支撑了公司 2010 年营业收入的快速增长，同行业雷曼光电 2010 年营业收入增长率较高，主要系该公司 2009 年营业收入基数较低。因此，本公司营业收入大幅增长具有行业同期普遍性。

- 利用产能扩张及产品线扩张的“双核驱动”，有效地满足了客户需求

为了支撑产品销量增加，公司于 2010 年购买较多的国际先进全自动化机器设备，扩大各产品线的产能，其中，2010 年 Lamp LED 产品产能较上年的 444,000 万只增加至 960,000 万只，2010 年 Display 产品产能较上年的 3,000 万只增加至 6,600 万元。同时，随着 SMD LED 产品线于 2010 年下半年正式投产，公司 SMD LED 产品产能大规模增加，营业收入达到 1,488.68 万元，满足了客户对 SMD LED 产品的需求。

- 公司一贯重视销售团队建设，形成多渠道、多维度拓展营销网络

自成立以来，公司十分重视销售团队的建设工作。随着产能的不断扩大和市场影响力的日益提高，在持续拓展市场、维护开发客户的同时，公司逐渐建成了一支以 LED 产品分类为基础，以地域区划为补充的结构稳定、精干有力的销售团队。目前，公司的销售团队专业领域覆盖 LED 封装、Display 及 LED 应用产品，销售范围拓展至全国大多数省份及部分境外地区。同时，通过不断进行调研获取市场信息并定期进行统一的业务培训，公司销售团队的业务能力获得持续提升。

遵循“销售本地化、运营市场化、管理总部化”的销售思路，公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式，建设了覆盖全国并延伸至境外地区的营销服务网络。目前，公司除在国内重点地区设立子公司外，还在全国各地建立了 10 余个办事处，初步构建了多层次结构、功能完善、管理统一、规范有序的全国性营销网络，不断向周边省市拓展销售渠道，提升了公司产品的知名度。通过全国性的营销网络，公司能够为客户提供稳定、及时、快捷的产品与服务。

2、主营业务收入产品结构分析

公司按产品大类主要划分为 Lamp LED、LED 应用、Dislpay 和 SMD LED 四大类。报告期内，各大类产品销售收入如下：

产品种类	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Lamp LED	49,843.49	63.77%	28,758.86	64.64%	24,947.26	67.47%
LED 应用	14,135.70	18.09%	9,639.67	21.67%	7,758.39	20.98%
Display	11,548.14	14.78%	5,309.51	11.93%	3,258.28	8.81%
SMD LED	1,488.68	1.90%	37.71	0.08%	5.17	0.01%
其他	1,139.48	1.46%	745.81	1.68%	1,008.21	2.73%
合计	78,155.49	100%	44,491.56	100%	36,977.31	100%

报告期内，Lamp LED 产品为公司的主要销售收入来源，分别占主营业务收入比重分别为 67.47%、64.64%和 63.77%。近几年，公司不断加大国际先进自动化机器设备投入力度，向设备供应商 ASM 定制 LED 封装设备，扩大了该产品产能并同时带动该产品营业收入不断增加。未来公司将不断加强 LED 封装技术

开发，生产出高功率、低成本的 Lamp LED，巩固公司在 Lamp LED 行业中的市场地位。

LED 应用产品收入为公司销售收入另一重要来源，报告期内该产品占主营业务收入比重在 20%左右。LED 应用主要包括显示屏、室内外照明灯及灯饰。公司在专注于 LED 封装领域的同时向下游应用产品延伸，丰富了公司的产品品种，提高公司在 LED 行业中的市场竞争力。

报告期内，Display 产品占公司主营业务收入比重分别为 8.81%、11.93%和 14.78%，呈上升的态势。Display 产品主要系向消费电器供应商如格兰仕、美的等供应。随着与国内知名消费电器供应商战略合作关系进一步加深，公司获得的销售订单也呈增加态势，导致 2009 年、2010 年该产品销售收入呈较快发展的态势。公司凭借着在 LED 封装领域的竞争优势，未来将不断开拓国内外其他消费电器供应商，带动该产品收入的增长。

报告期内，SMD LED 产品收入分别为 5.17 万元、37.71 万元和 1,488.68 万元，占公司主营业务收入比重较小。由于受 Lamp LED 前期产能瓶颈的影响，公司在该产品生产设备投入较少。目前，公司已在 SMD LED 封装领域积累相关的技术基础，同时公司在 2010 年下半年将投入较大规模的自动化设备以提高该产品的产能，未来将成为公司盈利的另一重点来源。

3、主营业务收入地域分析

地区	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国内	**67,149.03**	**85.92%**	**26,573.55**	**59.73%**	**27,553.24**	**74.51%**
其中：华南地区	45,179.34	57.81%	21,238.15	47.74%	22,472.57	60.77%
其中：出口代理商	3,115.05	3.99%	8,520.79	19.15%	14,275.60	38.61%
华东地区	12,498.98	15.99%	3,739.26	8.40%	4,757.71	12.87%
华中地区	6,249.19	8.00%	30.01	0.07%	20.76	0.06%
华北地区	1,361.41	1.74%	1,277.82	2.87%	11.90	0.03%

东北地区	1,093.82	1.40%	54.61	0.12%	233.41	0.63%
西南地区	482.69	0.62%	143.74	0.32%	18.15	0.05%
西北地区	283.60	0.36%	89.96	0.20%	38.75	0.10%
国外	**11,006.45**	**14.08%**	**17,918.02**	**40.27%**	**9,424.07**	**25.49%**
其中：香港木林森	-	-	11,699.30	26.30%	7,664.43	20.73%
合计	**78,155.49**	**100%**	**44,491.56**	**100%**	**36,977.31**	**100%**

报告期内，国外市场销售收入比重分别为 25.49%、40.27%和 14.08%，威莱森公司成立于 2008 年，该公司主要从事对外自营出口贸易 LED 封装及应用产品，公司于 2010 年 6 月将其纳入同一控制下企业合并，导致 2008 年及 2009 年国外销售收入比重有所提高。目前，公司国外客户大部分为 LED 下游应用产品生产商，随着公司在 LED 市场知名度不断提升，为了避免人民币升值带来美元结算汇兑损失，公司与客户进行协商，于 2010 年初开始，公司直接将货物销售给该海外客户在国内设立的子公司，导致 2010 年国外销售比重大幅度下降。

从国内市场收入的地域性结构看，华南地区是公司核心的区域市场，是公司收入和利润的最重要来源。报告期内，该区域收入占公司主营业务收入比重分别为 60.77%、47.74%和 57.81%，主要原因为公司地处华南，具有明显的区位优势，同时，公司在业内知名度影响较深，市场占有率较高，因此能占据该区域 LED 市场的较大份额。

报告期内，公司逐步将产品销售拓展至全国，在全国大部分省市地区设立了分公司或办事处。今后一段时间内公司拟加强对华东、华中、华北、东北、西南及西北等地区的营销力度，将上述区域打造为公司收入未来增长的潜力地区。

4、营业收入季节性分析

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	10,836.91	13.30%	5,952.38	13.04%	4,422.39	11.48%
第二季度	23,359.35	28.67%	11,213.87	24.57%	9,155.47	23.76%

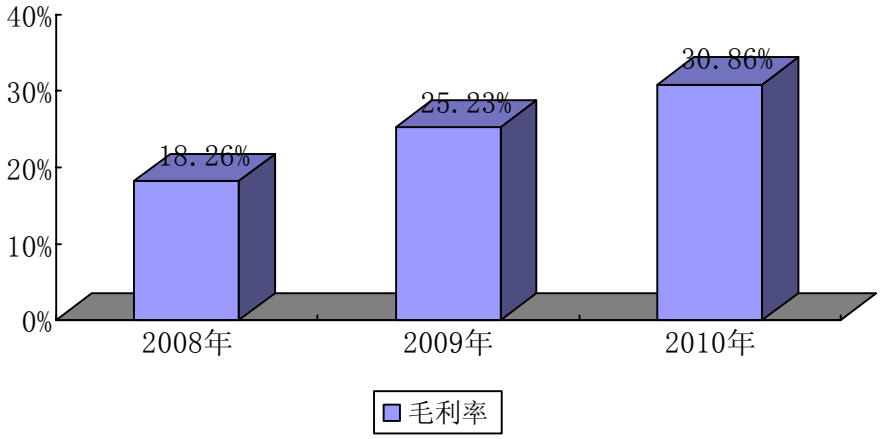
第三季度	25,513.79	31.31%	17,851.74	39.11%	16,097.56	41.77%
第四季度	21,766.58	26.72%	10,622.54	23.27%	8,863.66	23.00%
合计	81,476.63	100%	45,640.53	100%	38,539.08	100%

公司下游 LED 应用产品受季节性影响，下游 LED 应用销售旺季是在国外法定节假日期间，如圣诞、元旦等节日。因此下游 LED 应用制造商（如圣诞节日灯饰等）在每年的 2 季度及 3 季度提前向 LED 封装器件供应商下发订单较多，公司每年 3 季度收入为全年最高，占全年销售收入的比重一般在 30%-40%之间。每年 12 月份到次年 1、2 月份，公司逐渐进入生产经营淡季，第一季度销售收入相对较低，第二季度逐步回升，销售收入随之增长。

（三）毛利率分析

1、产品毛利率变动情况

报告期内，公司产品的综合毛利率变动如下图所示：



2、影响毛利率因素分析

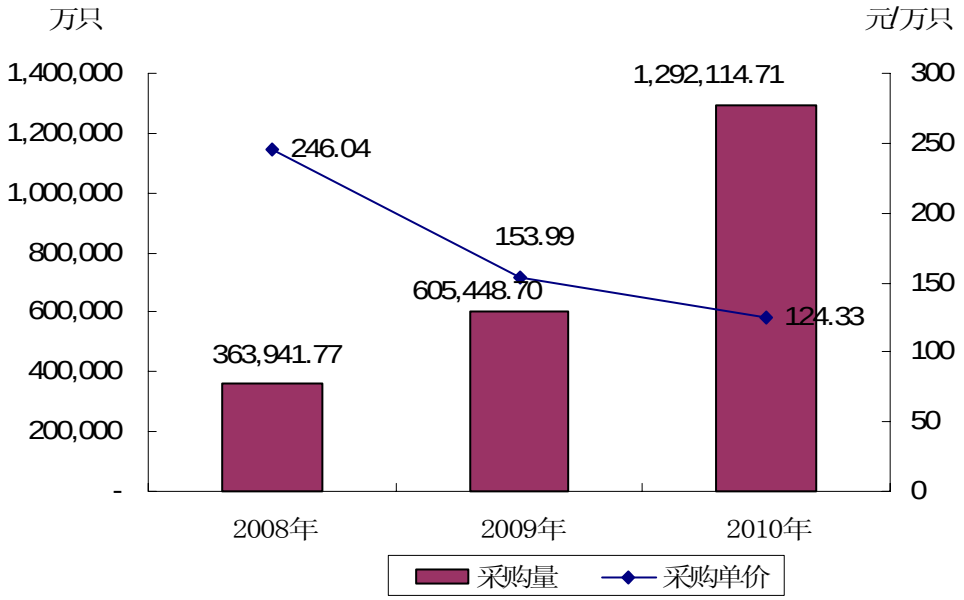
（1）产品售价

随着全球 LED 封装行业的快速发展，技术不断趋于成熟、原材料成本下降、市场竞争加剧及企业规模效应等因素的影响，LED 封装及应用产品价格不断趋于下降，但与传统照明灯相比，价格还是非常昂贵。报告期内，由于产品成本下降幅度高于价格下降的幅度，导致各产品毛利率呈上升态势。

（2）原材料成本的变动影响

- 核心原材料芯片采购单价下降影响

报告期内，本公司原材料芯片采购量及单价如下：



芯片采购价格逐年下降的主要影响因素：

首先，随着全球芯片生产技术的不断成熟，芯片产业投资增幅巨大，芯片产量大幅增加，芯片的单位生产成本大幅下降，封装厂商的芯片采购价格明显下降；

其次，2008 年前，公司产品 Lamp LED（用于灯饰）的原材料蓝、绿光芯片尺寸主要为 7mil×9mil，经过多年研发，在不改变产品性能、亮度等条件下，公司逐步将芯片尺寸调整为 7.5mil×7.5mil。报告期内，公司采购 7.5mil×7.5mil 蓝、绿光尺寸芯片金额分别 476.46 万元、1,585.15 万元、4,198.53 万元，占当年芯片采购比重分别为 5.32%、17.00%、26.13%，而 7.5mil×7.5mil 尺寸芯片单位成本明显低于 7mil×9mil 尺寸芯片，导致芯片平均采购价格下降。

- 其他主要原材料支架、胶水由外购转为自产的积极影响

为提高市场竞争力，降低产品成本，稳定除芯片外其他主要原材料支架、胶水供应渠道，公司于 2008 年、2009 年将二种原材料由外购转为自产。一方面，自产的支架、胶水能及时、稳定供给生产，避免供应商缺货对公司生产经营造成不良的影响；另一方面，公司能控制自产的支架、胶水质量，同时自产价格也较

外部采购单价有所下降。目前，公司生产所需的支架约 80%通过自产完成，对于胶水则通过外购环氧树脂等原材料调配生产获得，公司产品基本全部采用自产胶水。

（3）生产工艺改进

报告期内，公司加大研发投入力度，特别是在产品生产工艺研发方面取得良好的效果，并成功导入了铜线代替原先使用金线用于连接芯片和支架之间的介质，该生产工艺变更在确保产品品质的同时也节约了产品成本，公司已对该生产工艺申请了专利权利。

（4）规模化效应

随着公司业务规模的不断扩大，产能利用率不断提升，自动化机器设备投入增加，并全面替换原先半自动半人工生产方式，公司的规模化优势越显得突出。规模化效应带动了公司产品单位成本中制造费用呈下降态势。

项目	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	81,476.63	100%	45,640.52	100%	38,539.09	100%
毛利	25,147.21	30.86%	11,515.99	25.23%	7,036.79	18.26%
营业成本	56,329.41	69.14%	34,124.53	74.77%	31,502.30	81.74%
原材料	44,699.29	54.86%	27,381.44	59.99%	25,989.88	67.44%
其中：芯片成本	14,291.89	17.54%	9,081.45	19.90%	8,873.78	23.03%
人工成本	5,079.40	6.23%	3,030.05	6.64%	2,198.57	5.70%
制造费用	6,550.72	8.04%	3,713.04	8.14%	3,313.85	8.60%

注：“占比”指占营业收入的比重

2009 年，公司综合毛利率较上年上升 6.97%，主要系受芯片等原材料采购成本减少，导致营业成本中的原材料占收入比重较上年下降 7.45%；同时，由于 2009 年生产人员整体工资薪酬上涨，导致营业成本中人工成本占收入比重较上年上升 0.94%；2010 年，公司综合毛利率较上年上升 5.63%，主要系公司于 2010 年大规模扩大各产品产能，规模化效益明显，导致营业成本中人工成本、制造费用占收入比重分别较上年下降 0.41%和 0.10%，同时，原材料芯片成本占收入比重保

持下降态势，较上年下降 2.36%。

3、报告期内，公司各产品毛利贡献分析

报告期内，公司各产品毛利贡献占比如下：

产品种类	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Lamp LED	16,888.07	69.86%	7,945.17	70.14%	5,473.70	80.45%
LED 应用	3,799.56	15.72%	2,166.95	19.13%	885.14	13.01%
Display	3,033.75	12.55%	1,088.27	9.61%	383.01	5.63%
SMD LED	311.47	1.29%	9.81	0.09%	0.71	0.01%
其他	141.15	0.58%	118.01	1.04%	61.02	0.90%
毛利（主营业务）	24,174.00	100%	11,328.23	100%	6,803.58	100%

注：占比指占毛利（主营业务）比重

报告期内，公司主营业务毛利分别为 6,803.58 万元、11,328.23 万元、24,174.00 万元，呈逐年增加的态势，支撑公司经营业绩的增长，主营业务毛利的增加主要源于公司主要产品 Lamp LED 毛利增长，该产品报告期内占主营业务毛利比重分别为 80.45%、70.14%、69.86%。

4、报告期内，公司产品毛利率量化分析

报告期内，公司各类产品毛利率情况如下：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
Lamp LED	33.88%	27.63%	21.94%
LED 应用	26.88%	22.48%	11.41%
Display	26.27%	20.50%	11.76%
SMD LED	20.92%	26.03%	13.65%

（1）Lamp LED 产品毛利率变动分析

报告期内，Lamp LED 产品毛利率分别为 21.94%、27.63%和 33.88%，呈稳步上升的态势。Lamp LED 产品按发光颜色主要可分为白灯、红灯、蓝灯、绿灯

等，其毛利率变化趋势如下：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
白灯 Lamp LED	38.73%	32.77%	26.98%
红灯 Lamp LED	26.93%	19.81%	18.10%
蓝灯 Lamp LED	35.13%	30.04%	21.69%
绿灯 Lamp LED	34.77%	29.47%	24.60%

由于白灯 Lamp LED 封装生产技术工艺要求较高，市场需求量较大，用于下游 LED 应用产品较广泛，导致其毛利率相对其他颜色 Lamp LED 较高；而红灯 Lamp LED 为封装传统产品，产品附加值低，市场供给较饱和，毛利率则相对较低；蓝灯及绿灯 Lamp LED 毛利率则在白灯及红灯 Lamp LED 之间。

- 高毛利率白灯 Lamp LED 销售比重上升

产品种类	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Lamp LED	49,843.49	100%	28,758.86	100%	24,947.26	100%
其中：白灯	24,772.28	49.70%	13,111.74	45.59%	9,947.05	39.87%
红灯	8,332.86	16.72%	4,334.63	15.07%	3,604.87	14.45%
蓝灯	5,761.27	11.56%	4,567.55	15.88%	3,342.21	13.40%
绿灯	4,930.86	9.89%	2,175.65	7.57%	1,827.06	7.32%
其他	6,046.22	12.13%	4,569.29	15.89%	6,226.07	24.96%

报告期内，为了适应市场对高亮度、高功率 Lamp LED 需求增多，公司不断加大新产品研发投入力度，导致白灯 Lamp LED 销售收入占比有所提升，其中，2009 年、2010 年白灯 Lamp LED 占收入比重分别较上年上升 5.72%、4.11%，而该种产品毛利率相对较高，导致 Lamp LED 产品毛利率上升。

- Lamp LED 产品毛利率贡献分析

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度

	金额	增幅	毛利率影响数	金额	增幅	毛利率影响数	金额
单价	611.53	-27.90%	-28.00%	848.14	-4.55%	-3.72%	888.60
单位成本	404.33	-34.13%	34.26%	613.83	-11.50%	9.41%	693.63
毛利率	33.88%		6.26%	27.63%		5.69%	21.94%

注：以上分析方法采用因素替代分析法；其中，单价的毛利率影响数，即在单位成本保持上年度水平不变的情况下，单价变动所引起的毛利率变动。

2009 年、2010 年，公司 Lamp LED 产品的毛利率分别较上年上升 5.69%、6.26%，主要系 Lamp LED 产品单位成本下降幅度大于单价降幅所致。其中，2009 年 Lamp LED 产品由于单价减少导致毛利率下降 3.72%，但由于单位成本减少导致毛利率上升 9.41%，2010 年保持该种态势。

- 各产品单位售价及成本变动分析

Lamp LED 各产品售价、成本变动如下：

单位：元

Lamp LED	**指标**	**2010 年度**		**2009 年度**		**2008 年度**
		金额	变动率	金额	变动率	金额
白灯	单位售价	911.45	-28.16%	1,268.75	24.84%	1,016.29
	单位成本	558.45	-34.53%	853.04	14.96%	742.05
	毛利率	38.73%		32.77%		26.98%
红灯	单位售价	410.52	-13.91%	476.85	-7.18%	513.73
	单位成本	299.98	-21.56%	382.41	-9.11%	420.76
	毛利率	26.93%		19.81%		18.10%
蓝灯	单位售价	628.18	-16.72%	754.3	-29.71%	1,073.14
	单位成本	407.49	-22.78%	527.72	-37.20%	840.33
	毛利率	35.13%		30.04%		21.69%
绿灯	单位售价	701.55	-23.64%	918.72	-9.11%	1,010.83
	单位成本	457.62	-29.37%	647.94	-14.98%	762.14
	毛利率	34.77%		29.47%		24.60%

2009 年，白灯 Lamp LED 每万只售价较上年增加 252.47 元，主要系公司于 2009 年加大高亮度、高功率白灯 Lamp LED 销售比重，导致 2009 年白灯 Lamp LED 平均售价上升，而 2009 年白灯 Lamp LED 单位成本较上年增加 110.99 元，成本上升幅度低于售价增幅；其他红灯、蓝灯及绿灯 Lamp LED 售价也呈下降态势，但该等产品单位成本下降幅度大于售价降幅，主要系原材料采购成本减少所致，其中，2009 年芯片平均采购成本较上年的 246.04 元降低至 153.99 元，以上因素导致 2009 年 Lamp LED 各产品毛利率的上升。

2010 年，Lamp LED 各产品单位成本下降幅度大于售价降幅，主要系公司于 2010 年引进较多的机器设备，扩大了 Lamp LED 各产品线产能，规模化优势明显，导致各产品单位成本中人工成本、制造费用均较上年有所减少；同时，主要原材料芯片 2010 年平均采购单价较上年的 153.99 元降低至 124.33 元，也使 Lamp LED 单位成本减少。

（2）LED 应用产品毛利率变动分析

报告期内，LED 应用产品毛利率分别为 11.41%、22.48%和 26.88%，呈稳步上升的态势。LED 应用产品主要为显示屏、室内外照明灯及灯饰等，其毛利率变化趋势如下：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
显示屏	33.18%	28.21%	10.74%
室内外照明灯	28.07%	22.65%	-
灯饰	19.76%	17.11%	12.20%

公司 LED 应用产品所需封装产品基本为自供，由于自产的 Lamp LED 单位成本的下降，LED 应用各类产品成本减少，导致报告期内 LED 应用各类产品毛利率上升。

LED 应用各产品售价、成本变动如下：

单位：元

LED 应用	**指标**	**2010 年度**		**2009 年度**		**2008 年度**
		金额	变动率	金额	变动率	金额

显示屏	单位售价	7,756.79	-2.40%	7,947.79	-9.35%	8,767.80
	单位成本	5,183.25	-9.16%	5,705.60	-27.10%	7,826.39
	毛利率	33.18%		28.21%		10.74%
室内外照明灯	单位售价	179.46	15.02%	156.02	-	-
	单位成本	129.08	6.96%	120.68	-	-
	毛利率	28.07%		22.65%		-
灯饰	单位售价	10.73	-1.92%	10.94	-1.08%	11.06
	单位成本	8.61	-5.07%	9.07	-6.59%	9.71
	毛利率	19.76%		17.11%		12.20%

2009 年，显示屏毛利率较上年上升 17.47%，主要系公司于 2008 年初步涉足 LED 显示屏行业，产品成本及不良率较高，随着公司逐步加大该产品研发力度，及自供原材料 Lamp LED 成本减少，其中，显示屏 2009 年每平方米价格较上年减少 820.01 元，而单位成本较上年减少 2,120.79 元，成本下降幅度大于售价降幅，导致毛利率增幅较大，2010 年保持了该种趋势。

公司于 2009 年涉足 LED 应用室内外照明产品，主要包括太阳能灯、装饰灯、草坪灯等。2010 年，公司逐步加大室内外照明新产品开发力度，该种产品平均售价较上年增加 23.44 元，导致 2010 年毛利率较上年上升 5.42%。

公司 LED 灯饰产品所需的主要原材料为自产 Lamp LED。报告期内，随着 Lamp LED 成本下降，灯饰单位成本下降幅度大于售价降幅，导致灯饰产品毛利率稳步上升。

（3）Display 产品毛利率变动分析

报告期内，Display 产品毛利率分别为 11.76%、20.50%和 26.27%，呈稳步上升的态势，其中 2009 年、2010 年毛利率分别较上年上升 8.74%、5.77%。报告期内，Display 产品单位售价及成本变动如下：

单位：元

项目	2010 年度			2009 年度			2008 年度
	金额	增幅	毛利率影响数	金额	增幅	毛利率影响数	金额

单价	18,191.78	1.83%	1.43%	17,865.12	-37.60%	-53.18%	28,631.63
单位成本	13,412.72	-5.57%	4.35%	14,203.37	-43.78%	61.92%	25,265.98
毛利率	26.27%		5.77%	20.50%		8.74%	11.76%

Display 产品主要包括单色、双色及全彩数码组件等，由于该产品品种型号较多，且客户定制不同型号 Display 所需的芯片用量、颜色及大小等差异较大，导致该产品单位售价及成本变动幅度较大。2009 年，Display 产品单位成本下降幅度大于售价降幅，主要系公司于 2009 年引进全自动 Display 产品生产线，获得下游国内知名消费电器供应商销售订单呈增多态势，自动化程度提高及规模化效应使该产品分摊的成本下降，导致该产品 2009 年毛利率较上年上升 8.74%，2010 年保持了该种趋势。

（4）SMD LED 产品毛利率变动分析

报告期内，SMD LED 产品收入占公司主营业务收入比重分别为 0.01%、0.08%和 1.90%，占比较小。公司于 2010 年引进 SMD LED 产品全自动化生产线，由于产能未全部释放导致产品成本中分摊折旧费较大，因此 2010 年该产品毛利率有所下降。

5、与本公司经营模式相似的上市公司毛利率情况

目前，国内上市公司（拟上市公司）中与本公司业务类型相似的可比公司为国星光电、鸿利光电、雷曼光电，其产品毛利率对比情况如下表所示：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
国星光电综合毛利率	30.72%	33.43%	34.81%
鸿利光电综合毛利率	35.61%	33.47%	27.13%
雷曼光电综合毛利率	36.56%	39.35%	37.57%
平均	34.30%	35.42%	33.17%
本公司综合毛利率	30.86%	25.23%	18.26%
国星光电 Lamp LED 毛利率	13.60%	16.10%	17.24%
鸿利光电 Lamp LED 毛利率	34.29%	31.82%	25.40%
雷曼光电 Lamp LED 毛利率	40.65%	34.91%	34.34%

平均	29.51%	27.61%	25.66%
本公司 Lamp LED 毛利率	33.88%	27.63%	21.94%

从上表可知，公司综合毛利率低于国星光电、鸿利光电及雷曼光电，主要系产品业务结构不同所致。

国星光电主要系以 SMD LED 产品为主，该产品占公司营业收入比重为 70%左右，而本公司主要系以 Lamp LED 产品为主，由于目前 SMD LED 市场需求量较大、价格相对高于 Lamp LED，因此该产品整体毛利率较高于 Lamp LED；另外，国星光电还从事替日本三洋公司代加工调谐器及 LIB（锂电池）电源管理器，该业务毛利率比较高，也导致公司综合毛利率低于国星光电。与国星光电 Lamp LED 毛利率相比，公司 Lamp LED 毛利率高于国星光电，主要系公司在 Lamp LED 封装领域具有较大的竞争优势，规模化效应导致该产品毛利率较高。

鸿利光电主要系以 Lamp LED、SMD LED 及 LED 应用产品为主，公司的 Lamp LED 产品毛利率略低于鸿利光电，主要系鸿利光电产品结构中超高亮度白光及大功率 LED 产品比重较高，而该种产品毛利率相对较高所致。

雷曼光电主要系以 LED 封装器件及 LED 显示屏为主，其中 Lamp LED 器件主要应用于室内外 LED 显示屏市场，属于 LED 中高端应用领域，要求产品的稳定性、ESD 指标、衰减幅度、一致性、配光曲线等方面具有较高的性能，因此该产品毛利率较高于同行业水平。

6、相关因素对毛利率影响的敏感性分析

报告期内影响公司产品毛利率的因素众多，现以产品销售价格和原材料价格两个主要影响因素的变动对毛利率的变动作敏感性分析如下：

假定原材料价格、销量、人工成本及制造费用不变，则公司产品售价变动对公司综合毛利率的敏感性影响如下表所示：

产品售价变动幅度	综合毛利率变动幅度		
	2010 年度	2009 年度	2008 年度
5%	3.29%	3.55%	3.89%
（5%）	-3.64%	-3.92%	-4.29%

假定产品售价、销量、人工成本及制造费用不变，则公司原材料价格变动对综合毛利率的敏感性影响如下表所示：

原材料价格变动幅度	综合毛利率变动幅度		
	2010 年度	2009 年度	2008 年度
5%	-2.74%	-2.94%	-3.36%
（5%）	2.74%	2.94%	3.36%

由上表可见，产品售价对毛利率的敏感系数稍大于原材料价格对毛利率的敏感系数，表明公司产品销售价格的变动引起的毛利率变动大于原材料价格变动引起的毛利率变动。

7、公司在提升产品毛利率方面的努力

（1）优化产品结构

公司筛选淘汰一些档次低、利润薄、市场竞争力差的产品及客户，大力发展市场需求大、技术要求高、准入门槛高、利润水平高的产品及客户，加大高亮度、高功率的 Lamp LED 产品，向高毛利率的封装及应用产品领域扩展。产品品种结构及客户经过优化调整后，能较好地让市场与公司生产能力相适应，产生较好的经济效益。

（2）积极采取多种措施加强成本控制

在原成本控制的基础上，公司通过成本管理和技术革新进一步加强产品成本的控制，降低可变成本。公司通过规模化效应，有效分摊产品成本的机器设备折旧成本，降低公司自产支架及胶水原材料成本支出，实现公司产品生产各环节的协同效应，最大程度减少公司各种制造成本支出，进一步提升公司产品毛利率。

（3）优化产品生产工艺

公司通过向国外 LED 封装设备定制个性化、全自动化的机器设备，派出相应技术人员到设备供应商 ASM 学习实务操作技巧，不断优化公司产品生产流程工艺，有效降低生产各环节材料及能源消耗。同时，制定出标准化的生产工艺及生产出标准化的封装产品，不断降低公司产品单位成本，提升公司在行业中的市场地位。

（四）期间费用分析

1、报告期内期间费用总体分析

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用相关情况如下表所示：

费用种类	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,906.31	2.34%	1,425.21	3.12%	905.44	2.35%
管理费用	8,154.08	10.01%	5,117.75	11.21%	4,107.31	10.66%
财务费用	823.99	1.01%	330.00	0.72%	278.80	0.72%
合计	10,884.38	13.36%	6,872.95	15.06%	5,291.55	13.73%

注：“占比”指占营业收入的比重

与公司业务规模持续扩大相对应，本公司近三年期间费用总额逐年上升，但其占营业收入的比重保持在 13%左右，表明公司期间费用管理较好，不会对公司持续盈利能力产生重大影响。

2、报告期内，公司销售费用明细分析

报告期内，公司销售费用明细如下：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
工资薪酬	862.00	443.89	313.28
货物运输费	365.09	277.23	181.35
业务招待费	165.37	169.94	50.97
差旅费	126.67	97.42	65.59
物料消耗	87.49	138.02	59.66
广告宣传费	66.35	74.14	49.70
办公费	17.60	16.18	7.65
其他	215.74	208.39	177.24
合计	1,906.31	1,425.21	905.44

报告期内，公司销售费用分别为 905.44 万元、1,425.21 万元和 1,906.31 万元，占收入比重分别为 2.35%、3.12%和 2.34%，随着公司销售规模的持续扩大，报告期内公司销售费用呈逐年增加态势。公司销售费用大部分是与收入同步增长的支出，如销售人员工资薪酬、货物运输费、办公费等，在销售规模扩张的同时公

司整体销售费用也同步增加，销售费用占营业收入比重较小，表明公司对销售费用控制较好。其中，工资薪酬 2009 年较上年增加 130.61 万元，2010 年较上年增加 418.11 万元，主要系随着销售规模的扩大，公司销售人员增加及相应薪酬上涨所致；货物运输 2009 年较上年增加 95.88 万元，2010 年较上年增加 87.86 万元，主要系随着产品售量增加，相应货物运输费增加，而当货运量达到一定规模后单位货运价格则呈下降态势，导致 2010 年货物运输费增速放缓；业务招待费 2009 年较上年增加 118.97 万元，2010 年较上年略有减少，主要系公司于 2009 年开发及布局市场、储备业务发生支出较大所致；广告宣传费主要系展览展销费支出，2009 年较上年增加 24.44 万元，2010 年较上年略有减少，主要系公司于 2009 年参与各类展览展销活动较 2008 年及 2010 年多；除此之外，公司销售费用其他费用差旅费、办公费均与收入增加保持了适当的增长。

3、**报告期内，公司管理费用明细分析**

报告期内，公司管理费用明细如下：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
工资薪酬	4,210.44	2,186.70	1,487.10
研发费	2,064.46	1,214.09	1,298.18
办公及装修费	913.31	1,060.22	797.03
业务招待费	184.92	134.4	87.46
修理费	200.99	212.52	132.07
差旅费	138.14	109.28	97.19
其他	441.82	200.54	208.28
合计	8,154.08	5,117.75	4,107.31

报告期内，公司管理费用分别为 4,107.31 万元、5,117.75 万元和 8,154.08 万元，占收入比重分别为 10.66%、11.21%和 10.01%。公司的管理费用主要系管理人员工资薪酬、研发费、办公费等。其中，工资薪酬 2009 年较上年增加 699.60 万元，主要系公司管理人员增加及相应薪酬水平上涨所致；2010 年工资薪酬为 4,210.44 万元，较上年增加 2,023.74 万元，主要系公司 2010 年对管理层及骨干员工进行股权激励增加费用 1,809.07 万元，如果不考虑股权激励的影响，公司 2010 年工资薪酬为 2,401.37 万元，较上年增加 214.67 万元。

报告期内，公司投入研发费用为 1,298.18 万元、1,214.09 万元和 2,064.46 万元，呈持续上涨态势，该费用能够为公司保持产品的技术领先水平，不断满足客户对高品质、大功率 LED 封装产品的高层次需求，为公司未来收入增长奠定坚实的基础；2009 年办公及装修费较上年增加 263.19 万元，2010 年较上年略有减少，主要系公司于 2009 年增加办公设施及装修支出，而 2010 年该部分支出有所减少；其他管理费用业务招待费、修理费及差旅费均与公司业务规模整体保持同步增长。

4、销售费用、管理费用与同行业对比

（1）销售费用与同行业国星光电、鸿利光电、雷曼光电对比分析

费用种类	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
国星光电	2,070.16	2.36%	1,661.50	2.65%	1,511.23	2.67%
鸿利光电	3773.88	8.63%	2,462.56	9.60%	1,679.89	7.24%
雷曼光电	1,223.01	5.93%	661.48	6.51%	645.93	8.54%
本公司	1,906.31	2.34%	1,425.21	3.12%	905.44	2.35%

注：“占比”指占营业收入的比重

与同行业相对，公司销售费用占收入比重与国星光电相当，主要系公司业务特征与国星光电类似，均以 LED 封装产品为主，下游客户主要为 LED 应用厂商，导致发生的销售费用支出较低；鸿利光电 LED 近几年加大市场拓展力度，部分产品应用于北京奥运会开幕式、上海世博会观景点卢浦大桥及“广州地铁 LED 绿色节能示范工程”等项目，而销售费用中广告宣传费、展览费等销售费用较大，导致鸿利光电销售费用占收入比重偏高；雷曼光电业务主要以 LED 封装及显示屏为主，而 LED 显示屏的售后安装、维护费用支出则相对较大，导致雷曼光电销售费用占收入比重较高。

（2）管理费用与同行业国星光电、鸿利光电、雷曼光电对比分析

费用种类	2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

国星光电	7,758.24	8.84%	5,218.76	8.31%	4,419.50	7.80%
鸿利光电	4,013.99	9.17%	2,599.04	10.13%	1,932.02	8.32%
雷曼光电	1,771.43	8.59%	1,038.43	10.22%	940.87	12.44%
本公司	8,154.08	10.01%	5,117.75	11.21%	4,107.31	10.66%

注：“占比”指占营业收入的比重

与同行业对比，公司管理费用占收入比重略高于同行业，主要系公司涉足 LED 产业链较长，为了便于管理及考核业绩，公司设立较多的产品事业部，导致行政管理人员薪酬及相应的管理支出偏多。

5、财务费用变动分析

报告期内，公司财务费用主要包括利息支出、汇兑损失等，具体明细如下：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
利息支出	815.75	297.58	297.21
利息收入	- 47.24	-36.52	-35.16
汇兑损益	36.28	28.52	-0.19
银行手续费	16.16	15.2	16.94
其他	3.04	25.21	-
合计	823.99	330.00	278.80

报告期内，公司的财务费用金额较小，主要系利息支出。为提升公司产品档次、扩大产能，公司通过银行借款增加固定资产投资和配套生产流动资金，由此造成公司银行借款增加，相应利息支出增加。受人民币升值影响，2009 年、2010 年公司财务费用中的汇兑损益有所增加，随着公司以美元结算的国外销售比重下降，未来汇兑损益对公司盈利影响将逐步减少。

（五）收益率指标分析

指标名称	2010 年度	2009 年度	2008 年度
销售净利率	12.76%	9.23%	4.16%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润）	38.92%	22.38%	10.14%

总资产收益率	10.94%	9.93%	4.33%

报告期内，本公司销售净利率为 4.16%、9.23%和 12.76%，加权平均净资产收益率为 10.14%、22.38%和 38.92%，总资产收益率为 4.33%、9.93%和 10.94%。受毛利率持续上升影响，公司销售净利率整体也呈上升态势。

（六）非经常性损益、投资收益及少数股东损益对净利润的影响

报告期内，公司非经常性损益、投资收益及少数股东损益情况如下表所示：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非经常性损益	-203.55	428.01	324.67
投资收益	12.02	2.18	
少数股东收益	203.48	35.26	-101.61
净利润	10,397.19	4,210.68	1,603.85

从上表可见，报告期内非经常性损益占公司净利润的比例较小，未对发行人净利润产生重大影响。

（七）管理层对盈利能力的总结

报告期内，公司在加强技术开发、优化生产工艺、扩大生产规模的基础上，建立了以客户为中心、成本控制、先进全自化设备作业、标准化产品为特点的业务体系，市场竞争力大幅提高，在 LED 领域中具有较高的声誉，“木林森”品牌 LED 封装及应用产品获得了下游厂商广泛认可，由此推动了公司盈利能力的大幅提升。

报告期内，本公司不断增加资本性支出，购买国际先进的全自动化机器设备，增加各产品的产能及产量，为营业收入的快速增长奠定了坚实的基础；公司持续加大研发费用支出，不断加强高功率、高品质 LED 封装及应用产品开发、工艺技术优化，使公司的产品不断满足客户的要求；报告期内，公司加强对相关费用的管控，使公司在收入增长的基础保持净利润的增长。预计未来几年内，本公司将继续通过扩大生产能力、增加产品技术含量、为客户提供优质 LED 封装及应用产品等方式提高本公司的市场份额，增强盈利能力。

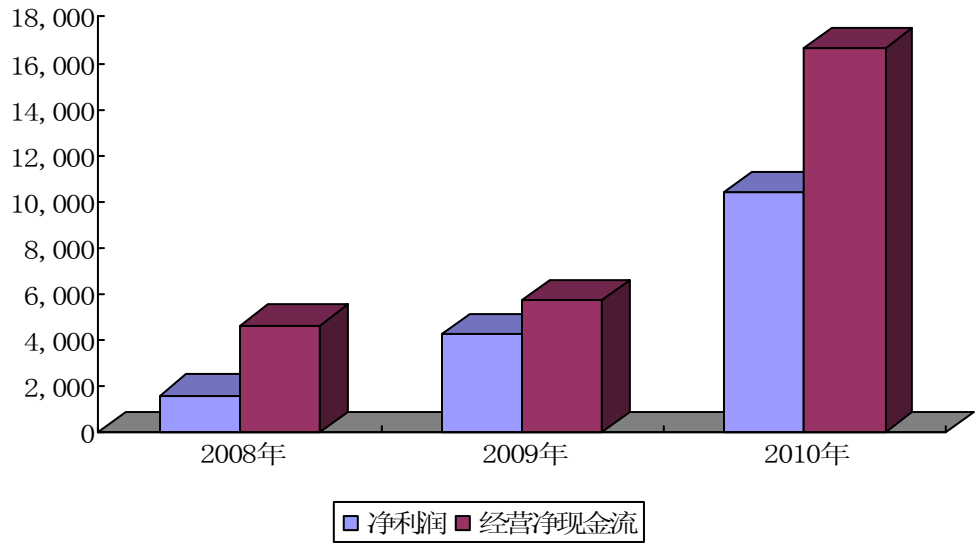
三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量如下表所示：

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	16,647.40	5,700.97	4,608.16
投资活动产生的现金流量净额	-38,167.70	-7,317.67	-6,411.73
筹资活动产生的现金流量净额	31,517.46	980.29	2,802.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.53	-8.53	0.54
现金及现金等价物净增加额	9,984.63	-644.94	999.78

（一）经营活动产生的现金流量

近三年，公司经营活动产生的现金流量净额累计为 26,956.53 万元，经营活动产生的现金流量净额平均为 8,985.51 万元，公司经营活动获取现金能力较强，净利润有良好的现金流支持。报告期内，公司净利润与经营净现金流关系如下：



2008 年经营活动产生的现金流量净额 4,608.16 万元，净利润为 1,603.85 万元，经营现金流大幅度增加，主要受国际金融危机影响，公司加大了存货管理力度，并取得了良好效果，存货增速低于营业收入的增幅；同时，公司在业内知名度不断提升，获得供应商的信用周期也较长，并加大汇票使用力度，2008 年末应付票据、应付账款大幅度增加，导致 2008 年经营现金流较充沛。2009 年、2010

年经营现金流也继续保持了较好的势头，公司的盈利质量较好。

（二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动现金流出持续增加，主要原因为：近几年，公司业务规模快速扩张，资本性支出（包括购买先进的机器设备等）逐年增加，上述投资性支出扩大了公司产品产能，增强了公司盈利能力，为公司今后的持续发展奠定坚实的基础。预计未来几年内，公司重大资本性支出主要为募集资金投资项目。在募集资金到位后，公司将按拟定的投资计划进行投资。本公司将继续通过扩大生产能力、为客户提供优质 LED 产品等方式提高本公司的市场份额，增强盈利能力。

（三）筹资活动现金流量

2008 年、2009 年，本公司筹资活动现金流量为 2,802.80 万元和 980.29 万元，筹资活动现金流持续流入，满足了公司经营规模的扩大带来了资金需求。2008 年末、2009 年末，公司银行借款余额为 4,185 万元和 5,328 万元。融资渠道逐步拓展支撑公司业务规模的不断扩大。

2010 年筹资活动现金流为 31,517.46 万元，主要系公司于 2010 年 9 月引进五位法人投资增资 10,200.00 万元及增加银行借款 24,356.00 万元所致。

四、资本性支出分析

（一）报告期重大资本性支出

报告期内，公司“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分别为 6,022.93 万元、7,324.26 万元和 38,026.77 万元，主要用于建造厂房、购买机器设备和土地使用权。随着在建工程的陆续建成，扩大了公司各产品产能，改善了经营办公场所，为公司核心竞争力的提升奠定了基础。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

本次发行募集资金投资项目请参见本招股说明书“第十三节募集资金运用”。除本次募集资金投资项目以外，公司未来可预见的重大资本性支出情况如下：

本公司于 2010 年 4 月 21 日与先进自动器材有限公司深圳分公司签订购买机器设备合同，合同总价款为美元 2,675.70 万元，机器设备于 2012 年 2 月底以前交付同时约定货款在交货前一周内付清。

本公司于2010年9月9日与先进自动器材有限公司签订购买机器设备合同，合同总价款为美元601万元，机器设备于2012年6月底以前交付同时约定货款在交货前一周内付清。

本公司于2010年9月9日与先进自动器材有限公司签订购买机器设备合同，合同总价款为美元1,708.70万元，机器设备于2011年11月底以前交付同时约定货款在交货前一周内付清。

本公司于2010年9月9日与先进自动器材有限公司签订购买机器设备合同，合同总价款为美元560万元，机器设备于2011年12月底以前交付同时约定货款在交货前一周内付清。

五、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）行业发展状况的影响

由于LED光源具有节能、环保、使用寿命长等诸多优势，已被公认为21世纪最具发展前景的电光源，同时各国也纷纷出台了一系列针对 LED 产业的扶持政策，使LED产业面临着较好的市场机遇。我国也相继启动了各种针对LED产业鼓励政策，目前具备了较好的产业基础，初步形成了完善的产业链。本公司为国内 LED 封装及应用产品的主要供应商，规模化、标准化生产带来的成本优势将更加突现，未来公司将面临着良好的市场前景。

（二）募集资金的影响

公司本次首次公开发行股票并上市成功后，将全面启动募集资金投资项目。“Lamp LED 产品技术改造项目”将扩大产能规模，缓解产能瓶颈约束，加大高品质、高功率Lamp LED器件的生产比重，增强市场反应能力，提升公司核心竞争力；“SMD LED 产品技术改造项目”将丰富公司产品的品种，满足客户不同层次的需求，为客户提供LED封装产品一站性服务“LED应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目”将进一步提升公司 LED 下游应用产品的产能，扩大公司在LED应用行业中的市场影响力，增强公司盈力能力。“研发中心技术改造项目”建成后将有力提升本公司产品开发实力，进一步强化本公司为客户提供高品质、高附加值产品的能力。

预计未来几年，本公司财务状况、盈利能力将随着募投项目的不断实施和投

产而持续改善，有利于增强公司整体竞争实力，进一步提升公司在行业中的优势地位。

第十二节　业务发展目标

一、未来三年发展目标

（一）整体发展规划

伴随着中国经济持续健康发展以及全球对节能环保产业的重视与支持，公司坚持自主创新，不断加大新技术、新工艺的研发应用，扩大技术、工艺应用范围，在巩固现有产品市场领先地位的基础上，加快功率型 LED 产品的发展，不断丰富 LED 封装产品线，并积极向 LED 应用产业链拓展，逐步发展成为产业链完整、具有国际竞争力的大型 LED 系列产品供应商。

（二）公司经营理念

本公司奉行“务实、诚信、责任、创新”的经营理念。根据公司总体发展目标和发展战略，业务上走标准化、流程化的道路，从原材料采购、生产、销售及售后服务建立起适合公司自身发展的一套标准，实现公司成本领先、规模化优势的既定目标，回馈社会，同时给客户、员工及股东以良好回报。

（三）整体经营目标

公司将结合募集资金投资项目的实施，在扩大现有 Lamp LED 产品产能和市场占有率的基础上，强化核心技术的研发；加大对 SMD LED 及功率型 LED 的投入；加强 LED 应用产品（显示屏、室内外照明灯及灯饰）的生产和销售力度；形成技术领先，产品系列多元化的生产体系；依托技术优势在提升产品品质的同时，进一步强化销售渠道的建设工作，打造辐射全国、高效、快捷的 LED 销售网络，巩固公司的市场地位，形成具有较强竞争实力的产品研发和技术创新体系、高效合理和低成本的制造体系以及广大的营销网络体系。

二、具体业务实施计划

（一）技术研发及产品创新计划

未来将加大科研投入力度，加快研发中心建设，建立健全技术研发机制，完善产品创新体系；同时加强与国内著名高校及科研院所的合作，使新科研成果能迅速转化为公司生产力，形成研发成果产业化的快速转换机制，从而带动产品不

断创新升级。

公司加大研发建设与 LED 封装产品生产所需原材料如支架、环氧树脂等供应相配套的生产线，整合原材料产业链，提高生产效率，提升产品品质，形成规模效应、成本效应，巩固公司在产业链整合方面的领先地位；提升 Lamp LED、LED 数码管及点阵产品技术水平，进一步优化生产工艺；加大 SMD LED 及功率型 LED 产品的投入，完善封装产品线；适时向下游领域拓展，研发出适合时代潮流、品质优良、具有较高竞争力的 LED 应用产品，包括显示屏、灯饰及室内外照明产品等。

（二）市场开发及营销网络建设计划

公司作为国内 LED 封装行业先进企业之一，已具有较高的行业知名度，公司将在稳定现有客户合作关系基础上，进一步加强国内及国际市场的营销力度，在提高产品品质和销售服务的基础上，提高客户对公司的依存度，不断提高公司产品的市场份额和占有率。

公司将大力开发高端客户，实现大规模客户定制产品，建立长期的合作关系；强化全国各地代表处的辐射力度、强化经销商的作用、加强电子商务平台建设，同时加强媒体广告的宣传力度；加大力度引进优秀销售人才，建立健全激励考核机制，打造一支高素质、高效率的营销队伍；通过在海外建立销售点及办事处，积极拓展海外市场。

（三）人才发展及企业文化建设计划

公司将进一步加强人力资源管理体系建设，建立健全人力资源管理制度，为员工招聘、培训、考核及晋级管理提供制度保障。公司在人才引用上执行“唯才是用、各尽所能、人尽其才”的人才理念，做到使每个员工在各自岗位能发挥其长处、贡献其最大价值。未来 3 年公司将重点引进研发型人才、产品创新型人才、销售人才及高素质管理人才；在人才引进途径上实行社会招聘与校园招聘相结合的方式，同时在公司营造良好的企业氛围、人文化的企业环境、透明化的激励制度，增强员工的归宿感和自豪感，留住和吸引各类型专业人才。

（四）财务成本管理及再融资计划

公司将继续做好财务管理工作，控制财务风险，加强财务预算和成本控制，

建立健全一整套财务内控制度。根据未来投资项目的具体发展资金需求情况，决定是否需要进行再融资计划，并研究拓展适合公司自身特点的融资渠道，以保障公司高速发展所面临的资金需求。

（五）国际化经营计划

目前公司下游应用产品中的灯饰照明等主要以出口为主，产品销往北美、欧洲等地区。从产品市场和客户角度分析，公司正逐步形成为全球化经营企业。本公司的国际化经营策略有：

1、进一步增强公司的技术研发和产品创新能力，始终保持产品品质和成本在国际市场的竞争优势，以巩固应用产品在国际市场份额的同时，增强公司产品在国际市场的竞争力。

2、加强对国际市场动态发展的跟踪与研究，加强国际交流与合作，提升公司产品生产创新技术，增强公司在国际市场的知名度及美誉度。

三、制定以上规划的依据

本公司拟定上述规划主要依据以下假设条件：

1、公司能够顺利实现上市目标，募集资金及时到位。

2、本公司所处行业正常发展，行业空间广阔、前景明朗，行业技术特点、行业竞争格局没有产生对公司不利影响的因素。

3、公司所处 LED 行业产业政策没有发生重大变化。

4、我国的国家政治、经济、法律和社会环境稳定，没有产生对公司经营活动不利的重大影响。

5、公司管理层稳定，实际控制人于未来三年不发生变化。

四、实施上述计划所面临的困难及后续措施

上述发展计划的顺利实施，需要大量的资金作为后续保障，公司目前实施计划的困难是资金瓶颈。虽然本公司盈利能力较强，现金流量充足，但单凭自身积累而实现规模扩张的资金需求还远远不够。能否拓宽公司的融资渠道，获得充裕的资金，是公司顺利实施上述计划的关键所在。

实施上述计划中，公司将采取以下措施：在提高产品品质的前提下，做好产

品成本及费用的控制工作，增强公司产品市场竞争力；向研发及核心技术展开攻势，提高产品技术水平，完善产品种类，增强公司核心竞争力；加大市场开发力度，完善销售网络的布局，提高产品市场占有率；公司在实现既定上市目标、募集资金到位后，将尽快推进拟建设项目的速度，使产品产能快速释放，成为公司新的利润增长点，强化公司的核心竞争优势。

五、业务发展计划与现有业务的关系

制定上述发展计划是以公司现有业务发展规划为基础和前提，是公司现有业务的拓展和全面提升，符合公司总体发展目标和发展战略。公司现已具备技术、工艺、管理和品牌方面的优势条件，为实施上述计划提供了良好的基础。

六、本次募集资金对公司业务发展目标的作用

本次募集资金运用对于公司实现上述目标意义重大，主要体现在：

1、本次募集资金到位后，公司将紧紧围绕主营业务进行，有利于公司进一步增加生产设备，加大研发投入力度，加强产品创新，完善产品多元化结构，为实现计划目标提供有力保证。

2、通过募集资金运用，公司的生产规模将得到迅速扩张，将进一步提高公司主导产品的生产能力，扩大销售规模，增加盈利，提升公司整体经营业绩。

3、通过募集资金运用，有利于拓宽融资渠道，解决公司近期发展所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构，提高公司资产质量，增强公司抗风险能力。

4、本次发行成功后，将有利于树立公司良好品牌，提升公司社会知名度，吸引各类专业人才加盟，提高公司的人才竞争实力，以实现公司的人才战略计划。

5、本次发行成功后，公司将成为社会公众公司，更有利于接受社会公众的监督，公司法人治理结构将更加完善，使公司在生产经营、产品质量、企业管理等各方面更加规范，为公司的良性发展打下坚实基础。

第十三节　募集资金运用

一、本次发行募集资金运用计划

经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，本次股票发行募集资金依轻重缓急用于以下四个项目。

单位：万元

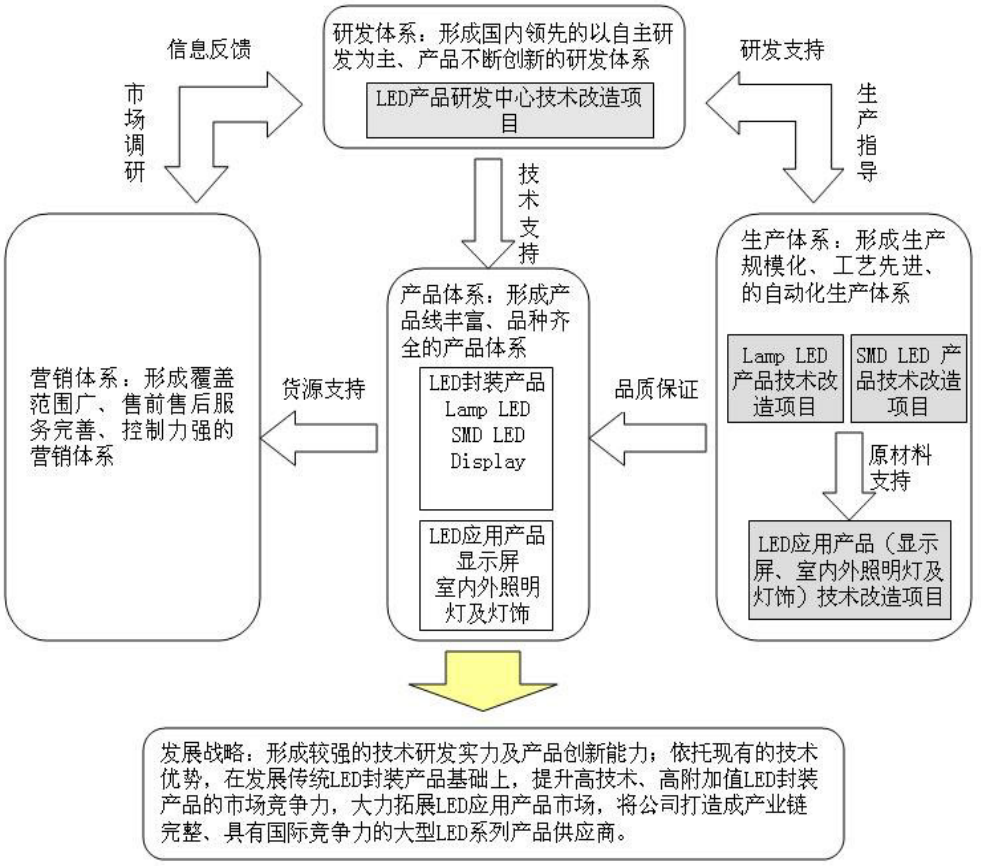
序号	投资项目	总投资	募集资金	建设期	项目备案
1	Lamp LED 产品技术改造项目	26,981.92	22,229.67	12 月	10200039711001865
2	SMD LED 产品技术改造项目	14,677.13	13,249.28	12 月	10200039711001867
3	LED 应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目	5,435.92	4,188.28	12 月	10200039721001866
4	LED 产品研发中心技术改造项目	3,144.79	2,964.59	12 月	10200039721001864
5	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-

上述项目中系土地使用权投资 1,402.67 万元和建筑工程投资 6,205.26 万元，由公司以自有资金投入。

若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。

二、募集资金投资项目与公司发展战略之间的关系

本次募集资金投资的四个项目是公司实施未来发展战略，将公司打造成国内乃至国际具有较强实力的 LED 封装及应用产品提供商的一个整体、系统工程。



“Lamp LED 产品技术改造项目”能够有效提升公司主营 LED 封装产品的品质和销售规模，并为公司 LED 灯饰产品生产提供原材料支持；“SMD LED 产品技术改造项目”是公司 LED 封装产品系列的丰富，旨在推进公司产品多元化，为 LED 显示屏和 LED 室内外照明灯提供原材料支持；上述两个募投项目将有效降低公司 LED 应用产品生产对外部原材料供应商的依赖程度。LED 应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目是公司 LED 封装产品在应用领域的拓展，旨在实现公司 LED 产品链向终端应用市场的适度延伸及覆盖，上述三个募集资金投资项目将进一步完善公司的产品线及产品收入结构。

“LED 产品研发中心技术改造项目”旨在提升公司的技术研发实力和产品自主创新能力，为 Lamp LED、SMD LED 及 LED 应用产品的研发、生产和销售提供更强大的技术支持及服务，建立工艺先进的生产体系，有效提升公司产品品质和技术的先进性，增强公司产品的市场竞争力。

公司的四个募集资金投资项目有机结合、相互补充、互为整体，将为实现公

司整体技术研发实力的提升、LED 封装产品竞争力的增强以及向 LED 应用市场拓展奠定坚实的基础，并为公司发展为产业链完整、具有国际竞争力的大型 LED 系列产品供应商提供了重要的战略保证。

三、募集资金投资项目市场前景及必要性分析

（一）募集资金投资项目市场前景分析

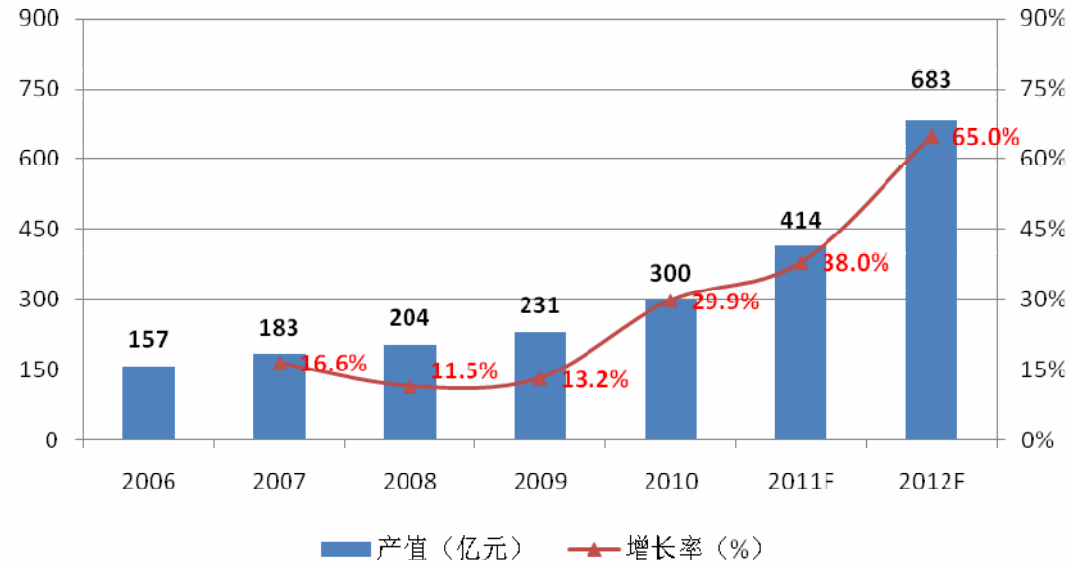
1、国家产业政策支持

近几年，国家各部委针对 LED 产业均出具了不同领域的扶持政策，如科学技术部于 2003 年启动的“国家半导体照明工程”，住房和城乡建设部于 2006 年印发的《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》，科学技术部于 2009 年启动了“十城万盏”半导体照明应用工程，国家 6 部委（国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部和国家质量监督检验检疫总局）于 2009 年联合公布的《半导体照明节能产业发展意见》等。其中《半导体照明节能产业发展意见》指出，到 2015 年半导体节能照明产业产值年均增长率在 30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到 20%左右，液晶背光源达到 50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到 70%以上。国家产业政策支持将使 LED 行业面临着较好的市场前景，未来行业需求增长将继续保持较快发展，巨大的 LED 市场需求将给公司提供广阔的发展空间。

2、市场容量

LED 作为新一代绿色照明光源，正广泛应用于各照明领域，其节能环保的特性得到了世界各国的普遍认可，未来市场空间巨大、前景广阔。目前，国内 LED 产品主要集中在景观装饰照明、显示屏、照明、LCD 背光、汽车、指示灯等应用领域。

2006-2012 年中国 LED 产值增长



数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，拓墣产业研究所

本公司募集资金投资项目正式投产后的产品应用领域为 LED 显示屏、室内外照明灯及灯饰等领域。因此，拟募集资金运用项目的市场容量分析主要涉及 LED 显示屏及灯饰照明等应用领域。

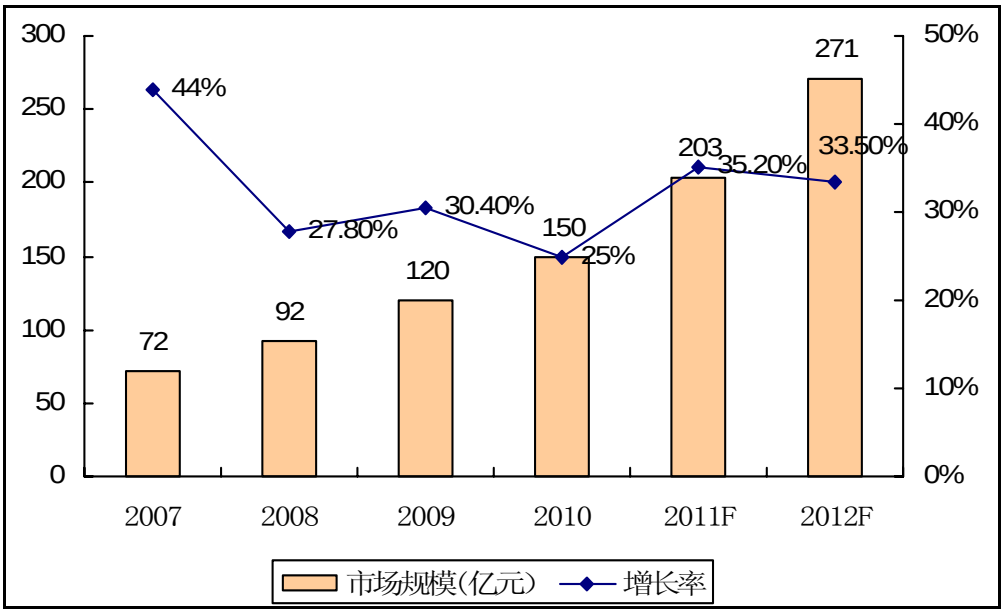
（1）LED显示屏

LED 显示屏是 LED 产业中发展较早且较成熟的产品，目前在全球被广泛地应用，近几年来在国内 LED 应用市场中占据了较大的市场份额。LED 显示屏市场的快速增长带动了国内 LED 产值的不断扩大。

LED 显示屏主要用于户外广告、体育场管、交通信息、证券银行等显示领域。LED 显示屏重要应用方面为户外广告显示屏，在中国一线城市普及率较高，但在二三线城市的需求还尚未释放，普及率有待提高，未来这些城市是国内 LED 显示屏市场发展的重要驱动力所在。此外，LED 显示屏市场的发展和大型活动的联系相对较为紧密，2008 年奥运会、2009 年 50 年国庆、2010 年世博会、世界杯、亚运会等大型活动都对 LED 显示屏市场发展有着较大的拉动作用。

2009 年，国内的 LED 显示屏产品市场已成为 LED 下游第二大应用领域，市场规模达到 120 亿元，占 LED 下游应用领域总产值的 20%。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，国内显示屏市场 2010 年的规模达到 150 亿元，比 2009 年的 120 亿元增长 25%，未来的市场空间将进一步扩大。

中国 LED 显示屏市场规模及增长变化



数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，中国光电协会 LED 显示分会

（2）LED 灯饰照明市场

LED 灯饰照明领域为 LED 封装产品的重要销售渠道。目前，LED 灯饰照明市场仍以建筑景观照明为主，替代性灯泡、建筑景观照明、娱乐照明、零售展示照明、商业及工业照明、住家照明及户外照明是未来 LED 照明的高成长型领域。根据拓墣产业研究所预测，2010 年至 2012 年 LED 照明市场产值复合增长率为 22.9%。

LED 照明各应用市场产值预测

单位：百万美元

照明应用市场	2008 年	2009 年	2010 年（E）	2011 年（F）	2012 年（F）	年复合增长率（2010－2012）
建筑景观	203	260	356	491	684	24.3%
字母灯饰	60	74	83	93	100	6.4%
商业及工业	46	69	95	125	160	19.0%
零售展示	34	60	95	135	193	26.7%
可携式照明	48	55	66	76	86	9.2%
替代性灯泡	15	26	45	67	93	27.4%
娱乐照明	13	20	35	49	69	25.4%

机器显示	15	18	20	23	26	9.1%
安全设施	15	17	18	18	18	0.0%
居家照明	7.3	15	29	51	118	59.6%
户外照明	3.2	5.5	14	24	41	43.1%
合计	459.5	619.5	856	1152	1588	22.9%

数据来源：拓墣产业研究所，2010 年数据尚未发布。

（二）募集资金投资项目的必要性

1、Lamp LED产品技术改造项目的投资必要性分析

（1）抓住行业发展机遇，发展民族品牌

目前，国内中央及地方政府均已出台了多项政策，鼓励 LED 照明行业的发展；另外，随着全球和国内对于环保节能的不断重视，未来全球和国内的 LED 行业将会迎来良好的发展前景。公司将抓住时机适时加大投入，充分利用自身的生产、技术和人才优势，在公司现有基础上继续做大做强，提高产品的技术含量，扩大生产规模及提升产品的品质，进一步提高市场知名度，强化并巩固公司在 Lamp LED 产品的市场领先地位。

随着本项目的实施，公司将进一步扩大 Lamp LED 封装产品的生产规模并降低生产成本，提升产品品质和生产效率，从而增强公司产品的竞争力和市场占有率，公司业务规模将进一步扩大。

（2）应对产能瓶颈，扩大销售规模

公司现有的生产能力已经束缚了公司产品的市场拓展和销售订单的执行，尤其在每年的生产高峰期，公司已有生产设备满负荷运转亦无法完全满足客户对产品交货期和需求量的要求，导致公司不得不放弃部分产品订单。尽管公司近年来也陆续采购了新的生产设备，但公司 Lamp LED 产品的生产仍然面临产能瓶颈的束缚，报告期内，相关生产设备的产能利用率分别达到 81%、95%和 93%。目前，Lamp LED 生产设备全年基本接近满负荷生产状态，公司急需扩建 Lamp LED 生产线，解决产能瓶颈问题。

随着本项目的顺利实施，公司将投产一批自动化程度高、规模化水平突出的 Lamp LED 生产设备，有效解决公司的产能瓶颈问题，更好地满足客户的需求，

持续扩大产品的销售规模。

（3）增强 Lamp LED 产品的竞争优势

公司在 Lamp LED 生产规模上处于行业领先地位，由于规模化效应导致公司 Lamp LED 产品成本具有较大的竞争优势。本项目将在 Lamp LED 产品现有年产能 960,000 万只的基础上新增 623,000 万只的年产能，进一步提高该产品的生产规模，强化产品的规模化优势，降低单位产品的生产成本；同时产销规模的提升将进一步带动原材料的大规模采购，增强公司对原材料供应商的议价能力，降低采购成本，从而进一步降低产品的总成本，提升 Lamp LED 产品的盈利水平。

2、SMD LED产品建设项目的投资必要性分析

（1）拓展 LED 封装产品的高端领域

与传统的 Lamp LED 产品相比，SMD LED 产品的技术含量较高、尺寸小、兼容性强，符合世界各国节能环保的消费理念，是 LED 封装产业不断向高端领域发展的重要方面。公司选择切入 SMD LED 封装市场，一方面可以优化公司现有的产品结构，丰富公司的产品线，满足不同层次 LED 下游应用客户的多样化需求；另一方面在把握 LED 封装产业发展趋势同时，紧跟全球 LED 封装产业升级换代的步伐，以求在未来的全球市场格局中占据较好的竞争地位。

（2）符合公司未来的发展战略

报告期内，SMD LED 产品营业收入为 5.17 万元、37.71 万元和 1,488.68 万元，由于受 Lamp LED 产品前期产能瓶颈的影响，公司在该产品生产设备投入较少，目前，公司已在 SMD LED 封装领域积累相关的技术基础，且在 2010 年下半年将投入较大规模的自动化设备以提高该产品的产能。本项目达产后将在原有产能每年 21,900 万只基础上，新增产能 238,000 万只。其中，该项目 1/3 产能将应用于募投项目“LED 应用产品技术改造项目”新增的产能，减少外部采购原材料 SMD LED 产品，实现原材料自我供应；同时，由于 SMD LED 产品生产设备、原材料芯片的采购、生产工艺流程等环节与 Lamp LED 产品类似，公司可以借助其在该领域积累的技术及资源，保证 SMD LED 产品的质量及成本优势；另外，由于客户对 Lamp LED 与 SMD LED 产品具有双向需求，公司将利用在 Lamp LED 领域中树立起的良好口碑，进一步深化与现有主要客户的长期战略合作关系，实行产品的交叉销售。

（3）开拓新的盈利空间

随着 SMD LED 产品成本逐年递减，通用照明与显示屏市场需求的迅速增长，SMD LED 产品日益成为 LED 封装行业的重要盈利来源。公司目前封装产品业务约 70%以上的营业收入主要来自 Lamp LED 产品的销售。随着本项目的顺利实施，公司每年将新增 SMD LED 产品产能 238,000 万只，公司业务将逐步实现多元化的目标，从而优化公司产品结构，开拓新的盈利空间，分散经营风险，保持公司持续、快速、稳定的发展。

3、LED应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目的投资必要性分析

（1）拓展 LED 下游应用领域

就 Lamp LED 封装领域而言，公司作为重要生产商，其产品品质、价格在国内具有较强的竞争力，积累了相应的品牌和成本优势。在 LED 应用领域，公司也积累了较丰富的生产经验，以中高端市场为定位的显示屏、室内外照明灯和灯饰产品畅销国内外。并且，随着环保节能理念的不断深入、各国政府的大力扶持，LED 应用产品必将面临着更好的市场前景。

因此，为增强公司的盈利能力，进一步拓展并整合 LED 应用领域，实现公司业务的多元化，公司拟扩大显示屏、室内外照明灯和灯饰产品的生产规模。本项目将在充分利用公司现有 LED 封装器件的产品优势同时，在降低 LED 应用产品的生产成本、提高 LED 应用产品品质的基础上，扩大显示屏、室内外照明灯和灯饰产品的生产规模，进一步确立公司 LED 应用产品的中高端市场定位，提升公司的盈利水平。

（2）优化 LED 应用产品的生产工艺，并提高产品生产效率

目前，公司 LED 应用产品的部分生产工艺环节自动化程度不高，检测检验方式还需进一步优化和完善。本项目顺利实施后，公司将购进先进的全自动化机器设备，较大幅度地以机械代替人工，运用先进设备提高产品生产的自动化水平，优化公司产品的生产工艺，提高生产效率和产品质量。

LED 显示屏产品现有生产工艺和执行扩产项目后的生产工艺对比：

指标	现有的产品生产工艺	扩产项目的产品生产工艺

焊接工艺	存在部分人工插件焊接	采用自动插件和全自动贴片焊接
生产效率	大部分使用人工进行逐一生产作业，LED 显示屏的零部件生产效率较低，且各工艺环节的作业质量不稳定	采用先进生产设备，并以室内表贴全部取代室内点阵，使室内表贴的生产效率大幅提升，生产工艺各环节的质量稳定性得到有效提高
自动化水平	产品生产中的刷锡膏、电子元件贴片等工艺环节上大部分采用人工作业，生产自动化水平较低	引进先进的自动/半自动化生产设备，解决人工刷锡膏、贴片耗时长和难于控制精准度等问题，并且提高产品生产效率，使整个产品生产工艺中人工的使用率大幅降低，提高了生产的自动化水平
质量控制	由于产品生产中大部分作业为人工操作，所引起的不良率及人工的自我返工率较高，从而影响产品的一次性合格率	引进先进设备并改进产品生产工艺，提高生产的自动化水平，使产品的一次性合格率有效提高。
产品的检验方式方法	生产中大部分为人工操作，每操作完一道工序后，作业人员需要亲自进行自检。QC 人员需要对焊接后的产品以及出货的产品进行 100%检验，并结合过程中不断巡检来完成检验工作，产品的检验耗时耗力、成本较高。	生产过程采用治具定位，并使用自动/半自动化设备，使人工直接操作的过程段减少，部分操作人员或 QC 人员只需抽样检验就可以完成前段检验工作，后焊接及出货才需要 QC 人员进行 100%检验，从而降低产品的检验成本，提高产品检验质量。

LED 室内外照明灯现有生产工艺和执行扩产项目后的生产工艺对比：

指标	现有生产工艺	扩产项目的生产工艺
生产效率	生产作业环节人工占比较高，导致产品加工效率不高，产品各工艺环节的加工质量难于控制	引进先进设备之后，优化生产工艺，大幅增加生产的自动化水平，从而有效提高产品的生产效率并降低各加工环节的返工率
自动化水平	现有的产品生产工艺中人工占比较高，生产自动化和流水化程度较低	引进自动化设备之后，提高了生产的流水化程度，产品制造工艺中的人工占比大幅减少，自动化水平大幅提升，
质量控制	现有产品的加工和检验环节大量使用人工作业，导致产品的一次性合格率不高	扩产之后利用先进设备，改进产品加工和检验方式，使得产品的一次性合格率大幅提升，产品质量能够有效控制

LED 灯饰产品现有生产工艺和执行扩产项目后的生产工艺对比：

指标	现有生产工艺	扩产项目的生产工艺
生产效率	灯饰产品生产中的 LED 焊接及 LED 装配工序主要依靠手工操作，	在焊接工序上采用全自动机械焊接，极大地提高生产效率，单机产量较扩

	效率较低、工艺质量不稳定。	产前大幅提升；在装配工序采用机械辅助安装，产品生产效率有所提高，生产质量显著提升。
自动化水平	挤出芯线、芯线加工、包覆防护层工序是机器生产，其他工序则主要是人工或机械化生产，机械辅助生产工序占比不高	主要生产过程均采用自动化机器生产，特别是焊接过程，采用自动化后产品的不良率大幅度下降，机械化生产占比大幅提升，除检测外，基本实现产品生产的机械化
质量控制	由于设备限制，对于来料的部分检测项目依靠供应商的出厂检测或委托第三方检测，部分生产工序或成品的检测项目不能实施，必须委托外检，影响产品质量的稳定性。	购入全套的检测计量设备，对来料进行较全面的检测判别，减少产品生产的风险，提高半成品、产成品的监控水平，提升产品的不良反应时效，从而提高产品的合格率，降低生产成本。
新产品开发与投产	现有产能已不能满足市场需要，抑制了新产品开发及投产。	产能空间的扩大，为新产品投产提供了空间。公司将加大新产品开发力度，充分利用扩产设备及检测设备，提高产品档次及附加值。

4、LED产品研发中心技术改造项目的投资必要性分析

（1）完善研发平台，适应未来市场竞争

技术创新是本公司多年以来的核心竞争优势之一，公司作为国内 LED 封装行业的主要生产企业，已具备了部分封装技术领先优势，但随着全球未来 LED 产业不断发展，客户对 LED 产品的品质、性能、性价比等方面的要求也在不断地提高，如何进一步持续增强技术优势，进行技术和产品升级，以应对未来的市场竞争对本公司至关重要。

因此，客观上需要公司建立研发设备更加先进、结构更加完善、人员配置更加合理的研发中心，进一步提升公司的研发实力，研发中心技术改造项目是公司适应未来市场竞争的战略所需。

（2）提升技术研发水平，保持技术优势

经过多年的发展，公司已具备较强的研发实力，拥有了一批经验丰富的LED封装技术研发团队，承担了较多的产学研科技项目，形成了多项自主知识产权。公司在直插式高密度LED支架、模条的开发、铜线焊接导入技术、大功率LED液态硅胶封装技术、高阻燃抗紫外线等方面具备独特的技术优势，使公司LED封装产品具备较大的市场竞争优势。

随着本项目的顺利实施，公司将进一步对已有的自主研发技术进行持续改进和升级，并且加快多项技术储备项目的研发进程，不断在封装技术、工艺及辅料设计等方面形成新的突破，不断保持并发展公司的技术优势。

四、募集资金投资项目新增产能适应了公司发展的需要

（一）募集资金投资项目产能逐年释放

近几年，LED 行业面临着较好的市场前景，根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的数据，未来几年全球 LED 产业继续保持较快的增长幅度，其中中国 LED 产业将迎来爆发性增长，年均增长幅度超过 30%。

经过十几年的发展，公司将依靠规模化生产、技术研发、产品系列丰富、稳定的客户资源等方面的优势，紧紧抓住行业发展契机，不断引进国内外先进自动化设备，扩大公司各产品线的产能。尽管如此，公司仍面临着产能不足的局面。通过本次募集资金投资项目的建设，公司产能将实现大幅度提高，缓解产能压力。公司募集资金投资项目产能逐步释放，具体如下：

项目		2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
Lamp LED 产品技术改造项目（万只）		-	155,750	404,950	560,700	623,000
Lamp LED 产能		960,000	1,115,750	1,364,950	1,520,700	1,583,000
产能增长率		-	16.22%	22.33%	11.41%	4.10%
SMD LED 产品技术改造项目（万只）		-	59,500	154,700	214,200	238,000
SMD LED 产能		21,900	81,400	176,600	236,100	259,900
产能增长率		-	271.69%	116.95%	33.69%	10.08%
LED 应用产品技术改造项目	LED 显示屏（平方米）	-	2,125	5,525	7,650	8,500
	LED 显示屏产能	8,112	10,237	13,637	15,762	16,612
	产能增长率	-	26.20%	33.21%	15.58%	5.39%
	LED 室内外照明灯（盏）	-	67,250	174,850	242,100	269,000

	LED 室内外照明灯产能	276,000	343,250	450,850	518,100	545,000
	产能增长率	-	24.37%	31.35%	14.92%	5.19%
	LED 灯饰（米）	-	1,000,000	2,600,000	3,600,000	4,000,000
	LED 灯饰产能	4,668,000	5,668,000	7,268,000	8,268,000	8,668,000
	产能增长率	-	21.42%	28.23%	13.76%	4.84%

注：假设本次募集资金在 2011 年 6 月底之前可以到账投入使用，按“一年建设、两年达产”的规划，第一年达产率为 50%，第二年达产率为 80%，第三年达产率为 100%。

目前，SMD LED 产品占公司总体销售比重较小，主要系公司近几年专注于 Lamp LED 产品研发、生产和销售，而在 SMD LED 产品领域，公司新增投入该产品机器设备较少。随着本次募投“SMD LED 产品技术改造项目”，将大幅度提升 SMD LED 产品产能，丰富公司产品结构，带动公司营业规模不断扩大。

SMD LED 产品技术改造项目达产后产能将达到 238,000 万只/年。由于受 Lamp LED 产品前期产能瓶颈的影响，公司在该产品生产设备投入较少，目前，公司已在 SMD LED 封装领域积累相关的技术基础。同时，由于 SMD LED 产品生产设备、原材料芯片的采购、生产工艺流程等环节与 Lamp LED 产品类似，公司可以借助其在该领域积累的技术及资源，保证 SMD LED 产品的质量及成本优势。

本项目新增 1/3 产能将应用于“LED 应用产品技术改造项目”新增的产能，减少外部采购原材料 SMD LED 产品，实现原材料自我供应；其余 2/3 产能用于对外销售，丰富公司产品结构，为客户提供更丰富的产品系列。由于客户对 Lamp LED 与 SMD LED 产品具有双向需求，公司将利用在 Lamp LED 领域中树立起的良好口碑，进一步深化与现有主要客户的长期战略合作关系，推动产品交叉销售。

因此，公司产能增长符合市场需求，适应了公司快速发展的要求，与公司未来业务增长相适应。

（二）进一步拓展国内外营销渠道，扩大市场份额

目前，公司在全国各大主要城市建立了销售办事处，销售网络遍及全国；在

亚洲的韩国、印度等地区，公司也通过经销商建立了产品销售渠道，覆盖周边国家。公司还通过展会、网络平台和相关贸易商向欧美地区推广和销售本公司的LED 产品。完善的销售渠道及优质的客户服务将为本公司进一步开拓市场、扩大市场份额打下坚实的基础。未来，公司将进一步强化全国各办事处的辐射力度，发挥代理商与中小客户合作关系，进一步深化与现有主要客户的长期战略合作关系，客户业务的持续扩张将消化公司新增产能，在客户的发展中，公司将实现自身业务规模地不断扩大。

（三）依托技术优势提高产品品质，强化产品市场竞争优势

公司按照严格的产品质量和生产标准建立了完善的品质管理体系，先后取得了 UL 认证、CCC 认证、CE 认证、ROHS 认证、ISO9001 品质认证、ISO14000 的环境管理认证等，产品获得众多知名企业的认可。公司产品的高品质得到了国内外市场的广泛认可，为公司进一步开展市场营销，提升产品市场份额提供了有利条件。

五、募集资金投资项目固定资产投资变化对经营成果的影响

（一）本次募集资金投资项目固定资产投资的必要性分析

1、房屋建筑物投资的必要性

公司目前生产所用厂房主要通过租赁方式取得，由此大幅减少了固定资产投资规模。上述生产模式是公司在规模较小时的现实战略选择，与公司发展初期的经营战略和资金实力相匹配，具有其形成的必然性。

公司通过近年的快速发展，已经成为集领先的研发设计能力、完善的产品品种生产线、健全的销售服务体系于一体的，具有较强综合实力的LED封装企业，发展前景良好。为了保持企业未来的平稳发展，控制财务、经营风险，公司需构建良好的资产结构，固定资产规模需要与生产、销售规模相匹配，并形成稳定的生产能力，增强抗风险能力。

2、研发、生产所需机器设备投资的必要性

LED行业属于资金与技术密集型行业，产品的生产需要投入大量资金购入各种先进生产设备，特别是公司新建高技术含量、高附加值产品投资项目后，产品生产对机器设备的要求更高，资金投入规模较大，一次性投入机器设备较多。本

次生产设备的投入主要是根据产能扩张的需求进行的相应投资。研发类和检测类设备投资不直接增加公司的产能，从表面上看降低了固定资产的投入产出比，但从长远看，该固定资产投资对提升公司的产品质量、技术创新的核心竞争力具有长远意义。

3、公司实现长远发展战略的需要

LED 封装产品对研发及生产环境的要求较高，大型客户往往对供应商的生产设备等硬件设施要求也较高，且将其作考察重要合作伙伴的条件之一。因此，公司需根据 LED 产品研发与生产的要求，建设一流的研发环境，提高研发水平；建设高标准的厂房和生产线，提高生产效率和产品质量。

综合以上分析，本次募集资金投资项目固定资产投资是合理的、必要的。

（二）固定资产投资增长与营业规模增长相匹配

根据募集资金投资计划，Lamp LED 产品技术改造项目、SMD LED 产品技术改造项目、LED 应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目中生产设备投资合计 29,587.37 万元，实现销售收入合计 85,602.00 万元，固定资产变化与销售收入变动的关系情况如下表：

项目	生产设备原值（万元）①	营业收入（万元）②	投入产出比 ③=②/①
Lamp LED 产品技术改造项目、SMD LED 产品技术改造项目、LED 应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目	29,587.37	85,602.00	2.89
2010 年	30,609.34	81,476.63	2.66

据上表，公司拟投资项目投入产出比分别为 2.89，与目前投入产出比相近，因此公司本次募集资金固定资产投资规模合理、与公司营业规模扩张基本一致。

（三）新增固定资产折旧、无形资产摊销费对未来经营成果的影响

根据募集资金投资计划，本次资募集资金投资项目完全达产后，每年将新增折旧摊销费用 3,476.15 万元，以公司 2010 年度综合毛利率 30.86%进行测算，项目建成后，在经营环境不发生重大变化的情况下，如公司存量资产实现的营业收入较项目建成前增长 13.83%万元，增加的毛利为 3,476.15 万元，即可消化掉因

新项目投资而导致的折旧摊销费用增加，确保公司营业利润不会因此而下降。

以 2010 年公司营业收入 81,476.63 万元为基础，假设其他经营条件不变，募集资金于 2011 年到位并投入使用，只要公司 2011 年营业收入较 2010 年收入增长超过 13.83%，就可确保公司营业利润不会因此而下降，而目前公司营业收入保持着良好的增长态势，2008 年至 2010 年公司营业收入年复合增长率达到 45.40%，同时，上述项目建设期不超过 1 年，1 年后募集资金投资项目建成后公司业务规模还将进一步扩大。即使不考虑项目投产带来的营业收入增长，以公司目前生产经营状况，就基本可消化掉上述折旧摊销费的增加对净利润的影响。因此，新增折旧摊销对公司未来经营成果不会产生重大不利影响。

六、募集资金投资项目简介

（一）Lamp LED产品技术改造项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为股份公司。

2、建设内容

本项目的投资总额为 26,981.92 万元，拟建四条生产线，购置各类机器设备及模具 1,100 多台，对 Lamp LED 产品进行技术改造。本项目建设期 12 个月，项目设计产能为年产 623,000 万只。

3、项目的生产工艺

本项目为现有 Lamp LED 产品的技术改造项目，生产工艺流程与现有产品一致。参见招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、本公司主要业务”相关内容。

4、主要原材料供应

本项目原材料主要为 LED 芯片、支架、铜线、胶水、荧光粉等，其中支架和胶水由公司自产，其他原材料由公司现有采购渠道解决。原材料的供应链比较完善，具有较强的选择性，能够满足项目生产的需要。

5、项目选址及用地

本项目位于中山市小榄镇木林森大道 1 号，交通便利，基础设施完备，有完

善的供电、给排水、通信等基础配套条件。拟占用的土地已由本公司获得国有土地使用权，取得编号中府国用（2010）第 051709 号的土地使用权证。目前厂房建设也已完工，拟占用的生产厂房的建筑面积为 30,144.40 平方米。

6、建设投资与设备方案

（1）本项目募集资金总量及其依据

项目	投资额（万元）	占总投资的比例
一、工程费用	20,627.99	76.45%
1、建筑工程	3,874.90	14.36%
2、设备购置	16,753.08	62.09%
二、土地使用权	877.35	3.25%
三、工程建设及其他费用	1,364.12	5.06%
1、安装工程	981.17	3.64%
2、电气、给排水、消防、弱电及室外配套设施工程	382.95	1.42%
四、预备费	905.86	3.36%
五、铺底流动资金	3,206.60	11.88%
募集资金总额	22,229.67	82.39%
项目投资总额	26,981.92	100%

注：土地使用权及厂房建筑工程以自有资金投入。

（2）建设投资估算

- 建筑工程及土地使用权投入明细

序号	费用名称	建筑/占地面积（平方米）	综合单价（万元/平方米）	合计（万元）
1	生产厂房	30,144.40	0.0898	2,705.96
2	辅助办公楼	2,740.40	0.0898	246.00
3	公用工程（包括绿化、道路、围墙和门卫室等）	-	-	145.73
4	厂区服务性工程（包括员工宿舍、饭堂等）	6,191.76	0.1255	777.22
5	土地使用权	16,399.07	0.0535	877.35

	合计			4,752.26

- 生产设备购置投入

序号	新增设备	型号	产地	单价（万元/台）	数量（台）	金额（万元）
1	进口直插全自动高速固晶机	Pantherlll	进口	37.12	108	4,009.07
2	扩晶机	-	国产	0.39	8	3.12
3	全自动金线球焊线机	Ihawk Xtremev	进口	63.38	120	7,605.29
4	全自动点荧光粉机	DJ-50A	国产	8.74	72	629.14
5	全自动封胶机	30FE	国产	30.50	36	1,098.00
6	全自动切脚机	HE813	国产	4.76	36	171.50
7	全自动分光机	SLS230T	国产	12.96	120	1,555.20
8	烤箱	-	国产	2.80	104	291.20
9	封口机	810×350×320	国产	0.30	8	2.40
10	真空箱	-	国产	0.56	8	4.48
11	真空机	2X-15	国产	0.48	8	3.84
12	吸晶机	K95-46003	国产	0.38	8	3.04
13	稳压电源	ZTY-100KVA	国产	1.20	64	76.80
14	模具	-	国产	2.00	400	800.00
15	冰箱、钢盘、料架、料车、电子称、电脑、搅伴机等	-	-	-	-	500.00
16	合计					16,753.08

- 工程建设及其他费用

序号	费用名称	建筑面积（平方米）	综合单价（万元/平方米）	合计（万元）

1	安装工程			981.17
1.1	生产厂房	30,144.40	0.0252	759.64
1.2	办公楼	2,740.40	0.0352	96.46
1.3	员工宿舍及食堂	6,191.76	0.0202	125.07
2	电气、给排水、消防、弱电及室外配套设施工程	39,076.56	0.0098	382.95
	合计			1,364.12

7、项目实施进度

本项目建设期为 12 个月。

8、环保情况

本项目生产过程不产生废水、废气；产生的废渣包括不合格产品、边角料和废包装等，属于非危险固体废弃物，该等固体废弃物可回收再利用；项目采用隔音罩和隔音玻璃屏蔽噪声，并对噪声进行定期监控，避免噪声对外界环境的影响。

中山市环境保护局对本项目出具了审查批复意见，同意本项目建设。

9、项目效益分析

项目达产后，预计每年可实现销售收入 43,610.00 万元，净利润 6,543.24 万元。

该投资项目的投资收益指标分析如下：

指标	指标	
	所得税前	所得税后
内部收益率	26.06%	22.89%
净现值（万元）	14,796.22	11,255.212
投资回收期（年）	5.16	5.55

（二）SMD LED产品技术改造项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为股份公司。

2、建设内容

本项目总投资 14,677.13 万元，拟新建两条 SMD LED 产品生产线，购置各类设备及模具 400 多台。本项目建设期 12 个月，项目设计产能为年产 238,000 万只。

3、项目的生产工艺

本项目采用的生产工艺流程与公司现有 SMD LED 产品相一致，参见招股说明书“第六节 业务与技术”的“五、本公司主要业务”相关内容。

4、主要原材料供应

本项目所需的原材料主要有 LED 芯片、支架、金线、胶水等，其中支架和胶水为公司自产，其他外购原材料由公司现有采购渠道解决。原材料市场供应充足，能够满足本项目的生产需要。

5、项目选址及用地

本项目位于中山市小榄镇木林森大道 1 号，项目所在地交通便利，基础设施完备，有完善的供电、给排水、通信等基础配套条件。公司对项目拟占用土地已取得编号为中府国用（2010）第 051709 号的国有土地使用权证。目前厂房建设也已完工，拟占用的生产厂房建筑面积为 8,029.00 平方米。

6、建设投资与设备方案

（1）本项目募集资金总量及其依据

项目	投资额（万元）	占总投资的比例
一、工程费用	11,683.43	79.60%
1、建筑工程	1,165.18	7.94%
2、设备购置	10,518.25	71.66%
二、土地使用权	262.66	1.79%
三、工程建设及其他费用	415.19	2.83%
1、安装工程	300.55	2.05%
2、电气、给排水、消防、弱电及室外配套设施工程	114.65	0.78%
四、预备费	546.67	3.72%
五、铺底流动资金	1,769.17	12.05%
募集资金总额	13,249.28	90.27%

项目投资总额	14,677.13	100%

注：土地使用权及厂房建筑工程以自有资金投入。

（2）建设投资估算

- 建筑工程及土地使用权投入明细

序号	费用名称	建筑/占地面积（平方米）	综合单价（万元/平方米）	合计（万元）
1	生产厂房	8,029.00	0.0898	720.74
2	辅助办公楼	1,605.80	0.0898	144.15
3	公用工程（包括绿化、道路、围墙和门卫室等）	-	-	41.23
4	厂区服务性工程（包括员工宿舍、饭堂等）	2,063.92	0.1255	259.07
5	土地使用权	4,909.53	0.0535	262.66
	合计			1,427.85

- 生产设备购置投入

序号	新增设备	型号	产地	单价（万元/台）	数量（台）	金额（万元）
1	进口水平全自动固晶机	AD830	进口	117.07	36	4,214.39
2	扩晶机	Na-6000A	国产	0.39	4	1.56
3	全自动焊线机	Ihawk Xtreme	进口	47.12	34	1,602.15
4	自动点胶机	5HOTMASTER3001MPP-1 双头	进口	20.00	22	440.00
5	烤箱		国产	2.80	26	72.80
6	胶饼预热机	-	进口	180.00	4	720.00
7	全自动切脚机	HE813	国产	5.00	12	60.00
8	角切式装载系统	SLT400（编带）	进口	67.96	24	1,631.14
9	全自动分选	SLS230T	进口	47.12	24	1,130.93
10	封口机	810×350×320	国产	0.30	4	1.20

11	真空箱	-	国产	0.56	4	2.24
12	真空机	2X-15	国产	0.48	4	1.92
13	吸晶机	K95-46003	国产	0.38	4	1.52
14	稳压电源	ZTY-100KVA	国产	1.20	32	38.40
15	模具	-	国产	2.00	200	400.00
16	冰箱、钢盘、料架、料车、电子称、电脑、搅伴机等	-	-	-	-	200.00
	合计					10,518.25

- **工程建设及其他费用**

序号	费用名称	建筑面积（平方米）	综合单价（万元/平方米）	合计（万元）
1	安装工程			300.55
1.1	生产厂房	8,029.00	0.0252	202.33
1.2	办公楼	1,605.80	0.0352	56.52
1.3	员工宿舍及食堂	2,063.92	0.0202	41.69
2	电气、给排水、消防、弱电及室外配套设施工程	11,698.72	0.0098	114.65
	合计			415.19

7、项目实施进度

本项目建设期为 12 个月。

8、环保情况

本项目生产过程中不产生废气和废水；产生的废渣包括不合格产品、边角料和废包装等，属于非危险固体废弃物，可以回收再利用；对于车间噪声，本项目拟设置隔音罩和隔音玻璃并执行定期噪声监控，以避免噪声对外界环境的影响。

中山市环境保护局对本项目出具了审查批复意见，同意本项目建设。

9、项目效益分析

项目达产后，预计每年可实现销售收入 23,800.00 万元，净利润 2,390.20 万

元。

该投资项目的投资收益指标分析如下：

指标	指标	
	所得税前	所得税后
内部收益率	33.13%	30.91%
净现值（万元）	12,326.45	10,932.43
投资回收期（年）	4.41	4.59

（三）LED 应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为股份公司。

2、建设内容

本项目的投资总额为 5,435.92 万元，拟建设三条生产线，LED 显示屏、室内外照明灯和灯饰产品各一条生产线，购置各类设备和模具 60 多台，对现有 LED 应用产品进行技术改造。本项目建设期 12 个月，设计产能为：LED 显示屏产品年产 8,500 平方米，LED 室内外照明灯年产 269,000 盏，LED 灯饰产品年产 4,000,000 米。

3、项目的生产工艺

本项目为现有 LED 应用产品的技术改造项目，生产工艺流程与现有产品一致。参见招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、本公司主要业务”相关内容。

4、主要原材料供应

本项目所生产 LED 应用产品使用的原材料中，Lamp LED 和 SMD LED 封装产品全部由公司自产，其他原材料包括电源线、电阻、电容、箱体和整流桥等均向国内中高端品牌厂商采购，以上原材料采购供应链完善，市场竞争充分，具有较强的选择性，能够满足本项目的生产需要。

5、项目选址及用地

本项目位于中山市小榄镇木林森大道 1 号，交通便利，基础设施完备，有完

善的供电、给排水、通信等基础配套条件。拟占用的土地已由本公司获得国有土地使用权，取得编号中府国用（2010）第 051709 号的土地使用权证。目前厂房建设也已完工，拟占用的生产厂房建筑面积为 6,423.20 平方米。

6、建设投资与设备方案

（1）本项目募集资金总量及其依据

项目	投资额（万元）	占总投资的比例
一、工程费用	3,337.07	61.39%
1、建筑工程	1,021.03	18.78%
2、设备购置	2,316.04	42.61%
二、土地使用权	226.61	4.17%
三、工程建设及其他费用	358.99	6.60%
1、安装工程	260.08	4.78%
2、电气、给排水、消防、弱电及室外配套设施工程	98.91	1.82%
四、预备费	133.75	2.46%
五、铺底流动资金	1,379.50	25.38%
募集资金总额	4,188.28	77.05%
项目投资总额	5,435.92	100%

注：土地使用权及厂房建筑工程以自有资金投入。

（2）建设投资估算

- 建筑工程及土地使用权投入明细

序号	费用名称	建筑/占地面积（平方米）	综合单价（万元/平方米）	合计（万元）
1	生产厂房	6,423.20	0.0898	576.59
2	辅助办公楼	1,605.80	0.0898	144.15
3	公用工程（包括绿化、道路、围墙和门卫室等）	-	-	41.23
4	厂区服务性工程（包括员工宿舍、饭堂等）	2,063.92	0.1255	259.07
5	土地使用权	5,101.87	0.0535	226.61

	合计			1,247.64

- **生产设备购置投入**

本项目中，LED 显示屏生产设备投入 521.04 万元，LED 室内外照明灯生产设备投入 1035.00 万元，LED 灯饰生产设备投入 760.00 万元，合计共 2,316.04 万元。

1）LED 显示屏

序号	新增设备	型号	产地	单价（万元/台）	数量	金额（万元）
1	空气压缩机	ERC-50SAY	国产	8.80	1	8.80
2	自动贴片机	SI-E1000	进口	96.00	3	288.00
3	回流焊	V-RTOP350 DS-LF-N2	国产	7.00	2	14.00
4	半自动锡膏印刷机	SP3040	国产	3.00	1	3.00
5	接驳台	MS-BC-380A	国产	0.45	8	3.60
6	自动编带机	TPC-300	国产	20.00	1	20.00
7	全自动中速插件机 DIP	XG-2000	国产	120.00	1	120.00
8	干燥机	20(JMS)	国产	0.40	1	0.40
9	光枪	CbM-8	国产	5.50	1	5.50
10	光谱分析仪	LXX2672	进口	5.00	1	5.00
11	电流检测钳流表	319	进口	0.30	1	0.30
12	红外线测温仪	TES1320	进口	0.20	1	0.20
13	自动上下板机	EW500P	国产	6.00	2	12.00
14	上下板料架	SZL-3BW	国产	0.03	8	0.24
15	产品组装流水线	W20M-50	国产	10.00	2	20.00

16	模具	MS PCB 定位系统\KK RP1 焊接工艺检测系统	国产	-	-	20.00
17	合计					521.04

2）LED 室内外照明灯

序号	新增设备	型号	产地	单价（万元/台）	数量（台）	金额（万元）
1	自动贴片流水线	松下 CM95R	进口	250.00	1	250.00
2	波峰焊	LF-350B	国产	25.00	1	25.00
3	老化设备（定做）	T8 E27 老化架	国产	200.00	1	200.00
4	流水组装线	环保防静电流水线	国产	10.00	1	10.00
5	工程、品管检测设备	GO-R5000	国产	100.00	1	100.00
6	工具（计算价格时含模具）	PS61005	进口	-	-	450.00
7	合计					1,035.00

3）LED 灯饰

序号	新增设备	型号	产地	单价（万元/台）	数量	金额（万元）
1	挤出机	Φ80 挤出机	进口	20.00	2	40.00
2	贴片机	MV2C	进口	80.00	1	80.00
3	回流焊机	IPC-810	进口	10.00	1	10.00
4	灯串焊接机	HJ-50K	国产	8.00	10	80.00
5	流水线	LS-20M	国产	10.00	4	40.00
6	注塑机	Y-310	进口	25.00	4	100.00
7	灌胶机	PGB-5000	国产	10.00	2	20.00
8	检测设备	-	国产	100.00	1	100.00

9	产品认证测试	-	国产	30.00	1	30.00
10	工具（计算价格时含模具）	MJ-00019	国产	-	-	250.00
11	其他辅助设备	-	国产	-	-	10.00
	合计					760.00

- **工程建设及其他费用**

序号	费用名称	建筑面积（平方米）	综合单价（万元/平方米）	合计（万元）
1	安装工程			260.08
1.1	生产厂房	6,423.20	0.0252	161.86
1.2	办公楼	1,605.80	0.0352	56.52
1.3	员工宿舍及食堂	2,063.92	0.0202	41.69
2	电气、给排水、消防、弱电及室外配套设施工程	10,092.92	0.0098	98.91
	合计			358.99

7、项目实施进度

本项目建设期为 12 个月。

8、环保情况

本项目生产过程不产生废水、废气，产生的废渣为可回收再利用的边角料、废包装和锡渣等，不会造成环境污染。项目拟设置隔音罩和隔音玻璃屏蔽噪声，并对噪声定期监控，车间噪声对外界环境基本不产生的影响。

中山市环境保护局对本项目出具了审查批复意见，同意本项目建设。

9、项目效益分析

项目达产后，预计每年可实现销售收入 18,192.00 万元，净利润 1,989.46 万元。

该投资项目的投资收益指标分析如下：

指标	指标

	所得税前	所得税后
内部收益率	36.20%	31.39%
净现值（万元）	5,501.80	4,376.55
投资回收期（年）	4.80	5.23

（四）LED产品研发中心技术改造项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为股份公司。

2、项目选址及用地

本项目位于中山市小榄镇木林森大道 1 号，交通便利，基础设施完备，有完善的供电、给排水、通信等基础配套条件。拟占用的土地已由本公司获得国有土地使用权，取得编号中府国用（2010）第 051709 号的土地使用权证。

3、建设内容

本项目总投资 3,144.79 万元。研发场地分为两个部分，分别为办公室 400m^2、实验室 1,205.80m^2。

4、建设投资与设备方案

（1）本项目募集资金总量及其依据

项目	投资额（万元）	占总投资的比例
一、工程费用	2,568.95	81.69%
1、建筑工程	144.15	4.58%
2、设备购置	2,424.80	77.11%
二、土地使用权	36.05	1.15%
三、工程建设及其他费用	75.88	2.41%
1、安装工程	60.14	1.91%
2、电气、给排水、消防、弱电及室外配套设施工程	15.74	0.50%
四、预备费	125.03	3.98%
五、铺底流动资金	338.88	10.78%
募集资金总额	2,964.59	94.27%
项目投资总额	3,144.79	100%

注：土地使用权及厂房建筑工程以自有资金投入。

（2）建设投资估算

- 建筑工程及土地使用权投入明细

序号	费用名称	建筑/占地面积（平方米）	综合单价（万元/平方米）	合计（万元）
1	研发中心实验室项目	1,205.80	0.0898	108.24
2	研发辅助工程	400.00	0.0898	35.91
5	土地使用权	674.00	0.0535	36.05
	合计			180.20

- 研发设备购置投入

募投项目所需设备包括专用设备及办公设备，合计 2,424.80 万元，其中研发设备投资 2,351.00 万元，办公设备投资 73.80 万元。研发设备具体明细见下表：

序号	新增设备	型号	产地	单价（万元/台）	数量（台）	金额（万元）
1	光谱仪	EDX-1800B	国产	35.00	3	105.00
2	自动送出料反应锅	3 米反应锅	国产	17.00	4	68.00
3	全自动复合反应釜	4000L 复合反应釜	国产	35.00	3	105.00
4	全自动塑封机	IDEALcompress	进口	150.00	2	300.00
5	单头全自动贴片机	YV100	进口	26.00	1	26.00
6	八段自动温控回流焊机	V-TOP8820-LF	国产	35.00	1	35.00
7	自动测试机	捷伦自动分光机	国产	2.00	3	6.00
8	全自动拉镀生产线	拉镀生产线	国产	70.00	3	210.00
9	全自动切片包装机	高速切片机	国产	11.00	9	99.00
10	铜柱冲模	PJD08-08	国产	0.50	8	4.00
11	高速冲床	H-45	国产	35.00	5	175.00

12	注塑模具	大功率 08-A	国产	12.00	2	24.00
13	全自动注塑机	JX-4000K	国产	40.00	2	80.00
14	冲模	45UP 冲模、724-G、大功率 08、3528-12A	国产	8.00	9	72.00
15	注塑模具	3528-12A	国产	8.00	1	8.00
16	全自动水平式固晶机	AD860	进口	34.00	6	204.00
17	全自动水平式焊线机	IHAWK03	进口	40.00	7	280.00
18	自动压壳机	R14 自动压壳机	国产	12.00	1	12.00
19	自动编带机	YC-320	国产	38.00	2	76.00
20	自动插件机	6380B	国产	40.00	2	80.00
21	波峰焊机	LF-350	国产	35.00	1	35.00
22	自动切脚机	YC-290	国产	6.00	1	6.00
23	模顶机	IDEALcompress	进口	150.00	1	150.00
24	高温煅烧炉	2000 度高温炉	国产	50.00	1	50.00
25	高温气氛还原炉	2000 度高温还原炉	国产	36.00	1	36.00
26	粒径分析仪	Easizer30 激光粒度仪	国产	40.00	1	40.00
27	研磨机	MF-10	进口	15.00	1	15.00
28	自动荧光粉点胶机	SHOTMASTER300	进口	25.00	2	50.00
	合计				83	2,351.00

5、研发方向

（1）高性能光学硅胶、SMD 用高 Tg 点胶水研发

市场上大功率 LED 灌封用硅胶、显示屏全彩 SMD 封装用环氧树脂基本是美日品牌垄断，原材料的高价效应不得不往产品价格上传导；开发的高性能光学硅胶将采用新型的技术，实现原材料国产化，确保整体成本下降，有利于 LED

产品的推广普及。

研发目标：研制光学级别硅橡胶，用于大功率 LED 或其他低光衰 LED 灌封；SMD 封装胶水国产化。

技术性突破点：提高硅胶透光率，特别是自带粘性硅胶的透光率；提高硅胶及胶水的耐温性、抗老化性、耐黄变性；实现硅胶带自粘性；实现胶水无毒化、胶气少；提高胶水与 PPA、金属的结合性能；提高胶水的防水性能。

（2）大功率 LED 硅胶液态模顶技术、IRM 环氧树脂液态模顶技术研发

市场上大功率 LED 封装普遍采用盖 PC 透镜灌封凝胶或模条灌封硅胶，以手工作业为主，生产效率低下，品质不稳定；研发中心和设备供应商一起研发液态硅胶模顶技术，除上下料，全程自动化作业，人工干预少，产品产量高、品质好。

传统意义上的眼珠型封装 IRM 一般用胶饼模顶而成，然而胶饼生产核心技术基本掌握在日本和台湾企业手中，产品单价较高，而且利用率很低；本研发中心和设备供应商一道研发液态环氧树脂模顶技术，采用低单价的环氧树脂代替胶饼封装，能有效降低产品成本。

研发目标：大功率 LED 封装流程自动化作业；眼珠型 IRM 自动化生产线导入。

技术性突破：解决模具漏胶问题；解决模具堵胶问题；解决胶水粘模问题。

（3）SMT 白光数码管导入生产

随着人们对家电的要求越来越高，普通的红黄蓝绿数码管已经能不满足人们的需要，因此白光数码管应运而生。白光数码管基本是封装荧光粉和表贴 SMD 再封装，采用表贴 SMD 封装工艺生产，能有效提高白光数码管的品质。

研发目标：自动化表贴 SMD 生产线导入。

技术性突破点：解决导入点数较多，容易漏贴，造成死点的问题；解决丝印锡膏不均匀，过回流焊容易竖碑的问题；解决回流焊变温曲线掌握不好，容易死灯的问题。

（4）红外光电耦合器产品开发

红外光电耦合器广泛应用于开关电源等领域。但是市售产品基本是胶饼模顶封装，成本较高。采用环氧树脂封胶，能降低产品成本，便于产品的推广应用。

研发目标：自动化红外光电耦合器产品生产线导入。

技术性突破点：解决支架间距较密，封装模条不易批量生产的问题；实现分 BIN 设备自动上料。

（5）高密度大功率支架开发

市面用 1W 大功率支架间距大，颗粒少。精心设计了高密度新型支架，支架之间的间距小，效率高。

研发目标：成功设计高密度大功率支架，使其单位成本最低。

技术性突破：使支架间距合理最小化，提升支架生产率，减小封装上下料时间。

（6）高密度 45 连体 LED 支架开发

市面用 Lamp LED 支架间距大，颗粒少。设计高密度新型支架，支架间距小，效率高。

研发目标：合理设计高密度 Lamp LED 支架，有效降低单位成本。

技术性突破点：使支架间距合理最小化，提升支架生产率，减小封装上下料时间。

（7）高密度 SMD LED 支架开发

市面用 SMD LED 支架间距大，颗粒少。设计高密度新型支架，支架间距小，效率高。

研发目标：合理设计高密度 SMD LED 支架，有效降低单位成本。

技术性突破：使支架间距合理最小化，提升支架生产率，减小封装上下料时间。

6、项目实施进度

本项目建设期为 12 个月。

7、环保情况

本项目的技术研发、产品测试等过程不产生废气、废水，产生的少量固体废弃物为可回收利用的 LED 试验用样品，项目对环境不产生任何污染。

中山市环境保护局对本项目出具了审查批复意见，同意本项目建设。

8、项目财务评价

本项目作为本公司的研发中心，不进行单独财务评价。项目效益主要体现为

提升研发实力、提高小批量试制产品销售收入，降低研发费用成本。

七、募集资金运用对发行人未来财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投入后，将对本公司的生产经营和财务状况等多方面产生较大影响，具体表现如下：

1、募集资金到位后，公司净资产及每股净资产均将大幅提高，这将进一步壮大公司整体实力，提高竞争力，增强抗风险能力。

2、由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在项目未达产的短期内净资产收益率会因为财务摊薄而有一定程度的降低。从中长期来看，本次募集资金项目均具有较高的投资回报率，随着投资项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，公司盈利能力和盈利的稳定性将不断增强。

3、募集资金到位后，公司的资产负债率水平将大幅降低，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险。

4、本次发行募集资金到位后，公司投资项目所需资金基本得到解决，负债规模在一定时期内不会有大幅增长，公司的资本结构在一定时期内将以自有资金为主，借贷资金为辅。

第十四节　股利分配政策

一、基本政策

公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、近三年股利分配情况

为满足公司生产规模不断扩大的资金需求，公司近三年未进行股利分配。

三、本次发行完成前滚存利润的分配政策

经本公司 2010 年第三次临时股东大会决议通过，本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

四、本次发行上市后的现金分红政策

发行人在公司章程（草案）中明确如下利润分配政策：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

第十五节　其他重要事项

一、信息披露制度与投资者服务

为保护投资者合法权益，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》等有关法律的要求，本公司已制订了《信息披露制度》和较为完备的投资者服务计划。本公司负责信息披露和投资者关系管理的部门是公司董事会秘书处，联系方式如下：

1、联系人：赖爱梅

2、联系地址：中山市小榄镇木林森大道 1 号

3、邮政编码：528400

4、电话号码：0760-87803366

5、传真号码：0760-87803399

6、电子信箱：IR@ZSMLS.COM

二、重要合同

截止本招股说明书签署之日，本公司正在履行和将要履行的重大合同（单项金额超过 500 万元或者对发行人生产经营有重大影响的合同）有：

（一）借款合同

1、2010 年 3 月 29 日，发行人与广东发展银行股份有限公司中山分行签订编号为（2010）中银综授字第 138008013 号《综合授信额度合同》，该行同意向发行人提供授信额度 4,500 万元，授信期限自 2010 年 3 月 29 日至 2011 年 3 月 28 日。截至本招股书签署之日，该《综合授信额度合同》项下的借款余额为 2,500 万元。

2、2011 年 1 月 5 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤抵保借字（中山）第 201101050421 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 2,700 万元，用于支付货款，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限自 2011 年 1 月 5 日至 2012 年 1 月 5 日。

3、2011 年 1 月 5 日，发行人与工商银行股份有限公司中山孙文支行签订编

号为 2011 年 280A 字第 04401 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 2,000 万元，用于支付货款，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限一年。

4、2011 年 2 月 14 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤抵保借字（中山）第 201102140118 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 2,000 万元，用于支付货款，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限 12 个月。

5、2011 年 3 月 2 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤抵借字（中山）第 201103020105 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 2,000 万元，用于支付货款，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限 12 个月。

6、2011 年 3 月 30 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤抵借字（中山）第 201103300270 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 3,300 万元，用于支付货款，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限 12 个月。

7、2011 年 6 月 22 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤抵保借字（中山）第 201106220378 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 5,000 万元，用于支付货款，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限 12 个月。

8、2011 年 2 月 21 日，发行人与交通银行股份有限公司中山分行签订编号为中交银贷字第 0110083 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 2,000 万元，用于购买原材料，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限不超过 12 个月。

9、2011 年 3 月 30 日，发行人与交通银行股份有限公司中山分行签订编号为中交银贷字第 0110084 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 1,000 万元，用于购买原材料，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限不超过 12 个月。

10、2011 年 6 月 30 日，发行人与交通银行股份有限公司中山分行签订编号为中交银贷字第 0110350 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 3,500 万元，用于购买原材料，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款

期限不超过 12 个月。

11、2011 年 6 月 30 日，发行人与交通银行股份有限公司中山分行签订编号为中交银贷字第 0110349 号的《流动资金借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 1,500 万元，用于购买原材料，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限不超过 12 个月。

12、2010 年 11 月 1 日，发行人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订编号为 ED820010000850 号《综合授信协议》，该行同意向发行人提供授信额度 5,000 万元，授信期限自 2010 年 11 月 1 日至 2011 年 11 月 1 日。

13、2010 年 3 月 18 日，发行人与平安银行股份有限公司中山分行签订编号为平银（中山分行）授信字（2011）第（A1001901100007）号《综合授信额度合同》，该行同意向发行人提供授信额度 40,000 万元，授信期限为 36 个月。截至本招股书签署日，该《综合授信额度合同》项下的借款余额为 40,000 万元。

14、2011 年 3 月 25 日，发行人与平安银行股份有限公司中山分行签订编号为平银（中山分行）贷字（2011）第（B1001901100002）号的《借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 5,000 万元，用于补充企业流动资金，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限 12 个月。

15、2011 年 4 月 2 日，发行人与平安银行股份有限公司中山分行签订编号为平银（中山分行）贷字（2011）第（B1001901100003）号的《借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 15,000 万元，用于补充企业流动资金，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限 36 个月。

16、2011 年 4 月 13 日，发行人与平安银行股份有限公司中山分行签订编号为平银（中山分行）贷字（2011）第（B1001901100006）号的《借款合同》，该行同意向发行人提供贷款 20,000 万元，用于补充企业流动资金、购买原材料和配件，年利率以同期同档次国家基准利率为准，借款期限 12 个月。

17、2011 年 4 月 13 日，发行人与中国民生银行股份有限公司中山分行签订编号为公授信字第 99032011296227 号《综合授信合同》，该行同意向发行人提供授信额度 12,000 万元，授信期限自 2011 年 4 月 13 日至 2012 年 4 月 12 日。截至本招股书签署日，该《综合授信合同》项下的借款余额为 5,000 万元。

18、2011 年 4 月 15 日，发行人与中国民生银行股份有限公司中山分行签订编号为公借贷字第 99032011295894 号《流动资金贷款借款合同》，该行同意向发

行人提供贷款 5,000 万元，用于购买材料、支付工资、日常支出等，年利率为 6.941%，借款期限一年。

19、2011 年 3 月 16 日，吉安木林森与中国建设银行股份有限公司吉安支行签订编号为 XC 建赣庐贷 2011-009 的《人民币流动资金贷款合同》，该行同意向吉安木林森提供贷款 1,000 万元，用于日常生产经营周转，年利率以同期同档次国家基准利率为准上浮 15%，借款期限 12 个月。

20、2011 年 3 月 18 日，吉安木林森与中国建设银行股份有限公司吉安支行签订编号为 XC 建赣庐贷 2011-010 的《人民币流动资金贷款合同》，该行同意向吉安木林森提供贷款 1,000 万元，用于日常生产经营周转，年利率以同期同档次国家基准利率为准上浮 15%，借款期限 12 个月。

21、2011 年 3 月 30 日，吉安木林森与中国建设银行股份有限公司吉安支行签订编号为 XC 建赣庐贷 2011-015 的《人民币流动资金贷款合同》，该行同意向吉安木林森提供贷款 500 万元，用于日常生产经营周转，年利率以同期同档次国家基准利率为准上浮 15%，借款期限 12 个月。

（二）抵押、质押合同

1、2010 年 3 月 30 日，发行人与广东发展银行股份有限公司中山分行签署（2010）中银权质字第 138008013 号《权利质押合同》，发行人将其所有的编号为 00231052 的金额为 1,000 万元的银行定期存单质押给该行，为其与该行签订的（2010）中银综授字第 138008013 号《综合授信额度合同》项下所有债权提供担保。

2、2011 年 3 月 16 日，吉安木林森与中国建设银行股份有限公司吉安支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：XC 建赣庐高抵 2011－009），吉安木林森将其所有的吉高新国用（2006）第 I-015、I-015A、I-016A、I-016B、I-076 号等 5 项《国有土地使用权证》项下土地使用权、房权证吉市高第 A0078、A00107、A00092、A00147、A00099、A00108 号《房屋所有权证》项下房产及 40 台机器设备作为抵押，为其与该行签订的 XC 建赣庐贷 2011-009 的《人民币流动资金贷款合同》项下 1,000 万元、XC 建赣庐贷 2011-010 的《人民币流动资金贷款合同》项下 1,000 万元及 XC 建赣庐贷 2011-015 的《人民币流动资金贷款合同》项下 500 万元的债权提供担保。

3、2010 年 11 月 19 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤借抵字（中山）第 201011190347-1 号《最高额抵押合同》，发行人将其所拥有的 420 套/台机器设备作为抵押，为其与该行签订的兴银粤抵保借字（中山）第 201101050421 号的《流动资金借款合同》项下 2,700 万元、兴银粤抵保借字（中山）第 201102140118 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元、兴银粤抵借字（中山）第 201103020105 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元、兴银粤抵借字（中山）第 201103300270 号的《流动资金借款合同》项下 3,300 万元及兴银粤抵保借字（中山）第 201106220378 号的《流动资金借款合同》项下 5,000 万元的债权提供担保。

4、2011 年 1 月 13 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤借抵字（中山）第 201011190347-2 号《最高额抵押合同》，发行人将其所拥有的中府国用（2010）第 290177 号、中府国用（2010）第 290178 号、中府国用（2010）第 290179 号、中府国用（2010）第 290180 号《国有土地使用权证》项下土地使用权作为抵押，为其与该行签订的兴银粤抵保借字（中山）第 201101050421 号的《流动资金借款合同》项下 2,700 万元、兴银粤抵保借字（中山）第 201102140118 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元、兴银粤抵借字（中山）第 201103020105 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元、兴银粤抵借字（中山）第 201103300270 号的《流动资金借款合同》项下 3,300 万元及兴银粤抵保借字（中山）第 201106220378 号的《流动资金借款合同》项下 5,000 万元的债权提供担保。

5、2011 年 3 月 29 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤借抵字（中山）第 201011190347-3 号《最高额抵押合同》，发行人将其所拥有的 306 套/台机器设备作为抵押，为其与该行签订的兴银粤抵保借字（中山）第 201101050421 号的《流动资金借款合同》项下 2,700 万元、兴银粤抵保借字（中山）第 201102140118 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元、兴银粤抵借字（中山）第 201103020105 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元及兴银粤抵保借字（中山）第 201106220378 号的《流动资金借款合同》项下 5,000 万元的债权提供担保。

6、2011 年 6 月 21 日，发行人与兴业银行股份有限公司中山分行签订编号为兴银粤借抵字（中山）第 201011190347-4 号《最高额抵押合同》，发行人将其所

拥有的 658 套/台机器设备作为抵押，为其与该行签订的兴银粤抵保借字（中山）第 201101050421 号的《流动资金借款合同》项下 2,700 万元、兴银粤抵保借字（中山）第 201102140118 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元、兴银粤抵借字（中山）第 201103020105 号的《流动资金借款合同》项下 2,000 万元、兴银粤抵借字（中山）第 201103300270 号的《流动资金借款合同》项下 3,300 万元、兴银粤抵保借字（中山）第 201106220378 号的《流动资金借款合同》项下 5,000 万元的债权提供担保。

7、2010 年 10 月 30 日，发行人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订编号为 ZD82001000085001 号《动产最高额抵押合同》，发行人将其所拥有的 222 套/台机器设备作为抵押，为其与该行签订的 ED820010000850 号《综合授信协议》项下 5,000 万元综合授信额度的债权提供担保。

8、2011 年 3 月 18 日，发行人与平安银行股份有限公司中山分行签订编号为平银（中山分行）抵字（20110318）第（A100190110007）号《最高额抵押合同》，发行人将其所拥有的中山市小榄镇木林森大道 1 号土地、粤房地权证中府字第 0110013957 号房产、粤房地权证中府字第 011001454 号房产、粤房地权证中府字第 011001455 号房产作为抵押，为其与该行签订的平银（中山分行）授信字（2011）第（A1001901100007）号《综合授信额度合同》项下 40,000 万元综合授信额度的债权提供担保。

9、2011 年 6 月 14 日，发行人与交通银行股份有限公司中山分行签订编号为中交银抵字 2110071 号《最高额抵押合同》，发行人将其所拥有的中府国用（2011）第 0501166 号《国有土地使用权证》项下土地使用权作为抵押，为其与该行在 2011 年 2 月 21 日至 2018 年 2 月 21 日期间签订的借款合同提供最高额抵押担保。

（三）采购合同

1、2010 年 4 月 21 日，发行人与先进自动器材有限公司签订《买卖合同》，发行人向先进自动器材有限公司购买一批价值 2,675.70 万美元的机器设备，交货时间为 2012 年 2 月底前。

2、2010 年 9 月 9 日，发行人与先进自动器材有限公司签订共计 10 份《买卖合同》，发行人向先进自动器材有限公司购买一批价值 2,869.70 万美元的机器设备，交货时间分别为 2011 年 11 月底前、2011 年 12 月底前及 2012 年 6 月底前。

3、发行人与台湾晶元光电股份有限公司之子公司晶元宝晨光电（深圳）有限公司[1]签订《产品采购框架协议》，对发行人 2011 年度向晶元宝晨光电（深圳）有限公司预估采购的 LED 芯片数量、货款结算方式等作了约定。

4、发行人与台湾企业光磊科技股份有限公司签订《产品采购框架协议》，对发行人 2011 年度向光磊科技股份有限公司预估采购的 LED 芯片数量、货款结算方式等作了约定。

三、对外担保情况

截止本招股说明书签署之日，本公司不存在对外担保情况。

四、诉讼及仲裁事项

截止本招股说明书签署之日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，不存在公司主要股东、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有涉及刑事诉讼事项。

[1] 2009 年，(台湾)晶元光电股份有限公司对其在大陆地区的销售渠道进行整合，由子公司晶元宝晨光电（深圳）有限公司统一负责大陆地区 LED 芯片销售业务。

第十六节　董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

孙清焕　　林文彩　　郑明波

易亚男　　王钢　　罗元清

鄢国祥

全体监事：

李冠群　　刘天明　　林玉陕

其他高级管理人员：

赖爱梅　　周立宏

木林森股份有限公司（盖章）

2011年7月19日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：_____（签名）

彭欢

保荐代表人：_____（签名）

丰赋

_____（签名）

陈华

法定代表人：_____（签名）

杨宇翔

平安证券有限责任公司（盖章）

2011 年 7 月 19 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

赖继红

邹晓冬

律师事务所负责人：

张学兵

北京市中伦律师事务所

2011年 5月 19日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：（签字）

潘新华

（签字）

杨敢林

会计师事务所负责人：（签字）

姜　波

利安达会计师事务所有限责任公司（盖章）

2011年 7月 19日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

签字注册会计师：（签字）

潘新华

（签字）

荣雪梅

会计师事务所负责人：（签字）

姜　波

利安达会计师事务所有限责任公司（盖章）

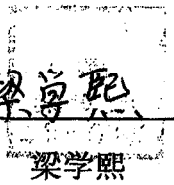
2011年 3月 19日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师： （签字）

周丽

 （签字）

梁学熙

评估机构负责人： （签字）

汤锦东

广东中广信资产评估有限公司（盖章）

2011年7月19日

第十七节　备查文件

一、本招股说明书的备查文件

1、发行保荐书及发行保荐工作报告；

2、财务报表及审计报告；

3、内部控制鉴证报告；

4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

5、法律意见书及律师工作报告；

6、公司章程（草案）；

7、中国证监会核准本次发行的文件；

8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

投资者可于本次发行承销期间，到本公司和保荐人（主承销商）的办公地点查阅。

三、查阅时间

除法定节假日以外的每日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。

四、查阅网址

深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn。